

科创板投资风险提示

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

无锡市好达电子股份有限公司

(无锡市滨湖经济技术开发区高运路 115 号)

 **SHOULDER**

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书

(申报稿)

本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）



(中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号)

联席主承销商



(深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦)

重要声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者声明

好达电子主要从事声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售，是国内极少数具备芯片设计、晶圆制造、封装测试于一体的全链条自主可控并规模化量产出货的 IDM 企业。凭借丰富的技术积累和突出的技术创新能力，好达电子作为项目负责单位或课题负责单位承担了 7 项国家级重点科研项目及 5 项省级重点科研项目，荣获了 2 次国家科学技术进步二等奖，积极推动我国声表面波射频滤波器领域的基础研究和国产化进程。

一、本次发行上市的目的

（一）加速我国声表面波射频滤波器的国产化进程

公司深耕声表面波滤波器技术研究和产品开发二十余年，是国内起步最早、生产规模最大、技术最先进的滤波器企业之一。公司多年批量供应下游各应用领域客户，产品得到客户的广泛认可，已成功打破了海外巨头长期以来在国内的垄断格局。公司计划通过本次发行上市，进一步加大资金投入和研发投入，加速提升公司的系列产品在国内外客户的市场份额，助力推动我国声表面波射频滤波器的国产化进程。

（二）保留和吸引行业顶尖人才，提高自主创新能力

在 5G/6G 通信、万物互联、智能汽车、商业航天、低空经济浪潮的推动下，声表面波射频滤波器已成为智能终端、物联网、汽车电子、基站、低轨卫星通信等应用领域不可或缺的核心元件。面对全球市场机遇与国产化替代的迫切需求，公司立志突破技术壁垒，实现从追赶者到引领者的跨越。公司的愿景是成为全场景射频滤波器解决方案的领先者，愿景的实现需要大量的顶尖人才的加盟及资源投入，通过本次上市，公司将进一步提升品牌影响力，吸引更多国内外顶尖科研和管理人才。未来，公司将持续将人、财、物资源投入到技术创新及产品创新中，攻克技术难题，引领行业发展，为产业链创造价值。

（三）提高核心竞争力，优化公司治理，回报投资者，为社会创造长期价值

公司通过上市将进一步优化公司治理结构，提升企业管理水平和透明度，进

一步提高企业的核心竞争力。本次上市也将为公司提供更多的融资渠道，支持未来的技术研发、人才引进和市场拓展，推动企业长期、可持续发展。公司希望通过资本市场这一平台，回报广大投资者的支持与认可，持续为社会创造长期价值。

二、现代企业制度的建立健全情况

公司自成立以来一直致力于现代企业制度的建立、完善和优化。公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，建立并完善了法人治理结构。公司已形成了规范、标准且健全的治理体系，符合法律、法规及中国证监会对上市公司治理的规范要求。为了切实维护股东权益，保持鼓励分配政策的持续性和稳定性，提高股东对公司经营和利润分配的监督，稳定投资者预期，公司制定了明确、清晰的上市盈利后股东分红回报规划。

三、本次融资的必要性及募集资金使用规划

公司本次募集资金主要投向“年产 6 亿颗 TC-SAW 及 4 亿颗 TF-SAW 滤波器生产线扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智能制造能力提升项目”及“补充流动资金”。募集资金投资项目均围绕主营业务开展，与公司经营战略方向一致，有利于提升公司综合实力。募投项目的实施有利于公司扩大生产规模、加强研发投入、提升智能制造能力和扩充资本实力，进一步巩固公司在国产滤波器领域的领先地位，并继续助力滤波器的国产化进程。

四、持续经营能力及未来规划

报告期内，公司营业收入分别为 41,851.74 万元、60,655.03 万元和 67,465.69 万元，2023 年至 2025 年复合增长率达 26.97%，经营业绩持续向好。公司高性能滤波器 TC-SAW 产品得到客户的广泛认可，TF-SAW 产品也实现了批量出货，公司高性能滤波器产品种类不断丰富，具备良好的持续经营能力。

未来，公司将继续深耕声表面波滤波器行业，全面提升技术研发实力，通过持续创新不断推动技术进步、优化产品结构、提升产品竞争力、继续提高声表面波滤波器国产化率，持续缩小与海外巨头的差距并最终实现对海外巨头的超越。

同时，公司将继续横向发展，同国内射频前端模组企业深度合作，助力实现射频前端模组的全国产化。公司未来还将进一步提升治理水平，不断完善内控监督体系，增强投资者回报能力。

实际控制人、董事长签名：

刘平

无锡市好达电子股份有限公司
2026年5月29日

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	本次发行不超过 2,565.4762 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占公司发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行不安排公司股东公开发售股份。
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所和板块	上海证券交易所科创板
发行后总股本	不超过 10,261.9047 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）
保荐人、主承销商	国联民生证券承销保荐有限公司
联席主承销商	国投证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

目 录

重要声明	1
致投资者声明	2
一、本次发行上市的目的	2
二、现代企业制度的建立健全情况	3
三、本次融资的必要性及募集资金使用规划	3
四、持续经营能力及未来规划	3
本次发行概况	5
目 录.....	6
第一节 释义	10
一、一般释义	10
二、专业术语	13
第二节 概览	17
一、重大事项提示	17
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况	20
三、本次发行概况	21
四、发行人主营业务经营情况	22
五、发行人符合科创板定位相关情况	24
六、发行人报告期主要财务数据和财务指标	25
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况	26
八、发行人选择的具体上市标准	26
九、公司治理特殊安排等重要事项	27
十、募集资金运用与未来发展规划	27
第三节 风险因素	28
一、与发行人相关的风险	28
二、与行业相关的风险	31
三、其他风险	32
第四节 发行人基本情况	34
一、公司基本信息	34

二、公司设立及报告期内股本和股东变化情况	34
三、公司成立以来重要事件	40
四、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况	40
五、公司股权结构	41
六、公司控股子公司、参股子公司基本情况	41
七、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况	43
八、发行人特别表决权股份情况	48
九、发行人协议控制架构情况	48
十、公司股本情况	48
十一、董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员	53
十二、本次申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排	64
十三、员工及其社会保障情况	70
第五节 业务与技术	72
一、发行人主营业务及主要产品的情况	72
二、发行人所处行业的基本情况	88
三、发行人销售情况和主要客户	122
四、发行人采购情况和主要供应商	127
五、发行人的主要固定资产和无形资产	129
六、发行人的核心技术与研发情况	137
七、发行人环境保护和安全生产情况	157
八、发行人的境外经营及境外资产情况	158
第六节 财务会计信息与管理层分析	159
一、发行人近三年财务报表	159
二、审计意见	163
三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况	165
四、重要会计政策和会计估计	165
五、非经常性损益	192
六、公司报告期内的纳税情况	192
七、分部信息	194
八、主要财务指标	194

九、经营成果分析	196
十、资产质量分析	228
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析	248
十二、重大资本性支出与资产业务重组事项	265
十三、期后事项、或有事项及其他重要事项	266
十四、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营情况	266
十五、盈利预测信息	266
十六、未来实现盈利的前瞻性信息	267
第七节 募集资金运用与未来发展规划	270
一、募集资金运用概况	270
二、公司战略规划与未来发展目标	275
第八节 公司治理与独立性	278
一、发行人内部控制情况	278
二、公司报告期内违法违规行及受到处罚情况	284
三、发行人资金占用和对外担保情况	286
四、公司直接面向市场独立持续经营的能力	286
五、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况	288
六、关联方、关联关系和关联交易	290
第九节 投资者保护	305
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排	305
二、发行后的股利分配政策	305
三、发行前后股利分配政策的差异情况	309
四、存在累计未弥补亏损情况的投资者保护措施	309
第十节 其他重要事项	310
一、重大合同	310
二、公司对外担保情况	319
三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项	319
四、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项	320

第十一节 声明	322
一、董事、审计委员会委员、高级管理人员声明	322
二、控股股东、实际控制人声明	329
三、保荐人（主承销商）声明	330
四、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明	331
五、联席主承销商声明	332
六、发行人律师声明	333
七、会计师事务所声明	334
八、资产评估机构声明	335
九、验资机构声明	337
第十二节 附件	338
一、备查文件	338
二、查询时间及地点	338
附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况	340
附件二：发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、高级管理人员及其他核心技术人员以及保荐人、证券服务机构作出的重要承诺及其履行情况和约束措施	342
附件三：股东会、董事会、历史监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况	367
附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明	370
附件五：募集资金投资项目具体情况	370

第一节 释义

在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

一、一般释义

发行人、公司、好达电子	指	无锡市好达电子股份有限公司
好达有限	指	无锡市好达电子有限公司
深圳分公司	指	无锡市好达电子股份有限公司深圳分公司
上海分公司	指	无锡市好达电子股份有限公司上海分公司
西安分公司	指	无锡市好达电子股份有限公司西安分公司
瑞驿通	指	无锡瑞驿通科技有限公司
思福易	指	无锡市思福易半导体设备有限公司
达波新材	指	苏州达波新材科技有限公司
凡麒微	指	上海凡麒微电子技术有限公司
好达投资	指	无锡市好达投资有限公司
舒达投资	指	上海舒达投资管理有限公司
采时科技	指	采时科技有限公司
宝和通讯	指	深圳市宝和通讯设备有限公司，原名为“深圳市戌月电子有限公司”
中和春生	指	苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）
共进同达	指	无锡市共进同达投资企业（有限合伙），原名为“无锡市好达投资管理企业（有限合伙）”
共进同达二号	指	无锡市共进同达二号投资合伙企业（有限合伙）
共进同达三号	指	无锡市共进同达三号投资合伙企业（有限合伙）
小米基金	指	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）
摩勤智能	指	上海摩勤智能技术有限公司
宽联投资	指	上海宽联投资有限公司
俱成秋实	指	南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）
哈勃投资	指	哈勃科技创业投资有限公司，原名为“哈勃科技投资有限公司”，于2021年11月名称变更为“哈勃科技创业投资有限公司”
杭州楚巽	指	杭州楚巽企业管理合伙企业（有限合伙），原名为“宁波梅山保税港区楚巽资产管理合伙企业（有限合伙）”，于2020年6月名称变更为“温州楚巽股权投资合伙企业（有限合伙）”，于2025年7月更名为“温州楚巽企业管理合伙企业（有限合伙）”，于2025年11月更名为“杭州楚巽企业管理合伙企业（有限合伙）”

苏民投君信	指	苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）
国投创业	指	国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）
枣庄拓海	指	枣庄拓海二号股权投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴君强	指	嘉兴君强投资合伙企业（有限合伙）
聚隆景润	指	深圳市聚隆景润科技有限公司
聚源铸芯	指	苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙）
金浦创拓	指	上海金浦创拓启元私募基金合伙企业（有限合伙），原名为上海金浦并购股权投资基金合伙企业（有限合伙），于2018年5月更名为“上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，于2025年11月更名为上海金浦创拓启元私募基金合伙企业（有限合伙）
嘉兴君俞	指	嘉兴君俞投资合伙企业（有限合伙）
宁波清容	指	宁波清容创业投资中心（有限合伙）
毓立投资	指	无锡毓立创业投资合伙企业（有限合伙）
温州毅巽	指	温州毅巽创业投资合伙企业（有限合伙），原名为“温州荣巽企业管理合伙企业（有限合伙）”，于2023年12月名称变更为“温州毅巽创业投资合伙企业（有限合伙）”
海南丰晟	指	海南丰晟企业管理合伙企业（有限合伙）
橙盛天际	指	无锡橙盛天际股权投资合伙企业（有限合伙）
追远财富	指	深圳追远财富投资合伙企业（有限合伙）
金程新高	指	无锡金程新高投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴科巽	指	嘉兴科巽股权投资合伙企业（有限合伙）
民生投资	指	民生证券投资有限公司
无锡市集成电路基金	指	无锡市集成电路产业基金（有限合伙）
小米	指	小米通讯技术有限公司及其关联公司
OPPO	指	OPPO 广东移动通信有限公司及其关联公司
vivo	指	维沃移动通信有限公司及其关联公司
华勤	指	华勤技术股份有限公司及其关联公司
龙旗	指	龙旗通信技术（香港）有限公司及其关联公司
中兴	指	深圳市中兴康讯电子有限公司
广和通	指	深圳市广和通无线股份有限公司
村田	指	株式会社村田制作所（Murata Manufacturing Co., Ltd.）
高通	指	美国高通公司（QUALCOMM Incorporated）
RF360	指	RF360 Holdings Singapore Pte. Ltd., 美国高通公司全资子公司
太阳诱电	指	日本太阳诱电株式会社（TAIYO YUDEN CO., LTD.）

思佳讯	指	美国思佳讯（Skyworks Solutions, Inc.）
威讯	指	美国威讯联合半导体（Qorvo, Inc.）
中电 26 所	指	中国电子科技集团公司第二十六研究所
德清华莹	指	中电科技德清华莹电子有限公司
麦捷科技	指	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
卓胜微	指	江苏卓胜微电子股份有限公司
威盛	指	韩国威盛（WISOL Co.,Ltd.）
东盛	指	无锡东盛净化科技有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
无锡工信局	指	无锡市工业和信息化局
无锡科技局	指	无锡市科学技术局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《无锡市好达电子股份有限公司章程》
公司章程（草案）	指	《无锡市好达电子股份有限公司章程（草案）》
主承销商、保荐人	指	国联民生证券承销保荐有限公司
申报会计师、中汇	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	北京德恒律师事务所
国联民生	指	国联民生证券股份有限公司
锡创投	指	无锡市创新投资集团有限公司
国联集团	指	无锡市国联发展（集团）有限公司
国发资本	指	无锡市国发资本运营有限公司
A 股	指	每股面值 1.00 元的人民币普通股
新股	指	公司本次首次公开发行时拟向社会公众发行的股份
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2023 年度、2024 年度及 2025 年度
报告期各期末	指	2023 年末、2024 年末及 2025 年末
Yole	指	Yole Développement Group，一家市场研究与战略咨询公司，专注于功率半导体与 MEMS 传感器等新兴科技领域。
WSTS	指	世界半导体贸易统计组织，主要为全世界半导体行业提供贸易出货量等行业数据统计及预测提供服务，系权威、可靠的全球级数据来源。
弗若斯特沙利文	指	Frost & Sullivan，简称“沙利文”，是一家全球知名的企业增长咨询公司，也是中国企业赴境外上市时最重要的第三方行业顾问。
中国半导体协会	指	是中国半导体产业最具权威性和影响力的全国性、行业性、非营利性社会组织

IDC	指	是一家全球性的科技市场研究与咨询机构，专注领域是信息技术和电信行业。
TrendForce	指	是一家全球高科技产业市场研究及顾问咨询机构。
IoT Analytic	指	是一家专注于物联网（IoT）及相关前沿技术的市场研究与战略咨询的机构。
Techno Systems Research	指	是一家精品市场研究机构，专注于电子、半导体、存储设备及汽车等领域的技术市场分析与预测。
Fortune Business Insights	指	是一家全球市场研究咨询公司，为能源、医疗、ICT 等多个行业提供数据分析和战略建议。
Precedence Research	指	是一家全球性的市场研究与咨询公司，专注于为医疗保健、技术、制造、能源和消费品等多个行业提供数据驱动的洞察、深入的市场分析和定制化研究解决方案。

二、专业术语

声表面波	指	在弹性体自由表面产生并沿着表面或界面传播的各种模式的波。
射频	指	表示可以辐射到空间的电磁频率，频率范围从300kHz-300GHz之间。
声表面波射频芯片	指	利用压电效应和表面波传播的物理特性所制成的射频芯片，包括声表面波滤波器、声表面波双工器和声表面波谐振器等。
压电效应	指	电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时，其内部会产生极化现象，同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷的物理现象。
滤波器	指	能够对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电子元件或芯片，通过将信号中特定波段频率滤除，可以得到一个特定频率的信号，或消除一个特定频率的信号。
双工器	指	由两颗滤波器组成，用于将发射和接收信号隔离，保证信号接收和发射在共用天线时的正常工作。
多工器	指	集成大于等于三个发射或接收通道，并共用一个副天线的滤波器，多用于FDD模式。
谐振器	指	产生谐振频率的电子元件或芯片，主要起频率控制的作用。
Rx 滤波器	指	接收滤波器，是位于无线通信设备接收链路前端的滤波器。
Tx 滤波器	指	发射滤波器，是位于无线通信设备发射链路前端的滤波器。
TRx 滤波器	指	收发共用滤波器，是在一个滤波器组件内同时服务于设备的发射和接收通道。它是现代无线通信系统，尤其是TDD系统中不可或缺的核心部件。
多滤波器（SAW Bank）	指	指在一个系统或单个器件中，集成了多个滤波器功能单元的设计、架构或技术。
体声波滤波器（BAW）	指	BAW 滤波器是指基于压电效应的射频前端核心器件，其工作原理是将电磁波信号首先转换为机械能形式的体声波信号，利用声波在固体内部的传播特性进行滤波，再将声波信号转换回电磁波信号
介质滤波器	指	是一种利用高介电常数介质材料（如陶瓷）制成、通过介质谐振器对信号进行选频滤波的无源射频器件
LC 滤波器	指	指由电感（L）和电容（C）两种无源元件构成的滤波网络，

		利用电感和电容在不同频率下的阻抗特性实现对信号频率的选择性通过或抑制
射频开关	指	实现射频信号接收与发射的切换、不同频段间的切换的射频芯片。
压电材料	指	能够将机械能和电能相互转换的功能材料，具有压电效应（即受外力作用时产生电荷，或在外电场作用下产生机械变形）。声表面波滤波器常用的压电材料包括铌酸锂(LiNbO ₃)、钽酸锂(LiTaO ₃)、石英(SiO ₂)等单晶压电材料。
TDD	指	在 TDD 系统中，通信的发送和接收是通过时间划分的。在某一时刻一个方向上只能发送，另一个方向只能接收。时间被分成多个时隙，每个时隙用来发送或接收。
FDD	指	在 FDD 系统中，通信双方通过不同的频率进行数据的发送和接收，即发送和接收各使用一个独立的频率通道，
LNA	指	低噪声放大器（Low Noise Amplifier），实现接收通道的射频信号放大的射频芯片。
PA	指	功率放大器（Power Amplifier），实现发射通道的射频信号放大的射频芯片。
IDT	指	叉指换能器（Interdigital Transducer），压电基片上交叉排列的金属电极，分为输入和输出换能器。
CSP	指	芯片级封装（Chip Scale Package），封装尺寸和芯片核心尺寸基本相同的封装技术。
WLP	指	晶圆级封装（Wafer Level Packaging），在晶圆上封装芯片，而不是先将晶圆切割成单个芯片后再进行封装。
SMD	指	表面贴装器件（Surface Mounted Devices）或一种表面贴片的封装形式。
Bare-Die	指	裸芯片或裸片，是指从晶圆上划片后，独立出来的、具备完整功能的微小芯片本体，但没有外部保护壳体、引线框架和引脚等任何封装结构。
IDM	指	垂直整合制造（Integrated Design and Manufacture），该模式下芯片设计、制造、封装测试等环节由同一家企业完成。
ODM	指	原始设计制造（Original Design Manufacturer），该模式下由采购方委托制造方提供从研发、设计到生产的全部服务，产品以采购方的品牌进行销售。
Fabless	指	无晶圆厂芯片设计企业，指企业只从事集成电路研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成。
Fab-lite	指	介于 Fabless 模式与 IDM 模式之间的集成电路企业经营模式，即在晶圆制造、封装及测试环节均采用自行建厂和委外加工相结合的方式。
SAW	指	采用常规体压电材料（如钽酸锂、铌酸锂）和工艺制备的滤波器。
TC-SAW	指	温度补偿型声表面波滤波器，在常规 SAW 的结构中引入特殊的温度补偿层（如二氧化硅），通过补偿层的负温度系数抵消压电材料的正温度系数，从而降低温漂，具有频率稳定性高的特点。
TF-SAW	指	又称“iHP-SAW”，基于 POI（单晶压电薄膜材料，Piezoelectric-on-Insulator）衬底材料制备的声表面波滤波器，具有高 Q 值、低温漂、高频工作能力强等特点。
POI	指	即单晶压电薄膜材料，由亚微米级单晶压电薄膜（如钽酸锂、铌酸锂）、介质过渡层（如二氧化硅）以及高声速支承

		衬底（如硅、碳化硅等）通过异质集成技术复合而成的衬底材料，系制备 TF-SAW 和 XBAR 滤波器的核心关键材料。
XBAR	指	采用单晶压电薄膜（如铌酸锂、钽酸锂）和叉指电极结构，通过横向电场激发体声波的谐振器技术
DUV	指	DUV 是 Deep Ultraviolet 的缩写，中文译为深紫外线或深紫外。它是一个描述电磁波谱中特定波段的光学术语，指波长介于短波紫外线和真空紫外线之间的紫外线，其典型波长范围约为 100 纳米到 300 纳米。
PVD	指	物理气相沉积，它是一种在真空环境下，利用物理方法将固体或液体材料源（称为“靶材”）气化成原子、分子或离子态，使其在工件（基片）表面沉积，从而形成一层具有特定功能的薄膜的工业制造技术。
L-PAMiD	指	指集成功率放大器（PA）、低噪声放大器（LNA）、射频开关、滤波器、双工器/多工器及耦合器等多种功能器件的超高集成度 5G 射频前端收发模组。
FEM	指	是指集成功率放大（PA）、低噪声放大（LNA）、滤波（Filter）和射频开关（Switch）等射频前端模组。
EDA	指	是指用于辅助完成集成电路设计、制造、封装、测试整个流程的计算机软件。
CP 测试	指	是指在晶圆制造完成后、划片封装之前，使用精密探针卡直接接触晶圆上每颗裸芯片的焊垫，对其电性能参数和基础功能进行测试的过程。
FT 测试	指	指芯片完成封装后，在最终出厂前对成品芯片进行全面的电性能测试和功能验证的过程。
Sub 6GHz	指	6GHz 频率以下的通信频段。
N77/N78/N79	指	N77、N78、N79 频率范围分别为 3.3GHz~4.2GHz、3.3GHz~3.8GHz、4.4GHz~5.0GHz。
载波	指	被调制以传输信号的波形，一般为正弦波。
基板	指	为集成电路载体，其内部线路用以连接晶片与印刷电路板（PCB）之间的讯号，主要为保护电路、固定线路并导散余热，为封装制程中的关键零件。
晶片	指	钽酸锂、铌酸锂和石英等压电材料制成的圆片。
光掩膜	指	光掩模版、掩模版，英文称 Mask，是在晶圆上制作电路所使用的模具，光罩与晶圆上的电路的关系，类似于底片和相片的关系。
物联网	指	IoT（the Internet of Things），互联网基础上的延伸和扩展的网络，将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点人、机、物的互联互通。
车联网	指	依托信息通信技术，通过车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位连接和数据交互，提供综合信息服务，形成汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态。
小基站	指	体积、容量较小的基站，与宏基站相对应，主要作用是热点地区扩容（补热），或者在无信号覆盖区域增加覆盖（补盲）。
宏基站	指	体积、容量较大的基站，与小基站相对应，适用于郊区话务量比较分散的地区，全向覆盖，功率较大。
低轨卫星通信	指	是部署在距地面约 500-2,000 公里轨道高度的卫星星座所构

		建的全球通信网络。
带外抑制	指	带外抑制（Attenuation）是衡量滤波器选择性能的指标，数值越高表示对干扰信号抑制程度越好。
插入损耗	指	插入损耗（Insertion Loss, IL）数值越低说明频段内需保留的信号衰减越小，滤波器性能越好。
隔离度	指	隔离度（ISO）是衡量双工器中发射端与接收端用滤波器之间的信号隔离能力的指标，数值越高表示两颗滤波器之间的信号干扰程度越小。
功率	指	功率（Power）是衡量发射端用滤波器最高耐受功率的指标，数值越高表示能够耐受的功率越高；
Q 值	指	声学谐振元件（或电路）在谐振频率附近储存能量与每周期损耗能量之比的度量参数。
温漂	指	指滤波器等电子器件的中心频率或关键性能参数随环境温度变化而发生漂移的现象。
PC1	指	是指由 3GPP（第三代合作伙伴计划）制定、专门针对固定无线接入（FWA）、车载应用及公共安全等高功率传输场景的功率等级标准
PAD	指	指芯片输入/输出接口处用于连接外部电路的金属层区域，是实现芯片与外部电路电气互连的关键结构。
凸点	指	是指在声表面波滤波器芯片输入/输出（I/O）焊盘上形成的微小金属凸起结构，是实现倒装芯片（Flip Chip）封装互连的核心技术，以“以点代线”的方式替代传统引线键合。公司采用的凸点材料分别有金、锡两种，简称金凸点、锡凸点
UBM	指	是指位于芯片输入/输出（I/O）焊盘与上方凸点（Bump）之间的多层金属薄膜结构，是实现倒装芯片（Flip Chip）先进封装的关键过渡层。

本招股说明书中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

本招股说明书所引用的有关行业的统计及其他信息，均来自不同的公开刊物、研究报告及行业专业机构提供的信息，但由于引用不同来源的统计信息及其他信息可能与其口径有一定的差异，故相关信息并非完全具有可比性。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”章节的全部内容。

（一）特别风险提示

1、持续亏损和存在累计未弥补亏损的风险

2023年至2025年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为-21,611.87万元、-7,975.47万元和-335.42万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-23,085.86万元、-7,705.28万元和-840.65万元。近年来，随着公司产能的不断扩张、产品结构优化、声表面波射频滤波器国产替代以及公司实力不断的提升，公司营业收入分别为41,851.74万元、60,655.03万元和67,465.69万元，复合增长率为26.97%，2025年亏损额亦较前期大幅收窄。但是，考虑到市场景气度、行业竞争、客户拓展、供应链管理等因素较为复杂，发行人的营业收入可能无法持续增长，存在未来一段时期内持续亏损的风险。

截至2025年12月31日，公司累计未分配利润为-45,818.52万元，预计首次公开发行股票并上市后，发行人账面累计未弥补亏损将持续存在，导致一定时期内无法向股东进行现金分红。

2、下游市场需求波动风险

公司产品主要应用于智能终端、物联网、汽车电子、基站、低轨卫星通信等领域，其市场需求与宏观经济发展、居民消费能力及通信技术迭代周期高度相关。若全球宏观经济出现不确定性波动、消费电子市场景气度发生周期性下行，或5G等下游通信网络建设进度不及预期，均可能导致客户订单减少或产品导入延迟，进而引发公司产能利用率下降、库存积压及存货减值等连锁反应，对公司营

业收入及盈利水平的稳定性构成不利影响。

3、存货跌价的风险

报告期各期末，公司存货余额分别为 40,454.74 万元、36,616.50 万元和 41,079.72 万元，存货跌价准备余额分别 19,464.12 万元、19,048.89 万元和 18,002.86 万元。报告期各期，公司存货跌价损失分别为-9,433.49 万元、-5,358.05 万元和-3,374.42 万元。2023 年以来，随着公司产品毛利率水平提升和公司库存管理水平加强，存货跌价损失有所收窄，但公司的账面存货余额仍然较高，存在一定的跌价风险。未来，若公司下游客户需求、市场竞争格局发生变化，或者公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理导致存货无法顺利实现销售或按合理的价格实现销售，则将存在存货大量增加且存货跌价准备金额进一步扩大的风险。

4、毛利率波动的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为-3.38%、20.63%和 26.98%。公司产品销售单价受市场供求关系、同行业厂商市场竞争策略、产品及技术的先进性、产品更新迭代、终端客户议价能力、过往销售价格以及公司的战略布局等因素的共同影响；产品单位成本亦受原材料以及产业链供需关系等因素影响，均存在一定的不确定性。

随着行业技术的发展和市场竞争的加剧，公司必须根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新，若公司未能正确判断下游需求变化或者公司技术实力未跟上市场需求变化，未能根据市场需求及时更新现有产品或推出符合市场趋势的新产品，或者因公司产品市场竞争格局发生变化、抢占市场份额导致销售价格持续下降，或者未来原材料供给紧张导致采购价格上涨，产能利用率不足，公司不能有效控制产品成本，均可能导致公司毛利率水平波动甚至下降，对公司盈利能力产生不利影响。

5、市场竞争加剧风险

声表面波滤波器行业市场竞争较为激烈。全球市场主要由村田、高通（RF360）、太阳诱电等多家综合实力雄厚的日美企业主导，其凭借深厚的专利积累、领先的技术储备及稳固的客户关系占据全球市场主要份额。与此同时，国

内产业政策支持也推动了本土企业的快速发展，行业产能持续扩张，市场竞争进一步加剧。若公司未来无法在技术迭代、产品性价比及客户服务响应等方面持续保持竞争力，将面临市场份额下滑、产品毛利率被压缩的风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

6、知识产权诉讼风险

声表面波射频芯片产业具有显著的技术密集型特征，设计技术与制造工艺难度较高。公司通过长期的研发投入，已形成包括芯片设计技术、制造、封测工艺及材料在内的多项核心技术。由于全球市场竞争激烈，行业内领先厂商常将知识产权诉讼作为维持其技术优势、限制竞争对手的商业策略。公司虽已针对核心技术采取了申请知识产权、建立保密体系等保护措施，但仍无法完全规避未来可能遭遇第三方提起的知识产权侵权主张或诉讼的风险。若发生此类纠纷，公司可能需要承担应诉成本、赔偿费用，或面临相关技术及产品的使用限制，进而对公司的研发创新、业务开展及经营业绩造成不利影响。

7、新产品研发失败风险

公司声表面波射频芯片研发过程涉及架构设计、精密工艺与系统应用的深度耦合，具有高度复杂性与不确定性。在新产品从架构设计、关键材料选型到流片试制的全流程中，任一环节的偏差均可能在后续工艺中放大，导致样品在插入损耗、温度稳定性或功率容量等核心指标上无法满足客户严苛的规格要求。同时，即便产品技术性能达标，若无法在量产成本与良率之间实现有效平衡，或产品定义未能精准契合终端应用的系统兼容性 & 客户产品迭代的时间窗口，均可能导致研发项目未能实现预期的产业化目标。若发生研发失败或产业化不及预期的情况，公司前期投入的大量研发成本将面临损失，并可能因错过关键市场窗口而导致技术竞争力下降，对公司品牌声誉及未来业务增长构成不利影响。

（二）本次发行相关主体作出的重要承诺

本公司提示投资者认真阅读公司及相关责任方已按照中国证监会及上海证券交易所等监管机构的要求出具的相关承诺，具体包括关于自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺、相关股东持股意向及减持意向的承诺、稳定股价及股份回购的

承诺、欺诈发行上市的股份购回的承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、依法承担赔偿责任的承诺、未履行承诺事项时采取的约束措施等。上述承诺事项参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二 发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、高级管理人员及其他核心技术人员以及保荐人、证券服务机构作出的重要承诺及其履行情况和约束措施”。

（三）本次发行前滚存利润分配方案及本次发行后股利分配政策

本次发行前滚存利润分配方案及本次发行后股利分配政策具体内容参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“一、本次发行完成前滚存利润的分配安排”、“二、发行后的股利分配政策”及“三、发行前后股利分配政策的差异情况”。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况			
中文名称	无锡市好达电子股份有限公司	有限公司成立日期	1999年6月14日
英文名称	Shoulder Electronics Co., Ltd.	股份公司成立日期	2020年6月8日
注册资本	7,696.4285 万元	法定代表人	刘平
控股股东	好达投资	实际控制人	刘平
注册地址	无锡市滨湖经济技术开发区高运路 115 号	主要生产经营地址	无锡市滨湖经济技术开发区高运路 115 号
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
（二）本次发行的有关中介机构			
保荐人	国联民生证券承销保荐有限公司	主承销商	国联民生证券承销保荐有限公司
发行人律师	北京德恒律师事务所	联席主承销商	国投证券股份有限公司
审计机构	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	评估机构	上海东洲资产评估有限公司
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系		保荐人关联方民生投资持有发行人 0.6961% 的股份，无锡市集成电路基金持有发行人 0.2320% 的股份，金程新高持有发行人 0.2320% 的股份，合计持有发行人 1.1601% 的股份。 联席主承销商国投证券股份有限公司的关联方国投创业持有发行人 0.6961% 的股份。	
（三）本次发行其他有关机构			

股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	收款银行	【】
其他与本次发行有关的机构		无	

三、本次发行概况

(一) 本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不超过 2,565.4762 万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量）	占发行后总股本比例	不低于发行后公司总股本的 25%
其中：发行新股数量	不超过 2,565.4762 万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量）	占发行后总股本比例	不低于发行后公司总股本的 25%
股东公开发售股份数量	本次发行不涉及股东公开发售股份	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	不超过 10,261.9047 万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量）		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】		
发行前每股净资产	【】元	发行前每股收益	【】元
发行后每股净资产	【】元	发行后每股收益	【】元
发行市净率	【】倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
预测净利润（如有）	不适用		
发行方式	本次发行采用网下向询价对象配售、向战略投资者配售（如有）和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或采用证监会和上交所规定的其他发行方式。		
发行对象	符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	年产 6 亿颗 TC-SAW 及 4 亿颗 TF-SAW 滤波器生产线扩建项目		
	研发中心建设项目		
	智能制造能力提升项目		
	补充流动资金		
发行费用概算	本次新股发行费用总额为【】万元，其中： 1、承销保荐费【】万元； 2、审计、验资费【】万元；		

	3、律师费【】万元； 4、与本次发行相关的信息披露费【】万元； 5、发行手续费及其他费用【】万元；
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	若公司决定实施高级管理人员及员工战略配售，则在本次公开发行股票注册后发行前，履行内部程序审议该事项的具体方案，并依法进行披露
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐人将安排依法设立的另类投资子公司或实际控制保荐人的证券公司依法设立的另类投资子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐人及相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	不适用
(二) 本次发行上市的重要日期	
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

四、发行人主营业务经营情况

(一) 主营业务概况

公司主要从事声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售，是国内极少数具备芯片设计、晶圆制造、封装测试于一体的全链条自主可控并规模化量产出货的 IDM 企业，主要产品包括滤波器、双工器、谐振器等。公司构建了以 SAW、TC-SAW 及 TF-SAW 为核心的技术平台，拥有领先的滤波器晶圆制造产线及 SMD、CSP、WLP、Bare-Die 等封装产线，形成了涵盖低频、中频、高频的完整产品体系，实现了 300MHz 到 6GHz 关键频段的全面覆盖，是国内声表面波滤波器龙头企业。

公司历经二十余年深耕，成为突破国外技术垄断、保障产业链安全和实现国产替代的中坚力量。在国内，公司率先实现技术难度、工艺一致性及温漂控制要求更高的 TC-SAW 产品量产出货，率先实现高集成度收发模组用晶圆级封装（WLP）滤波器的量产出货，确立了国内声表面波滤波器领域的领先地位。公司已建成年产能达 60 亿颗的规模化交付体系，报告期内产品出货量近 100 亿颗，

其中，WLP 滤波器出货量超 1.5 亿颗，TC-SAW 产品的出货量超 14.5 亿颗，均位居国内前列。

公司自成立以来，持续加大研发投入和技术创新，在声表面波滤波器技术关键领域实现全面的技术布局。在芯片设计方面，独立自主开发系列仿真软件和 EDA 开发平台，实现了全系列产品高精度设计；在芯片制造方面，率先突破了高质量 SiO₂ 温度补偿薄膜的沉积工艺和修频难题，实现了温度漂移系数的降低以及 Q 值的提升，完成了更高工艺复杂度和技术难度的 TC-SAW 滤波器制造工艺开发，实现了规模化量产；在封装测试环节，2012 年国内首条金凸点 CSP 声表面波滤波器封装产线量产出货，2020 年国内首条效率更高的锡凸点 CSP 声表面波滤波器封装产线量产出货，2020 年国内首条 WLP 声表面滤波器封装产线量产出货；公司致力于 POI 材料的研究，针对常规 POI 材料无法满足的应用场景，通过自主设计、自主制备新型 POI 材料，满足了客户的高性能超宽带和窄带滤波器等需求；在创新方面，长期专注于声表面波基础研究和前沿技术研究，作为国家滤波器领域科技攻关的核心单位，牵头承担或参与实施了 7 项国家级和 5 项省级重点科研项目，先后 2 次荣获国家科技进步二等奖以及多项省、部级奖项。

基于长期的技术积淀与完整的声表面波滤波器产品矩阵，公司精准把握下游终端客户的多样化需求，自成立以来持续突破市场壁垒，核心产品成功导入多个关键领域的头部客户供应链。凭借优异的产品性能与稳定的大规模交付能力，公司赢得了客户的广泛信赖，已成长为国内声表面波滤波器领域的头部供应商之一。公司客户覆盖智能终端、物联网、汽车电子、基站、低轨卫星通信等多个应用领域。其中智能终端领域客户包括 OPPO、vivo、小米、三星、中兴、荣耀、传音、联想等一线知名手机品牌，以及华勤、龙旗、天珑、闻泰、立讯等头部 ODM 厂商；物联网领域客户包括移远通信、广和通、中移物联、利尔达、美格智能等领先物联网模组企业；汽车电子领域终端客户包括比亚迪、小米、赛力斯等主流汽车品牌；基站领域客户包括中兴、罗森博格、京信等优质通信设备厂商；低轨卫星通信领域客户包括中兴、大唐等知名企业。2020 年公司率先向全球知名手机终端厂商提供技术先进的 WLP 滤波器，2023 年该全球知名手机终端厂商成为当年公司第一大客户。

（二）主要经营模式

公司主要从事声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售，是国内极少数具备芯片设计、晶圆制造、封装测试于一体的全链条自主可控并规模化量产出货的 IDM 企业，主要产品包括滤波器、双工器、谐振器等。公司采用 IDM 模式。

（三）主要原材料及重要供应商

公司采购的原材料主要包括晶片、基板、基座、光刻胶、合金线、环氧树脂、光掩膜等。报告期内，公司的主要供应商包括天通股份、美维电子、厦门佳达微、康强电子、盐城振弘等。

（四）销售模式及重要客户

公司采用直销和经销相结合的销售模式。报告期内，公司客户覆盖智能终端、物联网、汽车电子、基站、低轨卫星通信等多个应用领域。其中智能终端领域客户包括 OPPO、vivo、小米、三星、中兴、荣耀、传音、联想等一线知名手机品牌，以及华勤、龙旗、天珑、闻泰、立讯等头部 ODM 厂商；物联网领域客户包括移远通信、广和通、中移物联、利尔达、美格智能等领先物联网模组企业；汽车电子领域终端客户包括比亚迪、小米、赛力斯等主流汽车品牌；基站领域客户包括中兴、罗森博格、京信等优质通信设备厂商；低轨卫星通信领域客户包括中兴、大唐等知名企业。

五、发行人符合科创板定位相关情况

（一）发行人符合科创板行业领域的规定

公司所属行业领域	<input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术	<p>公司主营业务是声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，公司所处行业为“二十八、信息产业”之“5. 新型电子元器件制造”，属于鼓励类行业。</p> <p>根据《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司所处行业属于“1.新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”；根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报</p>
	<input type="checkbox"/> 高端装备	
	<input type="checkbox"/> 新材料	
	<input type="checkbox"/> 新能源	
	<input type="checkbox"/> 节能环保	
	<input type="checkbox"/> 生物医药	
	<input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域	

	及推荐暂行规定（2024年4月修订）》，公司的行业领域属于“新一代信息技术领域”中的“半导体和集成电路”领域，符合科创板行业领域的要求。
--	--

（二）发行人符合科创属性要求的规定

发行人符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2024年4月修订）第六条规定的科创属性指标要求，具体情况如下：

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例≥5%，或最近3年累计研发投入金额≥8000万元	✓是 □否	公司2023年、2024年及2025年累计研发投入为16,649.26万元，占累计营业收入比例为9.80%，最近3年累计研发投入占累计营业收入的比例超过5%，且超过8,000万元。
研发人员占当年员工总数的比例≥10%	✓是 □否	截至2025年12月31日，公司研发人员人数为90人，占公司员工总数比例为15.03%，研发人员占当年员工总数比例超过10%。
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利≥7项	✓是 □否	截至2025年12月31日，公司拥有应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利共计31项。
最近3年营业收入复合增长率≥25%，或最近一年营业收入金额≥3亿元	✓是 □否	公司2025年营业收入6.75亿元，超过3亿元；最近三年营业收入复合增长率26.97%，超过25%。

同时，公司也符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第七条规定的科技创新能力突出的情形：

科创属性评价标准二	是否符合	指标情况
作为主要参与单位或者核心技术人员作为主要参与人员，获得国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖，并将相关技术运用于主营业务	✓是 □否	公司作为主要参与单位或者核心技术人员作为主要参与人员，累计获得国家科学技术进步奖2次

六、发行人报告期主要财务数据和财务指标

项目	2025年12月31日/2025年度	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
资产总额（万元）	157,670.98	153,777.59	158,508.42
归属于母公司所有者权益（万元）	17,814.65	13,257.09	19,673.25
资产负债率（合并）	88.70%	91.38%	87.59%
资产负债率（母公司）	88.30%	91.08%	87.33%

营业收入（万元）	67,465.69	60,655.03	41,851.74
净利润（万元）	-335.42	-7,975.47	-21,704.63
归属于母公司所有者的净利润（万元）	-335.42	-7,975.47	-21,611.87
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	-840.65	-7,705.28	-23,085.86
基本每股收益（元）	-0.04	-1.05	-2.83
稀释每股收益（元）	-0.04	-1.05	-2.83
加权平均净资产收益率	-2.07%	-48.44%	-77.43%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	33,054.07	24,579.21	8,951.17
现金分红（万元）	-	-	-
研发投入占营业收入的比例	8.47%	9.78%	11.95%

七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日期间，公司经营状况良好，生产经营模式、采购及销售情况、行业政策、税收政策均未发生重大变化，公司管理层及核心技术人员均保持稳定，未出现对公司管理及研发能力产生重大不利影响的事项。

八、发行人选择的具体上市标准

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》，公司拟选取科创板第四套指标作为申报标准：“预计市值不低于 30 亿元，最近一年营业收入不低于 3 亿元。”具体分析如下：

（一）发行人营业收入符合上市标准（四）

发行人 2025 年全年营业收入 6.75 亿元，2025 年营业收入符合上市标准（四）中关于收入规模的要求。

（二）发行人预计市值符合上市标准（四）

发行人于 2025 年 4 月完成最后一轮外部融资。截至目前，发行人所处行业的发展趋势、长期供求关系、竞争格局并未发生重大变化，发行人业务的稳定性和可持续性未发生重大不利变化。因此，本次估值可参考发行人 2025 年 4 月外

部融资价格，即投后估值 43.10 亿元。基于公司业绩情况，并结合报告期内的外部股权融资情况、可比上市公司市值情况，公司预计市值不低于 30 亿元，符合上述标准。

九、公司治理特殊安排等重要事项

发行人不存在公司治理特殊安排事项。

十、募集资金运用与未来发展规划

经公司第二届董事会第二十次会议及 2025 年第七次临时股东会批准，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，投资项目及投入金额具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	年产 6 亿颗 TC-SAW 及 4 亿颗 TF-SAW 滤波器生产线扩建项目	51,893.41	51,893.41
2	研发中心建设项目	43,355.95	43,355.95
3	智能制造能力提升项目	8,326.06	8,326.06
4	补充流动资金	80,000.00	80,000.00
	合计	183,575.42	183,575.42

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额及项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

若实际募集资金净额超过上述项目拟投入金额的，超过部分将根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定的要求进行管理和使用。

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。

第三节 风险因素

一、与发行人相关的风险

（一）技术风险

1、技术迭代风险

公司所处的声表面波滤波器行业技术迭代迅速，主要源于下游智能终端、物联网、汽车电子、基站等应用领域对射频器件在高频化、微型化、集成化及高性能等方面的持续升级需求。如果公司未来对行业发展趋势的判断出现偏差，或在研发投入、技术路线选择等方面未能及时适应市场变化，将可能导致新产品开发滞后、现有技术被替代的风险。这不仅会使公司丧失市场份额、面临产品降价压力，甚至可能使其被主流供应链体系排除在外，进而对公司的核心竞争力与持续经营能力造成重大不利影响。

2、新产品研发失败风险

公司声表面波射频芯片研发过程涉及架构设计、精密工艺与系统应用的深度耦合，具有高度复杂性与不确定性。在新产品从架构设计、关键材料选型到流片试制的全流程中，任一环节的偏差均可能在后续工艺中放大，导致样品在插入损耗、温度稳定性或功率容量等核心指标上无法满足客户严苛的规格要求。同时，即便产品技术性能达标，若无法在量产成本与良率之间实现有效平衡，或产品定义未能精准契合终端应用的系统兼容性，及客户产品迭代的时间窗口，均可能导致研发项目未能实现预期的产业化目标。若发生研发失败或产业化不及预期的情况，公司前期投入的大量研发成本将面临损失，并可能因错过关键市场窗口而导致技术竞争力下降，对公司品牌声誉及未来业务增长构成不利影响。

3、核心技术泄露风险

公司的技术竞争力主要来源于其专有的声表面波滤波器设计、核心工艺及制造诀窍。若未来出现核心人才流失、现有保密体系无法有效覆盖或遭受第三方恶意侵权等情况，导致上述商业秘密或未专利化技术发生泄露，将直接削弱公司的技术壁垒。竞争对手可借此快速推出同质产品，不仅侵蚀公司市场份额与定价能

力,还可能动摇公司与关键客户之间建立的长期信任关系,从而对公司的持续经营能力构成重大不利影响。

(二) 财务风险

1、毛利率波动的风险

报告期内,公司主营业务毛利率分别为-3.38%、20.63%和 26.98%。公司产品销售单价受市场供求关系、同行业厂商市场竞争策略、产品及技术的先进性、产品更新迭代、终端客户议价能力、过往销售价格以及公司的战略布局等因素的共同影响;产品单位成本亦受原材料以及产业链供需关系等因素影响,均存在一定的不确定性。

随着行业技术的发展和市场竞争的加剧,公司必须根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新,若公司未能正确判断下游需求变化或者公司技术实力未跟上市场需求变化,未能根据市场需求及时更新现有产品或推出符合市场趋势的新产品,或者因公司产品市场竞争格局发生变化、抢占市场份额导致销售价格持续下降,或者未来原材料供给紧张导致采购价格上涨,产能利用率不足,公司不能有效控制产品成本,均可能导致公司毛利率水平波动甚至下降,对公司盈利能力产生不利影响。

2、存货跌价的风险

报告期各期末,公司存货余额分别为 40,454.74 万元、36,616.50 万元和 41,079.72 万元,存货跌价准备余额分别 19,464.12 万元、19,048.89 万元和 18,002.86 万元。报告期各期,公司存货跌价损失分别为-9,433.49 万元、-5,358.05 万元和-3,374.42 万元。2023 年以来,随着公司产品毛利率水平提升和公司库存管理水平加强,存货跌价损失有所收窄,但公司的账面存货余额仍然较高,存在一定的跌价风险。未来,若公司下游客户需求、市场竞争格局发生变化,或者公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理导致存货无法顺利实现销售或按合理的价格实现销售,则将存在存货大量增加且存货跌价准备金额进一步扩大的风险。

3、应收账款的回收风险

报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 16,773.62 万元、19,824.01 万

元和 13,061.02 万元，占流动资产的比重分别为 39.32%、44.98%和 23.88%。未来若客户的财务状况、合作关系发生恶化或催收措施不力，则公司将面临一定的应收账款回收风险，对公司盈利能力造成不利影响，亦会影响公司经营性现金流量，对公司资金状况造成不利影响。

4、资金短缺风险

报告期各期末，公司长短期借款融资规模分别为 116,009.95 万元、112,254.94 万元和 107,134.60 万元。考虑到公司尚未实现盈利，且随着业务规模扩大，库存备货和研发投入等方面的资金需求增加，如果公司现有融资渠道无法满足经营所需，公司将面临资金短缺的风险。

5、持续亏损和存在累计未弥补亏损的风险

2023 年至 2025 年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为-21,611.87 万元、-7,975.47 万元和-335.42 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-23,085.86 万元、-7,705.28 万元和-840.65 万元。近年来，随着公司产能的不断扩张、产品结构优化、声表面波射频滤波器国产替代以及公司实力不断的提升，公司营业收入分别为 41,851.74 万元、60,655.03 万元和 67,465.69 万元，复合增长率为 26.97%，2025 年亏损额亦较前期大幅收窄。但是，考虑到市场景气度、行业竞争、客户拓展、供应链管理等因素较为复杂，发行人的营业收入可能无法持续增长，存在未来一段时期内持续亏损的风险。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-45,818.52 万元，预计首次公开发行股票并上市后，发行人账面累计未弥补亏损将持续存在，导致一定时期内无法向股东进行现金分红。

（三）经营风险

1、知识产权诉讼风险

声表面波射频芯片产业具有显著的技术密集型特征，设计技术与制造工艺难度较高。公司通过长期的研发投入，已形成包括芯片设计技术、制造、封测工艺及材料在内的多项核心技术。由于全球市场竞争激烈，行业内领先厂商常将知识产权诉讼作为维持其技术优势、限制竞争对手的商业策略。公司虽已针对核心技

术采取了申请知识产权、建立保密体系等保护措施，但仍无法完全规避未来可能遭遇第三方提起的知识产权侵权主张或诉讼的风险。若发生此类纠纷，公司可能需要承担应诉成本、赔偿费用，或面临相关技术及产品的使用限制，进而对公司的研发创新、业务开展及经营业绩造成不利影响。

2、客户集中度较高的风险

报告期内，公司向前五大客户的销售收入占比分别为 62.19%、56.07%和 67.54%，公司主要通过经销或直销方式向智能终端、物联网及汽车电子领域客户销售声表面波滤波器，下游各领域客户的市场集中度相对偏高。如果未来主要客户的市场需求受外部负面因素影响出现大幅下滑，将可能对公司经营情况产生一定的不利影响。

二、与行业相关的风险

（一）市场竞争加剧风险

声表面波滤波器行业市场竞争较为激烈。全球市场主要由村田、高通（RF360）、太阳诱电等多家综合实力雄厚的日美企业主导，其凭借深厚的专利积累、领先的技术储备及稳固的客户关系占据全球市场主要份额。与此同时，国内产业政策支持也推动了本土企业的快速发展，行业产能持续扩张，市场竞争进一步加剧。若公司未来无法在技术迭代、产品性价比及客户服务响应等方面持续保持竞争力，将面临市场份额下滑、产品毛利率被压缩的风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

（二）下游市场需求波动风险

公司产品主要应用于智能终端、物联网、汽车电子、基站、低轨卫星通信等领域，其市场需求与宏观经济发展、居民消费能力及通信技术迭代周期高度相关。若全球宏观经济出现不确定性波动、消费电子市场景气度发生周期性下行，或 5G 等下游通信网络建设进度不及预期，均可能导致客户订单减少或产品导入延迟，进而引发公司产能利用率下降、库存积压及存货减值等连锁反应，对公司营业收入及盈利水平的稳定性构成不利影响。

（三）产业政策变动风险

公司的发展在一定程度上受益于国家对集成电路产业的政策扶持，包括科研资助、税收优惠及产业基金支持等。但产业政策本身具有动态调整的特性，国内扶持政策的重点方向、支持力度及退出机制未来可能发生变化。同时，全球贸易环境的不确定性增加，国际贸易摩擦可能导致主要经济体在半导体领域的出口管制、技术禁运等措施持续升级。若未来公司无法持续获得现有的政策支持，或关键设备及材料的进口受到限制，将可能对公司的研发投入能力、技术升级进程及日常生产经营造成不利影响，进而对公司长期发展战略的执行构成潜在威胁。

三、其他风险

（一）募集资金投资项目实施效果不及预期的风险

公司本次发行募集资金投资项目系基于当前市场前景与技术发展趋势进行规划。但下游市场需求受宏观经济波动、行业周期性变化及技术路线演进等多重因素影响，存在较大不确定性。若未来市场实际需求增长不及预期，或公司因市场竞争加剧、客户开拓未达预期而导致新增产能无法及时消化，则募集资金项目投产后可能出现产能利用率不足、固定资产折旧大幅增加等情况，进而对公司整体盈利能力产生不利影响，并可能导致项目整体投资收益水平低于预期。

（二）募投项目新增费用及折旧摊销影响公司盈利能力的风险

根据募集资金使用计划，本次募集资金投资项目建设期间，公司新增相关费用投入；本次募集资金投资项目建成后，公司新增固定资产的投入将导致相应的折旧、摊销费用增加，对发行人各年度经营业绩有直接影响。若未来发行人所处市场环境等因素发生重大不利变化，导致募集资金投资项目无法实现预计效益，则前述新增的折旧摊销、期间费用可能对公司盈利能力产生不利影响。

（三）发行失败的风险

公司本次申请首次公开发行股票并在科创板上市，发行结果将受到发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、公司经营业绩、投资者对行业及公司价值判断等多种内外部因素的综合影响，若本次发行时有效报价投资者或网下申购

投资者数量不满足法律规定要求，发行时总市值未能达到预计市值上市条件，或公司未在中国证监会予以注册决定的有效期内完成发行，公司将面临发行失败的风险。

第四节 发行人基本情况

一、公司基本信息

公司名称	无锡市好达电子股份有限公司
英文名称	Shoulder Electronics Co.,Ltd.
注册资本	7,696.4285 万元
法定代表人	刘平
成立日期	1999 年 6 月 14 日(股份有限公司成立于 2020 年 6 月 8 日)
住所	无锡市滨湖经济技术开发区高运路 115 号
邮编	214124
电话号码	0510-85629111
传真号码	0510-85629160
网址	http://www.shoulder.cn/
电子信箱	ir@wxsde.cn
信息披露和投资关系的部门	董事会办公室
信息披露和投资者关系负责人	丁艳
信息披露负责人电话	0510-85627586

二、公司设立及报告期内股本和股东变化情况

(一) 有限公司设立情况

1999 年 3 月 28 日，刘平、谢中华、周宗闽、陈书明、王建文、黄辉、王竞宇签署了《无锡市好达电子有限公司章程》，决定设立好达有限，注册资本为 50.00 万元，其中刘平出资 15.15 万元，谢中华出资 8.33 万元，周宗闽出资 8.33 万元，陈书明出资 8.33 万元，王建文出资 3.68 万元，黄辉出资 3.68 万元，王竞宇出资 2.50 万元。

1999 年 6 月 7 日，江苏诚意会计师事务所出具《验资报告》（苏诚会师内验[99]第 134 号），好达有限注册资本已足额到位，均为货币出资。

1999 年 6 月 14 日，江苏省无锡工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》（注册号：3202112101416）。

好达有限设立时，股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	刘平	15.15	30.30%
2	谢中华	8.33	16.68%
3	周宗闽	8.33	16.66%
4	陈书明	8.33	16.66%
5	王建文	3.68	7.35%
6	黄辉	3.68	7.35%
7	王竞宇	2.50	5.00%
合计		50.00	100.00%

（二）股份有限公司设立

无锡市好达电子股份有限公司系由无锡市好达电子有限公司整体变更设立。好达有限以截至2020年1月31日经审计的净资产为基础，按比例折为7,142.8571万股（每股面值1.00元），溢价部分计入资本公积。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次整体变更的出资情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏公W[2020]B046号）。

2020年6月8日，公司经无锡市行政审批局核准登记并取得《营业执照》（统一社会信用代码：913202117035640720）。

股份公司设立时的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	好达投资	1,938.6666	27.1413%
2	刘博	864.8340	12.1077%
3	共进同达	539.3011	7.5502%
4	黄辉	420.9022	5.8926%
5	小米基金	404.3127	5.6604%
6	哈勃投资	404.3127	5.6604%
7	王为标	356.7477	4.9945%
8	杨义平	350.2229	4.9031%
9	摩勤智能	292.7635	4.0987%
10	宽联投资	292.7635	4.0987%

序号	股东名称	持股数量	持股比例
11	王建文	219.2943	3.0701%
12	王竞宇	213.3988	2.9876%
13	茆林凤	201.6079	2.8225%
14	中和春生	154.0860	2.1572%
15	廖震	151.2059	2.1169%
16	俱成秋实	151.2059	2.1169%
17	杭州楚巽	141.1255	1.9758%
18	严雯	31.4787	0.4407%
19	林永波	14.6272	0.2048%
合计		7,142.8571	100.00%

(三) 报告期内公司股本及股东变化情况

报告期期初，发行人的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	好达投资	1,938.6666	25.4251%
2	刘博	864.8340	11.3421%
3	共进同达	539.3011	7.0728%
4	黄辉	420.9022	5.5200%
5	小米基金	404.3127	5.3025%
6	哈勃投资	404.3127	5.3025%
7	王为标	356.7477	4.6787%
8	杨义平	350.2229	4.5931%
9	摩勤智能	292.7635	3.8395%
10	宽联投资	292.7635	3.8395%
11	王建文	219.2943	2.8760%
12	王竞宇	213.3988	2.7987%
13	茆林凤	201.6079	2.6440%
14	中和春生	154.0860	2.0208%
15	廖震	151.2059	1.9830%
16	俱成秋实	151.2059	1.9830%
17	杭州楚巽	141.1255	1.8508%

序号	股东名称	持股数量	持股比例
18	苏民投君信	89.2865	1.1710%
19	国投创业	53.5714	0.7026%
20	枣庄拓海	53.5714	0.7026%
21	嘉兴君强	35.7142	0.4684%
22	聚隆景润	35.7142	0.4684%
23	聚源铸芯	35.7142	0.4684%
24	金浦创拓	35.7142	0.4684%
25	严雯	31.4787	0.4128%
26	嘉兴君俞	17.8571	0.2342%
27	宁波清容	17.8571	0.2342%
28	金程新高	17.8571	0.2342%
29	毓立投资	17.8571	0.2342%
30	温州毅巽	17.8571	0.2342%
31	海南丰晟	17.8571	0.2342%
32	橙盛天际	17.8571	0.2342%
33	追远财富	17.8571	0.2342%
34	林永波	14.6272	0.1918%
合计		7,625.0000	100.00%

报告期初至本招股说明书签署日，公司共历经 3 次股份转让、1 次增资，具体情况如下：

事项	时间	具体情况
股份公司设立后第二次股权转让	2023.01	杭州楚巽将发行人 85.4140 万股股份转让给嘉兴科巽，作价为 650.13 万元。
股份公司设立后第三次股权转让	2023.12	杭州楚巽将发行人 44.7115 万股股份转让给嘉兴科巽，作价为 340.03 万元。
股份公司设立后第二次增资	2025.04	发行人通过了 2025 年第二次临时股东大会决议，同意注册资本由 7,625.00 万元增加至 7,696.4285 万元，由民生投资和无锡市集成电路基金两名投资人合计认缴出资 71.4285 万元。
股份公司设立后第四次股权转让	2026.4	哈勃投资将发行人 20.00 万股股份转让给好达投资，作价为 1,120.00 万元。

（四）公司历史上股权代持及代持解除情况

公司股东层面曾存在股权代持的情形，具体情况如下：

1、舒达投资

(1) 股权代持及代持解除情况

2005年9月8日，好达有限召开董事会，同意刘平、黄辉、王建文、王竞宇分别将其持有好达有限385.95万元、96.70万元、96.70万元、64.33万元出资均转让给舒达投资。舒达投资工商登记文件上的股东为黄辉、王建文，实际股东为刘平、黄辉、王建文、王竞宇，四人实际持股比例为60:15:15:10。

2007年3月28日，好达有限召开董事会，同意舒达投资将其持有好达有限643.67万元出资转让给好达投资。此时好达投资股东为刘平、黄辉、王建文、王竞宇，四人持股比例为60:15:15:10。至此，舒达投资的股东层面代持情形解除。

(2) 股权代持形成原因

舒达投资存在股权代持情形主要系其股东签字和办理手续的便利性考虑，舒达投资办理工商登记时仅将黄辉、王建文登记为股东。

(3) 是否存在纠纷及潜在纠纷情况

上述股权代持及解除事项已经刘平、黄辉、王建文、王竞宇确认，同时上述股权代持情形已于2007年3月解除，不存在纠纷及潜在纠纷。

2、采时科技

(1) 股权代持及代持解除情况

2007年2月13日，刘博、杨义平分别将其持有的采时科技全部出资额转让给陈捷韶。彼时采时科技持有好达有限1,537.39万元出资额，采时科技名义股东为陈捷韶，实际股东为刘博、杨义平。

2007年3月28日，好达有限召开董事会，同意采时科技将其持有好达有限649.54万元出资额转让给宝和通讯；2008年7月1日，好达有限召开董事会，同意采时科技将其持有好达有限1,039.58万元出资额转让给宝和通讯。至此，采时科技已将持有的好达有限出资额全部转让给宝和通讯。上述期间，宝和通讯股东为刘博、杨义平，采时科技股东层面的代持情形解除。

(2) 股权代持形成原因

因当时刘博、杨义平准备更换持股平台，由采时科技变更为宝和通讯，并准备将采时科技注销。由于采时科技为香港公司，办理注销手续较为繁琐，故将股权转让给陈捷韶后由其办理注销采时科技的相关事宜。

(3) 是否存在纠纷及潜在纠纷情况

上述股权代持及解除事项已经刘博、杨义平、陈捷韶确认，同时上述股权代持情形已于 2008 年 7 月解除，不存在纠纷及潜在纠纷。

3、好达投资

(1) 股权代持及代持解除情况

2018 年 5 月，林强与刘思羽约定，以好达有限 6.54 元/注册资本为定价依据，林强出资 100 万元受让刘思羽持有的部分好达投资出资额从而间接持有好达有限 15.29 万元出资额。该次股权转让未办理工商变更手续，由此在好达投资层面形成股权代持情形。

2021 年 6 月 11 日，好达投资在无锡市行政审批局办理了股权代持还原的工商变更手续，林强显名持有好达投资 0.74% 出资份额。至此，好达投资股东层面的代持情形解除。

(2) 股权代持形成原因

因林强工作、生活地点位于深圳，当时刘思羽长期工作、生活在海外，双方不便办理相关股权转让手续，且林强考虑其持股比例较低，履行议案表决、决议签字等程序较为繁琐，经协商由刘思羽为其代持股权，由此形成股权代持事项。

(3) 是否存在纠纷及潜在纠纷情况

上述股权代持及解除事项已经刘思羽、林强确认，同时上述股权代持情形已于 2021 年 6 月解除，不存在纠纷及潜在纠纷。

（五）本次发行前涉及的业绩补偿、回购权的对赌条款或其他权利安排的约定及解除情况

2022年1月，发行人全体股东签订《关于无锡市好达电子股份有限公司的股东特殊权益条款之终止协议》，协议约定内容包括：各方的特殊权益条款、各方在该等条款下的权利义务及对应的重新生效条款均告终止，无任何争议和纠纷；义务方依据特殊权益条款承担的声明、承诺、保证、担保、回购、赔偿、补偿在内的连带或非连带性的任何义务和责任（无论该等义务是否已经产生），各方同意无条件且不可撤销地予以豁免；发行人全体股东除拥有根据公司法 and 发行人公司章程规定的股东权利外，对发行人及其控股股东、实际控制人、其他股东均不享有其他任何特殊权益或权利安排。

2025年4月，于发行人股份公司设立后第二次增资之时，发行人全体股东签订《股东协议》，该《股东协议》约定了投资人股东享有“上市前的股权转让、最惠国待遇”等特殊权利，同时约定了“特殊股东权利的解除”，各方同意任一股东的特殊股东权利均于发行人审议确定的首次发行股票并上市的申报基准日前无条件不可撤销地彻底终止，且自始无效、不附恢复条件。

根据上述协议，发行人相关对赌协议已彻底清理，对赌条款及其他权利安排已终止，对赌协议不存在效力恢复条款。

三、公司成立以来重要事件

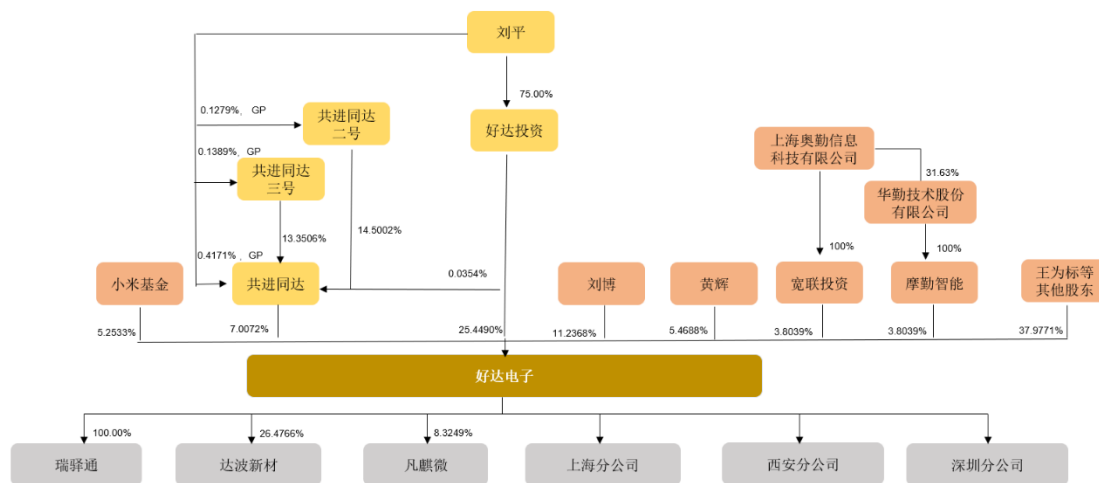
公司不存在其他未披露的成立以来的重要事件，报告期内公司不存在重大资产重组情况。

四、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况

本次发行前，公司不存在于其他证券市场上市或挂牌的情况。

五、公司股权结构

本次发行前，公司股权架构如下：



注：根据华勤技术 2026 年第一季度报告，上海奥勤信息科技有限公司持有华勤技术 31.63% 的股份，为华勤技术的控股股东。

六、公司控股子公司、参股子公司基本情况

本次发行前，公司拥有 1 家子公司，2 家参股公司，基本情况如下：

1、子公司瑞驿通

公司名称	无锡瑞驿通科技有限公司			
注册资本	500.00 万元			
实收资本	500.00 万元			
成立时间	2009 年 11 月 19 日			
注册地和主要生产经营地	无锡市滨湖经济开发区高运路 115 号			
主营业务及其在发行人业务板块中定位	主要从事原材料的采购			
股权结构	股东名称	股权比例		
	好达电子	100.00%		
	合计	100.00%		
最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年度/2025.12.31	7,280.69	-475.65	12,941.48	-89.55

注：最近一年主要财务数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、参股公司

(1) 达波新材

公司名称	苏州达波新材科技有限公司			
成立时间	2021年11月24日			
注册资本	1,227.5万元			
实收资本	1,227.5万元			
注册地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城东北区38幢3-6室			
主营业务及其在发行人业务板块中定位	半导体材料的研发、生产、销售，发行人布局半导体原材料领域			
股权结构	股东名称		股权比例	
	山东天岳先进科技股份有限公司		26.4766%	
	好达电子		26.4766%	
	苏州天岳好达企业管理合伙企业（有限合伙）		24.4399%	
	广东智成二号先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）		8.5540%	
	青岛锦创合信创业投资基金合伙企业（有限合伙）		4.0733%	
	扬州正为嘉豪股权投资合伙企业（有限合伙）		4.0733%	
	广州力合科城创业投资合伙企业（有限合伙）		4.0733%	
	王晓丹		1.6293%	
	深圳力合鲲鹏创业投资企业（有限合伙）		0.2037%	
	合计		100.00%	
最近一年主要财务数据（单位：万元）				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年度/2025.12.31	11,518.55	7,377.87	22.25	-1,893.73

注：最近一年主要财务数据经未经审计。

(2) 凡麒微

公司名称	上海凡麒微电子有限公司			
成立时间	2022年5月27日			
注册资本	838.09万元			
实收资本	838.09万元			
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路500弄7号1楼102-C室			
主营业务及其在发行人业务板块中定位	专注于设计开发射频前端芯片；发行人布局射频前端模组业务			

股权结构	股东名称		股权比例	
	王余峰		28.4357%	
	上海凡麒耀芯企业管理合伙企业（有限合伙）		18.7308%	
	邱丹		11.7863%	
	好达电子		8.3249%	
	上海长三角创新技术有限公司		7.9425%	
	中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）		7.0073%	
	嘉兴鑫乾股权投资合伙企业（有限合伙）		5.2555%	
	苏州市相城区相聚数字产业创业投资中心（有限合伙）		3.5037%	
	格兰康希通信科技（上海）股份有限公司		3.5037%	
	湖州麒微商务服务合伙企业（有限合伙）		2.1022%	
	孙康		1.7518%	
	上海泰倾电子有限公司		0.7007%	
	上海凡麒瑞芯信息科技有限公司（有限合伙）		0.6935%	
	苏州望望创芯伍号投资合伙企业（有限合伙）		0.2614%	
合计		100.00%		
最近一年主要财务数据（单位：万元）				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年度/2025.12.31	2,659.17	57.06	403.48	-2,498.45

注：最近一年主要财务数据未经审计。

七、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况

（一）公司控股股东、实际控制人基本情况

1、控股股东基本情况

截至本招股说明书签署日，好达投资直接持有公司 1,958.6666 万股股份，直接持股比例为 25.4490%，并通过持有共进同达出资额间接持有公司股份，为公司控股股东。其基本情况如下：

企业名称	无锡市好达投资有限公司
成立时间	2005年7月22日
注册资本	2,200.00万元
实收资本	2,200.00万元

注册地址	无锡经济开发区高浪东路999号（软件研发大厦）811室			
主营业务及其与发行人主营业务的关系	利用自有资金对外投资；与公司主营业务无直接关系			
法定代表人	刘平			
出资构成	序号	出资人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
	1	刘平	1,650.00	75.00%
	2	刘思羽	533.6771	24.2581%
	3	林强	16.3229	0.7419%
	合计		2,200.00	100.00%
最近一年主要财务数据（单位：万元）				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年度/2025.12.31	3,621.17	3,413.47	-	-460.21

注：最近一年主要财务数据经无锡连元会计师事务所（普通合伙）审计。

2、实际控制人基本情况

截至本招股说明书签署日，刘平通过持有好达投资 75%的份额、担任共进同达执行事务合伙人，合计控制公司 32.4562%的表决权，为公司实际控制人，其基本情况如下：

刘平：男，1962年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为：32021119621101****。

3、控股股东、实际控制人持有的股份质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

4、控股股东、实际控制人重大违法行为情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪的情形，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

5、控股股东和实际控制人控制的其他企业

截至本招股说明书签署日，公司控股股东为好达投资，实际控制人为刘平。

除公司及其控股子公司外，好达投资不存在控制其他企业的情形，刘平控制的其他企业基本情况如下：

(1) 好达投资

好达投资基本情况参见本节“七、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况”之“（一）公司控股股东、实际控制人基本情况”之“1、控股股东基本情况”。

(2) 共进同达

共进同达基本情况参见本节“十二、本次申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排”之“（一）股权激励情况”之“1、共进同达”。

(3) 共进同达二号

共进同达二号基本情况参见本节“十二、本次申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排”之“（一）股权激励情况”之“2、共进同达二号”。

(4) 共进同达三号

共进同达三号基本情况参见本节“十二、本次申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排”之“（一）股权激励情况”之“3、共进同达三号”。

(二) 其他持有公司 5%以上股份的主要股东的基本情况

截至本招股说明书签署之日，除好达投资外，其他持有公司 5%以上股份的股东的基本情况如下：

1、刘博

男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为：61012219730114****。

2、共进同达

共进同达基本情况参见本节“十二、本次申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排”之“（一）股权激励情况”之“1、共进同达”。

3、黄辉

男，1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为：32021119600801****。

4、小米基金

截至本招股说明书签署日，小米基金基本情况如下：

企业名称	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）		成立时间	2017年12月7日
认缴出资额	1,200,000.00万元		实缴出资额	1,200,000.00 万元
注册地址	武汉东湖新技术开发区九峰一路66号1层009号（自贸区武汉片区）			
主营业务及其与发行人主营业务的关系	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）；与公司主营业务无直接关系			
执行事务合伙人	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司			
出资构成	序号	出资人名称	出资额（万元）	出资比例
	1	珠海兴格资本投资有限公司	210,000.00	17.50%
	2	小米科技有限责任公司	200,000.00	16.67%
	3	湖北长江产业投资基金合伙企业（有限合伙）	200,000.00	16.67%
	4	武汉光谷产业投资有限公司	200,000.00	16.67%
	5	珠海格力金融投资管理有限公司	144,500.00	12.04%
	6	上海信银海丝投资管理有限公司	90,000.00	7.50%
	7	深圳金晟硕焯创业投资中心（有限合伙）	55,500.00	4.63%
	8	天津金星创业投资有限公司	34,000.00	2.83%
	9	北京汽车集团产业投资有限公司	14,000.00	1.17%
	10	海南华盈开泰投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	0.83%
	11	中国对外经济贸易信托有限公司	10,000.00	0.83%
12	广发乾和投资有限公司	10,000.00	0.83%	

	13	三峡资本控股有限责任公司	9,000.00	0.75%
	14	江苏溧阳光股权投资合伙企业（有限合伙）	9,000.00	0.75%
	15	温州信银泰盈股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000.00	0.25%
	16	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司	1,000.00	0.08%
	合计		1,200,000.00	100.00%

5、摩勤智能、宽联投资

截至本招股说明书签署日，摩勤智能、宽联投资合计持有公司股份占公司总股本的 7.6078%，摩勤智能、宽联投资为上海奥勤信息科技有限公司同一控制下企业。摩勤智能、宽联投资基本情况如下：

（1）摩勤智能

企业名称	上海摩勤智能技术有限公司		成立时间	2015年7月3日
注册资本	20,000.00万元		实收资本	20,000.00万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号9幢5层501室			
主营业务及其与发行人主营业务的关系	从事智能技术、信息科技、电子技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件的研发、设计、制作、销售，计算机硬件、通讯产品、电子产品的研发、设计、销售，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；与公司主营业务无直接关系			
法定代表人	崔国鹏			
出资构成	序号	出资人名称	认缴出资额（万元）	出资比例
	1	华勤技术股份有限公司	20,000.00	100.00%
	合计		20,000.00	100.00%

（2）宽联投资

企业名称	上海宽联投资有限公司		成立时间	2015年6月8日
注册资本	500.00万元		实收资本	500.00万元
注册地址	上海市奉贤区南桥镇南中路459号			
主营业务及其与发行人主营业务的关系	实业投资，创业投资，资产管理，市场营销策划，投资管理，企业管理服务，商务咨询，物业管理，会展服务。（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）；与公司主营业务无直接关系			

法定代表人	崔国鹏			
出资构成	序号	出资人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
	1	上海奥勤信息科技有限公司	500.00	100.00%
	合计		500.00	100.00%

八、发行人特别表决权股份情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

九、发行人协议控制架构情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构情况。

十、公司股本情况

(一) 本次拟发行的股份及发行前后公司股本情况

本次发行前公司总股本为 7,696.4285 万股，本次拟公开发行不超过 2,565.4762 万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量），发行后总股本不超过 10,261.9047 万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量）。按本次发行新股 2,565.4762 万股计算，发行前后公司的股本结构变化情况如下：

股东名称	发行前		发行后	
	股份数 (万股)	比例	股份数 (万股)	比例
一、有限售条件股份				
好达投资	1,958.6666	25.4490%	1,958.6666	19.0868%
刘博	864.8340	11.2368%	864.8340	8.4276%
共进同达	539.3011	7.0072%	539.3011	5.2554%
黄辉	420.9022	5.4688%	420.9022	4.1016%
小米基金	404.3127	5.2533%	404.3127	3.9399%
哈勃投资	384.3127	4.9934%	384.3127	3.7450%
王为标	356.7477	4.6352%	356.7477	3.4764%
杨义平	350.2229	4.5505%	350.2229	3.4128%
摩勤智能	292.7635	3.8039%	292.7635	2.8529%
宽联投资	292.7635	3.8039%	292.7635	2.8529%

股东名称	发行前		发行后	
	股份数 (万股)	比例	股份数 (万股)	比例
王建文	219.2943	2.8493%	219.2943	2.1370%
王竞宇	213.3988	2.7727%	213.3988	2.0795%
茆林凤	201.6079	2.6195%	201.6079	1.9646%
中和春生	154.0860	2.0020%	154.0860	1.5015%
廖震	151.2059	1.9646%	151.2059	1.4735%
俱成秋实	151.2059	1.9646%	151.2059	1.4735%
嘉兴科巽	130.1255	1.6907%	130.1255	1.2680%
苏民投君信	89.2865	1.1601%	89.2865	0.8701%
民生投资（CS）	53.5714	0.6961%	53.5714	0.5220%
国投创业	53.5714	0.6961%	53.5714	0.5220%
枣庄拓海	53.5714	0.6961%	53.5714	0.5220%
嘉兴君强	35.7142	0.4640%	35.7142	0.3480%
聚隆景润	35.7142	0.4640%	35.7142	0.3480%
聚源铸芯	35.7142	0.4640%	35.7142	0.3480%
金浦创拓	35.7142	0.4640%	35.7142	0.3480%
严雯	31.4787	0.4090%	31.4787	0.3068%
嘉兴君俞	17.8571	0.2320%	17.8571	0.1740%
宁波清容	17.8571	0.2320%	17.8571	0.1740%
金程新高	17.8571	0.2320%	17.8571	0.1740%
毓立投资	17.8571	0.2320%	17.8571	0.1740%
温州毅巽	17.8571	0.2320%	17.8571	0.1740%
海南丰晟	17.8571	0.2320%	17.8571	0.1740%
橙盛天际	17.8571	0.2320%	17.8571	0.1740%
追远财富	17.8571	0.2320%	17.8571	0.1740%
林永波	14.6272	0.1901%	14.6272	0.1425%
无锡市集成电路基金	17.8571	0.2320%	17.8571	0.1740%
杭州楚巽	11.0000	0.1429%	11.0000	0.1072%
二、本次发行股份				
社会公众股股东	-	-	2,565.4762	25.0000%
合计	7,696.4285	100.00%	10,261.9047	100.00%

（二）本次发行前的前十名股东

本次发行前，公司前十名股东及持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	好达投资	1,958.6666	25.4490%
2	刘博	864.8340	11.2368%
3	共进同达	539.3011	7.0072%
4	黄辉	420.9022	5.4688%
5	小米基金	404.3127	5.2533%
6	哈勃投资	384.3127	4.9934%
7	王为标	356.7477	4.6352%
8	杨义平	350.2229	4.5505%
9	摩勤智能	292.7635	3.8039%
10	宽联投资	292.7635	3.8039%

（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人任职情况

本次发行前，公司前十名自然人股东的持股及任职情况如下：

序号	姓名	职务	持股数（万股）	持股比例
1	刘博	董事、总经理	864.8340	11.2368%
2	黄辉	战略研究室主任	420.9022	5.4688%
3	王为标	首席技术官、副总经理、职工代表董事	356.7477	4.6352%
4	杨义平	-	350.2229	4.5505%
5	王建文	战略研究室研究员	219.2943	2.8493%
6	王竞宇	历史监事会主席、战略研究室研究员	213.3988	2.7727%
7	茆林凤	-	201.6079	2.6195%
8	廖震	-	151.2059	1.9646%
9	严雯	-	31.4787	0.4090%
10	林永波	-	14.6272	0.1901%

（四）发行人国有股份及外资股份的情况

1、国有股份

截至本招股说明书签署日，民生投资持有发行人 53.5714 万股股份，占总股

本的 0.6961%。根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委、财政部、证监会令第 36 号）等相关规定，江苏省政府国有资产监督管理委员会已出具《江苏省国资委关于无锡市好达电子股份有限公司国有股东标识管理事项的批复》，发行人如在公开市场发行股票并上市，民生投资在中国证券登记结算有限责任公司登记的证券账户标注“CS”；除民生投资外，发行人无其他国有股东。

2、外资股份

本次发行前，公司不存在外资股份情况。

（五）最近一年公司新增股东情况

本次申报前最近一年公司不存在新增股东情况。

（六）本次发行前各股东间的关联关系及各自持股比例

截至招股说明书签署日，公司各直接股东间的关联关系及各自持股比例如下：

序号	股东名称	持股比例	关联关系
1	好达投资	25.4490%	好达投资直接持有共进同达 0.04%的出资额，好达投资控股股东刘平直接持有共进同达 0.42%的出资额并担任共进同达执行事务合伙人
	共进同达	7.0072%	
2	好达投资	25.4490%	林强直接持有好达投资 0.74%的出资额，同时直接持有中和春生 1.50%的出资额
	中和春生	2.0020%	
3	宽联投资	3.8039%	上海奥勤信息科技有限公司系宽联投资控股股东，同时系摩勤智能控股股东华勤技术股份有限公司之控股股东
	摩勤智能	3.8039%	
4	俱成秋实	1.9646%	石春茂、谢建良、成都新易盛通信技术股份有限公司、常熟市国发创业投资有限公司、章晓虎、常熟市国发资产管理有限公司、东莞市盛和伟业投资有限公司、张平、范薇、纪天阳、李秀清、崔军分别直接持有中和春生 3.00%、2.58%、2.50%、2.33 %、2.17 %、2.08%、1.67%、1.67%、1.50%、1.42%、0.92%、0.83%的出资额并担任其有限合伙人，同时分别直接持有俱成秋实 0.54%、0.71%、2.68%、2.59%、0.63%、1.34%、2.23%、1.61%、1.34%、0.89%、1.07%、0.89%的出资额并担任其有限合伙人
	中和春生	2.0020%	
5	杭州楚巽	0.1429%	杨梅直接持有杭州楚巽执行事务合伙人上海赫智巽企业管理有限公司 81.00%的出资额；杨梅担任温州毅巽有限合伙人并直接持有其 84.40%出资额，其持有 48.00%出资额并担任执行事务合伙人的上海荣巽资产管理中心（有限合伙），直接持有温州毅巽 0.06%出资额并担任执行事务合伙人；杨梅担任嘉兴科巽有限合伙人并直接持有嘉兴科巽 99.95%的出资额
	温州毅巽	0.2320%	
	嘉兴科巽	1.6907%	

序号	股东名称	持股比例	关联关系
6	苏民投君信	1.1601%	上海国方母基金一期创业投资合伙企业（有限合伙）、上海国方母基金二期创业投资合伙企业（有限合伙）分别直接持有苏民投君信 5.49%、1.83%的出资额并担任有限合伙人；同时上海国方母基金一期创业投资合伙企业（有限合伙）、上海国方母基金二期创业投资合伙企业（有限合伙）分别直接持有金浦创拓 7.71%、2.57%的出资额并担任其有限合伙人
	金浦创拓	0.4640%	
7	聚源铸芯	0.4640%	长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）直接持有聚源铸芯 9.71%的出资额并担任其有限合伙人，同时直接持有毓立投资 9.78%的出资额并担任其有限合伙人
	毓立投资	0.2320%	
8	嘉兴君强	0.4640%	张莉直接持有嘉兴君强 11.51%的出资额并担任其有限合伙人，同时直接持有嘉兴君俞 51.43%的出资额并担任其有限合伙人
	嘉兴君俞	0.2320%	
9	温州毅巽	0.2320%	田卫兵直接持有温州毅巽 5.00%的出资额并担任其有限合伙人，同时直接持有嘉兴君俞 47.62%的出资额并担任其有限合伙人
	嘉兴君俞	0.2320%	
10	民生投资	0.6961%	国联民生控股子公司民生证券股份有限公司持股民生投资 100%的股份，国联集团是国联民生的控股股东，国联集团由无锡市人民政府国有资产监督管理委员会控股；锡创投直接持有无锡市集成电路基金 95.17%的份额并担任有限合伙人，无锡国联产业投资私募基金管理有限公司持有无锡市集成电路基金 0.96%的份额并担任执行事务合伙人，锡创投直接持有无锡国联产业投资私募基金管理有限公司的 55%的股权；无锡金投资本私募基金管理有限公司为金程新高执行事务合伙人，锡创投直接持有无锡金投资本私募基金管理有限公司 100%股权；国发资本持有锡创投 73.50%的股权，国发资本由无锡市人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股；国联集团董事长担任国发资本的董事长
	无锡市集成电路基金	0.2320%	
	金程新高	0.2320%	

注：上表中列示的为公司股东及基于其第一层股东间产生的关联关系。

（七）发行人私募投资基金股东的纳入监管情况

截至本招股说明书签署日，公司共有 16 名股东为私募投资基金，并已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，具体情况如下：

序号	股东名称	私募基金备案号	私募基金管理人	私募基金管理人备案号
1	小米基金	SEE206	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司	P1067842
2	中和春生	SL7062	常熟常兴创业投资管理有限公司	P1033581
3	俱成秋实	SGE506	南京俱成股权投资管理有限公司	P1069480
4	苏民投君信	SEN459	君信（上海）股权投资基金管理有限公司	P1066511

序号	股东名称	私募基金备案号	私募基金管理人	私募基金管理人备案号
5	国投创业	SGG209	国投创业投资管理有限公司	P1032006
6	枣庄拓海	SLJ189	无锡拓海股权投资基金管理有限公司	P1011360
7	嘉兴君强	SLC622	上海临芯投资管理有限公司	P1028940
8	聚源铸芯	SJT590	中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司	P1003853
9	金浦创拓	SW6284	上海金浦创新股权投资管理有限公司	P1063861
10	嘉兴君俞	SLB271	上海君桐股权投资管理有限公司	P1021028
11	宁波清容	SCJ290	北京清控金信投资管理有限公司	P1032060
12	毓立投资	SJL799	苏州协立股权投资管理中心（有限合伙）	P1066645
13	温州毅巽	SLC637	上海荣巽资产管理中心（有限合伙）	P1020243
14	追远财富	SEX013	北京追远创业投资有限公司	P1021019
15	嘉兴科巽	SXF314	前海英华投资管理（深圳）有限公司	P1030238
16	无锡市集成电路基金	SAEL28	无锡国联产业投资私募基金管理有限公司	P1005001

（八）发行人股东公开发售股份的情况

本次发行不涉及公司股东公开发售股份的情况。

十一、董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员

（一）董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员简历

1、董事会成员

姓名	性别	国籍	职位	提名人名称	本届任期
刘平	男	中国	董事长	好达投资	2023年6月30日至2026年6月29日
刘博	男	中国	董事、总经理	好达投资	2023年6月30日至2026年6月29日
王为标	男	中国	首席技术官、副总经理、职工代表董事	职工代表大会	2023年6月30日至2026年6月29日（2025年10月10日任职工代表董事）
倪谅	男	中国	董事	小米基金	2023年6月30日至2026年6月29日

姓名	性别	国籍	职位	提名人名称	本届任期
姚海锋	男	中国	董事	哈勃投资	2025年11月24日至2026年6月29日
晏胜	男	中国	董事	摩勤智能、宽联投资	2025年7月16日至2026年6月29日
涂武根	男	中国	独立董事	好达投资	2023年6月30日至2026年6月29日
汤立国	男	中国	独立董事	好达投资	2023年6月30日至2026年6月29日
程德兵	男	中国	独立董事	好达投资	2023年6月30日至2026年6月29日

公司董事会共设9名董事，其中独立董事3名。各位董事简历如下：

刘平先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年至1991年，历任无锡市无线电元件二厂技术员、工程师、车间主任；1991年至1994年，任无锡市江南电子器件有限公司副总经理；1994年至2005年，任无锡市文华电子有限公司执行董事；1999年至2020年历任好达有限总经理、董事长；2020年至今任公司董事长。

刘博先生，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年至1998年，任深圳广宇工业集团公司外销业务员；1998年至2006年，任深圳市戎月电子有限公司总经理；2006年至2020年，历任好达有限副总经理、总经理、董事；2009年至今，历任无锡瑞驿通科技有限公司董事长、执行董事；2020年至今，任公司总经理、董事；2021年至2023年，任思福易董事。

王为标先生，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。1991年至1994年，任教于江苏省丰县商业学校；1994年至1998年，任教于安徽省淮北教育学院；1998年至2001年，于南京大学声学专业学习，获硕士学位；2001年至2005年，于南京大学声学专业学习，获博士学位；2005年至2007年，于南京大学博士后工作站从事科研工作；2007年至2011年，任好达有限研发总监；2011年至2014年，任中国电子科技集团有限公司第五十五研究所高级工程师；2014年至2015年，任华为技术有限公司主任工程师；2016年至2020年，历任好达有限研发总监、董事；2020年至今，历任公司研发总监、董事、首席技术官、副总经理、职工代表董事，曾获国家科技进步二等奖等重要奖项，并享受国务院政府特殊津贴；2023年至今，任达波新材董

事。

倪谅先生，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年至2020年，任摩根士丹利华鑫证券投资银行部分分析师；2020年至今先后担任北京小米移动软件有限公司产业投资部投资经理、投资总监；2020年至今，任公司董事。

姚海锋先生，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任华为企业发展部投资总监。于2001年入职华为技术有限公司，历任工程师、经理、专家、总监等职务；2025年至今，任公司董事。

晏胜先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2003年，任仁宝电脑工业（中国）有限公司硬件部硬件助理工程师；2003年至2005年，任上海贝豪通讯电子有限公司、国龙信息技术（上海）有限公司工程师；2005年12月至今，先后在华勤技术股份有限公司担任射频开发经理、产品经理、负责投资业务；2025年至今，任公司董事。

汤立国先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995年至1998年任海鹰企业集团有限责任公司纺织电子研究所助理工程师；1998年至2004年，于南京大学声学专业学习，获博士学位；2004年至2005年，任香港理工大学机械工程系助理研究员；2005年至2009年，任厦门大学海洋技术与工程系讲师；2013年至2015年，作为访问学者于美国宾州州立大学材料研究所学习；2009年至今先后担任厦门大学应用海洋物理与工程系副教授、教授；2023年至今，任公司独立董事。

涂武根先生，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。1995年至1997年，任新余锻压有限责任公司财务部副科长；1997年至1999年，任江西新余会计师事务所审计部门经理；1999年至2002年，任上海闵瑞会计师事务所审计项目经理；2002年至2008年，任上海信光会计师事务所有限公司审计部门经理；2008年至今，任上海为众永光会计师事务所（普通合伙）主任会计师、执行事务合伙人；2020年至今，任公司独立董事。

程德兵先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历。2000年至2005年，任无锡市北塘区人民检察院检察官；2005年至2012年，任无锡市中级人民法院法官；2012年至2015年，任江苏漫修律师事务所律师；2016年至今，任江苏瀛恒律师事务所主任律师；2020年至今，任公司独立董事。

2、历史监事会成员

截至取消监事会前，公司监事会由王竞宇、王善良、谢学文组成。

根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定，2025年11月11日公司召开2025年第六次临时股东大会，决议调整公司内部监督机构，由董事会审计委员会承接原监事会的法定职权，不设监事会或者监事。

截至本招股说明书签署日，审计委员会成员包括涂武根、程德兵、刘博，由涂武根担任召集人。审计委员会成员的简历参见本节“十一、董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“1、董事会成员”。

3、高级管理人员

公司共有高级管理人员7名，简历如下：

刘博先生，公司总经理，简历参见本节“十一、董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“1、董事会成员”的相关内容。

王为标先生，公司副总经理，简历参见本节“十一、董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“1、董事会成员”的相关内容。

刘明先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1983年至2006年，于中国人民解放军服役；2007年至2020年，任好达有限市场部经理；2009年至今，任无锡瑞驿通科技有限公司总经理；2020年至今，历任公司市场部经理、销售部经理、副总经理。

王骏先生，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年至2008年，任深圳市中兴康讯电子有限公司商务经理；2008年至2011年，自由职业；2011年至2012年，任深圳市中兴供应链有限公司市场部经理；2012年至2017年，自由职业；2017年至2020年，任好达有限销售部总监；2020年至今，任公司销售部总监、副总经理。

丁艳女士，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年至2005年，历任中国农业银行无锡分行国际业务部主管、营业部会计主管、公司业务部科长、营业部部门经理；2006年至2007年，任中国农业银行无锡梁溪支行国际业务部总经理；2007年至2018年，历任中国农业银行无锡新吴支行国际业务部、公司业务部、综合管理部部门总经理；2018年至2020年，任好达有限董事会秘书；2020年至今，任公司董事会秘书；2021年至2023年，任思福易董事。

黄宇峰先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2011年至2014年，任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理；2014年至2015年，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2015年至2016年，任国信证券股份有限公司苏南分公司项目经理；2016年至2018年，任无锡兴达泡塑新材料股份有限公司董事会秘书；2018年至2020年，任好达有限财务负责人；2020年至今，任公司财务负责人。

陆增天先生，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2014年至2020年，历任好达有限研发工程师、研发部副部长、研发部部长；2020年至2024年，任公司研发部部长；2024年至今，任公司研发部部长、副总经理，曾获国家科技进步二等奖等重要奖项；2021年至2023年，任思福易董事。

4、核心技术人员

公司认定核心技术人员标准和依据如下：（1）拥有较为丰富的研发经验及与公司所处行业相匹配的学历背景；（2）指导、参与公司的研发项目，在公司专利和非专利技术等科研成果中发挥重要作用；（3）在公司研发部门、经营管理岗位担任重要职务，具备良好的研发、生产或经营管理能力。

基于上述标准，公司现有核心技术人员 3 名，简历如下：

刘平先生，公司董事长，简介参见本节“十一、董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“1、董事会成员”的相关内容。

王为标先生，公司首席技术官、职工代表董事、副总经理，简介参见本节“十一、董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“1、董事会成员”的相关内容。

陆增天先生，公司研发部部长、副总经理，简介参见本节“十一、董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“3、高级管理人员”的相关内容。

（二）董事、历史监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的近亲属关系

本次发行前，公司董事、核心技术人员刘平与高级管理人员刘明为兄弟关系。除上述情况外，董事、历史监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在近亲属关系。

（三）公司与董事、历史监事、高级管理人员及核心技术人员之间的协议及履行情况

在公司任职并领薪的董事、历史监事、高级管理人员及核心技术人员均与公司签订了聘任合同，此外公司与核心技术人员签订了保密、竞业禁止及知识产权归属协议。本次发行前，上述合同执行情况良好，不存在违约情形。

（四）董事、历史监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况

本次发行前，公司董事、历史监事、高级管理人员及核心技术人员持有的公司股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。

（五）董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况

本次发行前，公司董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员在除公司

及其控股子公司以外的兼职情况如下：

姓名	职务	其他单位兼职情况	所兼职单位与公司的关联关系
刘平	董事长	共进同达执行事务合伙人	实际控制人控制的其他企业
		好达投资执行董事兼总经理	实际控制人控制的其他企业
		无锡市盐锡拓海典当有限公司监事	无关联关系
		无锡市盐城商会会长、法定代表人	无关联关系
		共进同达二号执行事务合伙人	实际控制人控制的其他企业
		共进同达三号执行事务合伙人	实际控制人控制的其他企业
王为标	首席技术官、副总经理、职工代表董事	达波新材董事	公司参股企业
倪谅	董事	北京小米移动软件有限公司产业投资部投资总监	与小米基金存在关联关系
		嘉兴景焱智能装备技术有限公司董事	公司董事担任董事的企业
		宁波卢米蓝新材料有限公司董事	公司董事担任董事的企业
		科大智能（合肥）科技有限公司董事	公司董事担任董事的企业
晏胜	董事	华勤技术股份有限公司战略合作部投资总监	华勤技术股份有限公司通过摩勤智能间接持有公司3.8039%的股份
		合泰盟方电子（深圳）股份有限公司董事	公司董事担任董事的企业
姚海锋	董事	新港海岸（北京）科技有限公司董事	公司董事担任董事的企业
		裕太微电子股份有限公司董事	公司董事担任董事的企业
		英创新材料（绍兴）有限公司董事	公司董事担任董事的企业
		杰华特微电子股份有限公司董事	公司董事担任董事的企业
汤立国	独立董事	厦门大学应用海洋物理与工程系教授	无关联关系
涂武根	独立董事	上海为众永光会计师事务所（普通合伙）任执行事务合伙人、主任会计师	公司独立董事出资比例为50.00%并担任执行事务合伙人
程德兵	独立董事	江苏瀛恒律师事务所主任律师	公司独立董事出资比例为50.00%

注：北京小米移动软件有限公司为小米通讯技术有限公司全资子公司，小米通讯技术有限公司为雷军控制的企业。小米基金执行事务合伙人为湖北小米长江产业投资基金管理有限公司，根据公开资料查询，湖北小米长江产业投资基金管理有限公司受雷军间接控制。

（六）董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资

本次发行前，除对公司及其持股平台投资以外，董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员对外投资情况如下：

姓名	职务	对外投资单位名称	直接持股比例
刘平	董事长	射阳外国语学校	28.75%
刘博	董事、总经理	深圳市春宇无线科技有限公司	25.00%
		上海蜀淼电子科技合伙企业（有限合伙）	10.08%
		宁波磐霖嘉成创业投资合伙企业（有限合伙）	1.18%
		嘉兴磐霖乐达五号创业投资合伙企业（有限合伙）	2.99%
晏胜	董事	海南软胜创业投资合伙企业（有限合伙）	8.64%
涂武根	独立董事	上海为众永光会计师事务所（普通合伙）	50.00%
		上海图瑞精密电子有限公司	31.25%
程德兵	独立董事	无锡瀛达商务咨询有限公司	90.00%
		江苏瀛恒律师事务所	50.00%
		相亮贸易（无锡）有限公司	15.00%
		无锡市修明量宇科技有限公司	20.00%
		江苏顾垣得医疗科技有限公司	20.00%
		口袋瀛恒（无锡）科技产业发展有限公司	20.00%
		无锡万相灵策信息咨询合伙企业（有限合伙）	6.67%
刘明	副总经理	珠海中为好达投资合伙企业（有限合伙）	19.78%
黄宇峰	财务负责人	泉州蔓星鸿石股权投资合伙企业（有限合伙）	39.61%

公司董事、历史监事、高级管理人员及核心技术人员的上述对外投资行为与公司均不存在利益冲突。

（七）董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员的近两年变动情况

1、董事变动情况分析

时间	变动情况	变动原因	变动后董事名单
2024年初	-	-	刘平、刘博、王为标、倪谅、张建兴、盛建宏、汤立国（独立董事）、涂武根（独立董事）、程德兵（独立董事）
2024年1月	离任：盛建宏 新增：方伟	个人原因辞去 发行人董事职务	刘平、刘博、王为标、倪谅、张建兴、方伟、汤立国（独立董事）、涂武根（独立董事）、程德兵（独立董事）
2025年7月	离任：张建兴 新增：晏胜	个人原因辞去 发行人董事职务	刘平、刘博、王为标、倪谅、晏胜、方伟、汤立国（独立董事）、涂武根（独立董事）、程德兵（独立董事）
2025年10月	王为标调整为 职工代表董事	召开职工代表 大会选举职工 代表董事	刘平、刘博、王为标、倪谅、晏胜、方伟、汤立国（独立董事）、涂武根（独立董事）、程德兵（独立董事）

时间	变动情况	变动原因	变动后董事名单
2025年11月	离任：方伟 新增：姚海锋	个人原因辞去 发行人董事职 务	刘平、刘博、王为标、倪谅、晏胜、姚海锋、汤立国（独立董事）、涂武根（独立董事）、程德兵（独立董事）

2、历史监事变动情况分析

2024年初，发行人第二届监事会监事为王竞宇、王善良、谢学文，其中王竞宇为监事会主席，谢学文为职工代表监事。

2025年11月，发行人召开2025年第六次临时股东大会，决议调整公司内部监督机构，由董事会审计委员会承接原监事会的法定职权，不设监事会或者监事。

3、高级管理人员变动情况分析

2024年初，发行人总经理为刘博，王为标、刘明和王骏为副总经理，丁艳为董事会秘书，黄宇峰为财务负责人。

2024年4月，发行人召开第二届董事会第六次会议，选举陆增天为公司副总经理。

4、公司核心技术人员变动情况分析

公司核心技术人员近两年未发生变动。

（八）董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股权情况

1、直接持有本公司股份情况

本次发行前，全体董事、历史监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股权的情况如下：

姓名	职务或亲属关系	持股数（万股）	持股比例
刘博	董事、总经理	864.8340	11.2368%
王为标	首席技术官、职工代表董事、副总经理	356.7477	4.6352%
王竞宇	历史监事会主席、战略研究室研究员	213.3988	2.7727%

2、间接持有本公司股份情况

本次发行前，全体董事、历史监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股权的情况如下：

姓名	职务或亲属关系	间接持股公司	穿透后对公司的持股比例合计
刘平	董事长	好达投资	19.1204%
		共进同达	
		共进同达二号	
		共进同达三号	
刘思羽	刘平之女	好达投资	6.1740%
晏胜	董事	海南软胜创业投资合伙企业（有限合伙）	0.0151%
刘明	副总经理、刘平之弟	共进同达	0.1048%
刘言喆	刘明之子	共进同达二号	0.0260%
王骏	副总经理	共进同达	0.6549%
丁艳	董事会秘书	共进同达	0.1310%
黄宇峰	财务负责人	共进同达	0.1965%
陆增天	研发部部长、副总经理	共进同达	0.7848%
王善良	历史监事	共进同达	0.0655%
谢学文	历史监事	共进同达	0.0655%

注：晏胜持有海南软胜创业投资合伙企业（有限合伙）8.6368%的份额，华勤技术 2026 年第一季度报告披露海南软胜创业投资合伙企业（有限合伙）持有华勤技术 4.61%股份，摩勤智能为华勤技术的全资子公司，因此晏胜间接持股比例为 0.0151%。

本次发行前，除上述情况外，公司董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属不存在以其他方式直接或间接持有公司股份的情况。公司董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押或者冻结的情况。

（九）董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况

1、薪酬组成、确定依据

公司董事（不含外部董事、独立董事）、历史监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要包含：基本工资、相关津贴、绩效奖金和年终奖等；公司外部

董事倪谅、姚海锋、晏胜不在公司领取薪酬；公司独立董事汤立国、涂武根、程德兵每年在公司领取独立董事津贴。公司董事和历史监事薪酬由公司根据相关制度确定。

在公司领取薪酬的董事、历史监事、高级管理人员及核心技术人员均与公司签订了聘任合同，对薪酬事项作出了明确约定。

2、薪酬确定所履行的程序

公司董事、历史监事、高级管理人员的薪酬确定需要履行严格的程序：公司董事的年度薪酬须报经董事会同意后提交股东会审议；历史监事的年度薪酬须报经监事会同意后提交股东会审议；高级管理人员的年度薪酬，须提交董事会审议；核心技术人员的薪酬由公司遵照内部决策程序与员工签署劳动合同确定。

3、报告期内薪酬总额及占各期发行人利润总额的比重

报告期内，公司董事、历史监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额（不含股份支付）分别为 768.77 万元、881.49 万元、830.51 万元。

报告期各期公司尚未盈利，薪酬总额占同期公司合并报表利润总额的比例不具有参考性。

4、最近一年薪酬具体情况

公司董事倪谅、姚海锋、晏胜不在公司领薪，独立董事在公司只领取独立董事津贴，不享有其他福利待遇。公司董事、历史监事、高级管理人员和核心技术人员 2025 年度从发行人处领取薪酬合计为 830.51 万元。

除上述薪酬待遇外，公司现任董事、历史监事、高级管理人员和核心技术人员未在公司享受其他待遇和退休金计划。

（十）董事、历史监事、高级管理人员、核心技术人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况

公司董事、历史监事、高级管理人员、核心技术人员最近三年不涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证

监会立案调查情况。

十二、本次申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排

（一）股权激励情况

截至本招股说明书签署日，为进一步完善公司法人治理结构，吸引和稳定优秀的管理、业务和技术人才，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，进一步建立长效员工激励和约束机制，实现公司与员工共赢之目的，公司通过设立员工持股平台方式对公司员工实施股权激励。发行人设立了共进同达和共进同达二号、共进同达三号三个有限合伙企业。共进同达于2016年9月通过向好达有限增资的方式成为发行人股东，共进同达二号于2023年9月通过受让好达投资持有的共进同达份额的方式成为发行人的间接股东。共进同达三号于2026年4月通过受让好达投资持有的共进同达份额的方式成为发行人的间接股东。

1、共进同达

企业名称	无锡市共进同达投资企业（有限合伙）			
成立时间	2015年8月26日			
认缴出资额	535.00万元			
实缴出资额	535.00万元			
注册地址和 主要生产经营地	无锡经济开发区高浪东路999（软件研发大厦）811-1室			
执行事务合伙人	刘平			
出资构成	序号	出资人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
	1	共进同达二号	77.5763	14.5002%
	2	共进同达三号	71.4258	13.3506%
	3	陆增天	59.9202	11.2000%
	4	王骏	50.0000	9.3458%
	5	倪山林	20.0000	3.7383%
	6	陆凤志	19.9601	3.7309%
	7	黄宇峰	15.0000	2.8037%
	8	丁艳	10.0000	1.8692%
	9	谢中华	10.0000	1.8692%

10	荣健	8.0000	1.4953%
11	刘明	8.0000	1.4953%
12	宋旭宇	8.0000	1.4953%
13	殷志芬	8.0000	1.4953%
14	严丽	8.0000	1.4953%
15	傅肃磊	8.0000	1.4953%
16	韦鹏	7.9761	1.4909%
17	毛宏庆	5.0000	0.9346%
18	丁昌亮	7.9761	1.4909%
19	吴庄飞	5.0000	0.9346%
20	袁建平	5.0000	0.9346%
21	张爱萍	5.9920	1.1200%
22	王善良	5.0000	0.9346%
23	谢学文	5.0000	0.9346%
24	周庆华	5.9920	1.1200%
25	掌庆冠	7.9761	1.4909%
26	梅从祥	5.0000	0.9346%
27	李佳铭	7.9761	1.4909%
28	许志斌	5.0000	0.9346%
29	杨明亮	5.0000	0.9346%
30	陈庆贵	7.9761	1.4909%
31	孙昭苏	7.9681	1.4894%
32	李壮	7.9601	1.4879%
33	王绍安	3.0000	0.5607%
34	凡秀东	3.9920	0.7462%
35	董湘娟	3.9920	0.7462%
36	张莉	3.0000	0.5607%
37	王志祥	4.9840	0.9316%
38	万刚	3.0000	0.5607%
39	陈立右	7.9601	1.4879%
40	张德森	4.9840	0.9316%
41	陈猛	3.9920	0.7462%
42	华明	2.0000	0.3738%
43	陈敏伟	2.0000	0.3738%

	44	刘平	2.2314	0.4171%
	45	好达投资	0.1894	0.0354%
	合计		535.0000	100.0000%

截至本招股说明书签署日，好达投资股东为刘平、刘思羽、林强，荣健、万刚为已退休员工，梅从祥为离职员工，谢中华为外部顾问，其余均为公司员工（含退休返聘）。

根据股权激励协议，在服务期内如激励对象与公司劳动关系解除、终止，激励对象的股份由共进同达以原购买价回购，在此期间获得的分红退还给合伙企业。服务期满后，如激励对象因退休、岗位调整、正常离职且获得公司书面批准的情况下，激励对象可要求公司回购所持股份。共进同达已出具关于股份锁定的承诺，承诺具体内容请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、高级管理人员及其他核心技术人员以及保荐人、证券服务机构作出的重要承诺及其履行情况和约束措施”相关内容。

2、共进同达二号

企业名称	无锡市共进同达二号投资合伙企业（有限合伙）			
成立时间	2023年7月20日			
认缴出资额	782.00万元			
实缴出资额	782.00万元			
注册地址和 主要生产经营地	无锡经济开发区高浪东路999号（软件研发大厦）811-3室			
执行事务合伙人	刘平			
出资构成	序号	出资人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
	1	冯卓	100.0000	12.7877%
	2	沈振	50.0000	6.3939%
	3	王亚	30.0000	3.8363%
	4	程涛	30.0000	3.8363%
	5	胡晓峰	30.0000	3.8363%
	6	王万波	30.0000	3.8363%
	7	华诗宜	30.0000	3.8363%
	8	万玮	30.0000	3.8363%
	9	黄其军	30.0000	3.8363%

10	赵菲	30.0000	3.8363%
11	林力	30.0000	3.8363%
12	李飞	20.0000	2.5575%
13	钱淼	20.0000	2.5575%
14	刘朋虎	20.0000	2.5575%
15	朱洪雷	20.0000	2.5575%
16	刘言喆	20.0000	2.5575%
17	仓定元	20.0000	2.5575%
18	郑大霞	20.0000	2.5575%
19	冯丽娟	20.0000	2.5575%
20	王向阳	20.0000	2.5575%
21	陆凯健	20.0000	2.5575%
22	鲁明升	20.0000	2.5575%
23	王睿	16.0000	2.0460%
24	周军卫	10.0000	1.2788%
25	宋文杰	10.0000	1.2788%
26	周鸿燕	10.0000	1.2788%
27	朱洪雨	10.0000	1.2788%
28	胡亚巧	10.0000	1.2788%
29	董伟学	10.0000	1.2788%
30	郑宾宾	10.0000	1.2788%
31	钱艳花	10.0000	1.2788%
32	王新高	10.0000	1.2788%
33	李建跃	10.0000	1.2788%
34	张伟	10.0000	1.2788%
35	殷一峰	10.0000	1.2788%
36	袁伟	5.0000	0.6394%
37	刘平	1.0000	0.1279%
合 计		782.0000	100.0000%

截至本招股说明书签署日，共进同达二号共有 37 名合伙人，均为公司员工。

根据股权激励协议，激励对象在服务期内与公司劳动关系解除、终止，激励对象的权益份额由转让方以原购买价回购，在此期间获得的分红退还给合伙企业。

服务期满后，如激励对象因退休、岗位调整、正常离职且获得公司书面批准的情况下，激励对象可要求转让方回购所持权益份额。共进同达二号已出具关于股份锁定的承诺，承诺具体内容请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、高级管理人员及其他核心技术人员以及保荐人、证券服务机构作出的重要承诺及其履行情况和约束措施”相关内容。

3、共进同达三号

企业名称	无锡市共进同达三号投资合伙企业（有限合伙）			
成立时间	2026年1月16日			
认缴出资额	993.60万元			
实缴出资额	993.60万元			
注册地址	无锡经济开发区高浪东路999号启航大厦811-2室			
执行事务合伙人	刘平			
出资构成	序号	出资人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
	1	沈振	179.4000	18.0556%
	2	夏健	138.0000	13.8889%
	3	秦晓艳	41.4000	4.1667%
	4	谢建华	27.6000	2.7778%
	5	胡雨	27.6000	2.7778%
	6	朱洪雷	27.6000	2.7778%
	7	黄其军	27.6000	2.7778%
	8	胡亚巧	27.6000	2.7778%
	9	钱艳花	27.6000	2.7778%
	10	李大鹏	20.7000	2.0833%
	11	王睿	19.3200	1.9444%
	12	张宋连	13.8000	1.3889%
	13	张洋	13.8000	1.3889%
	14	蒋克	13.8000	1.3889%
	15	丁延彬	13.8000	1.3889%
	16	王健	13.8000	1.3889%
17	徐波	13.8000	1.3889%	

18	拜彦孚	13.8000	1.3889%
19	唐纪鹏	13.8000	1.3889%
20	李娴	13.8000	1.3889%
21	赵子聪	13.8000	1.3889%
22	陈湘	13.8000	1.3889%
23	汤剑惠	13.8000	1.3889%
24	王浩威	13.8000	1.3889%
25	徐斌	13.8000	1.3889%
26	毕玉梅	13.8000	1.3889%
27	李祥振	13.8000	1.3889%
28	陈云姣	13.8000	1.3889%
29	陈思蓉	13.8000	1.3889%
30	徐宝林	13.8000	1.3889%
31	张帅	13.8000	1.3889%
32	王海锋	13.8000	1.3889%
33	徐华萍	13.8000	1.3889%
34	周菊芬	13.8000	1.3889%
35	陈子煜	13.8000	1.3889%
36	石海平	13.8000	1.3889%
37	李建跃	13.8000	1.3889%
38	冯丽娟	13.8000	1.3889%
39	郑大霞	13.8000	1.3889%
40	董伟学	13.8000	1.3889%
41	冯青青	13.8000	1.3889%
42	李超	6.9000	0.6944%
43	李帅	6.9000	0.6944%
44	刘平	1.3800	0.1389%
合 计		993.6000	100.0000%

截至本招股说明书签署日,共进同达三号共有 44 名合伙人,均为公司员工。

根据股权激励协议,激励对象在服务期内与公司劳动关系解除、终止,激励对象的权益份额由转让方以原购买价回购,在此期间获得的分红退还给合伙企业。服务期满后,如激励对象因退休、岗位调整、正常离职且获得公司书面批准的情

况下，激励对象可要求转让方回购所持权益份额。共进同达三号已出具关于股份锁定的承诺，承诺具体内容请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、高级管理人员及其他核心技术人员以及保荐人、证券服务机构作出的重要承诺及其履行情况和约束措施”相关内容。

（二）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权等方面的影响

1、股权激励对公司经营情况的影响

通过实施股权激励，公司建立、健全了激励机制，充分调动了公司中高层管理人员及骨干员工的工作积极性。

2、股权激励对公司财务状况的影响

为公允地反映股权激励对公司财务状况的影响，公司就股权激励相关事项确认了股份支付。报告期各期，公司确认的股份支付金额分别为 1,225.64 万元、1,559.32 万元、892.98 万元，对公司的净利润会产生一定程度的影响。

3、股权激励对公司控制权变化的影响

股权激励实施前后，公司控制权未发生变化。

十三、员工及其社会保障情况

（一）员工结构

报告期各期末，公司员工总数分别为 582 人、563 人和 599 人。截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工的岗位构成分布如下：

单位：人

岗位情况	人数	占员工总数比例
管理人员	60	10.02%
生产人员	413	68.95%
研发人员	90	15.03%
销售人员	36	6.01%
合计	599	100.00%

（二）公司执行社会保障制度、住房公积金制度及医疗保险制度情况

公司按照国家 and 地方有关规定执行社会保障和住房公积金制度，为员工办理并缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险和住房公积金。

报告期各期末，公司在册员工社会保险和住房公积金缴纳情况如下：

单位：人

项目	2025年12月31日				2024年12月31日				2023年12月31日			
	总人数	应缴人数	缴纳人数	差异	总人数	应缴人数	缴纳人数	差异	总人数	应缴人数	缴纳人数	差异
社会保险	599	567	565	2	563	531	530	1	582	549	548	1
住房公积金		567	565	2		531	530	1		549	535	14

报告期末，发行人社会保险、住房公积金应缴人数与总人数的差异系退休返聘人员、社保买断人员无需缴纳社会保险和住房公积金。

2023年末、2024年末、2025年末，公司应缴未缴社会保险人数分别为1人、1人、2人，均为当月新入职员工。

2023年末、2024年末、2025年末，公司应缴未缴住房公积金人数分别为14人、1人、2人，均为当月新入职员工。

根据发行人及其分公司所在地社会保险、住房公积金管理部门出具的合规证明或信用中国网站显示的“有无违法违规记录”查询记录，确认报告期内公司未发生因违反社会保障法律、法规而被处罚的情形，不存在因违反住房公积金相关的法律、法规而受到处罚的情形。

（三）劳务派遣情况

公司劳务派遣人员占公司用工总量的比例未超过10%，符合《劳务派遣暂行规定》关于“使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%”的规定，且该等劳务派遣人员的主要工种为临时性、辅助性或可替代性强的工作，符合《劳动合同法》《劳动合同法实施条例》及《劳务派遣暂行规定》等法律法规的相关规定

第五节 业务与技术

一、发行人主营业务及主要产品的情况

（一）主营业务概况

公司主要从事声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售，是国内极少数具备芯片设计、晶圆制造、封装测试于一体的全链条自主可控并规模化量产出货的 IDM 企业，主要产品包括滤波器、双工器、谐振器等。公司构建了以 SAW、TC-SAW 及 TF-SAW 为核心的技术平台，拥有领先的滤波器晶圆制造产线及 SMD、CSP、WLP、Bare-Die 等封装产线，形成了涵盖低频、中频、高频的完整产品体系，实现了 300MHz 到 6GHz 关键频段的全面覆盖，是国内声表面波滤波器龙头企业。

公司历经二十余年深耕，成为突破国外技术垄断、保障产业链安全和实现国产替代的中坚力量。在国内，公司率先实现技术难度、工艺一致性及温漂控制要求更高的 TC-SAW 产品量产出货，率先实现高集成度收发模组用晶圆级封装（WLP）滤波器的量产出货，确立了国内声表面波滤波器领域的领先地位。公司已建成年产能达 60 亿¹颗的规模化交付体系，报告期内产品出货量近 100 亿颗，其中，WLP 滤波器出货量超 1.5 亿颗，TC-SAW 产品的出货量超 14.5 亿颗，均位居国内前列。

公司自成立以来，持续加大研发投入和技术创新，在声表面波滤波器技术关键领域实现全面的技术布局。在芯片设计方面，独立自主开发系列仿真软件和 EDA 开发平台，实现了全系列产品高精度设计；在芯片制造方面，率先突破了高质量 SiO₂ 温度补偿薄膜的沉积工艺和修频难题，实现了温度漂移系数的降低以及 Q 值的提升，完成了更高工艺复杂度和技术难度的 TC-SAW 滤波器制造工艺开发，实现了规模化量产；在封装测试环节，2012 年国内首条金凸点 CSP 声表面波滤波器封装产线量产出货，2020 年国内首条效率更高的锡凸点 CSP 声表面波滤波器封装产线量产出货，2020 年国内首条 WLP 声表面波滤波器封装产线量产出货；公司致力于 POI 材料的研究，针对常规 POI 材料无法满足的应用场景，

¹ 60 亿颗是指单滤波器数量的合计

通过自主设计、自主制备新型 POI 材料，满足了客户的高性能超宽带和窄带滤波器等需求；在创新方面，长期专注于声表面波基础研究和前沿技术研究，作为国家滤波器领域科技攻关的核心单位，牵头承担或参与实施了 7 项国家级和 5 项省级重点科研项目，先后 2 次荣获国家科技进步二等奖以及多项省、部级奖项。

基于长期的技术积淀与完整的声表面波滤波器产品矩阵，公司精准把握下游终端客户的多样化需求，自成立以来持续突破市场壁垒，核心产品成功导入多个关键领域的头部客户供应链。凭借优异的产品性能与稳定的大规模交付能力，公司赢得了客户的广泛信赖，已成长为国内声表面波滤波器领域的头部供应商之一。公司客户覆盖智能终端、物联网、汽车电子、基站、低轨卫星通信等多个应用领域。其中智能终端领域客户包括 OPPO、vivo、小米、三星、中兴、荣耀、传音、联想等一线知名手机品牌，以及华勤、龙旗、天珑、闻泰、立讯等头部 ODM 厂商；物联网领域客户包括移远通信、广和通、中移物联、利尔达、美格智能等领先物联网模组企业；汽车电子领域终端客户包括比亚迪、小米、赛力斯等主流汽车品牌；基站领域客户包括中兴、罗森博格、京信等优质通信设备厂商；低轨卫星通信领域客户包括中兴、大唐等知名企业。2020 年公司率先向全球知名手机终端厂商提供技术先进的 WLP 滤波器，2023 年该全球知名手机终端厂商成为当年公司第一大客户。



(二) 主要产品概况

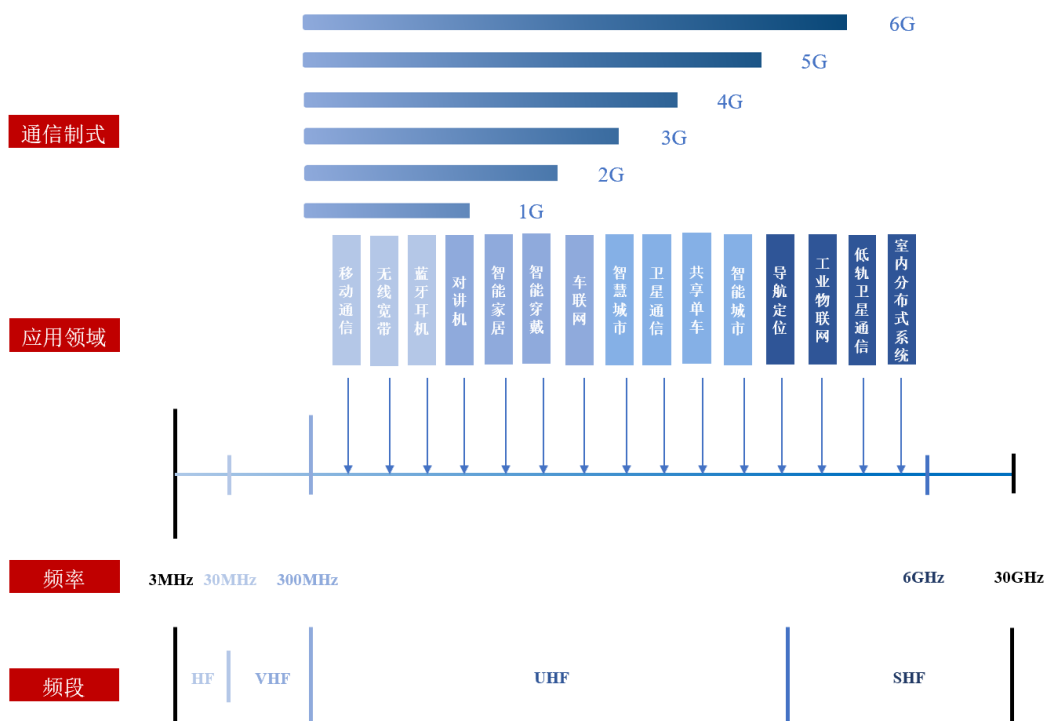
1、滤波器简介

滤波器是无线通信系统的核心器件，负责精准选择射频信号中有用频段信号

和滤除干扰信号，保障各类无线通信系统通信质量、数据传输速率及信号灵敏度。根据 Yole 的数据，滤波器的价值量占射频分立器件的 53%，是价值量最高也是体量最大的一类分立器件。

作为无线通信系统的核心元件，滤波器的技术演进与市场需求深度绑定。随着无线通信技术的演进与应用场景的拓展，所需支持的频段数量持续增加，频段范围从低频、中频延伸至高频和超高频。其中，300 MHz 至 6 GHz 频段是目前应用最为广泛的频谱资源，这一核心频段广泛应用于民用与工业应用领域，涵盖智能终端、物联网、汽车电子、基站、卫星通信等多个方向。在智能终端方面，智能手机、智能穿戴设备等均依赖该频段；在物联网方面，支持智能家居、智慧城市、无人机、机器人等海量连接场景；在汽车电子中，用于车载导航、智能辅助驾驶等；在基站和卫星通信领域，支持通讯基站与卫星通信终端等。上述广泛而多元的应用场景，对滤波器的性能、可靠性和成本提出了更高要求，亦持续驱动滤波器技术的创新与产业升级。

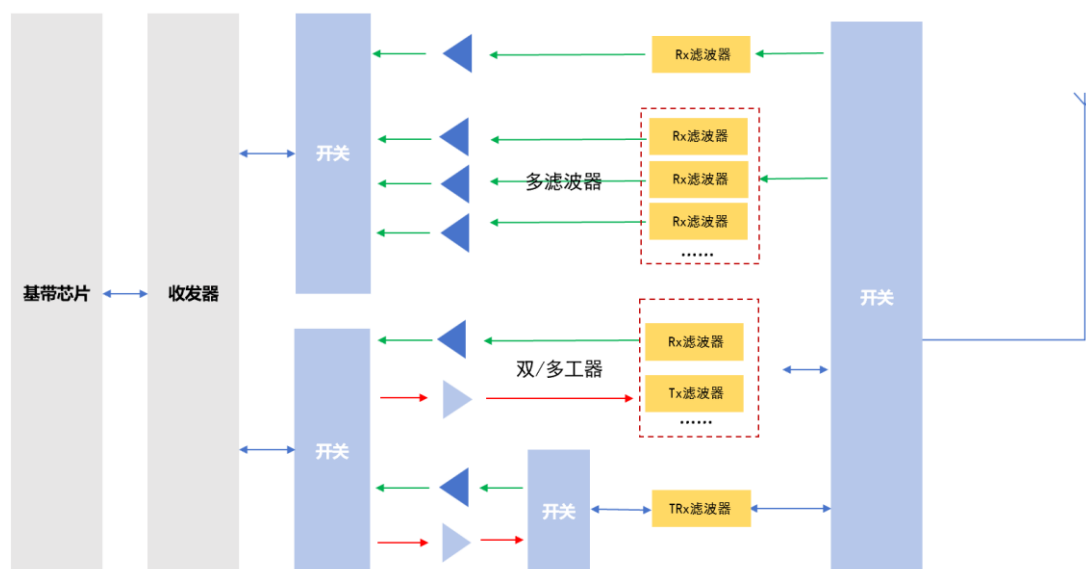
移动通信代际演进与下游应用领域分布



滤波器根据工作原理和制造工艺可分为多种类型，主要包括声表面波滤波器、

体声波滤波器、介质滤波器、LC 滤波器等，技术各具特色。其中，声表面波滤波器利用压电基板上的声波传播特性实现频率选择，具有频率选择性好、设计灵活、成本适中的优势，是移动通信领域、广域物联网领域、导航定位领域主流滤波器解决方案。

公司产品声表面波滤波器在无线通信系统中的位置



2、公司产品概况

公司主要产品包括滤波器、双工器、谐振器等。公司构建了完整的声表面波滤波器技术平台，具有行业的全系列封装形式，全面覆盖了智能终端、物联网、汽车电子、基站、低轨卫星通信等领域。在智能终端方面，涵盖智能手机、智能穿戴设备等；在物联网方面，支持智能家居、智慧城市、无人机、机器人等海量连接场景；在汽车电子领域，用于车载导航、智能辅助驾驶等；在基站和低轨卫星通信领域，包括通讯基站与卫星通信终端等。具体情况如下：

(1) 公司产品类型介绍

公司主营产品主要为滤波器和双工器。滤波器作为公司量级最大的产品类别，包含 Rx 滤波器、TRx 滤波器，以及多频段集成的多滤波器（SAW Bank）。公司的 Rx 滤波器系列已全面覆盖主流蜂窝通信频段，报告期内累计出货数十亿颗，持续被下游客户认可并广泛应用；单型号量级最大的 GPS L1 频段的滤波器在报

告期内累计出货达 6.7 亿颗，广泛应用于天线模组；新形态的多滤波器集成产品 SAW Bank 系列也已批量出货。

报告期内，公司双工器大类产品（包含双工器、多工器）销售快速增长，占主营业务收入的比例逐年上升，2025 年占比为 47.91%，其中主流频段 Band1、Band3、Band5、Band8 双工器系列累计出货达 18 亿颗，广泛应用于各大品牌手机产品和物联网通信模组。公司已批量供应数十款手机用 TC-SAW 双工器，覆盖多个主流频段，产品在芯片尺寸、电性能、封装适配性等方面对标国际主流厂商。此外，覆盖主流频段组合的四工器也已进入市场验证阶段，满足终端客户对小型化、集成化设计的核心需求。

类别	产品类型	产品介绍	产品应用领域
滤波器	Rx 滤波器	用于接收通道的滤波器	①智能终端：覆盖智能手机，智能穿戴，PDA 等移动设备中 LB、MB、HB 频段的滤波器、双工器、SAW Bank 等；频率覆盖 600MHz~2800MHz； ②物联网：公网物联网和专网物联；频率覆盖 600MHz~2800MHz； ③汽车电子：覆盖北斗、GPS, GLONASS, Galileo 全套导航系统滤波器；支持 4G、5G 车载通信用滤波器，双工器等；频率覆盖 600MHz~2800MHz； ④基站：覆盖宏基站、微站、小站、直放站等各种电信基础设施；频率覆盖 400MHz~6000MHz； ⑤低轨卫星通信：产品支撑低轨通信架构中的地面站、手持设备、轨道通信等多种通信终端；频率覆盖 300MHz~2300MHz； ⑥其他应用领域：应用于 CPE、工业路由器、无人机、NB-IoT 等领域设备；频率覆盖 300MHz~3500MHz；
	TRx 滤波器	集成发射和接收通道的滤波器，实现时分双工的功能，用于 TDD 模式	
	多滤波器 (SAW Bank)	集成多个不同频段的滤波器	
双工器	双工器	集成发射和接收通道的滤波器，实现频分双工的功能，用于 FDD 模式	④基站：覆盖宏基站、微站、小站、直放站等各种电信基础设施；频率覆盖 400MHz~6000MHz； ⑤低轨卫星通信：产品支撑低轨通信架构中的地面站、手持设备、轨道通信等多种通信终端；频率覆盖 300MHz~2300MHz； ⑥其他应用领域：应用于 CPE、工业路由器、无人机、NB-IoT 等领域设备；频率覆盖 300MHz~3500MHz；
	多工器	集成大于等于三个发射或接收通道，并共用一个副天线的滤波器。多用于 FDD 模式	
谐振器		对单频点的信号进行筛选的器件	汽车遥控、门帘遥控、空调遥控等各种遥控

注：FDD 和 TDD 是移动通讯信号处理的两种主要模式；FDD 指的是频分；TDD 指的是时分。

(2) 公司产品技术路线介绍

声表面波滤波器技术的演进经历了三个阶段，即 SAW、TC-SAW 和 TF-SAW。SAW 因其体积小、重量轻、成本低、性能优异，上世纪 90 年代起随着手机的

普及迎来爆发性增长，至今在主流手机市场还占有主导地位，但是因为具有较大的温度漂移和较低的 Q 值，逐渐无法完全满足移动通信发展的要求。TC-SAW 在改善温度特性同时，Q 值也得到大幅提升，2004 年推向市场后迅速成为中低频高性能滤波器的主流技术，近几年，随着技术进步，TC-SAW 成本进一步降低，功率耐受能力逐步提升，应用频段范围也逐步扩大，在滤波器市场表现出愈来愈强的竞争力，有取代部分 SAW 市场的趋势。TF-SAW 则是新一代革命性技术，具有极高 Q 值、优异的温度稳定性和更高的功率耐受能力，可以满足某些要求极高的应用场景，是未来向更高频段、大带宽及大功率极限性能演进的理想技术。公司的产品技术路线介绍如下：

产品技术路线	产品简介	产品特性	适用频段	结构示意图
SAW	采用钽酸锂、铌酸锂、石英等压电体材料作为衬底	设计灵活性大、成本较低、良好频率选择性（可选频率范围 300MHz~3.5GHz）	移动通信频段： 2G 至 4G 通信频段（Band 1-Band 41 等）、5G 通信部分频段（N28、N41、N77、N78 等） 非移动通信频段： 导航、WIFI，其他无线通信等频段	
TC-SAW	温度补偿声表面波（Temperature Compensated SAW）滤波器，通常指在叉指电极上覆盖 SiO ₂ 温补层的滤波器	能够改善 SAW 滤波器的温度性能，提升 Q 值、TCF 等关键性能指标（可选频率范围 300MHz~2.7GHz）	移动通信频段： 2G 至 4G 通信部分频段、5G 通信部分频段（N2、N3、N8、N20、N26、N28、N71 等） 非移动通信频段： 导航、WIFI，其他无线通信等频段	
TF-SAW	薄膜声表面波（Thin Film SAW）滤波器通常指采用压电单晶复合薄膜结构材料（POI）制备的滤波器	具有高 Q 值、低温漂、散热性良好等特点，全面提升 SAW 滤波器的产品性能。TF-SAW 在高频领域可达 6GHz，性能表现与 BAW 滤波器相当	移动通信频段： 2G 至 4G 通信部分频段（Band 40、Band 25、Band 1+3 等）、5G 通信部分频段（N41、N77、N78 等） 非移动通信频段： 导航、WIFI，其他无线通信等频段	

（3）公司产品封装形式介绍

目前，CSP 封装是声表面波滤波器分立器件最小封装形式。传统的 SMD 大封装因 4G/5G 时代频段激增、器件数量大幅提升而难以满足智能终端小型化需求，逐步被 CSP 封装替代，现主要应用于工业、航空、汽车等对器件可靠性要求高的领域。公司于 2012 年攻克 CSP 关键工艺，成功开发并量产手机用 CSP

封装声表面波滤波器与双工器。随着射频前端模组化，模组用滤波器多采用晶圆级封装（WLP）封装形式，比分立器件用的 CSP 封装滤波器尺寸更小。通过 WLP 封装工艺集成在射频前端模组中的滤波器尺寸更小、更薄、且散热性更好。公司于 2019 年成功开发晶圆级（WLP）封装技术，目前已成功量产数十款 WLP 封装声表面波滤波器。此外，裸芯片（Bare-Die）封装方案可用于对集成度要求较低的模组方案，封装灵活度高。

公司产品封装形式	公司典型产品示意图	封装特点	公司产品可支持封装尺寸
CSP		芯片级封装，小型化，广泛应用于消费电子	0.9mm*0.7mm ~2.5mm*2.0mm
SMD		高可靠性，大尺寸封装，广泛应用于工业、航天领域	2.5mm*2.0mm ~13.3mm*6.5mm
WLP		晶圆级封装，广泛应用于高集成度的模组方案	0.8mm*0.6mm~2.5mm*2mm
Bare-Die		裸 Die 封装方案，多用于接收集成模组	0.56mm*0.53mm~1.11*0.79mm

（三）主营业务收入构成

报告期内，公司主营业务收入按产品分类如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)
滤波器	33,325.81	49.64	31,793.35	52.63	25,570.22	61.41
双工器	32,167.80	47.91	26,659.44	44.13	13,460.52	32.33
谐振器	692.87	1.03	679.66	1.13	1,006.94	2.42
其他	954.79	1.42	1,278.82	2.12	1,602.64	3.85
合计	67,141.27	100.00	60,411.28	100.00	41,640.32	100.00

（四）公司的经营模式

1、经营模式

滤波器行业产业链涵盖芯片设计、晶圆制造、封装测试三大环节，经营模式主要分为 IDM 模式和垂直分工模式。IDM 模式下，企业独立完成滤波器的研发设计、晶圆制造及封装测试所有环节，对设计与工艺的协同能力、技术储备及资金实力要求极高；垂直分工模式下，芯片设计企业专注于芯片设计，将晶圆制造和封测环节分别外包给晶圆代工厂和封测代工厂。

IDM 模式因其能够实现从产品设计、压电材料开发、晶圆制造到封装测试的全链条一体化协同，已成为全球领先滤波器企业普遍采用的主流模式，尤其在高性能、高可靠性产品的规模化供应方面具备显著优势。该模式要求企业具备持续的工艺研发能力与相应的资本投入能力，但其对核心技术与关键产能的自主控制力，为企业构筑了长期且稳固的竞争壁垒。

公司与国际声表面波滤波器厂商的经营模式情况

公司名称	国家	经营模式
Murata（村田）	日本	IDM 模式
Qualcomm（高通）	美国	IDM 模式
Taiyo（太阳诱电）	日本	IDM 模式
Skyworks（思佳讯）	美国	IDM 模式
Qorvo（威讯）	美国	IDM 模式
Wisol（威盛）	韩国	IDM 模式
发行人	中国	IDM 模式

公司选择 IDM（垂直整合制造）模式，主要源于行业技术特征、供应链安全需求及竞争格局。具体原因如下：

第一，技术协同与持续创新的必然要求。声表面波滤波器的核心性能高度依赖于压电材料特性与平面微纳制造工艺的深度耦合。IDM 模式通过设计与制程的实时协同与同步优化，在材料构成、器件结构、工艺参数等关键环节实现一体化创新，通过快速迭代攻克技术难题、突破工艺瓶颈，实现器件的高性能、小型化和高可靠性。同时，这一模式构建了可持续发展的技术平台，依托自主可控的

产线，能够高效完成 TC-SAW、TF-SAW 等前沿技术的工艺验证与量产转化，加速创新成果的产业化落地，并通过全链条工艺整合与协同效应持续提升产品竞争力。

第二，产能自主是满足客户需求的核心保障。首先，通过自主掌控从晶圆制造到封装测试的全链条环节，公司确保了关键产能的自主可控，有效规避了外部代工依赖带来的供应风险，满足客户的及时交付。同时，也可使公司能够及时响应消费电子市场的增量波动，协助客户及时抓住市场机遇。再者，针对智能终端、物联网、汽车电子、基站、低轨通信卫星、无人机等差异化应用场景，提供快速、可靠的定制化解决方案，构建了“供应链产能自主、市场需求响应敏捷”的竞争优势。

第三，行业竞争格局下的战略选择。在声表面波滤波器领域，全球头部滤波器企业均采用 IDM 模式，并已构建了深厚的技术与产能壁垒。公司选择同一发展路径，能够在相同竞争维度上快速积累核心竞争力，并通过持续投入逐步缩小与领先者的技术差距，最终在高性能滤波器国产化替代及新兴应用市场中确立优势地位。

2、研发模式

公司能够结合市场需求进行新产品开发，形成具有市场竞争力的声表面波射频芯片产品。由于信号频段复杂多样，对应的声表面波射频芯片也品类繁多。公司会先根据市场需求确定多个研发方向并进行研发立项，再针对具体规格型号的声表面波射频芯片进行开发验证或性能升级，从而在各研发方向上形成技术积淀与经验积累。

公司已形成较为完善的研发管理制度。对于采取创新设计或工艺的新产品，公司的设计开发流程需要经过开发立项、产品设计、样品测试和小批量试产四个阶段，并通过多次评审等方式对设计开发全过程进行有效控制。

公司研发机构主要为研发部和工程技术部，其中研发部主要负责策划并实施新材料、新产品研究和开发活动；工程技术部负责新工艺开发、产品落地以及产品工艺控制能力提升和制造技术改进。上述团队各司其职、分工协作，保障了公

司研发工作的高效推进。

(1) 开发立项阶段

销售部门根据市场趋势或客户需求提出新产品开发建议，并由研发部进行可行性分析。项目可行性评估通过后由研发部确定项目任务和计划，形成整套开发立项文件。

(2) 产品设计阶段

开发立项评审通过后，研发部正式进入产品设计阶段。研发人员会根据项目任务和计划进行产品设计，通过在设计开发平台上进行芯片仿真确定产品的雏形，初步确定材料清单、工艺参数等开发要素，形成整体设计方案。

(3) 样品试制阶段

设计方案通过评审后，由研发人员根据拟定的材料清单、工艺参数等开发要素进行样品生产和验证。若样品经检测后未达标，研发人员需对设计方案或工艺流程进行调整并重新进行样品生产和验证。样品测试通过后由研发部和品管部共同出具样品的检验报告，并形成产品规格书。

(4) 小批量试产阶段

样品通过验证并能够满足市场或客户需求后，将进入小批量试产阶段。当小批量成品的良品率能够满足量产要求时视为新产品开发成功，试产报告通过评审后根据订单或销售预测进入量产阶段。

3、采购模式

公司采购的原材料主要包括晶片、基板、基座、光刻胶、合金线、环氧树脂、光掩膜等。公司的采购工作由计划部、物料部和品管部共同参与。计划部根据销售部提供的销售计划，物料部提供的原材料库存情况和采购周期等，并结合对市场需求预测，制定采购计划和生产计划；物料部根据采购计划，向供应商下达原材料采购订单；品管部负责对原材料进行质量检测，原材料经检测合格后进入合格品库。

公司已建立较为完善的合格供应商管理制度。新供应商的引入需要通过品管

部的资质审查、现场考察（如必要）和样品检验，同时每季度品管部会根据供应商在产品质量、服务质量、产品价格和产品交期等方面的表现进行考核评定，并据此调整合格供应商名单。

4、生产模式

公司主要采用“以销定产+合理库存”的生产模式，公司销售部门依据市场和客户需求制定销售计划，计划部依据销售计划制定生产计划，并下发至各生产车间，各生产车间依据生产计划制定并监控每日生产日程。公司计划部同步完成原材料采购计划，由物料部进行原材料交期管理。公司的晶圆生产由芯片制造部门完成，晶圆完成后交由公司封测制造部进行产品封装和测试。品管部负责生产过程中的质量管理、质量检验、质量监督，确保产品质量符合要求。

5、销售模式

公司采用直销和经销相结合的销售模式。在直销模式下，客户直接向公司下订单，公司根据客户订单或需求计划组织生产，公司针对大部分客户采用非寄售模式销售，对于少量客户采取寄售模式销售；在经销模式下，公司与经销商之间进行买断式销售。公司采用直销、经销相结合的销售模式符合行业惯例，既能够及时了解大型客户需求并针对性提供产品与服务，又能够提高对中小型客户的服务效率，从而不断扩大客户群体，提升品牌知名度与市场竞争力。

6、发行人采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及其在报告期内及未来的变化趋势

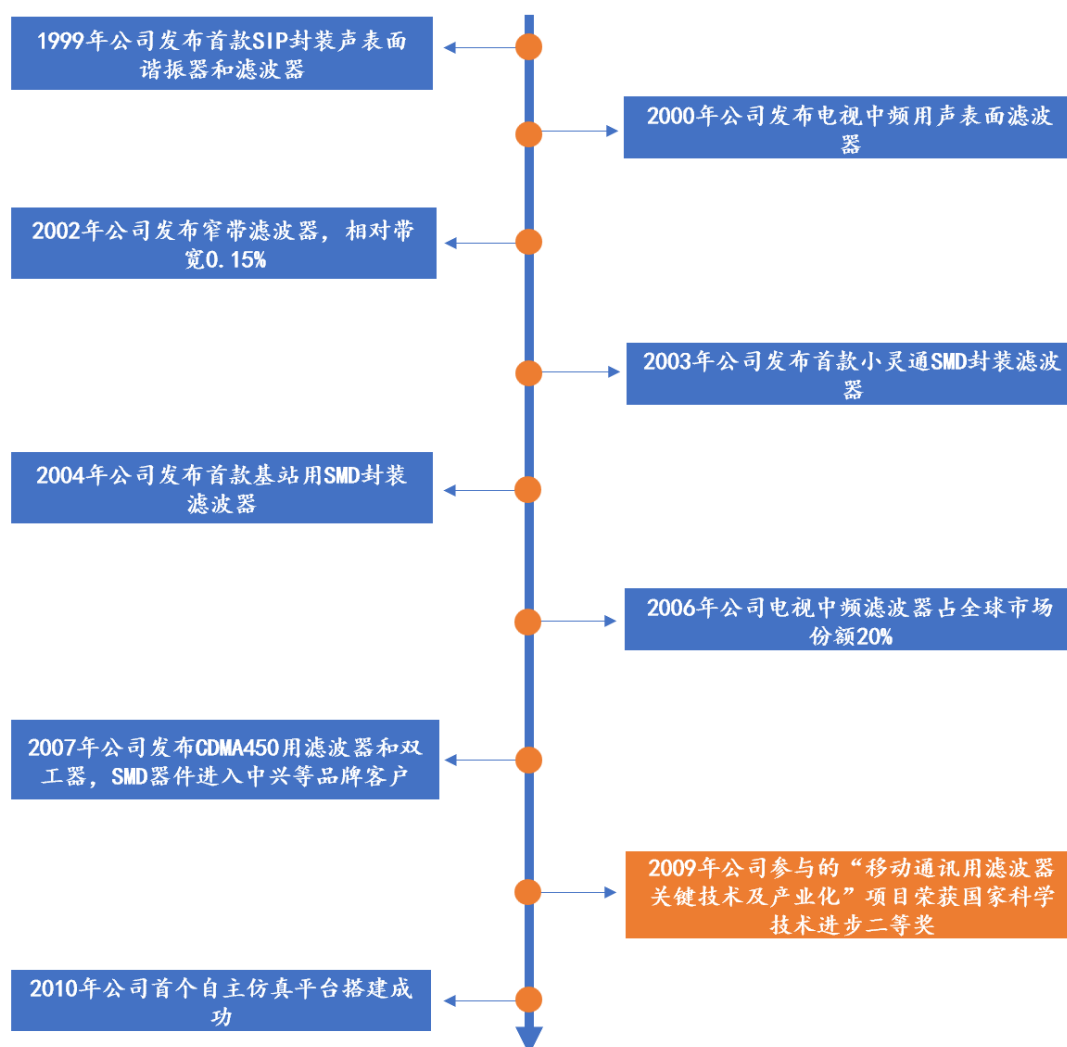
公司结合公司主营业务、所处行业特点、上下游产业链、核心技术能力、自身发展阶段等因素，形成目前的经营模式。报告期内，在现有经营模式下公司业务快速发展，同时上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化。预计未来公司经营模式不会发生重大变化。

（五）设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况

发行人主营业务为声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售。自成立之日起，公司主要产品的开发及演变情况如下：

1、第一阶段（成立至 2013 年）：技术积累与市场突破

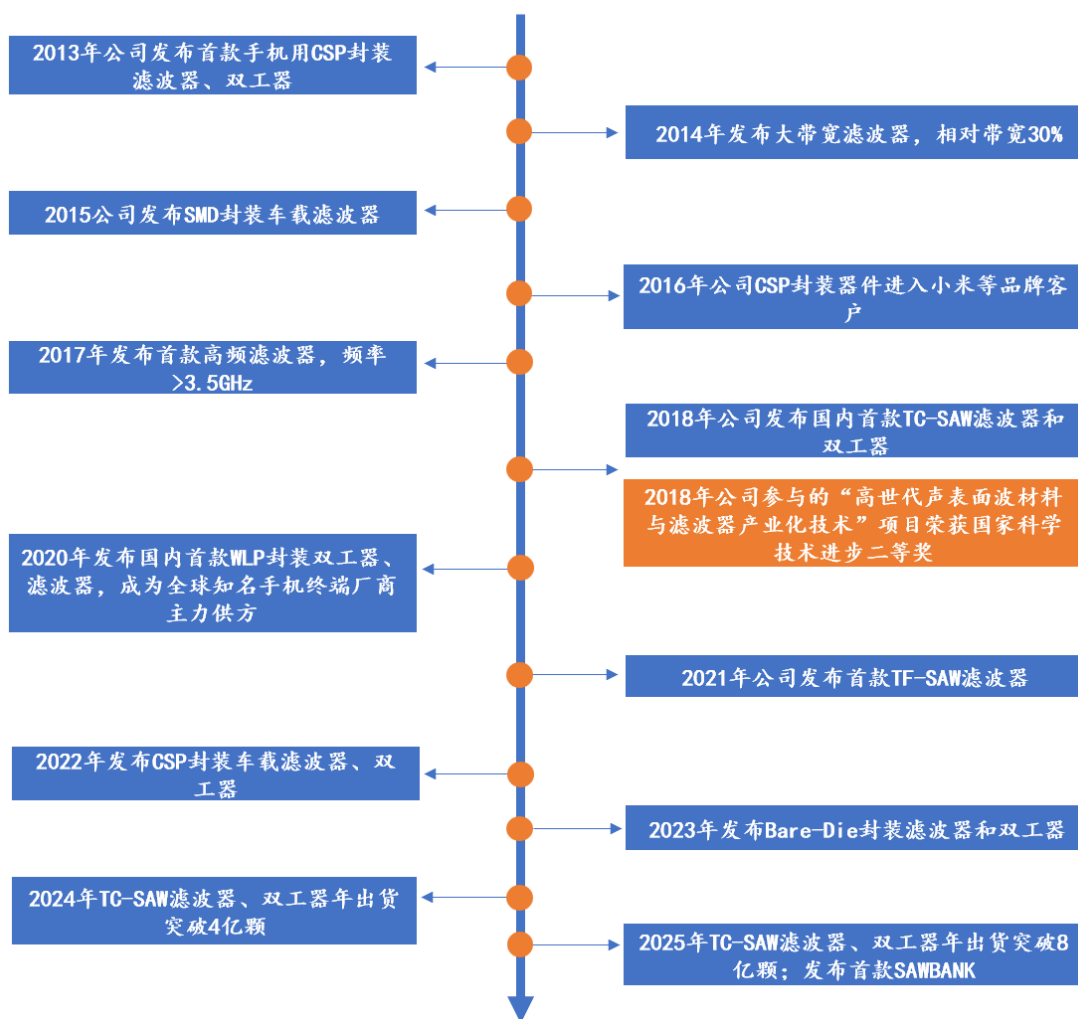
好达电子自 1999 年成立以来，通过自主研发构建了声表面波射频芯片的核心技术能力。公司发展初期以电视中频声表面波滤波器打开市场，至 2006 年占据全球 20% 份额。2009 年凭借“移动通信用滤波器关键技术及产业化”荣获国家科学技术进步二等奖，奠定了行业领先地位。公司于 2010 年建成首个射频仿真平台，为后续的持续自主创新与新产品开发奠定了坚实基础。



2、第二阶段（2013 至今）：创新发展与产业引领期

2013 年公司声表面滤波器产品进入智能手机市场，通过持续的产品迭代，在大带宽、小型化、封装形式等方面不断实现突破，并于 2018 年再次荣获国家科学技术进步二等奖。2020 年公司推出国内首款 WLP 滤波器、双工器，应用于 L-PAMiD、FEM 等高集成度模组，填补了国内空白。公司 TC-SAW 产品的出货

量超 14.5 亿颗，位居国内前列。



（六）主要业务经营情况和核心技术产业化情况

公司主要从事声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售，2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司的营业收入分别 41,851.74 万元、60,655.03 万元和 67,465.69 万元，呈快速增长的趋势。报告期内，公司主要业务经营情况良好，具体经营情况和财务数据参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”的相关内容。公司核心技术广泛应用于公司主营业务中，报告期内核心技术产品分别实现收入 40,037.68 万元、59,132.46 万元和 66,186.48 万元，占营业收入的比例均为 95.67%、97.49%、98.10%，发行人的核心技术产业化能力强。

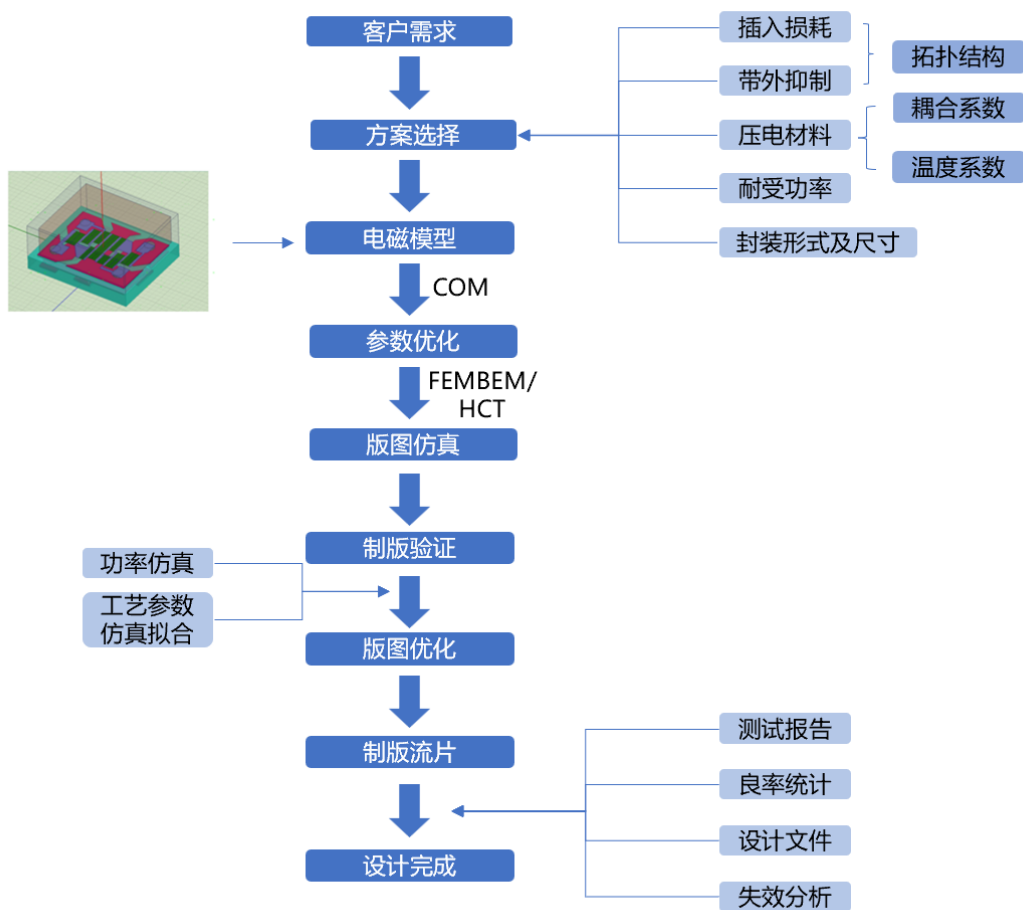
（七）主要产品的设计、工艺流程图

公司产品的设计、工艺流程主要包括芯片设计开发、晶圆制造、后道封装和

芯片测试四个环节。

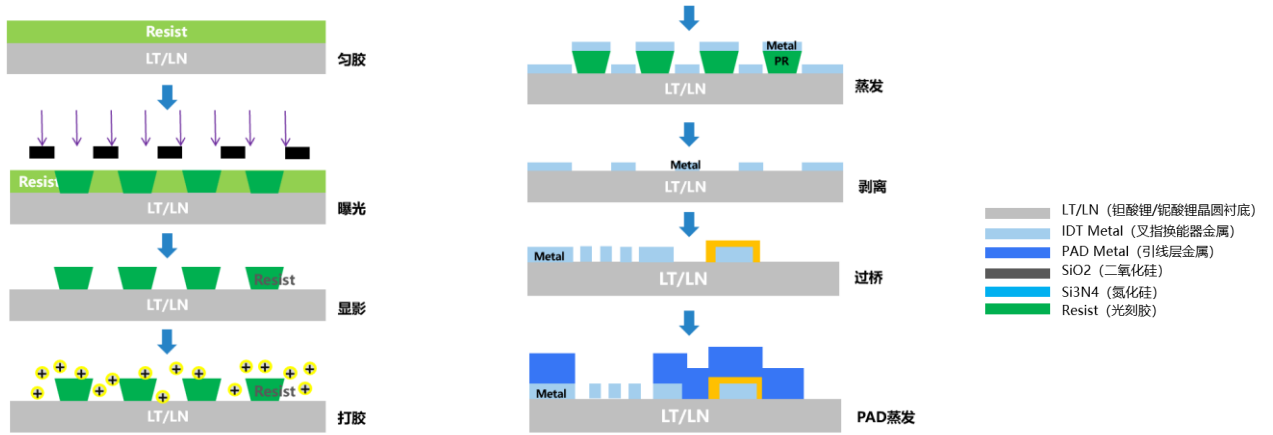
1、芯片设计

公司建立了从客户需求、方案选择、电磁模型、参数优化、版图仿真、制版验证、版图优化、制版流片、设计完成的全流程芯片设计开发体系。

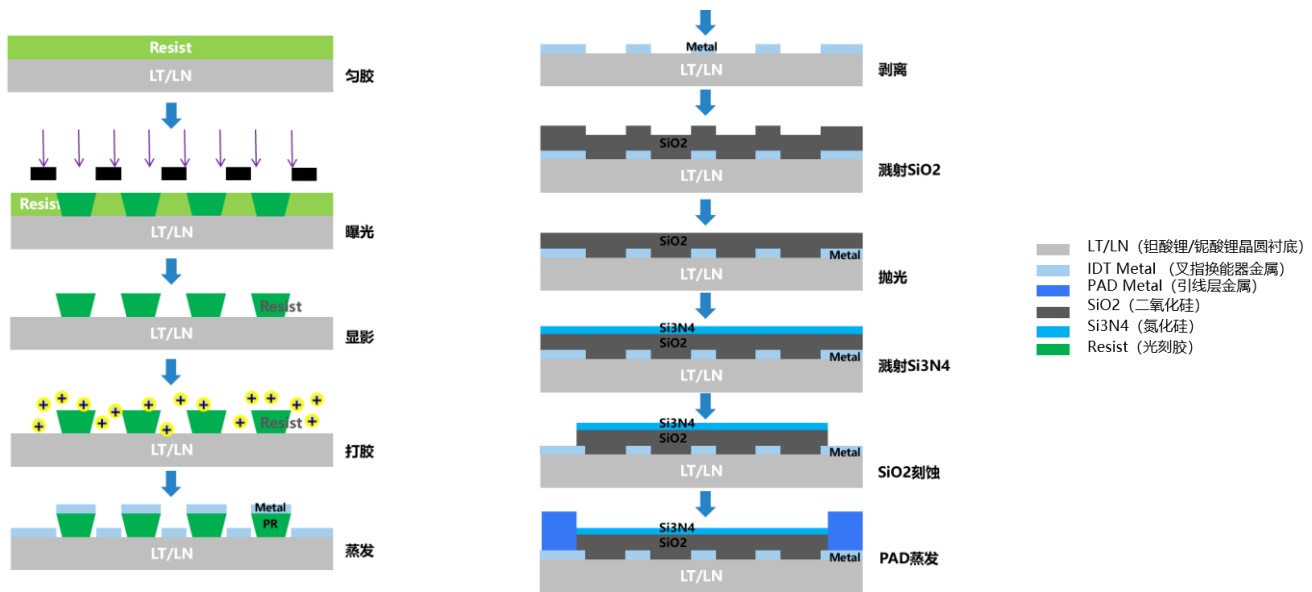


2、晶圆制造

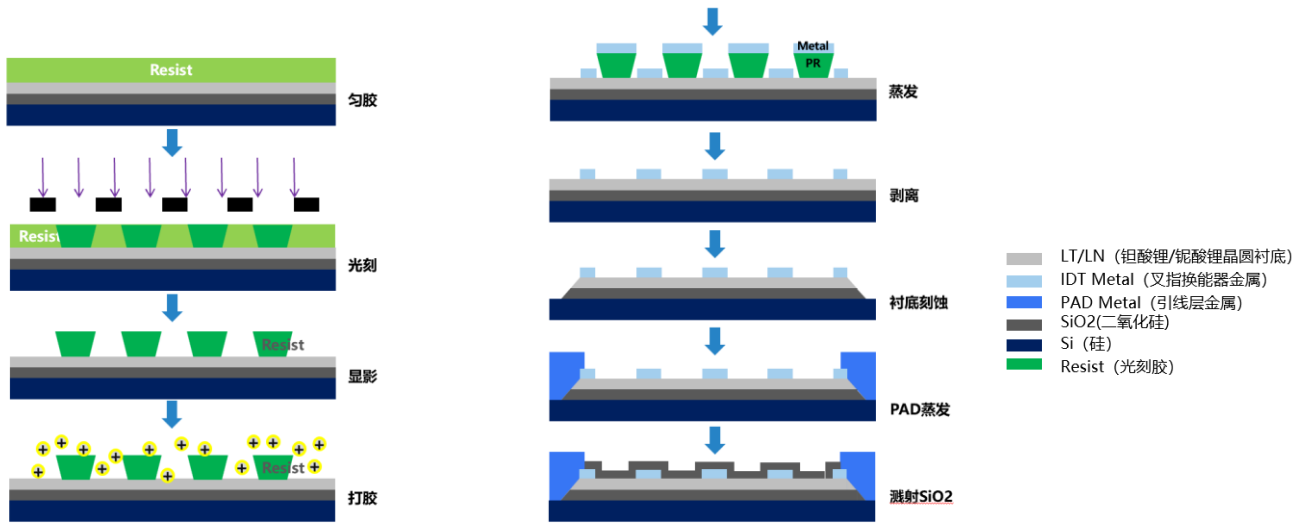
(1) SAW 工艺流程图



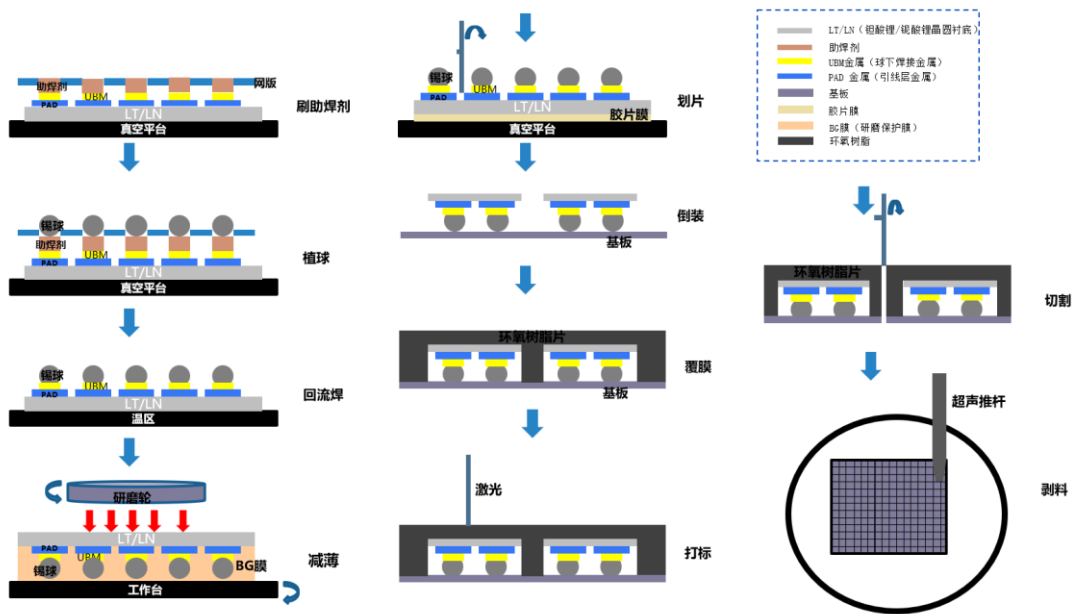
(2) TC-SAW 工艺流程图



(3) TF-SAW 工艺流程图



3、芯片封装



4、芯片测试

公司芯片测试环节包括 CP 测试和 FT 测试，其中 CP 测试是对晶圆上的裸晶粒进行测试，而 FT 测试是对封装后的独立芯片进行最终测试。

(八) 公司具有代表性的业务指标及其变动情况

根据公司所处行业和自身经营的特点，公司具有代表性的财务指标为主营业

务收入增长率、研发费用率等，上述指标对公司业绩的变动具有较强的预示作用。上述财务指标的变动情况参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“七、经营成果分析”。

（九）符合产业政策和国家经济发展战略的情况

声表面波滤波器行业的发展高度契合国家产业政策和经济发展战略。作为智能终端、物联网、基站、汽车电子、低轨卫星通信等战略性新兴产业的核心基础元件，该行业直接受益于国家关于推动电子信息制造业高质量发展、提升产业链供应链韧性与安全水平的宏观导向。具体情况参见本节之“二、（二）所属行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策”。

二、发行人所处行业的基本情况

（一）所属行业及确认所属行业的依据

公司主营业务是声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，公司所处行业为“二十八、信息产业”之“5. 新型电子元器件制造”，属于鼓励类行业。

根据《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司所处行业属于“1. 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”；根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》，公司的行业领域属于“新一代信息技术领域”中的“半导体和集成电路”领域，符合科创板行业领域的要求。

（二）所属行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策

1、所属行业主管部门、监管体制

公司所处的行业大类为电子设备制造业，政府主管部门为工业和信息化部、行业自律组织为中国电子元件行业协会。

具体行业管理体制如下：

机构名称	职能
行政管理部门	
工业和信息化部	研究拟定信息化发展战略、方针政策和总体规划；推动产业结构战略性调整和优化升级；拟订本行业的法律、法规，发布行政规章，组织制定行业的技术政策、技术体制和技术标准，并对行业的发展方向进行宏观调控；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。
行业自律组织	
中国电子元件行业协会	中国电子元件行业协会由电子元件行业的企（事）业单位自愿组成的、行业性的、全国性的、非营利性的社会组织，协会下设电感器件行业分会等 15 个分会。该行业协会的主要职能是开展行业调查研究和经营活动数据统计分析，加强行业自律，维护市场竞争环境，组织新产品鉴定、科研成果评审、行业标准制订和质量监督等工作。

2、所属行业主要法律法规政策

为了推动声表面波射频芯片行业的发展，国家出台了一系列鼓励、扶持政策，为声表面波射频芯片行业技术研发及应用建立了良好的政策环境。近年来国家颁布、实施的主要产业政策情况如下：

序号	主要政策	发布时间	发文单位	相关内容
1	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	2026 年	国务院	聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破
2	《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》	2025 年	工业和信息化部、市场监督管理总局	推动 5G/6G 关键器件、芯片、模块等技术攻关，加强 6G 技术成果储备
3	《国家发展改革委等部门关于做好 2025 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知》	2025 年	国家发展改革委工业和信息化部财政部海关总署税务总局	明确了 2025 年享受税收优惠的集成电路企业及软件企业的标准、程序和要求：“集成路线宽小于 65 纳米（含）的逻辑电路、存储器生产企业，线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产企业，集成路线宽小于 0.5 微米（含）的化合物集成电路生产企业和先进封装测试企业”
4	《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》	2024 年	国家统计局	“移动通信用宽频带滤波器”属于新一代信息技术产业，被明确为战略性新兴产业。
5	《工业和信息化部办公厅关于推进 5G 轻量化 Red Cap）技术演进和应	2023 年	工业和信息化部	构建 5G Red Cap（Reduced Capability 轻量化）产业体系。推动产业链上下游协同联动，推进 5G Red Cap 芯片、模组、终端、

序号	主要政策	发布时间	发文单位	相关内容
	《用创新发展的通知》			网络、仪表等产品研发和产业化，加快 Red Cap 与网络切片、高精度定位、5G LAN（局域网）等 5G 增强功能结合，满足不同行业场景应用需求。
6	《关于印发电子信息制造业 2023—2024 年稳增长行动方案的通知》	2023 年	工业和信息化部、财政部	聚焦集成电路、新型显示、服务器、光伏等领域，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，促进产业链上中下游融通创新、贯通发展，全面提升产业链供应链稳定性。
7	《2022 年国务院政府工作报告》	2022 年	国务院	要促进数字经济发展培育壮大集成电路、人工智能等数字产业。
8	《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023）》	2021 年	工业和信息化部等十部门	加快弥补产业短板弱项。加大基带芯片、射频芯片、关键射频前端器件等投入力度，加速突破技术和产业化瓶颈，带动设计工具、制造工艺、关键材料、核心 IP 等产业整体水平提升。
9	《关于推动 5G 加快发展的通知》	2020 年	工业和信息化部	加速 5G 应用模组研发，支撑工业生产、可穿戴设备等泛终端规模应用。持续支持 5G 核心芯片、关键元器件、基础软件、仪器仪表等重点领域的研发、工程化攻关及产业化，奠定产业发展基础。
10	《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》	2019 年	工业和信息化部	加快发展 5G 和物联网相关产业，深化信息化和工业化融合发展，打造工业互联网平台，加强工业互联网新型基础设施建设，推动关键基础软件、工业设计软件和平台软件开发应用，提高软件工程质量和网络信息安全水平。
11	《知识产权重点支持产业目录（2018 年本）》	2018 年	国家知识产权局	“下一代射频芯片”属于新一代信息技术产业，被明确为国家重点发展和亟需知识产权支持的重点产业。

3、行业监管体制、行业主要法律法规政策对发行人经营发展的影响

上述一系列支持法规和政策的推出和落实，为国内声表面波射频芯片行业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持，营造了良好的政策环境，有力推动了本土声表面波射频行业的发展，为公司提供了良好的发展机遇。

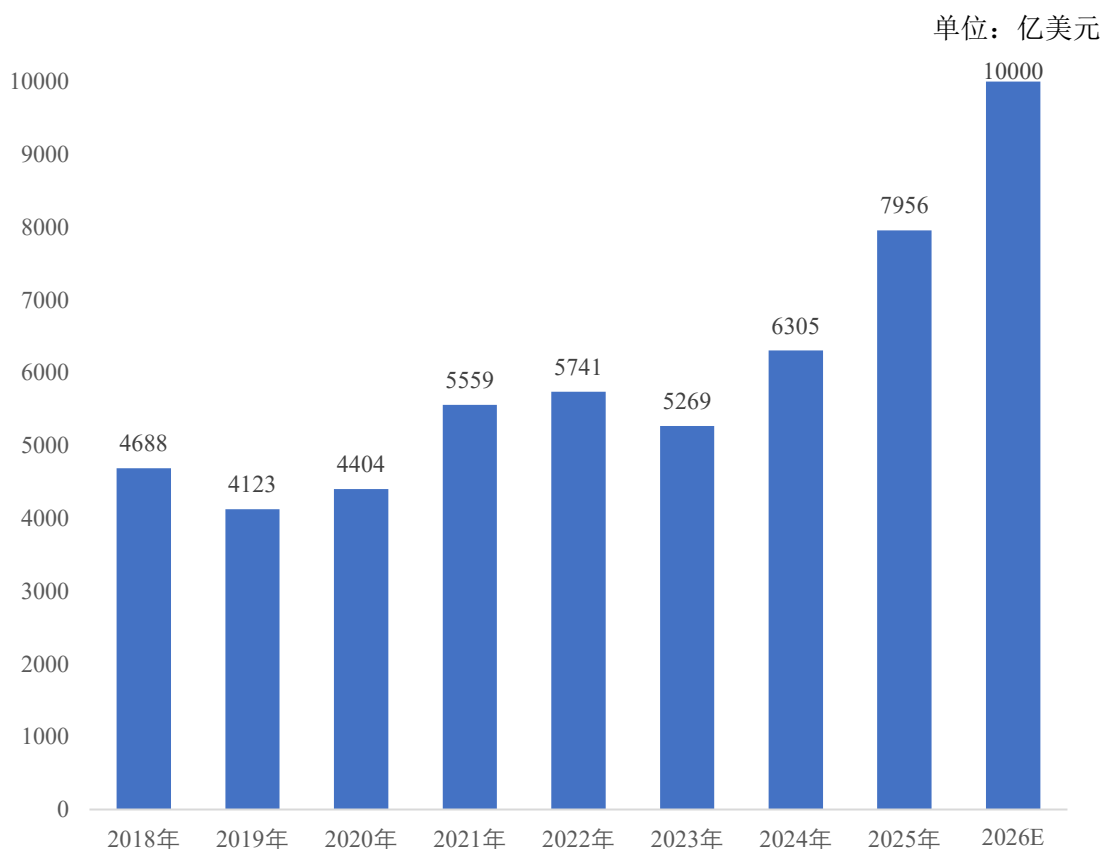
（三）行业发展状况及发展趋势

1、全球及中国集成电路行业概况

（1）全球集成电路发展状况

集成电路是现代电子技术的核心，通过将晶体管、电阻、电容等电子元件微缩互联于半导体晶圆之上，形成具备特定功能的微型电子电路。集成电路处于基础而关键的地位，其产业水平也成为评判一个国家科技和综合国力强弱的重要标志。据世界半导体贸易统计组织（WSTS）最新数据，全球集成电路市场在经历了 2022 至 2023 年的增速放缓后，于 2024 年逐步回暖，全球集成电路市场销售额为 6,305 亿美元，同比增长超过 19%；2025 年市场表现更为强劲，销售额攀升至 7,956 亿美元，同比增幅高达 26%。随着人工智能(AI)、高性能计算(HPC)、新能源汽车和物联网等新兴应用领域的持续驱动，2026 年全球集成电路销售额预计将延续增长态势，有望首次突破 1 万亿美元大关。

2018-2026 年全球集成电路销售额

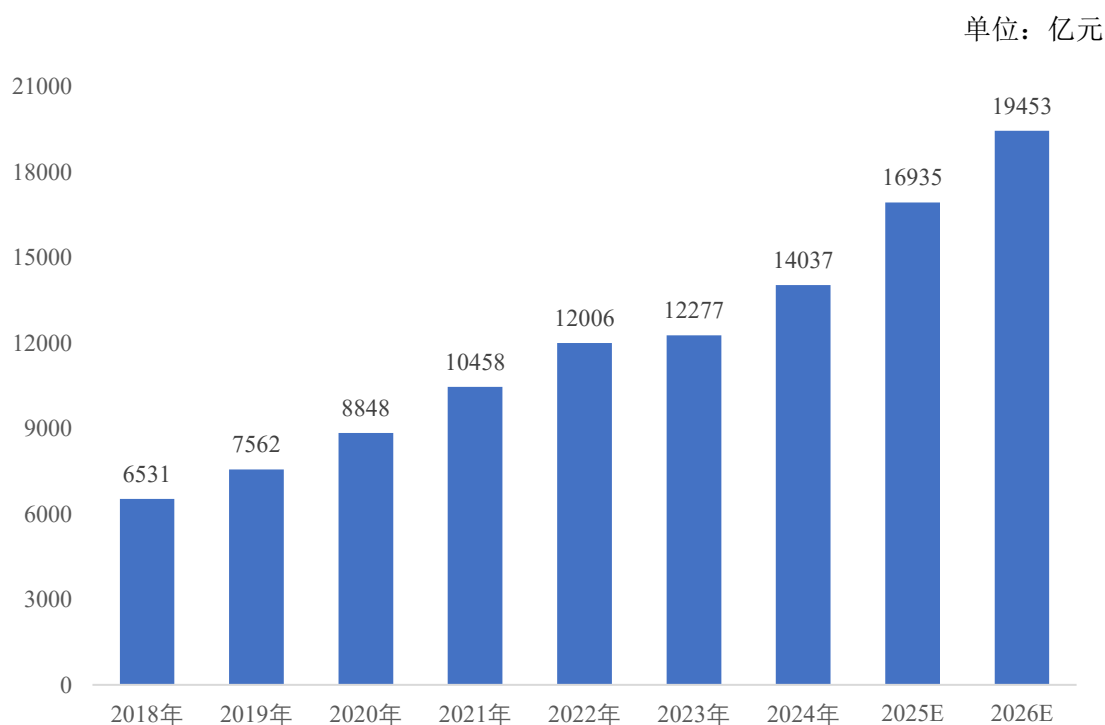


数据来源：WSTS

（2）中国集成电路发展状况

中国连续多年是全球最大的半导体消费国，其庞大的需求已成为驱动全球芯片产业发展的核心引擎。作为全球制造业中心与数字经济的巨人，中国每年进口的芯片金额长期超过 3,000 亿美元，消耗全球超过三分之一的芯片产量，从智能终端、新能源汽车到工业控制和人工智能设备，中国全产业链的蓬勃发展与终端产品的巨大产出，构成了对集成电路海量且持续增长的刚性需求。中国集成电路市场规模从 2018 年的 6,531 亿元增长至 2024 年的 14,037 亿元，期间年均复合增长率为 13.60%。未来，随着 AI、5G 等新兴领域的驱动、国内半导体产业链的自主化进程加快以及政策支持的增强，将继续保持高增长的态势，预计 2026 年中国集成电路市场规模预计达到 19,453 亿元。

2018-2026 年中国集成电路销售额



数据来源：中国半导体协会、弗若斯特沙利文

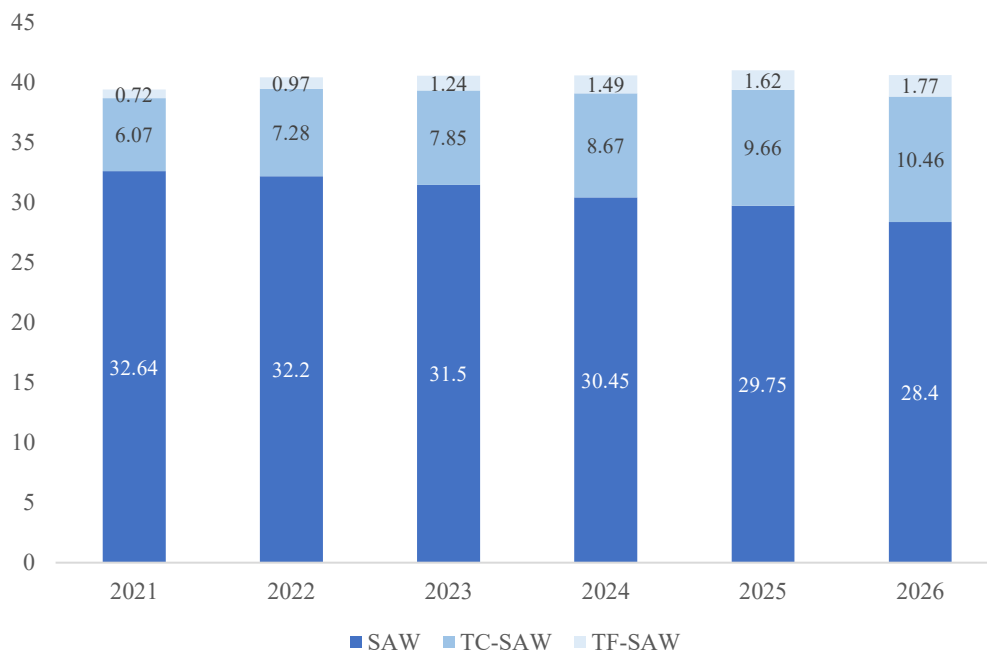
2、声表面波滤波器行业概况

根据 Yole 的数据，2021 年全球声表面波滤波器市场规模为 39.43 亿美元，2026 年预计达到 40.63 亿美元，市场规模较为稳定。其中，2021 年全球 TC-SAW、TF-SAW 产品市场规模为 6.07 亿美元、0.72 亿美元，2026 年预计 TC-SAW、

TF-SAW 产品市场规模为 10.46 亿美元、1.77 亿美元。2021 年至 2026 年，预计 TC-SAW 和 TF-SAW 产品的年均复合增长率为 11.50%和 19.71%。

全球声表面波滤波器市场规模

单位：亿美元



数据来源：Yole Development、浙商证券

3、声表面波滤波器行业下游应用市场情况

(1) 智能终端领域

射频前端包括功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、射频开关(RF Switch)、滤波器(Filter)等关键组件，其中滤波器是射频前端芯片中价值量最高的细分领域，其性能直接决定了设备的通信质量、频段支持能力和整体用户体验。智能手机作为声表面波滤波器最为重要的应用领域，主要应用在智能手机中的通讯(2G至5G)、导航(GPS、北斗等)、WIFI等无线通讯领域。

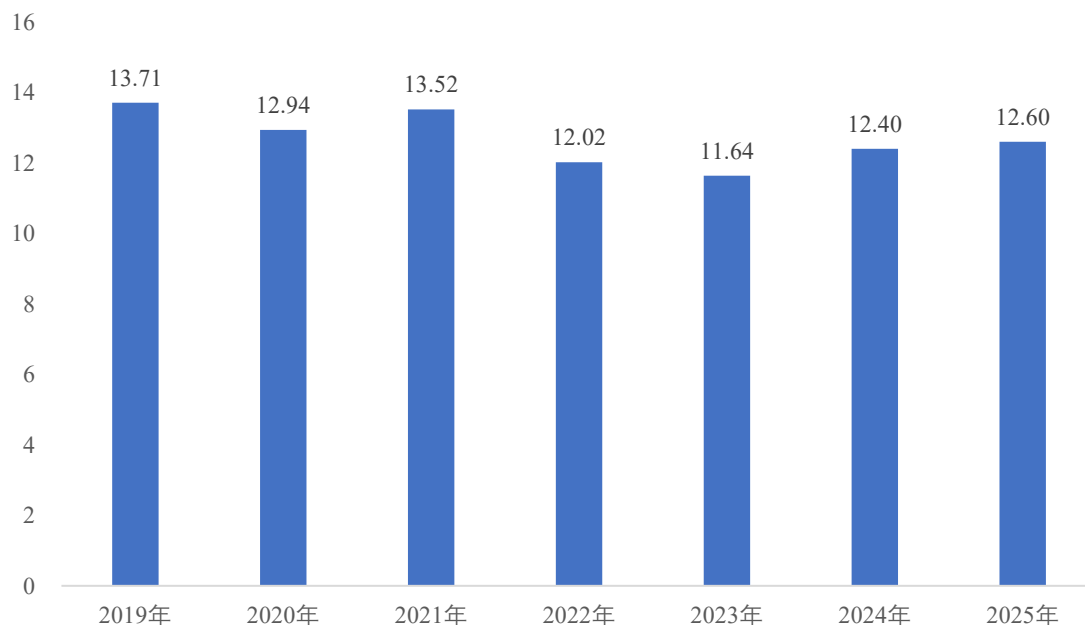
①智能手机存量市场庞大，通信制式升级驱动滤波器需求与价值同步提升

全球智能手机存量市场体量庞大，随着智能手机功能迭代的持续加快，AI增强功能、折叠屏技术、高刷新率屏幕、多摄系统等创新应用的普及，在一定程度上激发了用户的换机意愿，换机周期呈缩短趋势。目前，全球智能手机市场已

进入存量阶段，在经历 2022 年至 2023 年连续两年的出货量下滑后，于 2024 年迎来温和复苏。根据 IDC 发布的最新数据，2024 年全球智能手机出货量达到 12.40 亿台，较 2023 年的 11.64 亿台同比增长 6.40%；2025 年出货量进一步增至 12.60 亿台，同比增长 1.61%，增速趋缓，市场呈现稳中微增态势。

2019-2025 年全球智能手机出货量

单位：亿台

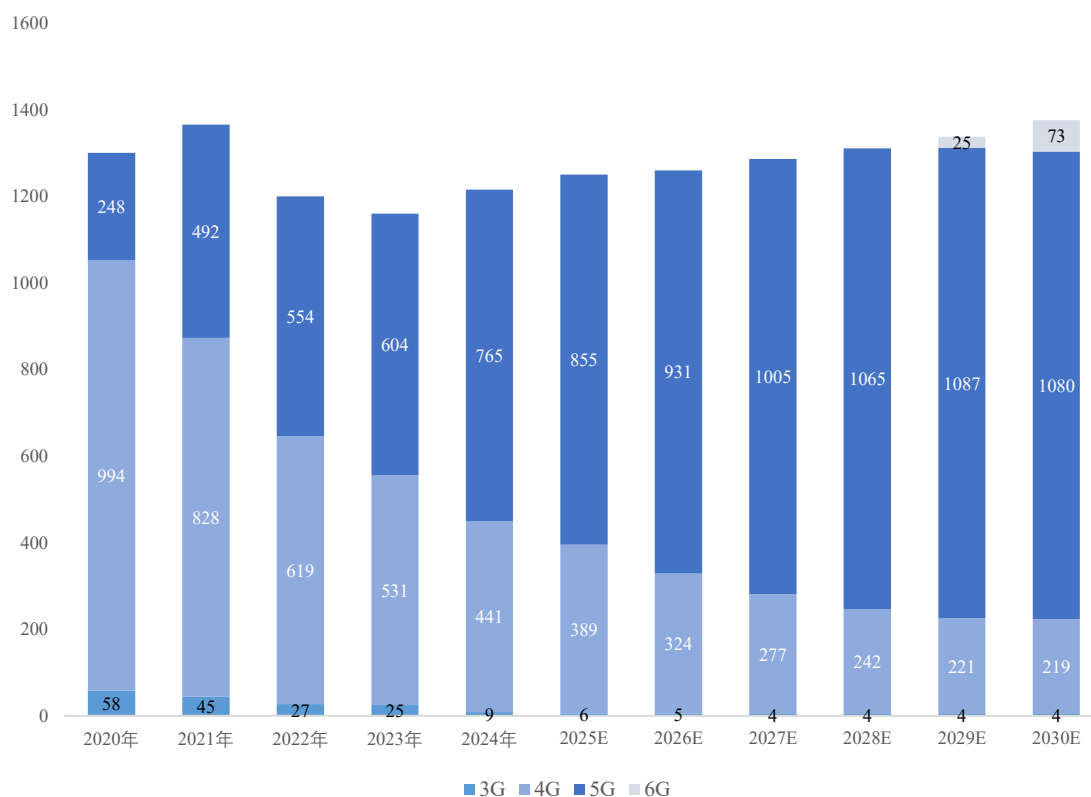


数据来源：IDC、WIND 数据库

从结构层面来看，5G 技术正深刻重塑全球智能手机市场格局。随着 5G 网络基础设施的不断完善及终端成本的持续优化，5G 手机渗透率快速攀升，已成为智能手机出货的绝对主力。据 Yole 数据及预测，全球 5G 手机出货量占比已从早期的快速导入期迈入稳步提升通道，将由 2025 年的 68.40% 进一步增长至 2030 年的 78.49%。这意味着在未来数年内，5G 手机不仅将完全主导新机市场，更将成为全球移动通信终端的存量主体，将为上游滤波器带来持续而确定的增量需求。

2020-2030 年全球手机分通信制式出货量

单位：百万台



数据来源：Yole Development

同时，随着通信制式从 2G 向 5G 的演进，手机通信频段数目从 2G 的 4 个频段上升到 5G 的 50 多个频段，由于每新增一个频段通常需要增加相应的滤波器进行信号筛选，滤波器用量随之大幅提升。根据 Yole 的统计，从 2G 到 5G，单机滤波器数量从 2-4 个激增至 40-80 个，单机滤波器价值量亦随之提升。未来随着 6G 通信制式的应用，单机滤波器的需求量和价值量将会进一步上升。

项目	2G	3G	4G	5G
滤波器数量（个）	2-4	4-8	20-40	40-80

数据来源：Yole Development

② 国内滤波器企业技术实力持续增强，供应链自主可控驱动国产替代加速

2025 年全球智能手机市场总产量超过 12 亿部，市场集中度持续提升，前八大手机品牌合计份额超过 85%。其中，小米、OPPO、vivo、传音、荣耀、联想等国产厂商合计产量达 6.44 亿部，占全球市场 50%以上。

一方面，智能手机用滤波器市场长期由海外厂商主导，但近年来，随着国产滤波器在产品性能、成本控制及交付响应等方面的持续提升，国际厂商的竞争优势逐步减弱，部分产品线因价格压力 and 市场竞争加剧而主动收缩或退出，这为好达电子等具备自主技术积累与规模化量产能力的国内企业提供了进一步替代国外厂商市场份额的机会。

另一方面，在供应链自主可控成为产业共识的背景下，国内头部终端厂商正加速从依赖海外供应转向培育本土供应商，为好达电子等国产滤波器企业明确了国产替代的战略机遇。公司持续提升产品性能与技术水准，已能够满足国产品牌手机对高性能滤波器的严苛要求。展望未来，随着国产终端品牌的持续崛起及公司技术能力的进一步增强，公司有望深度受益于这一产业趋势，实现业务的稳健增长。

2025 年全球智能手机市场份额（按产量统计）

手机品牌	2025 年产量（亿部）	占比
苹果	2.40	19.12%
三星	2.40	19.12%
小米	1.70	13.54%
OPPO	1.43	11.40%
vivo	1.02	8.13%
传音	0.98	7.81%
荣耀	0.71	5.62%
联想	0.61	4.86%
其他	1.30	10.38%
合计	12.54	100.00%

数据来源：TrendForce

（2）物联网领域

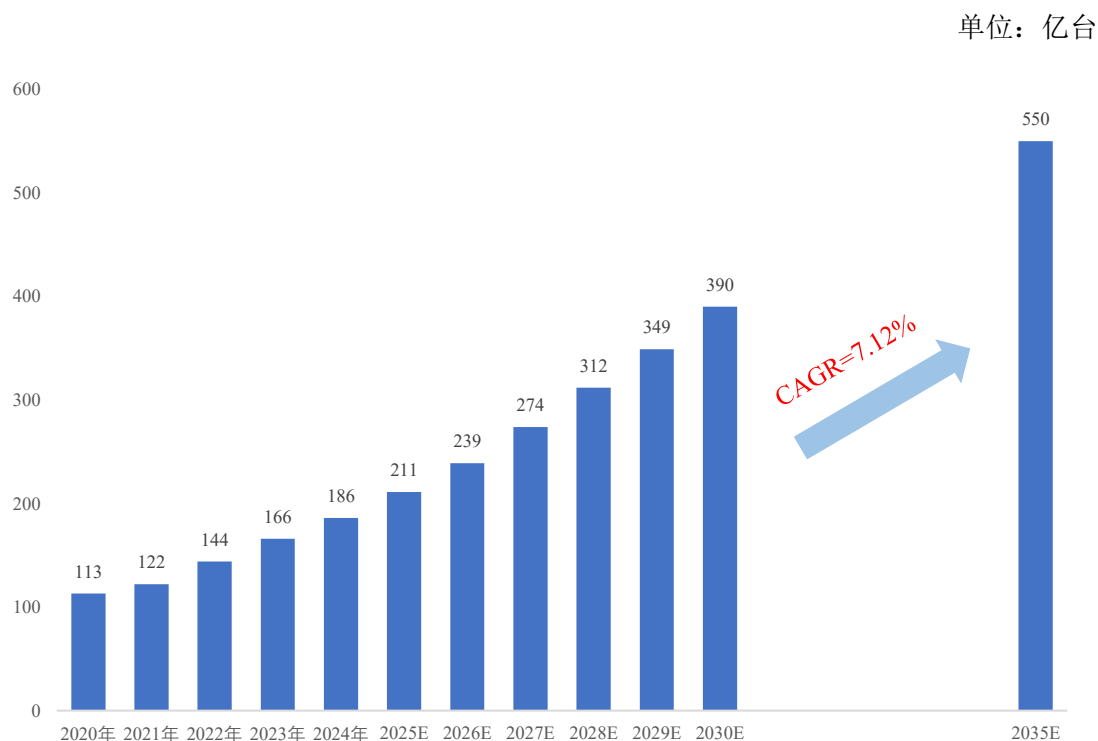
① 全球及中国物联网连接规模持续扩张，滤波器市场迎来广阔成长空间

物联网（IoT）通过实现人与物、物与物的泛在连接，构建起万物互联的基础。各类终端设备依赖蜂窝网络、Wi-Fi、蓝牙等无线通信技术实现数据传输。物联网应用场景向智能家居、工业自动化、智慧农业、智慧医疗、共享出行、智

能物流等多元领域持续拓展,催生了大量新增节点,包括智能表计、工业机器人、农业监测设备、医疗健康设备、智能门锁、共享出行终端、智能物流终端、无人机、割草机及家用服务机器人等。这些节点均需配备完整的无线通信模组。随着连接数的持续扩张以及通信频段增加,单终端无线通信价值量稳步提升。声表面波滤波器作为无线通信中的核心元件,通过精准滤除带外干扰、保障信号纯净度,直接决定了物联网设备通信质量与连接稳定性。

从全球范围看,全球物联网设备连接数呈现持续快速增长。根据 IoT Analytics 数据,2025 年全球物联网设备连接数预计将达 211 亿台,同比增长 14%,增速较 2024 年的 12%进一步提升,显示出物联网行业正进入加速发展阶段。预计到 2030 年,全球物联网设备连接数将增长至 390 亿台,2035 年有望突破 550 亿台。声表面滤波器市场需求与物联网连接数呈现强正相关关系,且受益于频段增加带来的滤波器用量增长,其市场规模有望实现超越连接数增速的快速扩容,展现出广阔的成长空间。

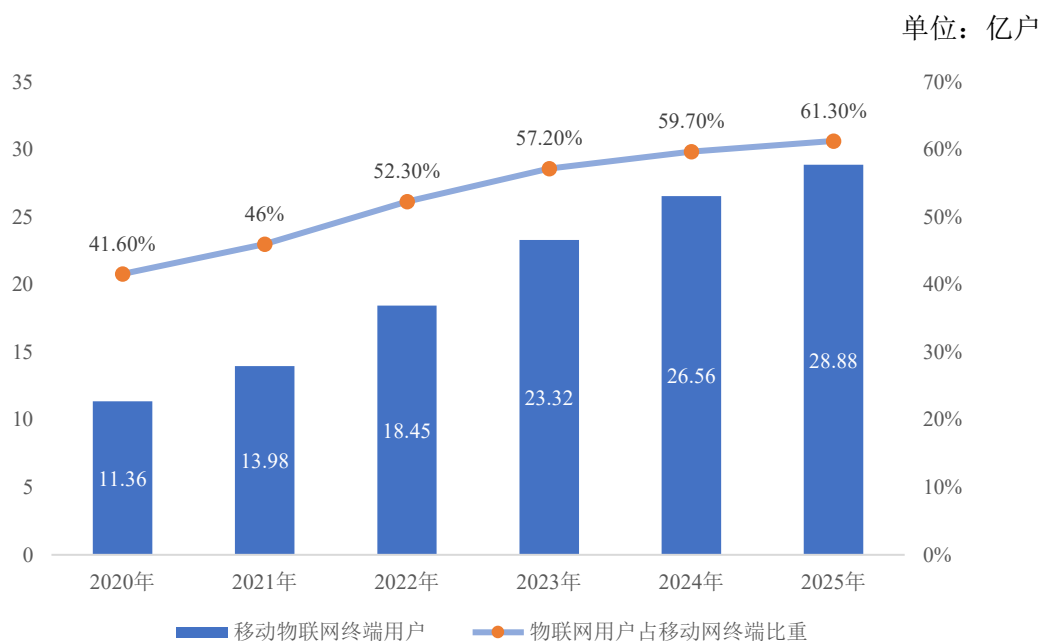
2020-2030 年全球物联网设备连接数



数据来源: IoT Analytics

聚焦国内市场,我国移动物联网终端用户规模亦实现跨越式增长。根据《2025年通信业统计公报》数据显示,2020年至2025年,移动物联网终端用户从11.36亿户增长至28.88亿户,年均复合增长率超20%。与此同时,移动网终端总数从27.31亿户扩大至47.11亿户,物联网用户占移动网终端的比重由41.6%快速提升至61.3%,标志着物联网已成为我国移动连接的主要增长极。

2020-2025年中国物联网用户情况



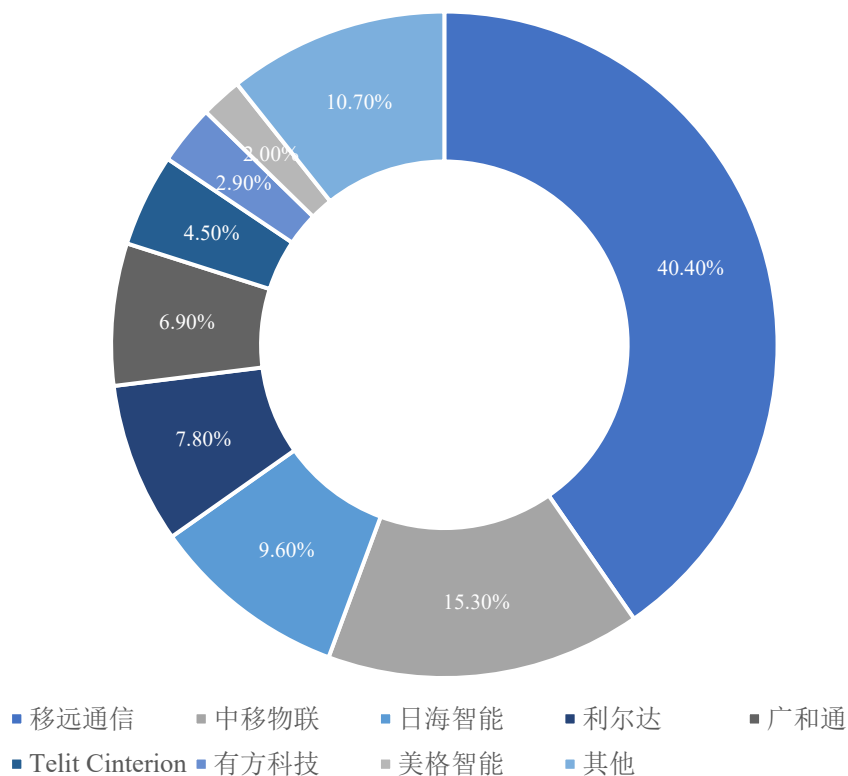
数据来源: 工业和信息化部

② 国产模组主导全球市场, 国内滤波器企业实力增强加速国产替代进程

中国是全球最大的物联网市场, 占全球份额超过四分之一。依托庞大的内需和完备的产业链基础, 国内头部模组厂商合计占据全球蜂窝物联网模组市场超过80%的份额。在物联网模组领域, 滤波器供应长期以海外厂商为主。近年来, 随着国内滤波器企业在产品性能、成本控制及交付能力等方面的持续提升, 国际厂商的市场优势有所减弱, 部分产品线基于市场竞争格局变化, 逐步调整业务布局, 由此释放出一定的市场空间。好达电子等具备自主技术积累与规模化量产能力的国内企业, 凭借扎实的技术储备和稳定的交付能力, 成功承接了这部分转移的市场份额, 已成为广和通、中移物联、利尔达、移远通信等国内主流物联网模组厂商的供应商之一, 实现批量供货。展望未来, 在物联网连接数持续增长的背景下,

公司所处的声表面波滤波器市场成长空间广阔。

2025 年全球蜂窝模组企业市场份额



数据来源：Techno Systems Research

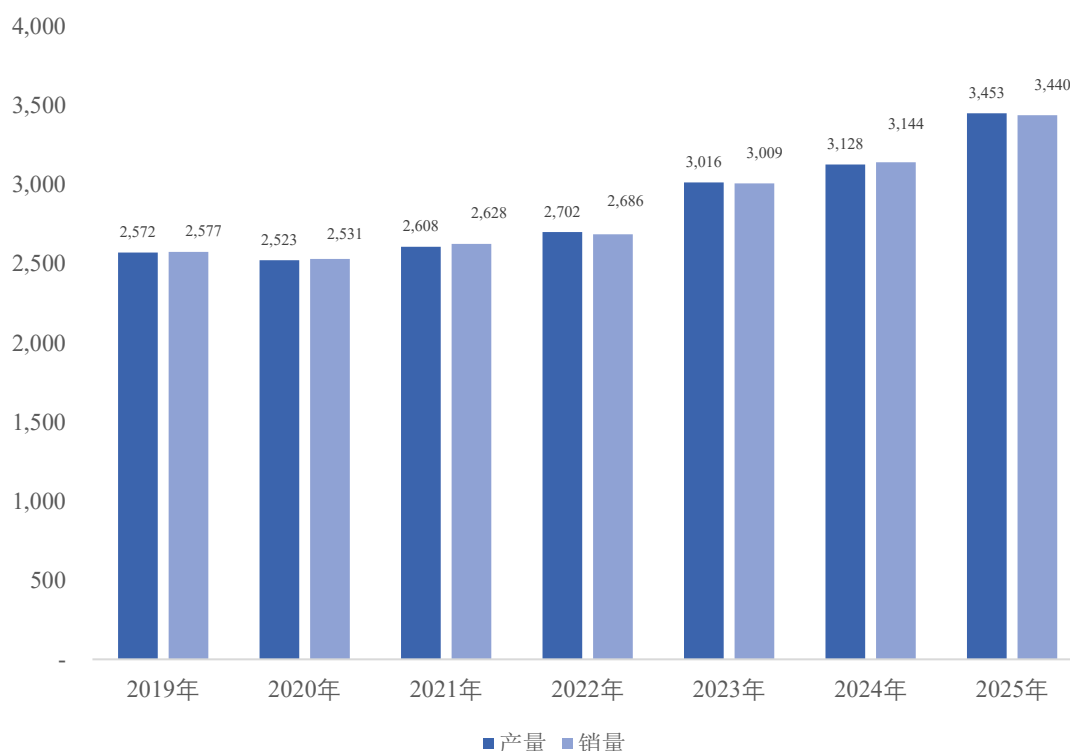
(3) 汽车电子领域

① 全球汽车产业规模庞大，中国市场占据重要份额

汽车产业是全球制造业的重要支柱，市场规模巨大。根据国际汽车制造商协会（OICA）数据，2025 年全球汽车产销量保持增长态势，产量达 9,640 万辆，销量为 9,980 万辆。聚焦国内市场，根据中国汽车工业协会数据，2019 年至 2025 年，中国汽车产量从 2,572 万辆增长至 3,453 万辆，销量从 2,577 万辆增长至 3,440 万辆，累计增幅分别达 34.3%和 33.5%。庞大的汽车产销量为上游汽车电子产业提供了坚实的市场基础。随着汽车电子在整车成本中的占比持续提升以及单车电子元器件数量的不断增加，声表面波滤波器等射频核心器件面临广阔的市场空间。

2019-2025 年中国汽车产量及销量

单位：万辆



数据来源：中国汽车工业协会

② 汽车智能化进程加速，单车滤波器用量显著增加

智能化是当前汽车产业最核心的技术发展趋势之一。在汽车智能化进程加速的背景下，车载无线连接需求呈爆发式增长，为声表面波滤波器开辟了广阔应用空间。声表面波滤波器凭借体积小、成本低、一致性好的优势，已广泛应用于车载通信系统的多个关键场景，包括车联网、智能辅助驾驶、卫星导航定位、T-BOX（车载远程通信终端）、蓝牙及 Wi-Fi 模块等。随着单车通信频段日益复杂，单车滤波器用量持续增加，车用声表面波滤波器市场空间快速扩容。

(4) 基站领域

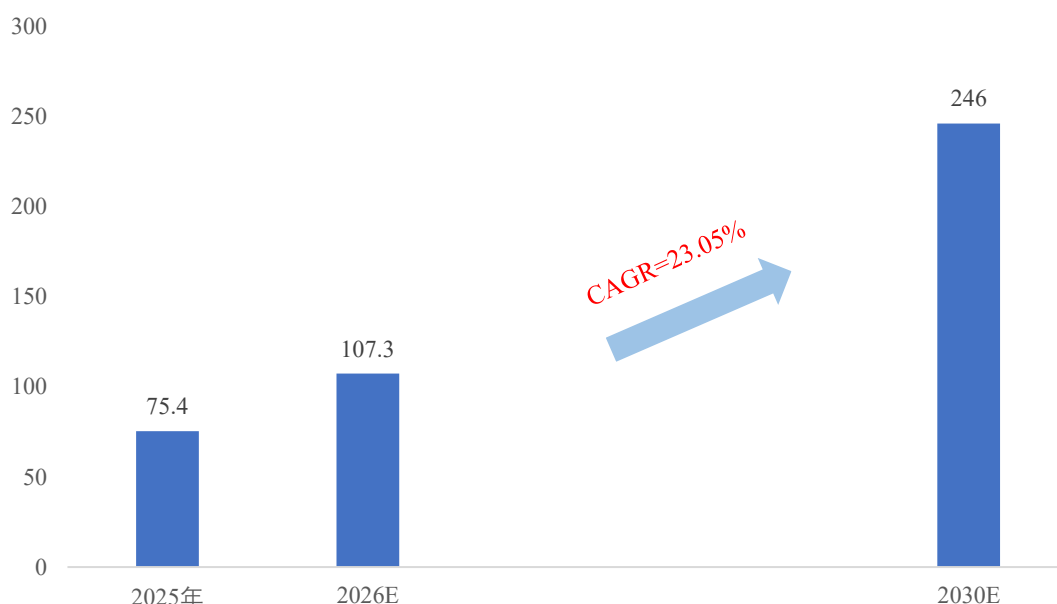
小基站（Small Cell）是一种小型化基站设备，具有可控性好、智能化和组网灵活等特点，主要专注热点区域的网络覆盖和弱覆盖区的信号增强，保障各应用场景的网络深度覆盖。小基站需要使用滤波器对信号频率进行选择过滤，声表面波滤波器凭借其体积小、成本低、一致性好的优势，与小基站的需求特性高度

匹配。

从市场规模看，全球小基站市场正进入快速扩张通道。根据 Fortune Business Insights 及 GII 数据，2025 年全球小基站 5G 网络市场规模预计达 75.4 亿美元；随着 5G 网络向室内深度覆盖推进，2026 年市场规模有望增长至 107.3 亿美元，至 2030 年将进一步扩大至 246 亿美元。伴随 5G 商业化进程不断加快，小基站建设规模持续扩容，对声表面波滤波器的需求也将同步提升。

2025-2030 年全球小基站市场规模

单位：亿美元



数据来源：Fortune Business Insights、GII

(5) 低轨卫星通信

声表面波滤波器在卫星通信中扮演着至关重要角色，凭借其卓越的频率选择性和陡峭的过渡带特性，它被广泛应用于卫星有效载荷和地面站终端中，主要用于精确地分离密集排列的通信信道、抑制强大的邻近信号干扰、滤除接收机中的镜像噪声，并确保发射信号的频谱纯净，从而在复杂的空间电磁环境中保障微弱信号的高质量、低误码率传输。其小尺寸、高可靠性和稳定性使其特别适合对重量和性能要求都极为苛刻的航天应用场景。

根据 Precedence Research 数据，2024 年全球卫星通信市场规模约为 320 亿

美元，预计到 2030 年将增长至 1,200 亿美元以上，年复合增长率超过 25%。增长主要驱动因素包括低轨卫星星座的大规模部署、手机直连卫星技术的成熟以及应用场景的不断拓展。同时根据 MarketsandMarkets 的研究报告，全球低轨卫星市场规模从 2025 年的约 118 亿美元一路攀升，预计至 2030 年将突破 206 亿美元，年复合增长率达 11.9%。

4、声表面波滤波器行业的产业链

声表面波滤波器产业链是一个基于独特压电材料与微声学工艺的垂直化体系。上游以铌酸锂、钽酸锂等压电晶体材料为核心，配合晶圆制造和封装设备；中游涵盖声学设计、精密 IDT（叉指换能器）制造及需空腔保护的封装，因制造工艺与半导体产线不兼容，在声表面波滤波器领域，采用 IDM（垂直整合制造）模式经营的厂商占据绝对主导地位；下游广泛应用于智能终端、基站、汽车电子等无线通信领域，是实现频率选择与信号纯净的关键基础元件。



(1) 产业链上游

声表面波滤波器行业的上游是典型的技术与资本双密集型领域，其核心围绕基础材料、关键设备构建，形成了行业发展的基础与瓶颈。在材料端，高纯度、特定切向的压电晶体材料（如钽酸锂 LT、铌酸锂 LN）是 SAW 滤波器工作的物

理基础，其晶体质量、均匀性和尺寸直接决定器件的频率特性、带宽、温度稳定性和功率耐受能力等性能。此外，用于制作 IDT 的超薄金属靶材（如铝、铜合金）、光刻胶等辅助材料，其纯度与一致性要求严苛。在设备端，SAW 滤波器的制造依赖半导体级工艺设备，关键设备包括 DUV 光刻机、电子束蒸发台、PVD、Trim 机台等。上游材料与设备的性能水平、工艺匹配度及供应链稳定性，直接决定了中游滤波器产品的性能上限、量产规模与成本竞争力。

（2）产业链中游

声表面波滤波器行业的中游是技术实现与价值创造的核心环节，聚焦于设计、制造和封装测试的高度集成，其本质是将上游的基础材料与关键设备，转化为满足特定频段、性能与可靠性要求的标准化产品的过程。这一环节兼具半导体行业的精密制造特性和定制化设计需求，呈现出高技术壁垒、高资本投入和强客户认证的特点。新进入者不仅需要突破复杂的设计与制造工艺，更面临巨大的客户认证壁垒，产品需通过手机等终端厂商长达 1-2 年的严苛认证周期，才能进入其供应链体系。目前，国内企业如好达电子等已在滤波器中游环节实现规模化国产替代，并持续向高性能滤波器领域突破。

（3）下游应用市场驱动行业发展

声表面波滤波器的下游是直接面向终端应用的市场，其需求和发展完全由智能终端、物联网、基站、汽车电子和低轨卫星通信等终端产业的繁荣和技术升级所驱动。

5、行业发展态势

（1）声表面波滤波器成为多元新兴应用领域的射频基石

声表面波滤波器的应用场景不断地扩展与多元化，早已突破传统智能手机、基站的范畴，快速地向物联网、汽车电子、低轨卫星通信及无人机等新兴领域扩展。在 5G 通信中，SAW 滤波器是 Sub-6GHz 频段射频前端的核心滤波元件；在物联网生态中，从智能家居的无线连接模组到工业传感器的精准数传，SAW 滤波器小型化、低成本的优势适用于需要大规模部署的物联网节点，有效降低了整体解决方案的成本；在汽车电子领域，随着智能网联和智能驾驶的推进，SAW

滤波器已广泛应用于车载通信、车载导航等系统中，其耐高温、高可靠性的特性得到充分验证；在低轨卫星通信领域，SAW 滤波器凭借其小型化、轻量化、高性能，为星载通信载荷和地面终端提供了抗干扰与频道分离的可靠保障。此外，在新兴的无人机领域，它通过精准的频率筛选功能，在无人机遥控、图传和数据传输链路、导航定位模块中发挥了重要的作用。SAW 滤波器在多个前沿领域的应用，充分证明了其作为核心基础元件的技术韧性和不可替代性。

(2) 政策支持、国产企业崛起加速国产替代进程

“十五五”规划纲要将集成电路列为战略性新兴产业之首，提出“采取超常规措施”，推动全链条关键核心技术攻关取得决定性突破。为解决滤波器领域的供应链安全问题，国家将滤波器纳入集成电路产业重大发展战略，通过一系列的产业政策扶持，构建起了从材料研发到芯片制造的全方位支持体系。在政策支持与市场需求的驱动下，国内企业已在 SAW 滤波器市场实现了突破，以好达电子为代表的 IDM 头部企业通过自建产线实现了规模化量产出货，并正向高频、高功率等领域持续拓展。

然而，全球声表面波滤波器市场仍呈现出国际巨头主导的产业格局，村田、高通（RF360）、思佳讯、太阳诱电等国际巨头通过数十年积累，构筑了较高的产业壁垒，占据着全球 SAW 滤波器市场主要份额，导致我国 SAW 滤波器国产化率长期较低。为保障产业链安全并抓住射频芯片的广阔市场机遇，以好达电子为典型代表的国内企业正通过加大研发投入、突破关键工艺，在智能终端、物联网、汽车电子、基站等应用领域加速推进国产替代进程，逐步提升市场份额。

(3) 客户需求快速变化，工艺迭代与供应保障成核心竞争力

当前，声表面波滤波器行业正呈现客户需求快速迭代的发展态势。随着智能终端、物联网、基站、汽车电子、低轨卫星通信等下游应用的持续升级，终端客户对滤波器的性能、尺寸及集成度提出了更高要求，驱动声表面波滤波器企业加快产品开发节奏。在此背景下，工艺的持续迭代与升级能力成为声表面波滤波器企业保持技术领先的核心优势，通过不断优化设计平台与制造工艺，企业能够快速响应客户需求，提升产品良率与性能一致性。IDM 模式将芯片设计、晶圆制造与封装测试深度融合，使企业能够根据市场需求灵活调配产能、协同优化工艺，

稳定的大规模供应能力是赢得客户信任的关键要素。通过建立长期供应协议与弹性产能保障机制，企业可有效应对市场波动，确保订单交付的及时性与可靠性。因此，聚焦客户需求，强化工艺迭代、夯实供应保障，已成为声表面波滤波器 IDM 企业塑造核心竞争力、实现可持续发展的重要路径。

6、行业技术水平及技术发展趋势

(1) 声表面波滤波器在频谱扩展、高功率耐受进行技术演进

随着通信技术向 5G/6G 持续演进，声表面波滤波器正经历深刻的技术变革，在频谱扩展、高功率耐受等方面取得系统性突破。在频谱扩展方面，通过单晶压电薄膜材料研发和声波模式优化，声表面波滤波器从传统瑞利波、水平剪切波向高声速模式（如 A1 模式、S0 模式）演进，有效提升了工作频率、机电耦合系数及 Q 值。同时，采用亚微米级光刻与深亚微米电极工艺，降低叉指换能器周期，实现高频谐振。上述技术路径使工作频率得以扩展至 6GHz，满足 5G-A/6G 新增频段需求。

第二，在高功率耐受层面，通过优化电极材料与结构，提升电极对应力与电迁移的耐受力；针对 TC-SAW 工艺，除了优化电极材料和结构，优化温度补偿薄膜的材料特性进一步降低温度漂移系数、使得器件的功率容量进一步提升，拓宽了 TC-SAW 工艺的高功率应用场景；针对基于单晶压电薄膜异质工艺，引入热管理设计，加速热量导出以降低工作温升，功率容量提升至 36dBm 以上。同时，采用优化谐振器声场约束结构、降低模式转换损耗等方法，将插入损耗控制在 0.8dB 以下，显著增强器件的可靠性。

这些突破共同推动了声表面波滤波器在智能终端、物联网、汽车电子、低轨卫星通信、无人机等新兴领域的规模化应用。

(2) 客户需求推动滤波器小型化和多滤波器集成化

移动终端对器件持续小型化和轻量化的需求，驱动滤波器小型化和集成化。在器件小型化方面，通过结构不断创新和迭代，在保持优异性能的同时实现尺寸缩减，适应终端设备轻薄化趋势。通过单片集成与优化封装工艺，在不增加封装面积的基础上，将多个频段的滤波器/双工器整合于单一封装体内，实现滤波器

集成化，缩减占板面积，降低综合成本，具备可重构配置、支持频段灵活切换等优势，为客户提供了更高性价比的解决方案。

(3) 射频前端模组化趋势下的滤波器技术突破

射频前端向高集成度模组化方向发展，是终端空间约束、通信性能升级与产业链效率提升共同驱动的行业趋势。在此进程中，声表面波滤波器作为射频模组实现信号筛选的关键器件，其性能直接决定模组的整体表现。在工艺层面，模组化对滤波器的尺寸、厚度及集成工艺提出了更高要求，持续推动滤波器封装技术与材料体系的创新演进。

公司作为国内声表面波滤波器领域的领先企业，长期专注于声表面波滤波器的自主研发与工艺创新。经过多年的技术积累，公司在滤波器工艺及器件封装方面取得关键突破，已连续多年为全球知名手机终端厂商的旗舰机批量供应晶圆级封装（WLP）滤波器，产品主要应用于 L-PAMiD、FEM 等高集成度射频前端模组。

目前，滤波器国产替代进程正加速推进，国内射频前端模组企业多专注于模组设计与系统集成，采用轻资产模式。随着国产替代趋势不断增强，本土声表面波滤波器企业迎来明确的战略机遇。公司凭借优越的设计能力、先进工艺与规模化交付能力，以及向头部客户长期批量供货的先发优势，将积极携手国内射频前端模组企业开展协同开发，加速滤波器在射频模组中的国产化替代，助力产业链自主可控进程。

7、行业壁垒

(1) 技术壁垒

声表面波滤波器行业存在较高的技术壁垒，这源于多学科知识的深度融合与半导体制造工艺的长期积累。成功进入该领域的滤波器厂商，不仅需要具备将复杂物理模型转化为可制造设计的能力，更需要精准掌握光刻、薄膜沉积等核心工艺，并持续优化以解决高频化、微型化带来的功率耐受和性能一致性等难题。这些必须通过长期研发与实践才能获得的核心技术与生产经验，共同构成了新进入者的壁垒。

(2) 资金壁垒

声表面波滤波器行业呈现出显著的资金壁垒，属于典型的资本密集型产业。企业需在初期投入大量资本用于购置光刻机、PVD、电子束蒸发台等半导体专用设备，并组建具备深厚经验的研发团队以进行持续的产品设计与工艺开发。此外，从产线建成到实现规模化、经济化的稳定生产，需要经历漫长的产能爬坡与良率提升过程，在此期间企业面临持续的资金投入压力而回报周期较长，对新进入者的资本实力与资金耐力构成了极高门槛。

(3) 客户认证壁垒

声表面波滤波器行业具有显著的客户认证壁垒，其核心体现在严格的供应商准入机制和稳定的供应链合作关系。作为无线通信系统的核心元件，滤波器厂商需通过通信设备商全方位认证，包括性能测试、工艺评估、量产稳定性验证等关键环节。这种高标准的认证体系一方面促使通信设备商与通过认证的供应商建立长期稳定的合作关系，另一方面对新进入者构成包括时间成本、资金投入和技术门槛在内的多重障碍。

(4) 人才壁垒

声表面波滤波器行业面临显著的人才壁垒，其核心竞争力高度依赖于具备跨学科知识深度与丰富产业经验的复合型专业人才。该领域要求研发人员不仅需要精通射频理论、声学、半导体工艺与材料科学等多个专业领域，还必须深刻理解其在产品设计与工艺实现上的复杂耦合关系。同时，具备大规模产线管理经验、精通良率提升与成本控制的技术管理人才同样稀缺。声表面波滤波器行业的高端人才培养周期长、成本高，已构成新进入者难以在短期内逾越的关键壁垒。

(四) 行业面临的机遇与挑战

1、行业面临的机遇

(1) 国家产业政策支持

声表面波滤波器行业正迎来国家产业政策支持的重大发展机遇。射频芯片行业属于新一代信息技术产业中的电子核心产业，被明确为国家重点发展和亟需知

识产权支持的重点产业。同时根据工信部发布《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，将射频滤波器列为技术创新突破的重点元器件。国家颁布一系列政策，通过税收优惠、研发费用加计扣除等政策为本土企业提供多维度支持。各级政府设立专项扶持资金，鼓励企业攻克 TC-SAW、TF-SAW 等高性能滤波器技术，建设本土化产线。这些产业政策缓解了企业的资金压力，加速技术突破和产业化进程。

（2）行业产业链日益完善

声表面波滤波器行业正迎来产业链日趋完善带来的重大发展机遇。随着国内企业在钽酸锂/铌酸锂晶体生长、压电材料制备等上游关键材料领域的突破和设备国产化进程加速，以及中游制造环节在工艺精度、量产规模与良率上的显著进步，行业初步形成了从材料、设备到设计、制造、封测的完整产业链条。同时下游市场方面，智能终端、物联网、基站、汽车电子、低轨卫星通信、无人机等应用市场的蓬勃发展为滤波器企业提供了丰富的应用场景和迭代机会。这一日趋完善的产业生态和上下游的紧密协作，不仅降低了声表面波滤波器企业的采购成本和供应链风险，更通过产业链的紧密合作加速了技术创新和产品迭代，为声表面波滤波器行业实现自主可控和产业升级提供了有力支撑。

（3）国产替代加速推进

声表面波滤波器行业正迎来国产替代加速推进的战略机遇期。在全球科技竞争格局变化和供应链自主可控需求提升的背景下，国内终端厂商积极推动射频滤波器供应链的国产化进程，为本土企业创造了前所未有的发展机遇。以好达电子等为代表的国内领先企业，通过持续的技术攻关，正逐步突破高性能滤波器的技术瓶颈，实现从智能终端到物联网、汽车电子、低轨卫星通信、无人机等新兴领域的应用拓展。这一替代趋势不仅带动了本土企业市场份额的快速提升，更促进了国内产业链在专利布局、工艺技术和供应链协同等方面的整体进步，为行业实现全面自主可控和参与全球竞争奠定了坚实基础。

2、行业面临的挑战

(1) 高端人才短缺

声表面波滤波器行业是典型的技术密集型行业，深度融合射频理论、声学、半导体工艺与材料科学等多学科知识，对从业人员的专业深度、跨学科理解能力及协同创新经验要求极高。目前，全球高端人才资源集中于少数具备先发优势的日美企业，导致国内产业在核心人才储备方面存在明显不足，尤其缺乏具备高端产品开发与量产经验的复合型人才。随着行业技术迭代加速、市场竞争日趋激烈，人才竞争态势预计将进一步升级。若国内企业无法在人才吸引、培养及保留机制上实现有效突破，将可能制约其技术创新能力与市场竞争力的提升，从而对行业可持续发展构成挑战。

(2) 全球 SAW 滤波器市场高度集中，先发优势构筑行业壁垒

全球声表面波滤波器行业市场高度集中，以村田、高通、太阳诱电、思佳讯、威讯为代表的国际巨头凭借数十年先发优势，长期占据全球 SAW 滤波器市场主要份额。上述企业通过持续大规模研发投入，积累了深厚的设计、制造经验，并与下游终端客户建立了长期稳定的供应链合作关系，形成了显著的竞争优势。新进入者不仅面临较长的客户认证周期和较高的客户切换成本，还需应对国际厂商在材料、设计、制造、封测等环节的垂直整合能力及规模化优势。这一基于先发优势的垄断格局，构成了国内企业扩大市场份额的主要挑战。

(五) 发行人所处竞争格局及主要企业

1、所属行业竞争格局

全球声表面波滤波器市场由日美企业主导，国外前五大声表面波滤波器厂商村田、高通（RF360）、太阳诱电、思佳讯和威讯等占据主要市场份额。国内滤波器市场主要依靠国外进口，国产化率低。国内声表面波滤波器企业包括好达电子、德清华莹、麦捷科技、中电 26 所等，目前国内市场已形成明显的分层竞争格局。一方面，以好达电子为代表的成熟厂商凭借多年的工艺积累和量产验证，已实现规模量产出货，市场渗透率正加速提升；另一方面，近年来涌现的大量初创企业依托资本支持和细分市场切入，但整体仍面临专利壁垒、良率爬坡及规模

化盈利能力的严峻考验。

2、行业内主要企业

声表面滤波器市场由日美企业主导，国外企业包括村田、高通（RF360）、太阳诱电、思佳讯和威讯等。国内企业主要包括德清华莹、麦捷科技、中电 26 所等，其中德清华莹的主营业务是声表面波滤波器；射频器件（含 LTCC 射频器件、射频模组、声表面波双工器）是麦捷科技的主营业务之一。

（1）国际知名企业

企业名称	简介
Murata（村田）	Murata（村田）全称为 Manufacturing Co., Ltd.，成立于 1950 年，日本东京证券交易所上市公司（6981.T）。村田的主营业务为先进电子元器件及多功能高密度模块的设计、制造及销售，主要产品包括陶瓷电容器、陶瓷滤波器、高频零件、感应器、声表面波滤波器等，应用范围覆盖手机、家电、汽车、能源管理系统、医疗保健器材等。
Qualcomm（高通）	Qualcomm（高通）全称为 QUALCOMM Incorporated，成立于 1985 年，美国纳斯达克上市公司（QCOM.O）。高通的主营业务为设计、制造和销售无线通讯产品和相关服务。2017 年 2 月高通与 TDK 株式会社成立合资公司 RF360 Holdings Singapore Pte. Ltd.（以下简称“RF360”），布局射频前端市场；2019 年 9 月高通将 RF360 收购为全资子公司，助力高通把射频前端技术完全整合到下一代 5G 解决方案中。目前高通在射频领域的主要产品包括声表面波滤波器、体声波滤波器等，应用范围覆盖移动终端和新兴业务领域。
Taiyo（太阳诱电）	Taiyo（太阳诱电）全称为 TAIYO YUDEN CO., LTD.，成立于 1950 年，日本东京证券交易所上市公司（6976.T）。太阳诱电的主营业务为电子元器件开发、生产及销售，主要产品包括陶瓷电容器、电感器、声表面波滤波器及模块、能源器件等，应用范围覆盖消费电子、汽车电子、工控等多个下游领域。
Skyworks（思佳讯）	Skyworks（思佳讯）全称为 SKYWORKS SOLUTIONS,INC，成立于 1962 年，美国纳斯达克上市公司（SWKS.O）。思佳讯的主营业务为提供无线集成电路解决方案及射频功率放大器、滤波器、射频前端模块等产品，具备射频前端全产品线。应用范围覆盖手机、基站、物联网、汽车等领域。
Qorvo（威讯）	Qorvo（威讯）全称为 Qorvo Inc.，成立于 2015 年，美国纳斯达克上市公司（QRVO.O）Qorvo 的主营业务为使用在移动手机上的射频功率放大器、滤波器、射频开关、LNA 等射频前端芯片生产和销售，是全球主要的射频前端产品供货商之一。
Wisol（威盛）	Wisol（威盛）全称为 Wisol Inc.，成立于 1992 年，作为全球领先的射频元件制造商，Wisol 的核心业务涵盖 SAW Filter、双工器（Duplexer）、射频模块（RF Module）等产品的研发与生产，广泛应用于手机、平板电脑、智能穿戴设备及车载 GPS 等领域。

(2) 国内知名企业

企业名称	简介
德清华莹	德清华莹全称为中电科技德清华莹电子有限公司，成立于1978年。德清华莹主营业务为声表面波器件、压电/光电晶体材料等产品的研发、生产和销售，主要产品包括声表面波滤波器、声表面波谐振器、声表面波传感器、铌酸锂/钽酸锂/石英晶棒和晶片、环形器/隔离器等系列产品，应用范围覆盖遥控、安防、智能家居、遥感遥测、雷达、通讯等领域。
麦捷科技	麦捷科技全称为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司，成立于2001年，2012年于创业板上市（300319.SZ）。麦捷科技主营业务专注于高端电子元器件及模组的研发、生产和销售，核心业务覆盖磁性元器件、射频器件、显示模组三大板块，产品广泛应用于通讯设备、消费终端、新能源、汽车电子、服务器、工业控制、安防设备等领域。其中，射频器件主要为LTCC射频器件、射频模组、声表面波双工器
中电26所	中电26所全称为中国电子科技集团公司第二十六研究所，成立于1970年。中电26所的主营业务为微声电子技术和惯性技术产品的研发、生产和销售，主要产品包括声表面波滤波器、声表面波/微波延迟线、声表面波振荡器、压电陀螺、线加速度计等，应用范围覆盖电子、通讯、广播电视、精密机械、车载导航等领域。

3、公司与行业主要企业的比较情况

(1) 经营状况

根据最新披露财年，公司与同行业公司的经营情况对比如下：

公司名称	单位	财年截止日	营业收入	净利润	总资产	净资产	研发费用	研发费用占营业收入的比重	研发人员（人）	研发人员占比
Murata (村田)	亿日元	2025-3-31	17,433.52	2,338.18	30,281.94	25,799.75	1,492.74	8.56%	未披露	未披露
Qualcomm (高通)	亿美元	2025-09-28	442.84	55.41	501.43	212.06	90.42	20.42%	未披露	未披露
Taiyo (太阳诱电)	亿日元	2025-3-31	3,414.38	23.28	5,731.88	3,191.71	未披露	未披露	未披露	未披露
Skyworks (思佳讯)	亿美元	2025-10-03	40.87	5.96	82.83	63.37	7.86	19.23%	3,600	36.00%
Qorvo (威讯)	亿美元	2025-03-29	37.19	0.56	59.33	33.92	7.48	20.10%	3,968	64.00%
Wisol (威盛)	亿韩元	2025-12-31	3,212.39	-362.79	3,462.39	2,947.06	152.00	4.73%	未披露	未披露
德清华莹	亿元	2025-12-31	7.56	0.29	24.74	15.53	未披露	未披露	未披露	未披露
麦捷科技	亿元	2025-12-31	37.94	3.17	74.58	49.35	1.70	4.49%	599	14.76%
中电26所	未披露									
发行人	亿元	2025-12-31	6.75	-0.03	15.77	1.78	0.57	8.47%	90	15.03%

注：数据来源于各公司年度报告或公开信息。

(2) 技术实力

取如下同行业公司相同频段中相同类型的 SAW、TC-SAW、TF-SAW 滤波器进行对比，其中 SAW、TC-SAW 选取的频段均为公司核心产品所应用的频段且收入占比较高，TF-SAW 选取的产品为已经在客户完成验证的产品。SAW 选取了 Rx 41 为 TDD 的通用频段、Band（1+41）为双滤波器的典型应用频段，Band1 为双工器的典型应用频段，均为应用于智能手机滤波器频段，L1 高抑制为 GNSS 系列滤波器；TC-SAW 选取了 Band 3 和 TRx41 为应用于智能手机滤波频段；TF-SAW 选取了 TRx40 和 Wifi 2.4G 频段，均为智能手机滤波器频段，具体对比情况如下：

①SAW 滤波器

频段	项目		好达电子	村田
Rx41	型号		HDFB41DRSS-B29	SAFFW2G59AB1E0A
	说明		SAW	SAW
	尺寸 (mm)		0.9*0.7	0.9*0.7
	插入损耗 (max)		2.6 (2496-2690M)	2.6 (2496-2690M)
	抑制 (min)		17 (2403-2461M)	15 (2401-2463M)
频段	项目		好达电子	RF360
Band(1+41)	型号		HDDDB01B41ARSS-B8	B39262B9970L210
	说明		SAW	SAW
	尺寸 (mm)		1.5×1.1	1.5×1.1
	RX1	插入损耗 (max)	2.4	2.2
		抑制 (min)	40 (1920-1980)	40 (1920-1980)
	RX41	插入损耗 (max)	3.4	3.2
抑制 (min)		15 (2453-2471)	15 (2453-2471)	
频段	项目		好达电子	WISOL
L1 高抑制	型号		HDF1588D-B5	SFHG89EA402
	说明		SAW	SAW
	尺寸 (mm)		1.1×0.9	1.1×0.9
	插入损耗 (max)		2.2 (1559.05-1605.89)	2.0 (1559.05-1605.89)

	抑制 (min)	41 (1710-2025M)	41 (1710~2025M)	
Band1	项目	好达电子	RF360	
	型号	HDDDB01ENSS-B26	B39212B1308L210	
	说明	SAW	SAW	
	尺寸 (mm)	1.6×1.2	1.6×1.2	
	TX	功率 (dBm)	30	30
		插入损耗 (max)	1.9	2.2
		抑制 (min)	42 (2110-2170M)	40 (2110-2170M)
		隔离度 (min)	53	53
	RX	插入损耗 (max)	2.0	2.2
		抑制 (min)	45 (1920-1980M)	45 (1920-1980M)
隔离度 (min)		50	53	

注：1、相同性能参数的滤波器尺寸越小，制造工艺难度越大，封装技术水平越高；2、插入损耗 (IL) 是衡量滤波器信号通过性能的指标，数值越低表示对频段内需保留信号的衰减越小；3、带外抑制 (Atten) 是衡量滤波器选择性能的指标，数值越高表示对频段外干扰信号抑制程度越好；4、产品性能数据来自于公司与可比公司产品规格书。

②TC-SAW 滤波器

频段	项目	好达电子	RF360	WISOL	
Band 3	型号	HDTDB03HNSS-B26	B39182B1290L210	SFXG47CHG02	
	说明	TC-SAW	TC-SAW	TC-SAW	
	尺寸 (mm)	1.6×1.2	1.6×1.2	1.6×1.2	
	TX	功率 (dBm)	30	30	31
		插入损耗 (max)	2.6	2.4	2.3@Any 4.5MHz
		抑制 (min)	49 (1805-1880M)	42 (1805.24-1879.76M)	40 (1805.24-1879.76M)
		隔离度 (min)	53	53	53
	RX	插入损耗 (max)	2.6@Any 5MHz	3.2@Any 4.5MHz	3.2@Any 4.5MHz
		抑制 (min)	48 (1710-1785M)	46 (1710.24-1784.76M)	40 (1710.24-1784.76M)
		隔离度 (min)	51	53	53
TRx41	项目	好达电子	RF360		
	型号	HDTFB41QTSS-B5	B39262B7591L210		
	说明	TC-SAW	TC-SAW		

频段	项目	好达电子	RF360	WISOL
	尺寸 (mm)	1.1×0.9	1.1×0.9	
	功率 (dBm)	32	32	
	插入损耗 (max)	2.6	2.6	
	抑制 (min)	4 (2462-2482M)	4 (2462-2482M)	

注：1、相同性能参数的滤波器尺寸越小，制造工艺难度越大，封装技术水平越高；2、插入损耗（IL）是衡量滤波器信号通过性能的指标，数值越低表示对频段内需保留信号的衰减越小；3、带外抑制（Atten）是衡量滤波器选择性能的指标，数值越高表示对频段外干扰信号抑制程度越好；4、功率（Power）是衡量发射端用滤波器最高耐受功率的指标，数值越高表示能够耐受的功率越高；5、隔离度（ISO）是衡量双工器中发射端与接收端用滤波器之间的信号隔离能力的指标，数值越高表示两颗滤波器之间的信号干扰程度越小。6、产品性能数据来自于公司与可比公司产品规格书。

③TF-SAW 滤波器

频段	项目	好达电子	RF360
TRx40	料号	HDSFB40BPSS-B5	B39242B7542L210
	说明	TF-SAW	TF-SAW
	尺寸 (mm)	1.1×0.9	1.1×0.9
	功率 (dBm)	32	32
	插入损耗 (max)	1.7	1.7
	抑制 (min)	27 (2422.5~2441.5M)	27 (2422.5~2441.5M)
频段	项目	好达电子	RF360
Wifi 2.4G	料号	HDSF2442B-B5	B39242B7555L210
	说明	TF-SAW	TF-SAW
	通带	2402.5-2481.5	2402.5-2481.5
	尺寸 (mm)	1.1×0.9	1.1×0.9
	功率 (dBm)	29	27
	插入损耗 (max)	2.0	1.9
	抑制 (min)	8 (2496-2501M)	10 (2496-2501M)

注：1、相同性能参数的滤波器尺寸越小，制造工艺难度越大，封装技术水平越高；2、插入损耗（IL）是衡量滤波器信号通过性能的指标，数值越低表示对频段内需保留信号的衰减越小；3、带外抑制（Atten）是衡量滤波器选择性能的指标，数值越高表示对频段外干扰信号抑制程度越好；4、功率（Power）是衡量发射端用滤波器最高耐受功率的指标，数值越高表示能够耐受的功率越高。5、产品性能数据来自于公司与可比公司产品规格书。

公司 SAW 滤波器、TC-SAW 双工器、TF-SAW 滤波器在多个关键性能指标（如插入损耗、带外抑制）的表现上已达到国外领先厂商的产品参数水平，部分

性能指标（如功率耐受性）甚至优于竞品。整体而言，公司产品综合性能已达到行业领先企业水平。

4、发行人市场地位

全球 SAW 滤波器市场集中度较高，主要被日本、美国企业所垄断，已形成较高的市场进入壁垒。尽管全球 SAW 滤波器市场仍由国外厂商主导，但国内企业在 SAW 滤波器市场目前已逐步实现规模化量产，市场占有率不断提高，逐渐替代进口。公司在射频芯片国产化的大趋势下，通过持续技术突破，已成为国产替代的重要力量。公司从 2018 年开始与 OPPO、vivo、小米、三星等全球知名手机品牌，华勤、龙旗、天珑、闻泰、立讯等头部 ODM 厂商，移远通信、广和通、利尔达等领先物联网模组企业，比亚迪、赛力斯等主流汽车品牌，以及中兴、大唐等通信设备商合作，逐步替代国外领先厂商，不断提高国产替代的份额。如下表所示，报告期内，公司市场占有率从 1.46% 增长至 2.29%，呈现持续增长态势。

报告期内，公司市场占有率变化情况如下：

项目	2023 年	2024 年	2025 年
公司营业收入	41,851.74 万元 人民币	60,655.03 万元 人民币	67,465.69 万元 人民币
全球声表面波滤波器市场规模	4,059 百万美元	4,061 百万美元	4,123 百万美元
市场占有率	1.46%	2.10%	2.29%

注：1、全球声表面波滤波器市场规模数据来自 Yole、浙商证券；2、2023 年至 2025 年美元兑人民币汇率按照 7.0467、7.1217、7.1429 换算。

综上，发行人产品市场地位突出，市场认可度高。

（六）发行人竞争优势与劣势

1、发行人竞争优势

（1）基础研究和开发能力并重，构建了从理论研究到工程实现的全链条创新体系，实现了对“卡脖子”技术的突破

公司研发团队长期专注于声表面波基础研究和前沿技术研究。在基础理论方面，公司对脉冲响应模型、COM 理论、2D-COM 理论、FEM/BEM、HCT 等声表面波理论体系进行了系统深入研究，并基于上述理论完全自主开发了系列声表

面波分析与设计软件，构建了公司产品设计与仿真平台。凭借深厚的理论积淀，公司先后 7 次承担科技部、工信部国家级重大科研项目，取得系列重要研究成果，在 IEEE 等期刊和国际会议上发表高水平论文 30 余篇，为推动本领域技术进步做出了积极贡献。

在技术创新方面，公司取得多项突破性成果，系国际上首次实现商用超大带宽滤波器，相对带宽达 31%，显著拓展了声表面波滤波器的应用场景；引领了基于铌酸锂的 POI 材料与器件研究，推动高性能滤波器向更高频段演进，在业内率先完成 n77/n78/n79 等 5G 声表面滤波器开发，相关成果经专家鉴定在多层结构宽带 SAW 器件设计与制备方面达到国际领先水平；2024 年，在国际上首次提出基于 LNOI 材料的大带宽横向模式自然抑制结构解决方案，并获得相关发明专利。

公司相关研究成果先后荣获国家科技进步二等奖 2 次、江苏省科学技术二等奖、北京市科学技术一等奖、中国电子元件行业协会一等奖等奖项。深厚的理论背景和持续的创新力，已经成为公司技术进步与未来发展的坚实基础和核心驱动力。

(2) 公司采用 IDM 模式，实现设计、制造一体化，具备开发周期短、交付及时、产品可靠性高等综合性优势

由于声表面波滤波器的设计与制造需要密切配合，目前行业内领先企业以 IDM 模式为主导，包括村田、高通（RF360）、太阳诱电、思佳讯等主要的 SAW 滤波器厂商均采用 IDM 模式。由于技术壁垒高，资金投入巨大，国内仅有少数企业采用 IDM 模式。公司是国内 IDM 厂商之一，已具备成熟的芯片设计、制造与封装测试能力，能够有效保障产品性能、提升良率和降低成本，从而获取全产业链产品附加值。公司滤波器年产能超过 60 亿颗，为稳定的市场供应提供了坚实保障。上述产能规模与竞争优势，主要依托于 IDM 模式的以下核心特点：

①研发与制造深度协同，缩短产品开发周期，提升研发效率，加速创新

由于设计参数的细微差异会对滤波器性能产生显著影响，滤波器设计者需要对制造工艺有深刻理解，只有将设计和制造工艺紧密结合，设计者才能实现最优的设计，制造工艺才能保证设计参数的实现，制造出符合设计的产品。公司制造

团队与设计团队协同开发，通过制造反馈推动设计规则优化，高性能的设计也将推动工艺的优化与提升，实现“工艺驱动设计”、“设计兼容制造”的双向耦合，加速新产品开发效率，提升器件性能，缩短产品开发周期。同时，公司可自由尝试新技术，不受外部制约，加速创新，推动新结构、新材料、新工艺的落地。

②交付周期可控，客户响应及时

IDM 模式有利于公司内部资源整合，能够根据市场变化，及时、灵活调整研发、产能策略，缩短产品上市周期，快速响应市场需求，提高竞争力。同时，IDM 模式供应链自主可控，产品供应稳定，有利于建立和巩固长期客户关系。

③全流程质量控制，产品具有良好的一致性和可靠性

IDM 模式可以实现全过程质量管控，从材料选型、工艺流程及封装测试遵循统一标准，从而保障产品的可靠性和一致性。

(3) SAW 滤波器产品系列持续迭代，满足小型化、集成化的市场需求

SAW 滤波器在部分应用场景具有较高的性价比。公司持续对 SAW 产品进行设计迭代与性能优化，通过精细化管理和技术创新不断提升产品良率、降低制造成本；同时，依托设计和工艺创新，持续缩小芯片尺寸，有效满足客户对器件小型化的持续需求。

在满足小型化的基础上，载波聚合技术的广泛应用对滤波器的集成化提出了更高要求。载波聚合作为提升数据传输速率的关键技术，通过同时利用多个信道实现速率提升，要求多个滤波器以共用天线形式实现集成化设计，以满足多频段并发处理时对信号隔离和天线接入的需求，进而推动多滤波器集成技术成为 SAW 滤波器技术的重要演进方向。SAW 凭借成本优势，在此集成化趋势中仍占据重要地位。

公司自 2019 年起率先布局双滤波器研发，是国内最早推出双滤波器的公司之一，已有多款双滤波器批量出货。公司在多滤波器设计及制造领域积累了丰富经验，已开发多款多滤波器产品，并批量出货。公司产品技术迭代路径与 SAW 滤波器小型化、集成化的行业演进趋势深度契合。

(4) 公司率先在国内突破 TC-SAW 关键技术，实现量产出货

①突破关键技术，构建核心技术体系

因其温度特性敏感、Q 值不高，SAW 滤波器无法满足部分频段对滤波器性能的严格要求。通过在 IDT 结构上涂覆一层薄膜补偿材料 SiO₂，制作成 TC-SAW 器件，相较于 SAW 滤波器具有良好的温度特性，同时具有较高的 Q 值，声速较低，易于低频器件的小型化设计。相较于 SAW，TC-SAW 滤波器在设计和制造上具有更高的工艺复杂度和技术难度，面临寄生杂波抑制、多层结构声波耦合机制、温补材料生长质量与应力控制等多重技术难题。公司完成了高质量 SiO₂ 温度补偿薄膜的沉积工艺开发，使得温度漂移系数由-80~-40 ppm/°C降低至-20~0 ppm/°C，实现了精确的应力与厚度均匀性控制，保证了器件的可靠性与良率。基于对 TC-SAW 横向模式的理论研究，公司开发出具备自主知识产权的新型结构，在有效抑制横向模式的同时，实现了器件 Q 值的提升。

②公司在国内率先实现 TC-SAW 滤波器量产出货，出货量位居国内前列

公司于2020年建成国内首条规模量产TC-SAW制造产线，截至目前TC-SAW滤波器出货量国内领先。公司已成功量产数十款手机用TC-SAW滤波器与双工器，覆盖多个主流频段，产品在芯片尺寸、电性能、封装适配性等方面对标国际主流厂商村田等，广泛应用于国内一线品牌手机，已向小米、OPPO、vivo、传音、联想、中兴、TCL等知名客户批量供货，同时向国外知名品牌手机如三星、HMD，以及全球头部智能终端ODM厂商如华勤、龙旗、闻泰、天珑等供货。

(5) 公司是国内少数具有 POI 材料制备能力的滤波器厂商，为未来公司产品迭代升级打下坚实基础

TF-SAW 滤波器因其优异的电性能、稳定的温度特性以及高功率耐受性，成为性能媲美 BAW 的滤波器技术，而且，由于压电材料及其切向的丰富性，可以灵活调整机电耦合系数，实现不同带宽，所以 TF-SAW 更具灵活性。TF-SAW 是高性能滤波器市场的必争之地。TF-SAW 的优势取决于 POI 材料，而商用 POI 材料规格较为单一，不能发挥 TF-SAW 的灵活性优点。公司在 POI 材料方面做了大量基础研究，具备了材料与滤波器协同设计能力。公司建立了 POI 材料的制

备与生产能力，可以充分利用基础研究成果，材料与器件协同开发，开发独具竞争力的 TF-SAW 产品。

①公司 IDM 模式上延至材料端，构建技术闭环与成本优势

公司通过自主研发掌握 POI 材料制备关键技术，成功打通“材料—芯片—封装”全链条核心环节，形成从材料制备到器件设计、制造、封装一体化的 IDM 技术闭环，材料与器件协同设计，可以大幅提升产品性能，增强交付可控性，有利于成本控制。

②通过自主研发，突破了 POI 材料多项技术瓶颈，实现量产应用

公司自 2020 年起自主研发 POI 材料关键技术，成功攻克钽酸锂、铌酸锂等高性能压电薄膜的键合、减薄、抛光、修频与均匀性控制等核心工艺难题。目前已实现多款高品质 POI 材料的开发，薄膜厚度不均匀性控制在 $<4\%$ ，表面粗糙度优于 0.2nm ，达到国际先进水平。在多项国家项目的支持下，公司在 POI 材料及器件应用做了大量基础研究，取得了系列研究成果。特别是在基于铌酸锂的 POI 材料及滤波器开发的研究方面，公司的研究处于国际引领地位。公司 POI 材料制备技术既支撑国家项目的顺利开展，又实现了在公司内部完成材料与器件的一体化设计和制造，形成独具竞争力的产品，公司在 TF-SAW 横向模式抑制技术取得重大进展，发展了“自然”抑制横向模技术，避开了国外横向模式抑制的相关专利。公司已经形成了具有自主知识产权的 POI 材料体系和 TF-SAW 器件体系。

③支持定制化开发，快速响应差异化需求

公司 POI 平台支持多种压电薄膜材料、不同晶向、厚度范围和衬底类型的定制开发能力，可快速响应公司在不同频段、不同应用场景下对 TF-SAW 滤波器的差异化设计需求，为客户提供更灵活产品支持。如公司基于特殊的材料设计为客户开发了系列高性能超宽带和窄带滤波器，常规的 POI 材料结构很难实现这类滤波器的开发。

(6) 公司产品系列覆盖频段全、品类多、应用广，满足客户多样化需求，具有较强的竞争优势

公司产品系列覆盖频段全景图

		FDD BAND 主力频段										
产品规格型号 (尺寸)		低频(450MHz-1000MHz)					中频(1800MHz-2300MHz)			高频(>2300MHz)		
		Band 5	Band 8	Band 12	Band 13	Band 14	Band 20	Band 1	Band 2	Band 3	Band 7	
Rx滤波器 (1109)												
双工器 (1814)												
双工器 (1612)												
		Band 26	Band 28a	Band 28b	Band 28F	Band 29	Band 71	Band 25	Band 32	Band 66	Band 30	
Rx滤波器 (1109)												
双工器 (1814)												
双工器 (1612)												
		TDD BAND 主力频段					GPS&WIFI主力频段					
产品规格型号 (尺寸)		中频(1000MHz-2300MHz)		高频(>2300MHz)				中频(1000MHz-2300MHz)		高频(>2300MHz)		
		Band 34	Band 39	Band 38	Band 40	Band 41N	Band 41F	产品规格型号 (尺寸)	GPSL1	GPSL5	Li+L5	WIFI
Rx滤波器 (1109)								滤波器 (0907)				
TRx滤波器 (1411)								滤波器 (1109)				
TRx滤波器 (1109)								双滤波器 (1511)				
		Multiplexer SAW (多滤波器)										
产品规格型号 (尺寸)		(> 450MHz)										
		Band (1+3)	Band (5+8)	Band(1+41)	Band (3+66)	Band(25+66)	Band(34+39)	Band(39+41)	Band(3+7)	Band(20+28)	Band(2+7)	
双滤波器 (1511)												
双滤波器 (1109)												
四工器 (1814)												
产品规格型号		LB (低频)		MHB (中高频)								
SAW Bank		Band(5+8+28)		Band(26+8+28)		Band(3+66+40+41)						
		NTN (低轨卫星通信)			工业							
产品规格型号 (尺寸)		中频(1800MHz-2300MHz)			产品规格型号 (尺寸)				高频(3300MHz-3600MHz)			
		23	24	65	Rx滤波器 (2016)				n77	n78		
Rx滤波器 (1109)												
TRx滤波器 (1411)												
双工器 (1612)												

注：1、代表 SAW、代表 TC-SAW、代表 TF-SAW；

2、FDD 和 TDD 是移动通讯信号处理的两种主要模式：FDD 指的是频分；TDD 指的是时分；

3、多滤波器集中多个频段的滤波器，可满足低、中、高频段的组合。

公司的核心竞争力体现为对声表面波滤波器主流频段、多场景的深度覆盖能力。依托自主构建的 SAW、TC-SAW 及 TF-SAW 技术平台，公司产品已实现对 300 MHz 至 6 GHz 范围内关键频段的全面覆盖，是国内少数具备从低频、中频到高频全系列滤波器规模化供货能力的企业。在滤波器集成化趋势下，公司推出覆盖 Band (1+3)、Band (5+8)、Band (1+41) 等主流频段组合的双工器、四工器及多滤波器产品，有效满足终端客户对小型化、集成化设计的核心需求。凭

借主流频段覆盖的系统化产品能力、多滤波器集成的技术领先性以及新兴应用领域的先发优势，公司已与各应用领域的头部客户建立长期合作关系，在日益激烈的市场竞争中构筑起差异化竞争壁垒。

(7) 公司制造技术持续创新，拥有先进的智能化制造平台

公司长期重视产品制造的技术创新与能力建设，围绕声表面波滤波器的关键工艺持续开展自主优化和系统集成，建设智能化工厂，打造出高效、高精度、可规模化的先进制造平台。

①研发—制造全流程协同创新，推动制造技术创新

在声表面波滤波器开发中，滤波器的设计和工艺技术密切配合，公司通过研发-制造—验证的全流程协同创新，研发与工艺相互促进，相互推动，制造技术不断进步。例如，在公司开发 TC-SAW 技术的过程中，研发团队提出技术方案，工艺团队开发工艺，在研发与工艺的不断磨合中，公司 TC-SAW 制造技术逐渐成熟。

②智能化制造提升产品一致性与良率水平

公司引入智能化制造控制系统，实现了基于大数据分析的生产管理，关键参数实时监控，随时修正，全过程追溯，保证了大批量生产中保持产品性能的一致性和稳定性，产品良率达到行业领先水平。

③工艺平台持续迭代升级，关键工艺自主可控，成本与效率协同优化

公司通过滤波器制造中的核心工序的工艺持续优化与创新，关键工艺能力（如线条精度、膜厚均匀性等）逐年提升，逐步构建起具有自主知识产权的制造工艺体系。通过制造创新，工艺路线逐步精简、材料成本持续优化和单位制造成本的逐步下降，公司产品具有较强的价格竞争力和性价比优势。

(8) 晶圆级封装（WLP）技术自主突破，率先进入高端射频前端模组供应链

公司已于 2019 年成功开发晶圆级封装（WLP）技术，在覆膜、光刻、植球、UBM 等关键工艺上实现自主突破，成为国内极少数可大规模量产 WLP 滤波器

的厂商。WLP 封装滤波器尺寸更小、更薄、散热性更好，最小尺寸达 0.8mm×0.6mm，并可耐受模组注塑工艺 180°C 高温及 3-5MPa 压力，满足 L-PAMiD、FEM 等高集成度模组的严苛封装要求。公司率先实现量产出货，已连续多年为全球知名手机终端厂商旗舰机批量供应 WLP 滤波器，成为国内极少数进入高端射频前端模组供应链的滤波器企业。

2、发行人竞争劣势

（1）融资渠道有限

公司采取 IDM 模式组织生产，需要持续投入大量资金用于研发设备购置、生产工艺升级和人才队伍建设。但受限于现有融资渠道较为单一，主要依赖股权融资及银行信贷等传统方式，导致公司在产能扩张、技术迭代和市场开拓等方面的投入能力与国际龙头企业存在明显差距。若不能及时拓展融资渠道、优化资本结构，将可能影响公司的技术升级速度和市场竞争力，从而对业务可持续发展形成制约。

（2）与国际龙头相比产业积累时间较短，存在先发差距

发行人虽已实现 SAW 及 TC-SAW 产品的规模化量产，但与村田、高通等拥有数十年产业积累的国际龙头企业相比，在基础理论研究、材料体系开发、工艺数据库积累等方面仍存在一定差距。滤波器行业属于技术与经验密集型产业，产品性能提升依赖于长期迭代与工艺磨合。国际龙头企业凭借持续的研发投入和人才储备，已形成深厚的工艺技术积累。发行人在产品的工艺稳定性、良率一致性及可靠性方面，仍需通过持续的大规模量产和客户验证进一步优化，这一过程需要较长时间的资金投入与市场积累。

三、发行人销售情况和主要客户

（一）主营业务收入的构成情况

1、按产品划分的收入构成

报告期内，公司主营业务收入按产品分类如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)
滤波器	33,325.81	49.64	31,793.35	52.63	25,570.22	61.41
双工器	32,167.80	47.91	26,659.44	44.13	13,460.52	32.33
谐振器	692.87	1.03	679.66	1.13	1,006.94	2.42
其他	954.79	1.42	1,278.82	2.12	1,602.64	3.85
合计	67,141.27	100.00	60,411.28	100.00	41,640.32	100.00

2、按技术路线划分的收入构成

报告期内，公司主营业务收入按技术路线分类如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)
SAW	44,320.82	66.01	43,975.96	72.79	34,491.67	82.83
TC-SAW	22,725.52	33.85	16,429.58	27.20	7,148.05	17.17
TF-SAW	94.94	0.14	5.74	0.01	0.60	0.00
合计	67,141.27	100.00	60,411.28	100.00	41,640.32	100.00

2、按销售地域划分的收入构成

报告期内，公司主营业务收入按地域分类如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)
内销	65,647.47	97.78	58,840.69	97.40	40,047.02	96.17
外销	1,493.80	2.22	1,570.59	2.60	1,593.30	3.83
合计	67,141.27	100.00	60,411.28	100.00	41,640.32	100.00

3、按销售模式划分的收入构成

报告期内，公司主营业务收入按销售模式分类如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)
经销	37,532.05	55.90	29,818.09	49.36	22,017.50	52.88
直销	29,609.22	44.10	30,593.19	50.64	19,622.83	47.12
合计	67,141.27	100.00	60,411.28	100.00	41,640.32	100.00

4、按季度划分的收入构成

报告期内，公司主营业务收入按季度分类如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)
第一季度	14,253.12	21.23	11,349.38	18.79	5,932.77	14.25
第二季度	20,099.62	29.94	14,111.38	23.36	8,583.72	20.61
第三季度	19,528.01	29.08	18,418.91	30.49	10,544.19	25.32
第四季度	13,260.52	19.75	16,531.61	27.37	16,579.64	39.82
合计	67,141.27	100.00	60,411.28	100.00	41,640.32	100.00

(二) 主要客户情况

报告期内，公司对前五大客户的销售金额及占营业收入比例如下：

单位：万元

年份	序号	客户名称	主要销售内容	收入金额	占营业收入比例
2025 年度	1	深圳市华凯科技开发有限公司	滤波器、双工器	12,738.16	18.88%
	2	深圳市普荣实业有限公司	滤波器、双工器	11,337.17	16.80%
	3	华勤技术股份有限公司	滤波器、双工器	8,299.73	12.30%
	4	龙旗电子(惠州)有限公司	滤波器、双工器	8,130.02	12.05%
	5	深圳市南盟电子有限公司	滤波器、双工器	5,060.36	7.50%
		合计		45,565.44	67.54%
2024 年度	1	龙旗电子(惠州)有限公司	滤波器、双工器	9,325.96	15.38%
	2	深圳市华凯科技开发有限公司	滤波器、双工器	7,413.45	12.22%
	3	深圳市普荣实业	滤波器、双工器	7,064.26	11.65%

年份	序号	客户名称	主要销售内容	收入金额	占营业收入比例
		有限公司			
	4	华勤技术股份有限公司	滤波器、双工器	6,265.49	10.33%
	5	A 公司	滤波器、双工器	3,938.05	6.49%
	合计			34,007.21	56.07%
2023 年度	1	A 公司	滤波器、双工器	5,784.25	13.82%
	2	深圳市华凯科技开发有限公司	滤波器、双工器	5,779.17	13.81%
	3	深圳市普荣实业有限公司	滤波器、双工器	5,546.01	13.25%
	4	华勤技术股份有限公司	滤波器、双工器	4,626.87	11.06%
	5	龙旗电子(惠州)有限公司	滤波器、双工器	4,289.45	10.25%
	合计			26,025.76	62.19%

注：列示前五大客户时，公司对下列同一控制下的客户合并计算：1、“深圳市普荣实业有限公司”包含深圳市普荣实业有限公司、H.K.EVERGROW INDUSTRIAL CO., LIMITED；2、“华勤技术股份有限公司”包含东莞华贝电子科技有限公司、南昌华勤电子科技有限公司、上海勤允电子科技有限公司和南昌勤胜电子科技有限公司。

报告期内，公司向前五名客户的销售收入合计占比分别为 62.19%、56.07% 和 67.54%，不存在向单个客户销售比例超过公司销售收入 50%的情形。

上述客户中，华勤技术股份有限公司系公司关联方、A 公司系公司曾经关联方，具体关联关系及与公司业务合作情况参见本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“六、关联方、关联关系和关联交易”相关内容。除上述情形以外，截至本招股说明书签署日，公司董事、历史监事、高级管理人员或持有发行人 5% 以上股份的股东与上述客户不存在关联关系。

（三）主要产品的产量和销量情况

1、产能、产量

报告期内，公司产品的产能利用率情况具体如下：

单位：万颗

技术路线	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
SAW	产能	468,537.12	451,588.06	422,785.23

技术路线	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
	产量	386,259.13	283,195.17	127,689.37
	产能利用率	82.44%	62.71%	30.20%
TC-SAW	产能	109,730.16	61,705.70	38,907.57
	产量	97,908.62	45,684.92	11,826.47
	产能利用率	89.23%	74.04%	30.40%

注：TF-SAW 和 SAW 除所用衬底不同，制造工艺类似、瓶颈工序一样，计算的 SAW 产能包含 TF-SAW 产能，为保持口径一致，此处 SAW 的产量含 TF-SAW 的产量。

通过持续不断地技术创新并克服短期资金压力，公司成为国内极少数采用 IDM 模式的企业之一，构建了稳定的市场供应能力。报告期内，凭借成熟的芯片设计、制造与封装测试能力，公司产品性能、良率大幅提升，SAW 和 TC-SAW 的产能利用率不断提高，其中 SAW 产能利用率从 30.20%提高至 82.44%；TC-SAW 的产能利用率从 30.4%上升至 89.23%。

2、产量、销量

报告期内，公司产品的产量和销量情况具体如下：

单位：万颗

技术路线	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
SAW	销量	347,555.93	283,400.87	217,152.93
	产量	386,259.13	283,195.17	127,689.37
	产销率	89.98%	100.07%	170.06%
TC-SAW	销量	82,391.61	46,586.69	16,740.44
	产量	97,908.62	45,684.92	11,826.47
	产销率	84.15%	101.97%	141.55%

注：TF-SAW 和 SAW 除所用衬底不同，制造工艺类似、瓶颈工序一样，计算的 SAW 产能包含 TF-SAW 产能，为保持口径一致，此处 SAW 的产量和销量含 TF-SAW 的产量和销量。

凭借 IDM 模式构建的稳定供应能力，公司产销量均快速提升，报告期内，公司 SAW 产销率分别为 170.06%、100.07%、89.98%；TC-SAW 产销率分别为 141.55%、101.97%、84.15%。其中 2023 年产销率较高，超过 100%，主要原因系公司销售前期库存较多。

四、发行人采购情况和主要供应商

（一）主要原材料的采购情况

1、原材料采购情况

报告期内，公司原材料采购分类明细情况如下：

单位：万元

项目	2025年		2024年度		2023年度	
	金额	占采购总额比	金额	占采购总额比	金额	占采购总额比
晶片	11,371.72	32.75%	9,149.63	33.02%	2,472.34	17.39%
基板	8,291.75	23.88%	5,901.05	21.30%	2,749.72	19.35%
合金线	1,546.27	4.45%	802.57	2.90%	252.78	1.78%
光刻胶	1,443.26	4.16%	1,200.94	4.33%	613.26	4.32%
环氧树脂	957.64	2.76%	668.14	2.41%	358.19	2.52%
基座	742.39	2.14%	478.00	1.73%	483.03	3.40%
光掩膜	547.13	1.58%	725.79	2.62%	509.88	3.59%
主要原材料合计	24,900.15	71.71%	18,926.12	68.30%	7,439.20	52.35%
其他类原材料	9,824.26	28.29%	8,782.73	31.70%	6,771.55	47.65%
原材料采购总额	34,724.41	100.00%	27,708.85	100.00%	14,210.75	100.00%

报告期内，随着经营规模的扩大，公司采购规模逐年增长。

2、主要原材料的价格变动趋势

报告期内，公司主要原材料平均采购单价及其变动情况如下：

单位：元

类别	单位	2025年度	变动比例	2024年度	变动比例	2023年度
晶片	片	202.53	-1.16%	204.91	-16.80%	246.30
基板	片	61.82	-16.40%	73.95	3.22%	71.64
合金线	卷	2,407.54	40.45%	1,714.15	31.42%	1,304.34
光刻胶	瓶	6,346.78	-1.12%	6,418.72	-5.28%	6,776.30
环氧树脂	Kg	1,286.38	-3.87%	1,338.21	-4.58%	1,402.46
基座	百只	25.50	-3.66%	26.47	-1.64%	26.91
光掩膜	块	2,896.38	-7.66%	3,136.51	10.60%	2,835.83

报告期内，公司主要原材料的采购价格整体呈下降趋势。报告期内，公司晶片分4寸晶片和6寸晶片，2025年晶片平均价格下降幅度较小的原因是价格较高的6寸晶片占比上升。公司合金线的平均采购价格逐年上升，主要受上游原材料黄金价格上涨的影响。公司基板和光掩膜的规格型号较多，价格差异较大，报告期内，公司不同型号的基板和光掩膜的采购价格整体呈下降趋势。2024年，公司基板和光掩膜的平均采购价格上升，主要受内部采购结构变化的影响，价格较高的基板和光掩膜的采购数量占比提升，整体拉高了平均采购价格所致。

（二）能源耗用情况

报告期内，公司水电耗用情况如下：

能源	项目	2025年度	2024年度	2023年度
水	水费（万元）	30.96	25.35	29.92
	数量（万吨）	7.44	6.11	6.76
	均价（元/吨）	4.16	4.14	4.42
电	电费（万元）	3,068.61	3,000.85	2,764.39
	数量（万千瓦时）	4,172.43	3,894.76	3,544.52
	均价（元/千瓦时）	0.73	0.77	0.78

（三）报告期内公司向前五名供应商采购情况

报告期内，公司前五大原材料供应商采购情况如下：

单位：万元

年份	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额（万元）	占总采购金额比例
2025年度	1	盐城晶弘电子材料有限公司	晶片	5,178.14	14.91%
	2	厦门佳达微集成电路有限公司	基板	4,205.48	12.11%
	3	安捷利美维电子（厦门）有限责任公司	基板	3,480.39	10.02%
	4	天通控股股份有限公司	晶片	3,195.11	9.20%
	5	宁波康强电子股份有限公司	合金线	1,545.18	4.45%
	合计			17,604.30	50.69%
2024年度	1	盐城晶弘电子材料有限公司	晶片	4,023.91	14.52%
	2	安捷利美维电子（厦门）有限责任公司	基板	3,925.80	14.17%

年份	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额 (万元)	占总采购金额 比例
	3	天通控股股份有限公司	晶片	3,233.31	11.67%
	4	苏州阿尔泰克电子科技有限公司	基板、墙膜、顶膜和显眼液等	2,131.97	7.69%
	5	INABATA SANGYO (H.K) LIMITED	晶片	892.50	3.22%
	合计			14,207.48	51.27%
2023 年度	1	安捷利美维电子(厦门)有限责任公司	基板	1,970.72	13.87%
	2	天通控股股份有限公司	晶片	1,865.91	13.13%
	3	苏州阿尔泰克电子科技有限公司	基板、墙膜、顶膜和显影液等	1,497.25	10.54%
	4	京瓷(中国)商贸有限公司上海分公司	基座	432.20	3.04%
	5	INABATA SANGYO (H.K) LIMITED	晶片	365.75	2.57%
	合计			6,131.83	43.15%

注：列示前五大供应商时，公司对下列同一控制下的供应商合并计算：1、“天通控股股份有限公司”包含天通控股股份有限公司、天通凯巨科技有限公司；2、“盐城晶弘电子材料有限公司”包含盐城晶弘电子材料有限公司、盐城市振弘电子材料厂；3、“安捷利美维电子(厦门)有限责任公司”包含安捷利美维电子(厦门)有限责任公司、广州美维电子有限公司；4、“苏州阿尔泰克电子科技有限公司”包含“苏州阿尔泰克电子科技有限公司、阿尔泰克(江苏)电子科技有限公司”。

公司不存在向单个供应商的采购比例超过当期原材料采购总额 50%的情况，亦不存在对少数供应商构成重大依赖的情形。

截至本招股说明书签署日，公司董事、历史监事、高级管理人员或持有发行人 5%以上股份的股东与上述供应商不存在关联关系。

五、发行人的主要固定资产和无形资产

(一) 主要固定资产情况

1、固定资产基本情况

公司主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输设备等。截至 2025 年 12 月 31 日，公司固定资产的具体情况如下：

单位：万元

固定资产	资产原值	资产净值	成新率
房屋建筑物	7,950.66	5,129.60	64.52%
机器设备	136,288.66	79,597.55	58.40%
运输设备	399.77	95.08	23.78%
其他设备	5,349.97	1,426.62	26.67%
总计	149,989.07	86,248.86	57.50%

2、主要房屋及建筑物

截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有已办理产权登记的房屋建筑物 1 处，具体情况如下：

序号	权利人	产权证号	房屋建筑面积（平方米）	地址	房屋性质	用途	颁证日期	有效期至	他项权利
1	好达电子	苏（2021）无锡市不动产权第 011274 2 号	38,822.29	高运路 11 5 号	自建房	工业、交通、仓储	2021.05.08	2054.03.31	一般抵押，抵押权人中国光大银行股份有限公司无锡分行，主债权数额 9,000 万元，抵押期限至 2025 年 9 月 29 日-2031 年 9 月 28 日

3、房屋租赁

截至本招股书签署日，公司所拥有的租赁房产或使用的办公场地具体情况如下：

序号	承租方	出租方	坐落位置	租赁用途	租期
1	无锡市好达电子股份有限公司上海分公司	上海吉易寻客信息科技有限公司	上海市闵行区顾戴路2337号1幢（A幢）605单元	办公	2026.3.1-2028.2.29
2	无锡市好达电子股份有限公司西安分公司	陕西昇昱不动产运营管理有限公司	西安市高新区唐延南路8号泰维智链中心项目T1楼（座）16层 1608号	办公	2025.5.8-2027.5.7
3	无锡市好达电子股份有限公司深圳分公司	深圳市新美达产业发展有限公司	深圳市南山区桃源街道平山一路111号的新视艺创客公园	办公	2025.2.25-2027.2.24

序号	承租方	出租方	坐落位置	租赁用途	租期
4	好达电子	张晟	无锡市滨湖区 海岸城37号 1501室	员工宿舍	2025.6.1-2026.5.31
5	好达电子	无锡太湖 城传感信 息中心发 展有限公 司	无锡市经开区 华庄街道华运 路19号人才公 寓02-213、 02-214	员工宿舍	2026.4.1-2027.3.31
6	好达电子	无锡市竭 诚企业后 勤管理服 务有限公 司	无锡市经开区 高浪东路518 号金泰公寓 302、303、305 、306、307、 308、309、 30101、30102 、30103	员工宿舍	2026.1.1-2026.6.30
7	好达电子	无锡太湖 城传感信 息中心发 展有限公 司	无锡市经开区 华庄街道华运 路19号人才公 寓02-609、 02-613、02-614 、02-615	员工宿舍	2026.1.10-2027.1.9
8	好达电子	无锡太湖 城传感信 息中心发 展有限公 司	无锡市经开区 华庄街道华运 路19号人才公 寓02-607、 02-608	员工宿舍	2026.3.9-2027.3.31

截至本招股说明书签署日，发行人租赁的房产均已签订合法有效的租赁合同。其中序号 1、2、3 项为办公场所，序号 3 未办理租赁备案；序号 4、5、6、7、8 项为解决部分员工的住宿需求，未办理租赁备案。

根据《民法典》第七百零六条之规定，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。公司承租的尚未办理租赁备案的相应房屋不影响租赁合同的法律效力，不会对公司的持续经营造成重大不利影响，不构成本次发行上市的实质性法律障碍。

此外，控股股东好达投资、实际控制人刘平就所租赁的瑕疵房产出具如下承诺：“如公司因其所租赁的房屋建筑物未办理权属证书而受到行政主管部门的处罚，本企业/本人自愿承担全部罚款。如行政主管部门要求出租方拆除违章建筑

物，影响公司生产经营的，本企业/本人自愿赔偿公司因此受到的全部损失（包括但不限于搬迁费用）。”因此，发行人相关租赁瑕疵不会对发行人生产经营造成重大不利影响。

（二）主要无形资产情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司所拥有的无形资产主要为商标、专利、软件著作权和土地使用权，具体如下：

1、专利技术

（1）国内专利

截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有国内专利 60 项，其中发明专利 39 项，具体情况如下：

序号	专利名称	类别	专利号	申请日	授权日	专利权人	取得方式	他项权利
1	电声换能器、声表面波谐振器及声表面波装置	发明	ZL202411136713.0	2024/8/19	2025/9/16	好达电子	原始取得	无
2	弹性波滤波器及射频前端结构	发明	ZL202410536977.9	2024/4/30	2025/8/19	好达电子	原始取得	无
3	弹性波滤波器及多工器	发明	ZL202410425937.7	2024/4/10	2025/8/5	好达电子	原始取得	无
4	弹性波装置	发明	ZL202310582156.4	2023/5/23	2024/9/10	好达电子	原始取得	无
5	弹性波滤波器及其制备方法	发明	ZL202310661476.9	2023/6/5	2024/6/7	好达电子	原始取得	无
6	声表面波装置	发明	ZL202311227663.2	2023/9/21	2024/5/7	好达电子	原始取得	无
7	弹性波器件	发明	ZL202310066430.2	2023/1/28	2024/5/7	好达电子	原始取得	无
8	横向激励薄膜体声波谐振器	发明	ZL202310349255.8	2023/4/3	2024/3/19	好达电子	原始取得	无
9	弹性波滤波器	发明	ZL202310815076.9	2023/7/4	2024/2/13	好达电子	原始取得	无
10	弹性波滤波器	发明	ZL202310957678.8	2023/8/1	2024/2/13	好达电子	原始取得	无
11	弹性波器件	发明	ZL202310624423.X	2023/5/30	2024/2/13	好达电子	原始取得	无
12	一种具有活塞模式的声表面波装置	发明	ZL202310589302.6	2023/5/23	2023/12/22	好达电子	原始取得	无
13	一种低损耗的声表面波装置	发明	ZL202110786410.3	2021/7/12	2023/11/17	好达电子	原始取得	无
14	一种基于活塞模式的声表面波装置及制备方法	发明	ZL202310409624.8	2023/4/17	2023/11/17	好达电子	原始取得	无

序号	专利名称	类别	专利号	申请日	授权日	专利权人	取得方式	他项权利
15	一种高功率耐受性温补型声表面波滤波器结构及制备方法	发明	ZL202010139489.6	2020/3/3	2023/11/3	好达电子	原始取得	无
16	一种石墨烯声表面波滤波器结构及其制备方法	发明	ZL202010095465.5	2020/2/17	2023/9/29	好达电子	原始取得	无
17	一种具有复合膜层的声表面波装置	发明	ZL202111087051.9	2021/9/16	2023/9/29	好达电子	原始取得	无
18	一种高性能的声表面波滤波器	发明	ZL202210025563.0	2022/1/11	2023/8/1	好达电子	原始取得	无
19	一种体声波谐振器及其制备方法	发明	ZL202110779441.6	2021/7/9	2023/7/18	好达电子	原始取得	无
20	一种新型键合结构声表面波器件及其制备方法	发明	ZL202110233563.5	2021/3/3	2023/7/11	好达电子	原始取得	无
21	声表面波谐振器电极传输结构	发明	ZL201611203372.X	2016/12/23	2023/6/16	好达电子	原始取得	无
22	一种具有温度补偿功能的声表面波换能器的制备方法	发明	ZL202110008821.X	2021/1/5	2023/5/26	好达电子	原始取得	无
23	一种具有横模抑制功能的声表面波换能器及其制备方法	发明	ZL202010095481.4	2020/2/17	2023/3/28	好达电子	原始取得	无
24	一种声波换能器结构	发明	ZL202210150552.5	2022/2/18	2023/3/28	好达电子	原始取得	无
25	一种声表器件的微型化叠层多芯片封装结构及其制备方法	发明	ZL202110233571X	2021/3/3	2023/2/28	好达电子	原始取得	无
26	一种叉指结构过补偿的声表面波滤波器	发明	ZL201811450879.4	2018/11/30	2023/2/28	好达电子	原始取得	无
27	一种高频大带宽薄膜体波滤波器结构及其制备方法	发明	ZL201911347704.5	2019/12/24	2021/12/7	好达电子	原始取得	无
28	一种声表面波滤波器	发明	ZL201810325614.5	2018/4/12	2021/10/29	好达电子	原始取得	无
29	一种声表面波谐振器的杂波抑制方法	发明	ZL201810325632.3	2018/4/12	2021/4/6	好达电子	原始取得	无
30	一种滤波器的新型晶圆级封装方法	发明	ZL201910923479.9	2019/9/27	2021/2/19	好达电子	原始取得	无
31	一种超大带宽声表面波滤波器	发明	ZL201611203355.6	2016/12/23	2020/11/24	好达电子	原始取得	无
32	一种基于碳化硅衬底/氧化锌或掺杂氧化锌薄膜的声表面波器件及其制备方法	发明	ZL201810069487.7	2018/1/24	2020/11/10	清华大学、好达电子	原始取得	无

序号	专利名称	类别	专利号	申请日	授权日	专利权人	取得方式	他项权利
33	一种滤波器探针测试方法	发明	ZL201811450858.2	2018/11/30	2020/10/2	好达电子	原始取得	无
34	一种辅助显影版图制作方法	发明	ZL201811450862.9	2018/11/30	2020/9/8	好达电子	原始取得	无
35	一种滤波器的新型封装结构和封装方法	发明	ZL201910922987.5	2019/9/27	2020/9/4	好达电子	原始取得	无
36	芯片级倒封装滤波器载板防环氧树脂流入的隔离结构	发明	ZL201611213187.9	2016/12/23	2019/9/17	好达电子	原始取得	无
37	可测温射频标签以及安装有该标签的助航灯具	发明	ZL201510218292.0	2015/5/4	2018/3/30	好达电子	原始取得	无
38	在柔性衬底上沉积高c轴取向氮化铝薄膜的方法	发明	ZL201410705974.X	2014/11/27	2017/6/16	清华大学、中电26所、好达电子	继受取得	无
39	具有非周期结构的声学超晶格谐振器及其杂峰抑制方法	发明	ZL201210384847.5	2012/10/11	2015/2/11	好达电子	原始取得	无
40	具有活塞模式的声表面波装置	实用新型	ZL202420795244.2	2024/4/16	2025/1/10	好达电子	原始取得	无
41	一种高可靠性弹性滤波器及多工器	实用新型	ZL202420786289.3	2024/4/16	2024/12/13	好达电子	原始取得	无
42	一种声表面波谐振器组件和滤波器	实用新型	ZL202123143639.X	2021/12/14	2022/6/21	好达电子	原始取得	无
43	一种晶圆级封装声表器件	实用新型	ZL202220070672.X	2022/1/11	2022/6/21	好达电子	原始取得	无
44	一种大带宽声表面波滤波器及射频前端滤波装置	实用新型	ZL202123140628.6	2021/12/14	2022/6/17	好达电子	原始取得	无
45	一种减小应力分布不均的PCB基板焊盘结构	实用新型	ZL202122300052.9	2021/9/23	2022/4/19	好达电子	原始取得	无
46	一种声波器件的封装结构	实用新型	ZL202122250417.1	2021/9/16	2022/3/1	好达电子	原始取得	无
47	一种具有空气隙的BAW谐振器	实用新型	ZL202122308677.X	2021/9/23	2022/3/1	好达电子	原始取得	无
48	一种滤波器的晶圆级封装结构	实用新型	ZL202121591881.0	2021/7/13	2021/12/21	好达电子	原始取得	无
49	一种声速连续的键合结构声表面波器件	实用新型	ZL202120465887.7	2021/3/3	2021/12/7	好达电子	原始取得	无
50	一种集成IPD的晶圆级封装声表器件	实用新型	ZL202120466458.1	2021/3/3	2021/10/29	好达电子	原始取得	无

序号	专利名称	类别	专利号	申请日	授权日	专利权人	取得方式	他项权利
51	一种提升双工器隔离度的 PCB 镀层结构	实用新型	ZL202120707920.2	2021/4/7	2021/10/15	好达电子	原始取得	无
52	一种超大带宽声表面波滤波器	实用新型	ZL201621422230.8	2016/12/23	2017/6/20	好达电子	原始取得	无
53	一种带标尺的声表面波器件电极	实用新型	ZL201621422224.2	2016/12/23	2017/8/4	好达电子	原始取得	无
54	一种声表面波器件电极	实用新型	ZL201621422200.7	2016/12/23	2017/7/14	好达电子	原始取得	无
55	易于集成的微型化声表面波滤波器件封装结构	实用新型	ZL201621422223.8	2016/12/23	2017/7/14	好达电子	原始取得	无
56	CSP 封装的声表面波滤波器芯片隔离槽	实用新型	ZL201621422266.6	2016/12/23	2017/7/7	好达电子	原始取得	无
57	一种声表面波滤波器反射栅结构	实用新型	ZL201621431474.2	2016/12/23	2017/7/7	好达电子	原始取得	无
58	一种带内匹配电路的声表面波滤波器	实用新型	ZL201621422197.9	2016/12/23	2017/6/20	好达电子	原始取得	无
59	一种石英声表面波高 Q 值谐振器的结构	实用新型	ZL201621422222.3	2016/12/23	2017/6/20	好达电子	原始取得	无
60	叉指换能器的多层金属电极结构	实用新型	ZL201621422225.7	2016/12/23	2017/6/20	好达电子	原始取得	无

(2) 国外专利

截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有境外发明专利 1 项，具体情况如下：

序号	国家	专利名称	专利号	专利权人	授权日
1	美国	TYPE OF ULTRA-WIDE BAND SAW FILTER	US 10,998,883 B2	好达电子	2021.05.04

2、注册商标

截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有商标 8 项，具体情况如下：

序号	商标名称	商标图像	权利人	取得方式	注册号	核定使用类别	注册地	有效期	他项权利
1	HD		好达电子	原始取得	8454551	9	中国	2031 年 07 月 20 日	无
2	好达		好达电子	原始取得	3631589	9	中国	2035 年 02 月 13 日	无

序号	商标名称	商标图像	权利人	取得方式	注册号	核定使用类别	注册地	有效期	他项权利
3	SHOULDER		好达电子	原始取得	3631588	9	中国	2035年02月13日	无
4	好达		好达电子	原始取得	1642509	9	中国	2031年09月27日	无
5	好达		好达电子	原始取得	62397468	9	中国	2032年9月27日	无
6	SHOULDER		好达电子	原始取得	62419720	9	中国	2032年7月20日	无
7	好达		好达电子	原始取得	62406466	42	中国	2032年9月20日	无
8	好达		好达电子	原始取得	1829275	9	西班牙	2034年10月12日	无

3、软件著作权

截至2025年12月31日，公司拥有软件著作权1项，具体如下：

序号	软件名称	著作权人	登记号	取得方式	登记批准日期	他项权利
1	好达声表面波滤波器设计软件 V1.0	好达电子	2019SR1090779	原始取得	2019.10.28	无

4、土地使用权

截至2025年12月31日，公司拥有1项土地使用权，具体如下：

序号	土地使用证号	宗地位置	用途	所有人	面积(m ²)	终止日期	取得方式	他项权利
1	苏(2021)无锡市不动产权第0112742号	高运路115号	工业用地	好达电子	23,932.40	2054.03.31	出让	一般抵押，抵押权人中国光大银行股份有限公司无锡分行，主债权数额9,000万元，抵押期限至2025年9月29日至2031年9月28日

(三) 特许经营权情况

报告期内，公司不存在特许经营权的情况。

(四) 主要业务资质情况

截至2025年12月31日，发行人取得的其他主要相关资质证书、业务许可及证书情况如下：

1、高新技术企业证书

公司名称	核发单位	核发日期	编号	有效期
好达电子	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	2023.11.06	GR202332002180	3年

2、海关进出口货物收发货人备案回执

公司名称	核发单位	海关备案日期	海关编码	有效期
好达电子	中华人民共和国无锡海关	2013.09.03	3202963265	长期

3、对外贸易经营者备案登记表

公司名称	核发单位	核发日期	备案登记表编号	有效期
好达电子	江苏无锡对外贸易备案登记机关	2020.06.18	04184568	长期

截至2025年12月31日，公司已取得从事日常经营活动所必需的行政许可、备案、注册或者认证等业务资质，上述业务资质不存在被吊销、撤销、注销、撤回的重大法律风险或者到期无法延续的风险。

六、发行人的核心技术与研发情况

（一）主要产品的核心技术情况

1、核心技术的基本情况

公司主要从事声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售，已具备成熟的芯片设计技术、制造与封测工艺，并拥有多项核心技术。公司现阶段所掌握的主要核心技术如下：

序号	核心技术类别	技术名称	技术来源	技术简介	相关技术所处阶段	是否具有独创性
1	芯片设计类	声表面波射频芯片精确仿真技术	自主研发	公司能够根据不同的理论基础自主开发出适用于不同类型的声表面波射频芯片仿真平台，并通过仿真平台对芯片的性能表现进行有效模拟。该核心技术在运用基础理论、开发软件工具等方面具有较高的技术成熟度，目前主要应用于声表面波射频芯片设计、产品质量分析、新技术开发和新材料研究等领域。	应用阶段	所有声学仿真与设计平台独立开发；功率仿真方法具有独创性
2	芯片制造类	声表面波射频芯片前道技术	自主研发	公司的芯片制造能力能够满足芯片设计的参数要求，公司在匀胶、光刻、显影、蒸发、剥离、修频等芯片制造的关键工序上已积累	大批量生产阶段	-

序号	核心技术类别	技术名称	技术来源	技术简介	相关技术所处阶段	是否具有独创性
				形成具备竞争力的工艺能力。该核心技术在叉指换能器的线条加工、线条尺寸控制、金属膜厚控制等方面具有较高的技术成熟度，目前主要应用于高品质声表面波射频芯片的量产制造中。		
3		高功率滤波器制造技术	自主研发	公司的芯片制造能力能够满足拓扑结构的设计要求，公司已能够制备性能稳定的高功率耐受性叉指换能器电极薄膜。该核心技术在提高滤波器的功率耐受性等方面具有较高的技术成熟度，目前主要应用于高功率滤波器的量产制造中。	大批量生产阶段	高织构电极材料的制备具有独创性
4		TC-SAW 滤波器制造技术	自主研发	公司的 TC-SAW 滤波器制造能力能够满足高性能低温漂滤波器的要求，公司 SiO ₂ 温度补偿薄膜的制备已积累形成具备竞争力的工艺能力，包括 SiO ₂ 薄膜生长质量、一致性控制等。	大批量生产阶段	-
5	封装测试类	声表面波射频芯片 CSP、WLP 封装技术	自主研发	公司 CSP 封装量产交付最小尺寸为 0.9mm×0.7mm 的滤波器、1.4mm×1.1mm 的双工器，WLP 生产线能够量产交付最小尺寸为 0.8mm×0.6mm 的滤波器。该核心技术在减小封装面积与厚度、增加抗压性能等方面具有较高的技术成熟度，目前主要应用于高品质声表面波射频芯片的封装过程中。	大批量生产阶段	-
6	材料制备类	POI 材料制备技术	自主研发	公司具有高一致性 POI 晶圆材料制造能力，能够满足高性能 TF-SAW 滤波器开发要求。公司在晶圆键合、晶圆减薄、薄膜厚度精修等形成具备竞争力的 POI 材料制备工艺能力，该核心技术为公司高性能 TF-SAW 滤波器提供高质量衬底材料。	批量生产阶段	公司开发的 POI 材料中，基于铌酸锂的 POI 材料结构、基于石英衬底的材料结构及基于 SiC 衬底的材料结构具有独创性

2、核心技术先进性及具体表征

(1) 芯片设计类核心技术

在芯片设计方面，公司具备 1 项核心技术，即声表面波射频芯片精确仿真技术。

①核心技术概述

芯片仿真即在 EDA 开发平台上对芯片的性能表现进行模拟，用以确保芯片进入流片生产环节前符合预期设计要求，是芯片设计的关键环节。声表面波滤波

器的工作原理涉及力学与电学的耦合，精确仿真技术难度较大，且市场上尚无成熟的商用软件可用。目前国际领先的声表面波滤波器厂商的仿真与设计平台均为自主研发，芯片仿真技术已成为声表面波滤波器厂商的核心竞争力之一。

芯片仿真的精确性取决于理论建模的有效性。不同种类的声表面波滤波器在声学、电学和材料特性存在差异，需要借由不同的理论模型进行仿真拟合。基础理论研究是声表面波滤波器设计与开发的前提，声表面波滤波器厂商的理论研究能力、模型构建能力能够对其芯片仿真技术水平产生深刻影响。针对声表面波滤波器的行业特点，公司专门在研发部设置理论组进行基础理论与仿真软件开发。目前公司已根据不同的理论基础自主开发出适用于不同种类的声表面波滤波器的仿真软件，具体情况如下：

序号	开发时间	理论基础	仿真软件	产品类型
1	2007	脉冲响应模型与衍射补偿理论	SAW designer	传统切指加权滤波器
2	2009	声表面波耦合模理论	COM simulator	Spudt 滤波器、TF-SAW 滤波器
3	2010	周期 FEM/BEM ² 理论	Periodic SAW	参数提取、基础研究、温度特性分析、TF-SAW 滤波器
4	2010	有限长 FEM/BEM 理论	Finite SAW	常规 SAW 滤波器、TF-SAW 滤波器
5	2012	电磁场理论与声波理论	SAW platform	低损耗滤波器、TF-SAW 滤波器
6	2018	有限元级联理论	FEM SAW	TC-SAW 滤波器、TF-SAW 滤波器
7	2024	电磁场与热传导理论	SAW Power	TX 滤波器、双工器和 TF-SAW 滤波器
8	2025	二维耦合模型与有限元理论	FEMCOM2 D	TC-SAW 滤波器、TF-SAW 滤波器

②核心技术的先进性

公司运用滤波器基础理论所开发的上述仿真软件是公司射频芯片设计、产品质量分析、新技术开发和新材料研究得以实现的工具基础。作为核心技术之一，公司射频芯片精确仿真技术的先进性主要体现在公司基础理论的运用能力与软件工具的性能表现上的比较优势。

² 周期 FEM（周期有限元法）和周期 BEM（周期边界元法）是计算力学中用于分析周期性结构（如光子晶体、声子晶体、复合材料等）的两种数值方法。它们通过利用结构的周期性特征，大幅降低计算复杂度。

A、基础仿真平台（2010年）：基于 FEM/BEM 理论

公司于 2010 年成功开发基于周期 FEM/BEM 理论的软件 Periodic SAW 和基于有限长 FEM/BEM 理论的软件 Finite SAW，均可以应用于手机滤波器的仿真设计。FEM/BEM 模型中，半无限大真空介质、压电层用边界元方法建模，金属电极与介质层用有限元仿真，共同构建一套完整的数学模型，仿真结果更为准确。周期 FEM/BEM 理论可以用来分析材料特性（如提取反射系数、机电耦合系数、温度系数等基本技术参数），有限长 FEM/BEM 理论可以直接用来计算滤波器电性能参数，两种理论均是学界公认的分析 SAW 滤波器的精确模型，亦已成为国外领先厂商和公司分析与设计声表面波滤波器的理论基础。

B、高性能仿真平台（2018年）：基于有限元级联理论

公司于 2018 年成功开发基于有限元级联理论的 FEM 软件，并应用于高性能手机滤波器的仿真设计。相较于 SAW 滤波器，温度补偿型声表面波滤波器（TC-SAW）、多层介质声表面波滤波器等射频芯片性能表现更好，但结构较为复杂。公司根据有限元级联理论自主开发的 FEM 软件适用于复杂结构声学滤波器的精确分析，可以应用于 SAW、TC-SAW、TF-SAW 等声表面波滤波器和 BAW、FBAR 等体声波滤波器的快速精确仿真，既能够用于现有产品的设计开发，也为公司新产品线的研发提供工具支持。此外，有限元级联理论是对声表面波滤波器进行仿真的先进理论，可以大幅提升仿真速度。以一个 300 根指的耦合双模谐振器型（DMS）滤波器为例，基于有限长 FEM/BEM 理论的软件 Finite SAW 仿真一个频率点需用时 5-10 秒，而基于有限元级联理论的 FEM SAW 软件用时仅 0.3-2 秒。

C、功率仿真平台（2024年）：基于电磁场与热传导理论

公司于 2024 年成功开发基于电磁场与热传导理论的 SAW Power 软件，并应用于高性能发射（TX）滤波器和双工器的仿真设计。随着无线通信从 2G 到 5G 的演进，系统对发射滤波器承受的功率要求愈来愈高，传统的设计方法缺少对滤波器功率的精确仿真，进一步提升滤波器承受功率遇到较大困难，开发周期也较长。公司自主开发的软件 SAW Power 可以快速精确的仿真滤波器的功率能力，仿真精度小于 0.5dBm。该软件的使用大幅度提升了公司 TRx 滤波器和双工器的

功率承受能力，极大缩短了开发周期。以双工器为例，功率提升 1dBm 开发周期至少需要一年时间，超过十次的工艺迭代，使用 SAW Power 软件优化滤波器功率，可以将时间缩短至一个月。

D、横模抑制仿真平台（2025 年）：基于二维耦合模理论

针对声表面波器件横向模式抑制这一技术难题，公司于 2025 年成功开发了基于二维耦合模(2D COM)理论的横模抑制快速仿真平台，并已应用于 TC-SAW、TF-SAW 等器件的设计优化。该问题传统解决方案主要依赖三维有限元仿真(3D FEM)或实验验证，但前者模型规模大、计算成本高，单变量仿真耗时数小时，且采用无限周期边界条件难以准确捕捉谐振点前端模态特征，导致仿真结果与实际存在较大偏差；而后者则需耗费大量材料与时间，成本高、效率低。二维耦合模理论是进行 SAW 器件横模抑制仿真的先进理论，可显著提升仿真效率并降低计算资源消耗。公司基于该理论自主开发的横模抑制仿真平台，能够高效、精准地实现横模抑制仿真分析，为现有产品性能提升及高性能滤波器新品研发提供了关键工具支撑。以一款典型采用 piston 结构抑制横模的 TC-SAW 滤波器为例，传统 3D FEM 方法进行单变量仿真需耗时五至六小时，而基于公司 2D COM 理论的横模抑制仿真平台仅需数分钟即可完成，效率提升数十倍，有效支撑了器件结构的高效优化与快速迭代。

(2) 芯片制造类核心技术

在芯片制造方面，公司具备 3 项核心技术，即声表面波射频芯片前道技术、高功率滤波器制造技术和 TC-SAW 滤波器制造技术。

①声表面波射频芯片前道技术

A、核心技术概述

声表面波射频芯片的生产可以分为前道芯片制造和后道封装测试两大工序，其中前道芯片制造的关键工艺包括匀胶、光刻、显影、蒸发、剥离、修频等，其工艺水平能够决定声表面波射频芯片在电性能、一致性等主要指标上的表现。只有较高的前道技术水平才能够满足声表面波滤波器在电极膜厚、介质膜厚、指条线宽、指条形状等相关参数方面的精确度要求，从而生产出在频率、损耗和驻波

等方面表现良好的声表面波滤波器。前道工艺能力能够决定产品的性能表现和良品率，是声表面波滤波器厂商的核心竞争力之一。

公司在前道技术能力建设方面持续投入，芯片制造能力持续提升，已形成覆盖各关键工艺的声表面波射频芯片前道技术。

B、核心技术的先进性

公司拥有 20 多年的射频芯片生产经验，在前道技术方面持续投入先进设备、开发技术工具并引入新式材料，不断创新关键工艺技术，已形成能够满足高品质滤波器制造要求的声表面波射频芯片前道技术。

滤波器在插入损耗方面的表现能够在一定程度上反映前道工艺技术水平。在移动通讯的部分常用频段中，公司量产的声表面波滤波器在插入损耗方面的表现较好，公司产品相比于同行业公司插入损耗（IL）的数值较低，已达到国外领先厂商的技术水平，反映出公司声表面波射频芯片前道技术具有较高的先进性。

②高功率滤波器制造技术

A、核心技术概述

随着移动通信系统输入功率的提高和器件尺寸的减小，声表面波滤波器承受的功率密度越来越大。传统多晶铝换能器电极材料在高功率信号加载下，容易引起铝原子迁移和器件发热，从而导致器件短路或断路，严重影响器件的可靠性。

公司经过持续研发，现已掌握换能器电极材料与压电材料间的机电耦合规律，能够厘清力、电、热协同作用下声表面波滤波器失效机理，业已形成一套切实可行的、性能稳定的高功率耐受性叉指换能器电极薄膜制备加工和滤波器拓扑结构增强功率优化设计技术。

B、核心技术的先进性

公司通过采用纳米过渡层调控薄膜材料的结构和晶体取向，能够提升多晶铝电极抗电迁移能力、增加芯片功率耐受性。公司滤波器产品采用具有强织构的抗电迁移材料，对比传统多晶铝换能器电极材料，结合力提高约 2 倍，抗电迁移能力提升约 10 倍，成功解决了滤波器因原子迁移导致器件损坏的难题，大幅度提

高了滤波器的功率耐受性；另外，通过优化声表面波滤波器的拓扑结构，有效降低声表面波芯片上的能量密度，从而进一步提高芯片的功率耐受性。通过换能器材料和拓扑结构设计两者的结合，公司已将传统的声表面波滤波器的耐受功率从 29dBm 提升到 35dBm，提升了 3.75 倍，能够满足移动通信对高功率声表面波滤波器的需求。

公司高功率滤波器制造技术已具备较高的先进性与成熟度。在技术方面，公司参与的“高世代声表面波材料与滤波器产业化技术”项目于 2018 年获得国家科学技术进步奖二等奖，其中高功率滤波器制造技术是获奖内容之一。

③TC-SAW 滤波器制造技术

A、核心技术概述

随着 LTE 和 5G 频段以及卫星通信频段的广泛应用，频谱资源的日益拥挤导致不同频段之间的间隔更加狭窄。为防止频段间的信号串扰，提高器件的频率温度稳定性成为滤波器发展的关键技术。SAW 滤波器温漂系数一般在 $-40\sim-80\text{ppm}/^\circ\text{C}$ ，难以满足 4G 性能提升和 5G 通讯发展要求。TC-SAW 滤波器通过在叉指电极上覆盖正温度系数的 SiO_2 温度补偿层进行性能改进，实现器件温度稳定性的提升。

经过多年的研发积累，公司已拥有 TC-SAW 滤波器精确、仿真温补结构设计、寄生杂波抑制、高质量 SiO_2 温度补偿层生长、器件修频和一致性控制等制备关键技术。公司在 SiO_2 温度补偿薄膜的制备关键工序上形成具有竞争力的工艺能力，TC-SAW 滤波器制造能力能够满足高性能低温漂滤波器的要求。

B、核心技术的先进性

基于 TC-SAW 滤波器制造技术，TC-SAW 滤波器在器件 Q 值和温度稳定性方面取得显著提升。相较于 SAW 滤波器，TC-SAW 器件的 Q 值提升 1.5~2 倍，温漂系数从 $-80\sim-40\text{ppm}/^\circ\text{C}$ 降至 $-20\sim 0\text{ppm}/^\circ\text{C}$ ，大幅提高滤波器的温度性能，有效保证滤波器在高低温等恶劣使用环境中的性能要求。

公司 TC-SAW 滤波器制造技术已具备较高的先进性与成熟度。公司参与的“声表面波材料与器件技术及产业化”项目于 2022 年获得北京市科学技术进步

一等奖，其中 TC-SAW 滤波器制造技术为获奖内容之一。

(3) 封装测试类核心技术

在封装测试方面，公司具备 1 项核心技术，即声表面波射频芯片 CSP、WLP 封装技术。

①核心技术概述

目前手机射频前端中滤波器存在分立和模组两种集成模式。

分立模式下，手机滤波器主要采取 CSP（Chip Scale Package）的封装形式，即芯片级封装。CSP 封装是声表面波滤波器分立器件最小封装形式。在 CSP 封装之前，手机用声表面波滤波器的最小的封装形式是 SMD 封装，最小尺寸 2.5mm*2mm，双工器最小尺寸 5mm*5mm。在 2G 时代，手机支持的频段少，所用滤波器、双工器数量不多，随着 4G、5G 手机的普及，手机支持多个频段，滤波器、双工器的数量大幅增加，SMD 封装不能满足手机对滤波器小型化的需求，更小尺寸的 CSP 封装形式逐渐成为主流。CSP 封装的关键技术包括基板设计、植球、倒装、覆膜、测试等。国内手机用声表面波滤波器的 CSP 封装技术起步较晚，公司于 2012 年攻克 CSP 关键工艺，成功开发并量产手机用 CSP 封装声表面波滤波器与双工器。此后，公司不断改善与提升 CSP 技术，生产良率与可靠性不断提升，目前公司芯片级封装（CSP）生产线能够生产产品尺寸为 0.9mm*0.7mm 的滤波器、1.4mm*1.1mm 的双工器。

模组模式下，手机滤波器主要采取 WLP（Wafer Level Package）封装形式，即晶圆级封装。随着 5G 的到来，手机内部空间愈发紧张，模组化集成能够进一步减少射频芯片的占用空间，是未来射频前端的发展趋势。目前手机射频前端的模组方案主要包括 DiFEM（集成射频开关、滤波器）、L-DiFEM（集成射频开关、滤波器和低噪声放大器）、L-PAMiF（集成射频开关、天线、低噪放大器、滤波器）和 L-PAMid（集成射频开关、滤波器、低噪声放大器、滤波器和双/多工器）等，已使用在高端智能手机中，并不断向物联网、车联网等应用领域发展。通过 WLP 封装工艺集成在射频前端模组中的滤波器尺寸更小、更薄、且散热性更好，满足模组的注塑封装工艺对滤波器提出的高温高压要求（耐受 180℃的高

温与 3-5MPa 的压力)。晶圆级封装 (WLP) 是目前声表面波滤波器尺寸最小的一种封装形式, 亦能满足模组注塑工艺中的高温抗压要求。目前公司晶圆级封装 (WLP) 生产线能够生产产品尺寸最小为 0.8mm*0.6mm 的滤波器。

②核心技术的先进性

公司于 2012 年成功开发芯片级封装 (CSP) 技术, 迄今已成功量产百余款以 CSP 为封装形式的声表面波滤波器; 公司近年来亦在覆膜、光刻、植球、UBM 等 WLP 关键工艺上实现突破, 于 2019 年成功开发晶圆级 (WLP) 封装技术, 目前已成功量产数十款以 WLP 为封装形式的声表面波滤波器。公司声表面波滤波器 CSP、WLP 封装技术成熟, 相关产品均已应用于下游知名客户的智能手机中, 在芯片尺寸、综合性能等方面与国外领先厂商大致相当。

(4) 材料制备类核心技术

在材料制备方面, 公司具备 1 项核心技术, 即 POI 材料制备技术。

①核心技术概述

5G 移动通讯的快速发展对滤波器“高频率、高功率、大带宽、低损耗”提出更高的要求, 超越传统声表面波器件用压电体材料性能极限。基于 Si、SiC 等高声速衬底的钽酸锂、铌酸锂压电薄膜材料 (Piezoelectric on Insulator, POI) 可以控制声能量仅在压电薄膜中传播, 形成波导效应, 降低器件损耗, 同时提升声速、耦合效率、散热等性能, 因此 POI 材料被视作解决滤波器高频、大带宽、低损耗、高温稳定性等业内痛点的核心关键材料。掌握 POI 材料制备技术是声表面波滤波器厂商的核心竞争力之一, 可为后续高性能 TF-SAW 滤波器芯片研发生产奠定坚实的基础。

经过多年的研发积累, 公司已突破晶圆键合、晶圆减薄、薄膜厚度精修等 POI 材料制备关键技术, 开发出了满足高性能 TF-SAW 滤波器需求的高质量、大尺寸、高均匀度 POI 材料, 在 POI 材料制备上形成了具备竞争力的工艺能力。该核心技术为公司高性能 TF-SAW 声表面波滤波器提供高质量衬底材料。

②核心技术的先进性

公司运用 POI 材料制备关键技术，已成功生产多款厚度均匀、表面平整的高质量钽酸锂、铌酸锂薄膜 POI 材料，其薄膜厚度不均匀性<4%，表面粗糙度低于 0.2nm。基于公司开发的 POI 材料，滤波器的器件损耗下降、Q 值为传统压电体材料 4~5 倍左右、机电耦合效率提升 40%以上、温度漂移系数降低至<5ppm/°C。公司 POI 材料全面提升声表面波滤波器的产品性能，POI 材料已应用于公司多款高性能 TF-SAW 声表面波滤波器产品开发上。此外，公司自主拥有根据滤波器性能需求自主开发不同规格的 POI 材料，可快速响应公司高性能 TF-SAW 声表面波滤波器开发对各种压电材料切向、各种厚度规格、各种衬底材料的定制化、差异化需求，比如公司开发的铌酸锂薄膜 POI 材料为 5G 等 n77/n78 等高频大带宽频段提供了解决方案。同时，避免了受限于市面特定规格 POI 材料和收货周期长问题。公司自主开发的 POI 材料制备关键技术使公司在开发高性能 TF-SAW 滤波器保持独特性和竞争力。

公司 POI 材料制备关键技术已具备较高的先进性与成熟度。在技术方面，公司主持的“面向 5G 通讯的新型结构声表面波滤波器及其产业化”项目于 2023 年获得中国电子元件行业协会科技进步奖一等奖，其中 POI 材料制备及其高频大带宽滤波器是获奖内容之一；在产品方面，公司自主研发的 POI 材料已在多款高性能 TF-SAW 声表面波滤波器实现应用，产品成熟度较高。

3、核心技术在主营业务及产品或服务中的应用和贡献情况

报告期内，公司核心技术产品占营业收入的比例如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
核心技术产品收入	66,186.48	59,132.46	40,037.68
营业收入	67,465.69	60,655.03	41,851.74
占营业收入的比例	98.10%	97.49%	95.67%

公司主要产品滤波器、双工器和谐振器均需运用到芯片设计、制造和封装测试相关的全部核心技术，故公司依靠核心技术开展生产经营所产生收入为滤波器、双工器和谐振器的销售收入。报告期内，公司核心技术产品的收入为 40,037.68 万元、59,132.46 万元和 66,186.48 万元，占营业收入的比例均为 95.67%、97.49%、98.10%，占比逐年升高。报告期内，公司主要的生产经营能够以核心技术为基础，

公司能够将核心技术进行成果转化，形成基于核心技术的产品并实现销售。

4、核心技术的保护措施

公司高度重视核心技术保护，已围绕主要技术方向和在研产品构建了系统的知识产权体系。截至报告期期末，公司累计获得授权专利 61 项，其中发明专利 40 项，实用新型专利 21 项。具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“五、发行人的主要固定资产和无形资产”之“（二）主要无形资产情况”之“1、专利技术”的相关内容。同时研发技术人员签署保密协议和竞业禁止协议，确保公司的核心技术处于保密状态。

（二）科研实力和成果情况

1、主要认定、奖项或荣誉

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人先后 2 次荣获国家科技进步二等奖以及多项省、部级奖项，具体情况如下：

序号	发证机关	获奖内容	获奖年份
1	国务院	国家科学技术进步二等奖：高世代声表面波材料与滤波器产业化技术	2018
2	国务院	国家科学技术进步二等奖：移动通信用滤波器关键技术及产业化	2009
3	教育部	科学技术进步奖一等奖：高世代声表面波材料与滤波器产业化技术	2018
4	科技部	国家重点新产品：双通道数字电视声表面波滤波器	2010
5	工业和信息化部	移动终端用射频滤波器“一条龙”应用示范单位	2021
6	中国电子元件行业协会	2023 年度（第 2 届）中国电子元件行业协会科学技术进步一等奖	2023
7	江苏人民政府	江苏省科学技术二等奖	2024
8	江苏省工业和信息化厅	专精特新中小企业	2025
9	江苏省工业和信息化厅	2022 年度省工业互联网示范工程（标杆工厂）	2022
10	江苏省工业和信息化厅	江苏省智能制造示范车间	2022
11	江苏省工业和信息化厅	江苏省省级企业技术中心	2020
12	江苏省工业和信息化厅	江苏省智能制造示范车间声表面波滤波器测试车间	2023
13	江苏省科学技术厅	省级工程技术研究中心	2023
14	江苏省科学技术厅	高新技术产品认定：片式芯片级封装 CSP	2016

序号	发证机关	获奖内容	获奖年份
		声表面波器件	
15	江苏省科学技术厅	高新技术产品认定：移动通讯用片式声表面波滤波器	2010
16	江苏省科学技术厅	高新技术产品认定：双通道数字电视声表面波器件	2009
17	江苏省科学技术厅	高新技术产品认定：3G 通信基站声表面波滤波器	2009
18	江苏省发展和改革委员会	江苏省射频微声滤波器工程研究中心	2022
19	江苏省民营科技企业协会	江苏省民营科技企业	2012
20	北京市人民政府	北京市科学技术一等奖	2022
21	无锡市人民政府	科技创新优秀企业	2019
22	无锡市人民政府	无锡市科学技术进步奖二等奖：贴片式高频（200MHz-1600MHz）声表器件开发及产业化	2008
23	无锡市人民政府	第五届无锡市专利奖优秀奖：双通道声表面波滤波器	2012
24	无锡市工业和信息化局	无锡市绿色工厂	2024
25	无锡市工业和信息化局	5G 高性能声表面波滤波器智能工厂	2023
26	无锡市工业和信息化局	2020 年无锡市智能车间	2020
27	无锡市工业和信息化局	无锡市认定企业技术中心	2019
28	无锡市科学技术局	无锡市重点实验室	2023
29	无锡市科学技术局	2020 年无锡市准独角兽企业	2020
30	无锡市科学技术局	无锡市声学滤波器工程技术研究中心	2009
31	无锡经济开发区工作委员会、无锡经济开发区管理委员会	2018 年度新兴产业奖	2019

2、承担的重大科研项目

截至 2025 年 12 月 31 日，公司作为主要承担单位，先后牵头承担或参与实施了 7 项国家级和 5 项省级重点科研项目，具体情况如下：

序号	项目名称	计划类别	起止时间	牵头承担/参与实施
1	单晶压电薄膜及高频声学滤波器	科技部国家重点研发计划	2025 年 12 月至 2029 年 11 月	牵头承担
2	高频大带宽射频滤波关键材料与器件技术	科技部国家重点研发计划-课题三	2022 年 11 月至 2025 年 10 月	课题承担单位
3	面向 5G 通讯的高性能滤波器材料和器件应用	科技部国家重点研发计划	2020 年 11 月至 2022 年 10 月	牵头承担
4	高性能声表面波滤波器产业化集成与示范	科技部国家重点研发计划-课题四	2016 年 7 月至 2020 年 6 月	课题承担单位

序号	项目名称	计划类别	起止时间	牵头承担/参与实施
5	声表面波换能器材料与制备关键技术	科技部国家重点研发计划-课题二	2016年7月至2020年6月	课题承担单位
6	涉密项目 C	工信部高质量发展专项项目	2021年1月至2022年12月	牵头承担
7	新一代移动通信终端用声表面波滤波器/双工器	工信部工业转型升级强基工程	2015年1月至2017年4月	牵头承担
8	高性能碳化硅声表面波器件关键技术研发	江苏省前沿技术研发计划	2025年9月至2028年8月	牵头承担
9	面向 5G 的高频大宽带声表面波滤波器研发及产业化	江苏省科技成果转化项目	2023年1月至2026年6月	牵头承担
10	无锡市好达电子股份有限公司研发机构创新能力提升项目	江苏省重点产业技术创新-企业研发机构创新能力	2022年1月至2023年12月	牵头承担
11	5G 用 BAW 滤波器及射频模块 SAW 滤波器研发试制线项目	2021年度省级战略性新兴产业发展专项	2019年9月至2021年12月	牵头承担
12	新型石墨烯高品质超大带宽声表面波滤波器研发	江苏省重点研发计划-产业前瞻与共性关键技术重点项目-课题四	2018年6月至2021年9月	课题承担单位

3、发表论文情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及研发人员多次在国内外权威期刊和会议上发表论文，其中部分代表性论文发表情况如下：

序号	论文题目	作者	期刊/会议名称	收录类型	发表年份
1	Cost-Effective Frequency Scaling of Acoustic Devices from Sub-6 GHz to X-Band on Pizeo-on-SiC	Peisen Liu, Jiajun Gao, Sulei Fu (傅肃磊), Boyuan Xiao, Qiufeng Xu, Xinchun Zhou, Haoqin Ma, Shouren Xie, Zhibin Xu (许志斌), Shuai Zhang (张帅), Rui Wang, Cheng Song, Fei Zeng, Weibiao Wang (王为标), Feng Pan	2025 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM)	EI 检索	2025 年
2	Anisotropy-Matched LN/Quartz Heterostructure With Inherent Spurious Mitigation for Wideband SAW Devices	Boyuan Xiao, Peisen Liu, Sulei Fu (傅肃磊), Rongxuan Su, Xinchun Zhou, Qiufeng Xu, Jiajun Gao, Haoqin Ma, Shouren Xie, Shuai Zhang (张帅), Rui Wang, Cheng Song, Fei Zeng, Weibiao Wang (王为标), Feng Pan	IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques	SCI 检索	2025 年
3	Ultrahigh Frequency SAW Devices Based	Jiajun Gao, Sulei Fu (傅肃	IEEE Electron Device Letters	SCI 检索	2025 年

序号	论文题目	作者	期刊/会议名称	收录类型	发表年份
	on 128° Y-X LiNbO ₃ /SiO ₂ /Sapphire Structure	磊), Huiping Xu, Peisen Liu, Boyuan Xiao, Xincheng Zhou, Rui Wang, Donghui Zhang, Feng Pan, Cheng Song			
4	Layered LiNbO ₃ /AT-Quartz Wideband Devices With Inherent Transverse Mode Suppression	Peisen Liu, Boyuan Xiao, Sulei Fu (傅肃磊) , Huiping Xu, Qiufeng Xu, Xincheng Zhou, Rui Wang, Cheng Song, Fei Zeng, Weibiao Wang (王为标) , Feng Pan	IEEE Microwave and Wireless Technology Letters	SCI 检索	2025 年
5	TCF Reduction of Wideband SAW Device on LNOI Platform Using Multilayer IDT Electrodes	Zhibin Xu (许志斌) , Zengtian Lu (陆增天) , Sulei Fu (傅肃磊) , Peisen Liu, Boyuan Xiao, Baichuan Li, Liwen Han, Feng Pan, Weibiao Wang (王为标) , Hui Zhang	2025 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS)	EI 检索	2025 年
6	High-Performance Wideband SAW Filters on LNOI Platform	Weibiao Wang (王为标) , Sulei Fu (傅肃磊) , Zhibin Xu (许志斌) , Huiping Xu, Peisen Liu, Boyuan Xiao, Feng Pan	2024 IEEE MTT-S International Conference on Microwave Acoustics & Mechanics (IC-MAM)	EI 检索	2024 年
7	SAW Filters on LiNbO ₃ /SiC Heterostructure for 5G n77 and n78 Band Applications	Huiping Xu, Sulei Fu (傅肃磊) , Rongxuan Su, Peisen Liu, Shuai Zhang (张帅) , Zengtian Lu (陆增天) , Boyuan Xiao, Rui Wang, Cheng Song, Fei Zeng, Weibiao Wang (王为标) , Feng Pan	IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control	SCI 检索	2023 年
8	Scaling Surface Acoustic Wave Filters on LNOI platform for 5G communication	Rongxuan Su, Sulei Fu (傅肃磊) , Zengtian Lu (陆增天) , Junyao Shen, Huiping Xu, Peisen Liu, Zhibin Xu (许志斌) , Haowei Wang, Shuai Zhang, Rui Wang, Cheng Song, Fei Zeng, Weibiao Wang (王为标) , Feng Pan	2022 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM)	EI 检索	2022 年
9	Fractional Bandwidth up to 24% and Spurious Free SAW Filters on Bulk 15°YX-LiNbO ₃ Substrates Using Thickness-Modulated IDT Structures	Zengtian Lu (陆增天) , Sulei Fu (傅肃磊) , Zhibin Xu (许志斌) , Weibiao Wang (王为标) , Qiaozhen Zhang, Jianrun Zhang, Hui Zhang	Micromachines	SCI 检索	2022 年

序号	论文题目	作者	期刊/会议名称	收录类型	发表年份
10	High-selectivity SAW DMS filter with in-between shorted-gratings	Weibiao Wang (王为标) , Haodong Wu	2010 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS)	EI 检索	2010年

注：上表中公司员工加粗标注。

(三) 研发项目情况

1、在研项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司主要在研项目及进展情况如下：

项目名称	进展情况	项目负责人员	未来达到目标	与行业技术水平的比较
单晶压电薄膜及高频声学滤波器	样品试制	王为标	聚焦于开发面向高频声学滤波器芯片应用的高性能单晶压电薄膜材料，突破当前声学滤波器在频率提升、带宽扩展与性能优化等方面的技术瓶颈，研制具有高价值与卓越性能的高频新型声学谐振器与滤波器，支撑下一代通信系统关键器件自主化。	实现 10GHz 以上高频段声学滤波器开发，布局 6G 前沿技术，并积极应对毫米波、低轨卫星通信等新兴应用对高端射频器件的需求。
面向 5G 的高频大带宽声表面波滤波器研发及产业化	小批量生产	王为标	突破高频、大带宽、低损耗声表面波滤波器的关键技术瓶颈，建立从材料设计、器件仿真、工艺制备到封装测试的全流程研发与产业化体系，打造公司具有自主知识产权的高性能声表面波滤波器产品，推动国产替代与产业升级。	符合滤波器技术发展趋势，拓宽声表面波滤波器应用领域，满足 5G 通信对高频大带宽滤波器的需求。
高频大带宽射频滤波关键材料与器件技术	样品试制	王为标	突破 XBAR、YBAR 等新型结构高频大带宽声学滤波器关键材料制备、结构与精准加工技术，研发面向下一代应用的新型声学滤波器材料与器件技术。	实现 3-7GHz 高频段声学滤波器开发，一些关键技术达到世界领先水平，参与国际竞争。
模组用滤波器芯片开发项目	批量生产	王为标	开展模组用滤波器芯片关键材料、结构、工艺及封装的研发验证，实现芯片的批量量产，进入手机和车载模组供应链，推动公司滤波器由单芯片向模组化的跨越式升级。	符合滤波器技术发展趋势，满足移动通信对滤波器小型化、模组化、高性能的需求

项目名称	进展情况	项目负责 人员	未来达到目标	与行业技术水平的 比较
高耐受功率射频滤波器研发项目	批量生产	陆增天	依托公司已掌握的滤波器设计与制造能力,通过材料优化、结构创新和封装改进,提升滤波器的高功率承受能力,实现滤波器在PC1 功率及基站应用条件下的长期稳定工作。	符合滤波器高功率的发展趋势,满足新一代移动通信对滤波器功率耐受度的要求。

2、合作研发情况

报告期内,公司与其他单位合作研发的情况如下:

合作方及合作 期间	主要内容	成果分享与权利义务划分	保密措施
好达电子、清华大学、中电 26 所 (2022-2025)	各方同意就共同承担国家重点研发计划“高频大带宽射频滤波关键材料与器件技术”项目课题三“高品质因素大带宽器件设计与制备技术”课题达成合作研发协议。本项目下仅设一个课题,各方同意由好达电子作为该课题的依托单位,清华大学、中电 26 所作为项目的合作单位。	<p>根据课题任务分工,在各方的工作范围内独立完成的科技成果及其形成的知识产权归各方独自所有。一方转让其专利申请权时,其他各方有以同等条件优先受让的权利。</p> <p>在课题执行过程中,由各方共同完成的科技成果及其形成的知识产权归各方共有。一方转让其共有的专利申请权的,其他各方有以同等条件优先受让的权利。一方声明放弃其共有的专利申请权的,可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。合作各方中有一方不同意申请专利的,另一方或其他各方不得申请专利。</p> <p>由各方共同完成的技术秘密成果,各方均有独自使用的权利。未经其他各方同意,任何一方不得向第三方转让技术秘密。</p> <p>共同完成的科技成果的精神权利,如身份权、依法取得荣誉称号、奖章、奖励证书和奖金等荣誉权归完成方共有。</p> <p>各方对共有科技成果实施许可、转让专利技术、非专利技术而获得的经济收益由各方共享。收益共享方式应在行为实施前另行约定。</p>	<p>因执行课题的需要,各自向对方提供的未公开的、或在提供之前已告知不能向第三方提供的与本课题相关的技术资料、数据等所有信息,包括但不限于各自所有或合法拥有的任何计算机程序、代码、算法、公式、过程、观念、图表、照片、制图、设计、产品、样品、发明创造(包括发明、实用新型和外观设计,无论是否获得专利)、技术秘密、版权、商标、产品研发计划、预测、策略、规范、实际或潜在商业活动的信息、客户与供应商名单、财务事项、市场营销计划等技术、商务上的信息等。未经提供方同意,不得提供给第三方。不管本申请是否获得资助,该条款长期有效。</p>
好达电子、东南大学 (2024-2026)	为支撑产品的发展需求,针对 5G 通信对高频大带宽声表面滤波器的迫切需求,研制 n77、n78 等高频大带宽声表面波滤波器。	<p>合作双方在本合作之前各自获得、拥有的知识产权及相应权益均归各自所有。因合作的需要,各自向对方提供的相关信息,不构成向任何合作方授予任何关于专利、著作权、商标权等知识产权的许可行为或其他权力。</p>	<p>甲、乙双方对于合作期间接触到的对方的未公开信息都负有保密责任。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保密内容(包括技术信息和经营信息):涉及本协议的技术文件、资料、经营信息和商业秘密。 2. 涉密人员范围:直接和间接涉及本协议内容的有关人员。

合作方及合作期间	主要内容	成果分享与权利义务划分	保密措施
			<p>3. 保密期限:合作期间及合作终止后三年内。</p> <p>4. 泄密责任:泄密方承担因此给信息提供方造成的损失。</p> <p>5. 双方可以另行签署保密协议或类似协议,具体约定相关事项;在签署本合同之前,为履行本合同之目的,已经签署保密协议或类似协议的,对双方具有约束力。</p>
好达电子、清华大学、中国科学院声学研究所、达波科技、杭州电子科技大学(2025-2029)	25年度国家重点研发计划“工程科学与综合交叉”重点专项“单晶压电薄膜及高频声学滤波器”项目	各方共同完成的科技成果及其形成的知识产权归各方共有。一方转让其共有的专利申请权的,其他各方有以同等条件优先受让的权利。一方声明放弃其共有的专利申请权的,可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。合作各方中有一方不同意申请专利的,另一方或其他各方不得申请专利。	由各方共同完成的技术秘密成果,各方均有独自使用的权利。未经其他各方同意,任何一方不得向第三方转让技术秘密。

3、委托研发情况

报告期内,发行人向高等院校等单位委托研发情况如下:

序号	委托单位	委托协议	研发内容	权利义务/成果归属	保密措施	合作期限
1	江南大学	技术开发(委托)合同	小型宽带声表面波滤波器研制	履约方式:提交标的技术的相关技术资料或现场提供技术指导。本合同履行中产生的新的技术成果及知识产权的权属属于甲方所有。乙方享有使用权,但乙方无权转让给第三方使用。	保密期限3年,自合同生效之日起开始。若需明确双方保密义务的违约责任,甲方与乙方可另行签订相应的保密协议。	2021-2023年
2	江南大学	技术开发(委托)合同	超高性能声表面波滤波器研制	履约方式:提交标的技术的相关技术资料或现场提供技术指导。本合同履行中产生的新的技术成果及知识产权的权属属于甲方所有。乙方享有使用权,但乙方无权转让给第三方使用。	保密期限3年,自合同生效之日起开始。若需明确双方保密义务的违约责任,甲方与乙方可另行签订相应的保密协议。	2022-2024年
3	江南大学	技术开发(委托)合同	基于三维封装技术的声表面波IPD混合结构滤波器研究	履约方式:提交标的技术的相关技术资料或现场提供技术指导。本合同履行中产生的新的技术成果及知识产权的权属属于甲方所有。乙方享有使用权,但乙方无权转让给第三方使用。	保密期限3年,自合同生效之日起开始。若需明确双方保密义务的违约责任,甲方与乙方可另行签订相应的保密协议。	2023-2024年
4	华南理工大学	技术开发(委托)合同	通信用滤波器/双工器研究开发	本合同甲方委托乙方研究开发通信用滤波器/双工器设计开发项目,并支付研究开发经费和报酬。乙方接受委托并进行此项研	与本课题相关的所有实验方案、内容和数据。保密期限5年,自合同生效之日	2022-2023年

序号	委托单位	委托协议	研发内容	权利义务/成果归属	保密措施	合作期限
				究开发工作。	起开始。	
5	上海师范大学	技术开发(委托)合同	射频声表面波器件的非线性调控技术开发技术	项目研发过程中甲乙双方共同获得的新型器件结构专利申请权归双方共同所有,项目研发过程中甲乙双方共同完成的工艺改进专利申请权归甲方所有,参与研发的人员具有署名权,排名顺序由甲乙双方协商决定;项目研发过程中甲乙双方共同获得的知识产权的使用权由双方共同所有;甲乙双方共同授权给其他方使用所产生的收益,由甲乙双方根据具体情况,决定双方分配比例;双方另有约定的,按约定执行。	项目研发过程中涉及甲乙双方各自已有的技术情报和资料归各自所有,一方有责任为另一方保密;双方另有约定的,按约定执行。未经甲乙双方书面同意,任何一方不得以任何方式将项目涉及的技术情报和资料以及项目研究成果泄露、转让或许可给其他方。	2025-2027年

4、研发投入情况

报告期内,公司研发投入整体保持较高水平,具体情况如下:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
研发费用(万元)	5,717.43	5,931.82	5,000.02
营业收入(万元)	67,465.69	60,655.03	41,851.74
研发费用/营业收入	8.47%	9.78%	11.95%

(四) 核心技术人员及研发人员相关情况

1、技术与研发人员情况

作为技术密集型企业,技术人才是公司保持创新能力和成本优势的根基。为保障新产品设计研发、生产成本控制及技术服务质量的持续优化,公司组建了一支高水平的研发团队。截至2025年12月31日,公司研发人员共90人,占员工总数的比例为15.03%。

2、核心技术人员情况

依据任职情况、所承担研发工作的重要性及研发成果等因素,公司认定刘平、王为标、陆增天等3人为公司核心技术人员,报告期内未发生变化。公司核心技术人员基本情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员”之“(一)董事、历史监事、高级管

理人员与核心技术人员简历”之“4、核心技术人员”相关内容。其学历背景、专业资质、重要科研成果、获得奖项情况、对公司研发的具体贡献的情况如下：

(1) 刘平

姓名	刘平
职位	董事长
学历背景	山东大学物理学系压电铁电物理专业本科
获得奖项情况	2018 年度教育部科技技术进步一等奖 2023 年度中国电子元件行业协会科学技术进步一等奖 2022 年度北京市科学技术进步一等奖
对公司研发的具体贡献	公司重要创始人，具有多年行业从业经验，主要负责公司整体发展战略规划及未来公司研发方向的制定，参与公司各项核心技术的研发指导工作，积极推动公司研发管理、成果激励、技术保护、人才引进等制度的建立健全。

(2) 王为标

姓名	王为标
职位	职工代表董事、副总经理、首席技术官
学历背景	南京大学电子科学与工程系声学专业博士研究生
专业资质	正高级工程师、国务院特殊津贴获得者
重要科研成果	国内外发表专业论文 49 篇，作为发明人取得专利 14 项
获得奖项情况	2018 年度国家科学技术进步二等奖 2018 年度教育部科技技术进步一等奖 2023 年度中国电子元件行业协会科学技术进步一等奖 2023 年度江苏省科学技术奖二等奖 2022 年度北京市科学技术进步一等奖 2025 年度江苏省有突出贡献的中青年专家
对公司研发的具体贡献	①国家重点研发计划“单晶压电薄膜及高频声学滤波器”的项目负责人； ②国家重点研发计划“面向 5G 通讯的高性能滤波器材料和器件应用”的项目负责人； ③国家重点研发计划“声表面波材料与器件”课题四“高性能声表面波滤波器产业化集成与示范”的课题负责人； ④主导公司滤波器基础理论与新技术研究，仿真技术与仿真工具开发，建立了基于全波分析方法的滤波器开发平台； ⑤主导公司新产品的开发。

(3) 陆增天

姓名	陆增天
职位	副总经理、研发部部长
学历背景	东南大学先进制造专业博士研究生

重要科研成果	国内外发表专业论文 21 篇，作为发明人取得专利 24 项
获得奖项情况	2018 年度国家科学技术进步二等奖 2018 年度教育部科技技术进步一等奖 2022 年度北京市科学技术进步一等奖 2023 年度中国电子元件行业协会科学技术进步一等奖 2023 年度江苏省科学技术二等奖
对公司研发的具体贡献	主导公司滤波器新工艺、新产品的研发与试制，总体负责公司内部各研发项目，为制造工艺的持续升级提供技术经验支持。参与项目情况如下： ①国家重点研发计划“面向 5G 通讯的高性能滤波器材料和器件应用”的骨干成员； ②国家重点研发计划项目“声表面波材料与器件”课题四“高性能声表面波滤波器产业化集成与示范”的骨干成员； ③江苏省重点研发计划“面向人工智能应用的高品质特种石墨烯制备及传感器件关键技术研发”课题四“新型石墨烯高品质超大带宽声表面波滤波器应用开发”的骨干成员； ④江苏省科技成果转化项目“面向 5G 通讯的高频大带宽声表面波滤波器研发及产业化”的产品生产负责人。

2、发行人对核心技术人员实施的约束激励措施

公司核心技术人员均持有公司股权，核心技术人员也适用于公司的绩效考核和研发奖励激励制度。公司核心技术人员持有的公司股权有禁售期限制，并与公司签订了竞业禁止协议、保密协议。

（五）保持技术不断创新的机制、技术储备及技术创新的安排

1、研发组织体系

公司研发管理机构主要为研发部和工程技术部，其中研发部主要负责策划并实施新产品设计和开发活动；工程技术部负责设计试制转入试生产的评审和试生产阶段工艺控制和技术改进。上述团队各司其职、分工协作，保障了公司研发工作的高效推进。

2、技术创新机制

（1）全面的战略部署，筑牢技术创新的基石

公司所处的声表面波滤波器行业属于技术密集型行业，技术创新是公司实现持续增长和保持产品市场竞争力的根本所在。面对全球化的竞争格局与下游应用的快速迭代，持续的技术突破是公司满足客户需求、紧跟技术前沿、并逐步确立市场地位的核心所在。

公司始终将技术创新视为一项系统化工程。报告期内，公司在高管团队的带领下，对研发体系进行了全方位与前瞻性的布局，在创新机制、研发流程以及人才激励方面投入了大量资源。经过多年的优化与积淀，公司已在产品设计、工艺流程及材料研究等领域形成了扎实的技术储备，构筑了强大的研发与产业化基础，为公司的规模化发展提供了关键支撑。

(2) 积极的薪酬体系，激发研发团队的活力

人才是公司创新与发展的核心要素。鉴于声表面波滤波器行业技术密集、跨学科交叉的突出特点，公司始终将人才队伍的建设与激励置于战略高度。我们所需人才覆盖声学、半导体物理、电子工程、材料科学与微电子制造等多个关键学科，对研发、设计、工艺及检测人员的专业能力与综合素养要求极为严格。为保障研发团队的持续创新能力并激发全员潜能，公司已构建并实施了一套开放、系统且富有竞争力的人力资源体系。该体系涵盖具有市场竞争力的薪酬结构、与绩效紧密挂钩的奖励机制，以及清晰的职业发展通道与持续培养方案。目前，公司已组建起一支结构合理、专业扎实、经验丰富的核心团队，充足的人才储备为公司持续的技术迭代、规模扩张与战略目标的实现提供了坚实的智力保障与竞争优势。

(3) 开展产学研合作，巩固创新优势

为构筑可持续的技术壁垒并引领行业创新，公司积极构建并深化以企业为主体、市场为导向的产学研合作体系。我们与多所顶尖高校及科研机构建立了战略合作关系，致力于将前沿学术研究与产业实际需求深度融合。通过共同合作承担国家级科研项目等方式，公司有效对接了学术界在声学理论、新材料和新型器件架构等领域的前沿探索，加速了基础研究成果向先进滤波器产品与核心工艺的转化。这一开放式的创新生态，不仅为公司提供了持续的技术源泉，巩固了我们在产品上的竞争优势，更为公司前瞻性技术布局和培育未来增长点开辟了新的赛道。

七、发行人环境保护和安全生产情况

(一) 发行人环境保护情况

公司是声表面波射频芯片生产厂商，不属于重污染行业。公司生产经营过程

中产生的主要污染物包括废气、废水、噪声和固体废物，经处理后均能实现达标排放，具体情况如下：

污染物类别	主要污染物	处理措施	处理能力
废气	光刻、匀胶、蚀刻等工序产生的废气	经由不同装置处理后通过排气筒排放或组织排放	达标排放
废水	生产废水	经污水处理站处理后回用于生产	全部处理
	生活污水	化粪池预处理后接入污水处理厂	达标排放
噪声	各类设备产生的噪声	合理布局、隔声、距离衰减	达标排放
固体废物	生活垃圾	环卫部门清运	全部处理
	不合格品	收集后外售	
	危险废物	委托有资质单位处置	

（二）发行人安全生产情况

公司所处行业不属于高危行业范畴。公司严格遵守国家安全生产方面的法律、法规，并将安全生产规定落实到生产作业的全过程及各工作岗位，严格抓好安全管理，保证生产安全。同时，公司还结合自身生产经营特点，建立了一套较为完善的安全生产管理体系。

报告期内，公司未发生安全生产事故或重大违规事件。

八、发行人的境外经营及境外资产情况

截至本招股说明书签署之日，本公司未在境外开展生产经营活动。

第六节 财务会计信息与管理层分析

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2023年12月31日、2024年12月31日和2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度、2024年度和2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表进行了审计,并出具了无保留意见的《审计报告》。

本招股说明书披露的财务会计信息包含了财务报告及审计报告的重大财务会计信息,但并不包括财务报告及审计报告的所有信息,投资者在做出投资决策之前,应仔细阅读财务报告及审计报告全文。

一、发行人近三年财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产:			
货币资金	103,342,804.68	10,095,681.12	21,567,220.48
应收票据	45,373,534.00	26,791,710.16	12,940,405.42
应收账款	130,610,240.83	198,240,114.07	167,736,164.41
应收款项融资	19,295,535.33	7,782,894.20	1,244,193.33
预付款项	2,036,988.62	2,966,657.57	2,800,168.10
其他应收款	7,417,529.40	16,033,149.56	9,740,048.22
存货	230,768,546.66	175,676,132.72	209,906,190.60
其他流动资产	8,033,515.45	3,165,099.41	618,704.24
流动资产合计	546,878,694.97	440,751,438.81	426,553,094.80
非流动资产:			
长期股权投资	19,534,095.54	24,548,056.97	26,889,045.16
其他权益工具投资	697,700.00	697,700.00	697,700.00
固定资产	862,488,572.15	928,584,358.45	1,028,529,003.13
在建工程	19,188,155.97	23,387,570.28	4,098,008.87
使用权资产	959,600.09	417,338.94	1,741,504.22
无形资产	6,865,498.41	9,004,026.35	11,302,769.16
长期待摊费用	11,229,511.10	8,567,570.58	930,815.48

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
递延所得税资产	107,222,224.32	101,817,818.87	83,254,350.53
其他非流动资产	1,645,720.00	-	1,087,858.96
非流动资产合计	1,029,831,077.58	1,097,024,440.44	1,158,531,055.51
资产总计	1,576,709,772.55	1,537,775,879.25	1,585,084,150.31
流动负债：			
短期借款	389,811,729.96	443,940,747.62	399,931,715.84
应付票据	2,821,792.00	1,045,416.35	-
应付账款	191,816,215.90	167,721,189.28	112,651,707.73
合同负债	625,155.83	2,763,087.27	22,902,465.12
应付职工薪酬	21,069,978.51	20,461,153.80	18,062,244.79
应交税费	759,485.95	655,033.73	668,334.58
其他应付款	8,945,325.70	6,358,404.25	3,591,446.61
一年内到期的非流动负债	158,267,764.94	405,349,895.41	310,701,825.11
其他流动负债	36,576,191.59	24,841,365.76	4,649,401.40
流动负债合计	810,693,640.38	1,073,136,293.47	873,159,141.18
非流动负债：			
长期借款	448,898,807.89	71,640,610.47	245,026,433.97
租赁负债	99,321.81	34,077.61	521,613.95
长期应付款	75,157,285.57	201,917,804.74	205,606,095.10
预计负债	-	700,000.00	700,000.00
递延收益	63,714,176.27	57,776,167.64	63,338,407.08
递延所得税负债	-	-	-
非流动负债合计	587,869,591.54	332,068,660.46	515,192,550.10
负债合计	1,398,563,231.92	1,405,204,953.93	1,388,351,691.28
所有者权益：			
股本	76,964,285.00	76,250,000.00	76,250,000.00
资本公积	554,721,976.12	506,506,467.79	490,913,259.79
盈余公积	4,645,465.42	4,645,465.42	4,645,465.42
未分配利润	-458,185,185.91	-454,831,007.89	-375,076,266.18
归属于母公司所有者权益合计	178,146,540.63	132,570,925.32	196,732,459.03
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	178,146,540.63	132,570,925.32	196,732,459.03

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
负债和所有者权益合计	1,576,709,772.55	1,537,775,879.25	1,585,084,150.31

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
一、营业收入	674,656,886.93	606,550,261.50	418,517,352.94
二、营业总成本	662,093,268.82	657,611,558.87	601,888,155.82
减：营业成本	491,262,902.19	480,668,035.24	432,333,427.96
税金及附加	1,233,852.28	1,109,195.67	1,031,997.50
销售费用	24,423,730.87	24,995,126.95	22,062,063.32
管理费用	38,178,212.98	39,672,603.27	39,757,473.98
研发费用	57,174,255.10	59,318,226.47	50,000,155.47
财务费用	49,820,315.40	51,848,371.27	56,703,037.59
加：其他收益	18,227,443.06	13,321,475.39	15,340,671.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,013,961.43	-2,340,988.19	3,680,398.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,076,010.56	-3,356,180.01	-4,954,970.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,799,917.07	-55,414,072.94	-97,447,777.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,980.91	822,047.71	10,738,814.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,965,787.68	-98,029,015.41	-256,013,666.46
加：营业外收入	111,670.42	233,272.14	591,571.77
减：营业外支出	904,466.21	522,466.78	3,540,780.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,758,583.47	-98,318,210.05	-258,962,874.77
减：所得税费用	-5,404,405.45	-18,563,468.34	-41,916,570.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,354,178.02	-79,754,741.71	-217,046,304.65
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,354,178.02	-79,754,741.71	-217,046,304.65
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1、少数股东损益	-	-	-927,601.83
2、归属于母公司股东的净	-3,354,178.02	-79,754,741.71	-216,118,702.82

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利润			
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-3,354,178.02	-79,754,741.71	-217,046,304.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,354,178.02	-79,754,741.71	-216,118,702.82
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-927,601.83
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	-0.04	-1.05	-2.83
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.04	-1.05	-2.83

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	668,905,147.73	569,668,116.59	333,249,829.74
收到的税费返还	652,715.98	-	603,113.25
收到其他与经营活动有关的现金	28,659,973.40	6,667,028.47	21,186,685.73
经营活动现金流入小计	698,217,837.11	576,335,145.06	355,039,628.72
购买商品、接受劳务支付的现金	180,950,269.30	167,870,446.24	117,912,142.74
支付给职工以及为职工支付的现金	135,681,224.53	125,524,118.40	116,371,043.26
支付的各项税费	24,713,933.91	20,962,475.34	6,664,104.73
支付其他与经营活动有关的现金	26,331,664.41	16,186,010.95	24,580,683.51
经营活动现金流出小计	367,677,092.15	330,543,050.93	265,527,974.24
经营活动产生的现金流量净额	330,540,744.96	245,792,094.13	89,511,654.48
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,044.25	3,371,364.97	26,580,845.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	713,901.07
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	15,044.25	3,371,364.97	27,294,746.27

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,821,448.15	49,034,595.01	50,966,608.74
投资支付的现金	-	-	3,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	21,821,448.15	49,034,595.01	54,216,608.74
投资活动产生的现金流量净额	-21,806,403.90	-45,663,230.04	-26,921,862.47
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	39,999,960.00	-	-
取得借款收到的现金	834,046,947.76	268,724,660.00	427,418,728.46
收到其他与筹资活动有关的现金	430,659,496.07	539,055,877.62	435,001,567.35
筹资活动现金流入小计	1,304,706,403.83	807,780,537.62	862,420,295.81
偿还债务支付的现金	605,992,450.84	492,310,563.15	566,637,197.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,433,896.86	55,563,847.25	55,942,683.08
支付其他与筹资活动有关的现金	892,796,523.59	476,738,074.75	285,182,348.71
筹资活动现金流出小计	1,547,222,871.29	1,024,612,485.15	907,762,229.78
筹资活动产生的现金流量净额	-242,516,467.46	-216,831,947.53	-45,341,933.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-119,568.22	5,600,616.49	-5,582,729.67
五、现金及现金等价物净增加额	66,098,305.38	-11,102,466.95	11,665,128.37
加：期初现金及现金等价物余额	9,964,753.53	21,067,220.48	9,402,092.11
六、期末现金及现金等价物余额	76,063,058.91	9,964,753.53	21,067,220.48

二、审计意见

（一）审计意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度、2024 年度和 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了《审计报告》（中汇会审[2026]10585 号）。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：好达电子的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2025 年 12 月 31 日、2024 年 12

月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度、2024 年度和 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 关键审计事项

关键审计事项描述	在审计中的应对程序
<p>2023 年度、2024 年度和 2025 年度,好达电子营业收入分别为 41,851.74 万元、60,655.03 万元和 67,465.69 万元。由于收入金额重大且为关键业绩指标之一,从而存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险,中汇将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>针对与收入确认相关的关键审计事项,中汇执行了以下程序:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解好达电子与收入确认相关的关键内部控制,评价相关内部控制的设计和运行,并测试其运行的有效性; 2、复核销售合同或销售订单,评价收入确认政策的恰当性; 3、执行分析性复核程序,包括分析主要产品年度及月度收入、主要客户的变化及销售价格、毛利率的变动,检查是否存在异常波动; 4、对销售收入进行细节测试,检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售订单、销售出库单、销售发票、收货签收单、出口报关单等; 5、获取出口报关单数据,与账面确认的外销收入进行核对; 6、针对资产负债表日前后确认的销售收入进行截止测试,评估销售收入是否确认在恰当的期间,检查期后是否存在异常退货或者大额收入冲回的情况; 7、对主要客户报告期内的销售收入金额及对应的应收账款余额进行函证; 8、对主要客户执行走访程序,了解双方交易背景、交易流程、货款结算、财务数据等内容,分析收入确认政策的合理性; 9、检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
<p>好达电子报告期各期末存货账面余额分别为 40,454.74 万元、36,616.50 万元和 41,079.72 万元,已计提的存货跌价准备余额为 19,464.12 万元、19,048.89 万元和 18,002.86 万元。由于存货跌价准备金额重大,且管理层在计量存货跌价准备时涉及重大估计和判断,为此中汇确定该事项为关键审计事项。</p>	<p>针对与存货跌价准备计提相关的关键审计事项,中汇执行了以下程序:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解与存货跌价准备相关的关键内部控制,评价相关内部控制的设计和运行; 2、获取存货跌价准备计算表,复核管理层计提存货跌价准备的方法,评估其进行测试时所使用的假设和数据合理性; 3、将管理层估计的售价与期后实际售价、市场信息等进行比较,将管理层估计的加工至完工的成本、销售费用以及相关税费与期后或历史实际数据进行比较,检查是否存在显著差异; 4、结合存货监盘程序,检查期末存货中是否存在库龄较长、产品呆滞或毁损等情形,分析存货跌价准备计提是否充分、准确; 5、检查与存货跌价准备相关的信息是否在财务报表中作出恰当列报和披露。

(三) 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司在确定与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准时,结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况,具体从性质和金额两个方面来考虑。从性质来看,主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的

财务状况、经营成果和现金流量；从金额来看，因公司尚未盈利，根据营业收入总额的 0.5%确定合并财务报表的重要性水平。

三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》的披露规定编制财务报表。

公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

（二）合并报表范围及其变化

报告期内，公司合并财务报表的合并范围及变化情况如下：

序号	公司名称	是否纳入合并报表范围			备注
		2025 年	2024 年	2023 年	
1	瑞驿通	是	是	是	-
2	思福易	否	否	是	2023 年出售

2023 年 5 月，经公司董事会决议批准，同意公司将所持有的无锡市思福易半导体设备有限公司 51% 股权公司出售，2023 年 8 月公司收到该股权转让款，自 2023 年 8 月起，公司不再将其纳入合并财务报表范围。除此以外，公司合并报表范围不存在其他变化。

四、重要会计政策和会计估计

（一）外币业务折算

1、外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布

的当日外汇牌价的中间价，下同）折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2、外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：（1）属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；（2）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及（3）以公允价值计量且变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益或其他综合收益。

（二）金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类、确认依据和计量方法

（1）金融资产和金融负债的确认和初始计量

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“四、重要会计政策和会计估计”之“（十一）收入”

所述的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：A、扣除已偿还的本金；B、加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；C、扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：A、对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。B、对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续

期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：A、公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。B、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得或损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述①、②情形外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融负债的分类和后续计量

公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。公司不确认权益工具的公允价值变动额。

2、金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指公司将金融资产（或其现金流量）让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，公司予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值

进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分在终止确认日的账面价值；（2）终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

3、金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

4、金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“四、重要会计政策和会计估计”之“（三）公允价值”

5、金融工具的减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认

其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

6、金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（三）公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是公司在计量日能够进入的交易市场。

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重

新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（四）应收票据

1、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

公司按照本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“四、重要会计政策和会计估计”之“（二）金融工具”之“5、金融工具的减值”所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。公司将信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收票据按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

2、按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	非6家大型商业银行及9家上市股份制银行
财务公司承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的财务公司
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

注：6家大型商业银行及9家上市股份制银行系指：中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中国交通银行6家大型商业银行以及招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、平安银行、兴业银行和浙商银行9家上市股份制银行，共计15家银行

3、按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值测试。

（五）应收账款

1、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

公司按照本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“四、重要会计政策和会计估计”之“（二）金融工具”之“5、金融工具的减值”所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账

款的信用损失。公司将信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

2、按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	应收公司合并报表范围内关联方及存在控制关系的法人及自然人的应收款项等

3、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

公司按照先发生先收回的原则统计并计算应收账款账龄。

4、按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试。

（六）存货

1、存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

（2）企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

（3）企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法。低值易耗品按照一次转销法进行摊销。包装物按照一次转销法进行摊销。

（5）存货的盘存制度为永续盘存制。

2、存货跌价准备

存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1) 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(七) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、

出租或经营管理持有的；（2）使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2、固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

3、固定资产的折旧方法

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同的方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率和折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

固定资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20	10	4.50
机器设备	年限平均法	10	10	9.00
运输设备	年限平均法	5	10	18.00
电子及其他设备	年限平均法	5	10	18.00

注：1、符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；2、已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率；3、公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理

4、其他说明

（1）因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

（2）若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认，并停止折旧和计提减值。

（3）固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相

关税费后的差额计入当期损益。

(4) 公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(八) 无形资产

1、无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2、无形资产使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，

视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命依据	期限（年）
软件	预计受益期限	3-5
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	50

对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

3、研发支出的归集范围及相关会计处理方法

（1）基本原则

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性

改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

公司将研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下简称试运行销售)的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的确认为相关资产。

(2) 具体标准

公司研发支出主要包括人工工资、社会保险费、住房公积金、福利费、直接材料、折旧、水电费、测试费、差旅费等。开发阶段系产品量产前，将研究成果应用于产品设计，以生产出新的或具有实质性改进的产品的研发活动阶段。报告期内，公司不存在开发阶段研发支出资本化的情形。

(九) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

2、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

4、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

6、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；

7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“四、重要会计政策和会计估计”之“（三）公允价值”；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

（十）股份支付

1、股份支付的种类

公司的股份支付是为了获取职工（或其他方）提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。包括以权益结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

4、股份支付的会计处理

（1）以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积，在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额（将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积）。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

5、涉及公司合并范围内各企业之间、公司与公司实际控制人或其他股东之间或者公司与公司所在集团内其他企业之间的股份支付交易，按照《企业会计准则解释第4号》第七条集团内股份支付相关规定处理。

(十一) 收入

1、收入的总确认原则

公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建的商品；（3）公司履

约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

2、公司收入的具体确认原则

（1）内销：寄售模式下，公司按销售合同（订单）约定，将相关产品发至客户指定货仓，根据客户实际领用情况对账完成时作为收入的确认时点；非寄售

模式下，公司按销售合同（订单）约定，将相关产品交付给客户，经客户到货签收，公司在确认已完成交货的相关信息并取得收款权利后，确认销售收入。

（2）外销:公司按销售合同（订单）约定，对于采用 FOB 方式结算的，在货物装运完毕并办理完成相关报关手续后确认销售收入；对于采用 EXW 方式结算的，将货物交付给提货人或承运人时确认收入；对于采用 FCA 方式结算的，将货物在指定的地点并经承运人签收后确认收入。

（十二）政府补助

1、政府补助的分类

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

（1）政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

（2）根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的，划分为与收益相关的政府补助。

（3）若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，

作为与收益相关的政府补助。

2、政府补助的确认时点

公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4) 根据公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3、政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（十三）递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项；（3）按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具的股利支出，按照税收政策可在企业所得税税前扣除且所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以

下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），并且初始确认的资产和负债不会产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

(2) 对于与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），并且初始确认的资产和负债不会产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

(2) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），公司对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所

得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2、当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（十四）租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、作为承租方租赁的会计处理方法

（1）使用权资产

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额）；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用公司的增量借款利率作为折现率。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

（3）短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

2、作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，公司将该转租赁分类为经营租赁。

经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3、售后租回交易

公司按照本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“四、重要会计政策和会计估计”之“（十一）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。在租赁期开始日后，对于包含非取决于指数或比率的可变租赁付款额的售后租回交易，公司采用合理方法确定租回所保留的权利占比，不确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“四、重要会计政策和会计估计”之“（二）金融工具”。

（2）出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述出租人的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“四、重要会计政策和会计估计”之“（二）金融工具”。

（十五）重要会计政策和会计估计的变更及前期会计差错更正

1、重要会计政策变更

报告期内，公司不存在重要会计政策变更。

2、重要会计估计变更

报告期内，公司不存在重要会计估计变更。

3、前期会计差错更正

报告期内，公司不存在前期会计差错更正。

五、非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1.90	82.20	1,466.50
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	561.27	185.57	837.75
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	44.10
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-70.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79.28	-48.92	-269.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25.14	-489.05	-538.80
小计	505.24	-270.19	1,470.53
减：所得税影响额	-	-	-
少数股东损益影响额（税后）	-	-	-3.46
归属于母公司股东的非经常性损益净额	505.24	-270.19	1,473.99

报告期各期，公司归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为 1,473.99 万元、-270.19 万元和 505.24 万元，主要受政府补助和非流动资产处置损益的影响，具体分析参见本节之“九、经营成果分析”之“（五）其他利润表项目分析”和“（六）政府补助”等相关内容。

六、公司报告期内的纳税情况

（一）公司主要税种和税率

税种	计税（费）依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，	按3%、5%、6%、9%、13%等税率计缴。出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税

税种	计税（费）依据	税率
	差额部分为应交增值税	率为5%-13%。
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

（二）不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

公司存在以下不同企业所得税税率主体：

纳税主体名称	所得税税率
好达电子	15%
瑞驿通	20%、25%
思福易	20%

（三）税收优惠及批文

公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，2023年11月6日，公司取得“高新技术企业证书”，证书编号：GR202332002180，有效期三年。公司自2023年起至2025年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号）规定和《财政部、税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号），对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，无锡瑞驿通科技有限公司2023年、2024年享受小型微利企业所得税减免政策所得税按20%的税率计缴，无锡市思福易半导体设备有限公司2023年享受小型微利企业所得税减免政策所得税按20%的税率计缴。

2023年3月26日，财政部、税务总局发布了公告2023年第7号《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2023年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2023年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。公司2023年、2024年、2025年享受此优惠。

2023年9月3日，财政部、税务总局发布了公告2023年第43号《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。公司2023年、2024年、2025年享受此优惠。

2018年7月11日，财政部、国家税务总局发布了财税2018年第76号《财政部 国家税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》，自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。公司2023年、2024年、2025年享受此政策。

七、分部信息

公司不存在独立承担不同于其他组成部分风险和报酬、可区分的业务分部，无需列报更详细的经营分部信息。

公司分产品的主营业务收入分类的情况参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“九、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”。

八、主要财务指标

（一）主要财务指标

主要财务指标	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
流动比率（倍）	0.67	0.41	0.49
速动比率（倍）	0.39	0.25	0.25

资产负债率（母公司）	88.30%	91.08%	87.33%
资产负债率（合并）	88.70%	91.38%	87.59%
归属于发行人股东的每股净资产（元）	2.31	1.74	2.58
主要财务指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率（次）	3.89	3.15	3.21
存货周转率（次）	1.26	1.25	0.91
息税折旧摊销前利润（万元）	17,188.79	8,695.68	-8,523.74
利息保障倍数（倍）	0.82	-0.73	-4.24
归属于发行人股东的净利润（万元）	-335.42	-7,975.47	-21,611.87
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-840.65	-7,705.28	-23,085.86
研发投入占营业收入的比例	8.47%	9.78%	11.95%
每股经营活动产生的现金流量（元）	4.29	3.22	1.17
每股净现金流量（元）	0.86	-0.15	0.15

注：1、流动比率=流动资产÷流动负债；2、速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债；3、资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%；4、归属于发行人股东的每股净资产=归属于公司普通股股东的期末净资产÷期末股本总数；5、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额；6、存货周转率=营业成本÷存货平均余额；7、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧与摊销额；8、利息保障倍数=（利润总额+利息支出）÷利息支出；9、研发投入占营业收入的比例=（研发投入÷营业收入）×100%；10、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总数；11、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本总数

（二）净资产收益率及每股收益

按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的公司净资产收益率和每股收益如下表所示：

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2025 年度	-2.07%	-0.04	-0.04
	2024 年度	-48.44%	-1.05	-1.05
	2023 年度	-77.43%	-2.83	-2.83
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2025 年度	-5.19%	-0.11	-0.11
	2024 年度	-46.80%	-1.01	-1.01
	2023 年度	-82.71%	-3.03	-3.03

九、经营成果分析

报告期内，公司的主要经营业绩情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业总收入	67,465.69	60,655.03	41,851.74
营业总成本	66,209.33	65,761.16	60,188.82
营业利润	-796.58	-9,802.90	-25,601.37
利润总额	-875.86	-9,831.82	-25,896.29
净利润	-335.42	-7,975.47	-21,704.63
归属于母公司所有者的净利润	-335.42	-7,975.47	-21,611.87
少数股东损益	-	-	-92.76

（一）营业收入分析

1、营业收入总体情况分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务收入	67,141.27	99.52	60,411.28	99.60	41,640.32	99.49
其他业务收入	324.42	0.48	243.75	0.40	211.41	0.51
合计	67,465.69	100.00	60,655.03	100.00	41,851.74	100.00

公司专注于声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售，主要产品包括滤波器、双工器等。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重均超过 99%，主营业务突出。其他业务收入主要为材料等销售收入，占营业收入比重较小。

2023 年至 2025 年，公司主营业务收入分别为 41,640.32 万元、60,411.28 万元和 67,141.27 万元，逐年增长，具体原因如下：

（1）国产替代进程加速，市场份额提升

滤波器是无线通信系统的核心器件。中国是全球主要的滤波器需求大国之一，村田、高通（RF360）、太阳诱电、思佳讯和威讯等国际厂商占据主要市场份额，

国内厂商发展前景广阔。

在国产化的大趋势下，公司抓住行业发展机遇，持续进行产品研发及迭代升级，不断优化产品结构，在 SAW 方面，公司持续对 SAW 产品系列进行设计迭代与性能优化，通过精细化管理和技术创新不断提升产品良率、降低制造成本；同时，依托设计和工艺创新，持续缩小芯片尺寸，有效满足客户对器件小型化的持续需求；在 TC-SAW 方面，公司掌握了 TC-SAW 关键技术，率先实现国内 TC-SAW 滤波器量产出货，出货量位居国内前列；在 TF-SAW 方面，公司是国内少数具有 POI 材料制备能力的滤波器厂商，为未来公司产品迭代升级打下坚实基础。报告期内，公司 SAW 收入持续增长，年均复合增长率为 13.36%；TC-SAW 的销售收入快速增长，年均复合增长率为 78.30%；TF-SAW 产品也实现了批量出货，产品的结构不断优化。

凭借优质的产品性能、稳定的产品品质、持续稳定自主的规模化供货能力、快速的交付响应、丰富的产品矩阵等，公司产品得到市场的广泛认可，已成为国产替代的重要力量。报告期内，公司累计销售主营产品近百亿颗，市场占有率从 1.46% 增长至 2.29%，市场份额逐年提高，是国内企业中少数能与同行业全球知名公司直接竞争的声表面波射频滤波器制造厂商。

(2) 下游应用领域广泛，市场空间广阔

公司产品实现了 300MHz 以上到 6GHz 以下关键频段的全面覆盖，广泛应用于智能终端、物联网、汽车电子、基站、低轨卫星通信等多个应用领域。

根据 IDC 数据，2023 年至 2025 年，全球智能手机出货量分别为 11.64 亿台、12.40 亿台和 12.60 亿台，总体保持稳定。目前每部手机平均搭载数十颗滤波器，滤波器需求量达数百亿颗。报告期内，公司智能终端领域的销售收入持续快速增长，年均复合增长率为 29.63%，市场份额不断提升。

根据 IoT Analytics 数据，2025 年全球物联网设备连接数预计将达 211 亿台，同比增长 14%，增速较 2024 年的 12% 进一步提升，显示出物联网行业正进入加速发展阶段。预计到 2030 年，全球物联网设备连接数将增长至 390 亿台，2035 年有望突破 550 亿台。报告期内，公司物联网领域的销售收入持续增长，年均复

合增长率为 19.27%。

根据国际汽车制造商协会（OICA）数据，2025 年全球汽车产销量保持增长态势，产量达 9,640 万辆，销量为 9,980 万辆。根据中国汽车工业协会数据，2019 年至 2025 年，中国汽车产量从 2,572 万辆增长至 3,453 万辆，销量从 2,577 万辆增长至 3,440 万辆，累计增幅分别达 34.3%和 33.5%。庞大的汽车产销量为上游汽车电子产业提供了坚实的市场基础。随着汽车电子在整车成本中的占比持续提升以及单车电子元器件数量的不断增加，声表面波滤波器等射频核心器件面临广阔的市场空间。报告期内，公司汽车电子领域的销售收入持续快速增长，年均复合增长率为 111.63%。

（3）规模化交付与全链条自主，规模效应逐步显现

公司构建了集芯片设计、晶圆制造与封装测试于一体的全链条能力，是国内少数实现滤波器从理论设计到规模化量产出货全链条自主可控的 IDM 企业。规模化量产，持续稳定的交付能力是 IDM 企业保持竞争优势的关键因素。为把握射频芯片国产替代的整体趋势，公司抓住历史机遇，在 2020 年至 2021 年积极扩充产能，经过近几年的积累发展，公司逐步完成了产能产量爬坡和良率提升，产能利用率不断提升，产量大幅增长。报告期内，公司产能利用率分别为 30.22%、64.07%和 83.73%，逐年增长；产量分别为 13.95 亿颗、32.89 亿颗和 48.42 亿颗，年均复合增长率为 86.29%，为公司主营业务收入的稳定增长提供了重要保障；同时随着公司产量的增长，IDM 模式的规模效应逐步显现，显著降低了单位成本，提升了公司的市场竞争力。

（4）产品矩阵丰富，客户资源不断积累

公司构建了以 SAW、TC-SAW 及 TF-SAW 为核心的技术平台，拥有领先的滤波器晶圆制造产线及 SMD、CSP、WLP、Bare-Die 等封装产线，形成了涵盖低频、中频、高频的完整产品体系，实现了 300MHz 到 6GHz 关键频段的全面覆盖，产品矩阵丰富。

报告期内，公司积极开拓市场，客户资源不断积累，智能终端领域客户包括 OPPO、vivo、小米、三星、中兴、荣耀、传音、联想等一线知名手机品牌，以

及华勤、龙旗、天珑、闻泰、立讯等头部 ODM 厂商；物联网领域客户包括移远通信、广和通、中移物联、利尔达、美格智能等领先物联网模组企业；汽车电子领域终端客户包括比亚迪、小米、赛力斯等主流汽车品牌；基站领域客户包括中兴、罗森博格、京信等优质通信设备厂商；低轨卫星通信领域客户包括中兴、大唐等知名企业。

2、主营业务收入产品构成及分析

报告期内，公司主营业务收入按产品分类如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)
滤波器	33,325.81	49.64	31,793.35	52.63	25,570.22	61.41
双工器	32,167.80	47.91	26,659.44	44.13	13,460.52	32.33
谐振器	692.87	1.03	679.66	1.13	1,006.94	2.42
其他	954.79	1.42	1,278.82	2.12	1,602.64	3.85
合计	67,141.27	100.00	60,411.28	100.00	41,640.32	100.00

公司主营产品主要为滤波器和双工器。报告期内，公司滤波器和双工器的销售收入合计分别为 39,030.74 万元、58,452.79 万元和 65,493.61 万元，占主营业务收入比重分别为 93.74%、96.76%和 97.55%。报告期内，公司主营产品具体情况如下：

(1) 滤波器

滤波器是公司主营业务收入的主要来源。报告期内，公司滤波器销售收入分别为 25,570.22 万元、31,793.35 万元和 33,325.81 万元，占主营业务收入的比例为 61.41%、52.63%和 49.64%。

报告期内，公司滤波器产品销售收入、销售数量和销售单价的变动情况如下：

项目		2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售数量	销售量（万颗）	284,035.12	227,419.60	183,523.17
	变动比例	24.89%	23.92%	-

项目		2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售 单价	平均销售价格（元/颗）	0.12	0.14	0.14
	变动比例	-16.07%	0.34%	-
销售 收入	销售收入（万元）	33,325.81	31,793.35	25,570.22
	变动比例	4.82%	24.34%	-

滤波器是无线通信系统的核心器件，负责精准选择射频信号中有用频段信号和滤除干扰信号，保障各类无线通信系统通信质量、数据传输速率及信号灵敏度。

①销售数量

报告期内，公司滤波器的销售数量分别为 183,523.17 万颗、227,419.60 万颗和 284,035.12 万颗，持续增长，主要系：

A、公司滤波器已实现对 300 MHz 至 6 GHz 范围内主要通信频段的全面覆盖，是国内少数具备从低频、中频到高频全系列滤波器规模化供货能力的企业。报告期内，公司持续对滤波器进行设计迭代与性能优化，通过精细化管理和技术创新不断提升产品良率、降低制造成本；同时，依托设计和工艺创新，持续缩小芯片尺寸，有效满足客户对器件小型化的持续需求，产品得到了客户的广泛认可；

B、庞大的智能手机市场和快速发展的物联网、汽车电子等新兴市场，为公司滤波器销量的增长提供了有利的外部环境；

C、报告期内，公司产线逐步完成了产能产量爬坡和良率提升，产量大幅增长，规模效应逐步显现，显著降低了单位成本，提升了公司的市场竞争力，市场份额不断提升。

②销售单价

报告期内，公司滤波器的平均销售价格为 0.14 元/颗、0.14 元/颗和 0.12 元/颗，总体呈下降趋势，主要与电子元件行业发展规律及行业内公司竞争策略有关，具体原因如下：

A、射频前端芯片的发展在一定程度上遵循摩尔定律，随着终端厂商对智能手机功能多样化、机身轻薄化的要求不断提高，滤波器、双工器等射频前端芯片

厂商需要不断进行工艺研发以缩减产品尺寸。在相关工艺成熟后，单颗滤波器所需晶片、封装材料等原材料耗用量相应减少，单位成本下降从而带动销售价格下降；

B、随着通信技术持续演进，运用于射频前端的芯片产品不断更新迭代，新推出产品通常在一段时间内具备性能优势，售价相对较高。随着时间推移，市场竞争者逐渐出现，行业领先企业通常为保证市场份额而让渡部分利益，下调产品价格。受行业整体价格下降影响，公司滤波器产品的单价有所下调。

③销售收入

报告期内，公司滤波器的销售收入分别为 25,570.22 万元、31,793.35 万元和 33,325.81 万元，逐年增长。2024 年，公司滤波器销售收入较 2023 年增加 6,223.14 万元，增幅为 24.34%，主要系公司滤波器销售数量增加所致。2025 年，公司滤波器的销售收入较 2024 年增加 1,532.45 万元，增幅为 4.82%，主要系 2025 年，公司滤波器销售数量持续增加，抵减了销售单价下降的影响所致。

(2) 双工器

报告期内，公司双工器销售收入快速增长，占主营业务收入的比例逐年上升，逐步成为公司主营业务收入的重要组成部分。报告期内，公司双工器销售收入分别为 13,460.52 万元、26,659.44 万元和 32,167.80 万元，占主营业务收入的比例分别为 32.33%、44.13%和 47.91%。

报告期内，公司双工器产品销售收入、销售数量和销售单价的变动情况如下：

项目		2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售数量	销售量（万颗）	139,419.87	95,514.81	41,020.52
	变动比例	45.97%	132.85%	-
销售单价	平均销售价格（元/颗）	0.23	0.28	0.33
	变动比例	-17.34%	-14.94%	-
销售收入	销售收入（万元）	32,167.80	26,659.44	13,460.52
	变动比例	20.66%	98.06%	-

双工器在滤波的同时能够将发射和接收信号隔离，是集成发射和接收通道的滤波器，实现频分双工的功能。

①销售数量

报告期内，公司双工器的销售数量分别为 41,020.52 万颗、95,514.81 万颗和 139,419.87 万颗，持续快速增长。

公司双工器主要为 TC-SAW。经过多年的积累和发展，公司掌握了 TC-SAW 关键技术，在国内率先实现 TC-SAW 量产出货，已成功量产数十款手机用 TC-SAW 双工器，覆盖多个主流频段，产品在芯片尺寸、电性能、封装适配性等方面对标国际主流厂商，广泛应用于国内一线品牌手机。公司双工器在 2024 年实现大规模的量产出货，替代了国外厂商的部分市场份额，同时叠加 2024 年手机出货量增加和物联网、汽车电子市场需求增长的影响，公司双工器的销售数量大幅增加，较 2023 年大幅增长 132.85%。2025 年，随着新产线产能利用率及良率的提升，公司双工器单位成本持续下降，规模效应进一步显现，市场竞争力提升，双工器的销量持续放量，销量较 2024 年增长 45.97%。

②销售单价

双工器是集成发射和接收通道的滤波器，单位平均销售单价高于上述滤波器。与上述单滤波器产品类似，受电子元件行业发展规律及市场竞争情况等因素影响，报告期内，公司双工器的平均销售价格逐年下降。

③销售收入

2024 年、2025 年，公司双工器销售收入分别为 26,659.44 万元、32,167.80 万元，分别较 2023 年、2024 年增长 98.06%和 20.66%，主要系公司双工器销售数量逐年增加，抵减了销售平均单价下降的影响所致。

(3) 谐振器及其他

谐振器和其他产品非公司重点发展的产品，报告期内，公司谐振器和其他产品的销售收入整体呈下降趋势，具体情况如下：

谐振器是滤波器的基础单元，主要用于实现特定频率的谐振，是对单频点的信号进行筛选的器件，主要用于汽车遥控、门帘遥控、空调遥控等。报告期内，公司谐振器的销售收入分别为 1,006.94 万元、679.66 万元和 692.87 万元，占主

营业务收入的比例分别为 2.42%、1.13%和 1.03%，占比较低。

其他产品主要为低频谐振器、低频滤波器等，该等产品系公司委托 ODM 厂商贴牌生产。报告期内，对于不适用公司芯片制造工艺、市场上具备较为成熟的简单通用工艺、生产环节附加值较低的低频谐振器、低频滤波器等产品，公司委托 ODM 厂商进行贴牌生产。报告期内，公司其他产品的销售收入分别为 1,602.64 万元、1,278.82 万元和 954.79 万元，占主营业务收入的比例分别为 3.85%、2.12% 和 1.42%，占比较低。

3、主营业务收入技术路线构成及分析

报告期内，公司主营业务收入按技术路线分类如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)
SAW	44,320.82	66.01	43,975.96	72.79	34,491.67	82.83
TC-SAW	22,725.52	33.85	16,429.58	27.20	7,148.05	17.17
TF-SAW	94.94	0.14	5.74	0.01	0.60	0.00
合计	67,141.27	100.00	60,411.28	100.00	41,640.32	100.00

按技术路线划分，公司产品由 SAW、TC-SAW 及 TF-SAW 组成。在 SAW 方面，公司持续对 SAW 产品进行设计迭代与性能优化，通过精细化管理和技术创新不断提升产品良率、降低制造成本；同时，依托设计和工艺创新，持续缩小芯片尺寸，有效满足客户对器件小型化的持续需求；在 TC-SAW 方面，公司掌握了 TC-SAW 关键技术，率先实现国内 TC-SAW 滤波器量产出货，出货量位居国内前列；在 TF-SAW 方面，公司是国内少数具有 POI 材料制备能力的滤波器厂商，为未来公司产品迭代升级打下坚实基础。

报告期内，公司 SAW 收入持续增长，年均复合增长率为 13.36%；TC-SAW 的销售收入快速增长，年均复合增长率为 78.30%；TF-SAW 产品也实现了批量出货，产品的结构不断优化。

4、主营业务收入分地区构成

报告期内，公司主营业务收入按地区分类构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)
内销	65,647.47	97.78	58,840.69	97.40	40,047.02	96.17
外销	1,493.80	2.22	1,570.59	2.60	1,593.30	3.83
合计	67,141.27	100.00	60,411.28	100.00	41,640.32	100.00

在射频芯片国产替代加速推进背景下，公司滤波器、双工器产品逐步获得国内主流手机终端厂商及代工厂商、头部新能源汽车和物联网等客户的认可，主营业务收入以内销为主。

5、主营业务收入分销售模式构成

报告期内，公司主营业务收入按销售模式分类情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)
经销	37,532.05	55.90	29,818.09	49.36	22,017.50	52.88
直销	29,609.22	44.10	30,593.19	50.64	19,622.83	47.12
合计	67,141.27	100.00	60,411.28	100.00	41,640.32	100.00

按照行业惯例和公司特点，公司采用直销与经销相结合的销售模式。公司与经销商的关系属买断式销售关系，通过选择具备良好市场资源与渠道优势的经销商，拓展市场覆盖面，提高产品市场渗透率；对于部分终端客户，公司采用直销模式。报告期内，公司直销收入和经销收入占比相对稳定。

6、主营业务收入分季度构成

报告期内，公司主营业务收入分季度构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)
第一季度	14,253.12	21.23	11,349.38	18.79	5,932.77	14.25
第二季度	20,099.62	29.94	14,111.38	23.36	8,583.72	20.61
第三季度	19,528.01	29.08	18,418.91	30.49	10,544.19	25.32

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)	收入	比例 (%)
第四季度	13,260.52	19.75	16,531.61	27.37	16,579.64	39.82
合计	67,141.27	100.00	60,411.28	100.00	41,640.32	100.00

报告期内，公司各季度主营业务收入存在一定波动，但未呈现明显季节性。2023 年，公司第一季和第四季度的收入占比差异较大，主要系 2023 年上半年，中国手机市场出货量持续下滑，第三季度逐步企稳复苏，第四季度环比增长所致。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
主营业务成本	49,023.60	99.79	47,949.73	99.76	43,046.93	99.57
其他业务成本	102.69	0.21	117.07	0.24	186.41	0.43
合计	49,126.29	100.00	48,066.80	100.00	43,233.34	100.00

报告期各期，公司主营业务成本分别为 43,046.93 万元、47,949.73 万元和 49,023.60 万元，占营业成本比重均超过 99%，为营业成本的主要组成部分。其他业务成本主要为销售原材料的采购成本等，金额和占比较小。

2、主营业务成本产品构成分析

报告期内，公司主营业务成本按产品构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	成本	比例 (%)	成本	比例 (%)	成本	比例 (%)
滤波器	21,586.05	44.03	23,377.32	48.75	24,679.19	57.33
双工器	26,102.88	53.25	23,209.10	48.40	15,669.22	36.40
谐振器	644.00	1.31	622.33	1.30	1,517.24	3.52
其他	690.67	1.41	740.99	1.55	1,181.28	2.74
合计	49,023.60	100.00	47,949.73	100.00	43,046.93	100.00

公司主营业务成本主要为滤波器和双工器产品成本。报告期内，公司滤波器和双工器的销售成本合计分别为 40,348.41 万元、46,586.41 万元和 47,688.93 万元，占主营业务成本的比重分别为 93.73%、97.16%和 97.28%。

3、主营业务成本构成分析

报告期内，公司主营业务成本的明细构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
直接材料	28,046.55	57.21	24,890.55	51.91	19,846.56	46.10
直接人工	6,436.76	13.13	6,585.26	13.73	6,523.69	15.15
制造费用	14,540.29	29.66	16,473.93	34.36	16,676.68	38.74
合计	49,023.60	100.00	47,949.73	100.00	43,046.93	100.00

公司采用 IDM 模式，设计与制造一体化，拥有从芯片设计、晶圆制造到封装测试的全产业链能力。报告期内，随着公司产能利用率和良率的提升，产量逐年增加，规模效应逐步显现，制造费用和直接人工占比逐年下降。报告期内，公司直接材料的规模随公司经营规模的扩大，逐年增长，同时受制造费用和直接人工占比下降的影响，公司直接材料占比逐年上升。

（三）毛利率分析

1、营业毛利

报告期内，公司各期间营业毛利构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
主营业务毛利	18,117.67	12,461.55	-1,406.61
其他业务毛利	221.73	126.68	25.00
合计	18,339.40	12,588.22	-1,381.61

公司营业毛利主要来自主营业务。报告期内，公司主营业务毛利分别为 -1,406.61 万元、12,461.55 万元和 18,117.67 万元。

2、主营业务毛利

报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
滤波器	11,739.76	8,416.04	891.03
双工器	6,064.93	3,450.34	-2,208.70
谐振器	48.87	57.33	-510.30
其他	264.12	537.83	421.36
合计	18,117.67	12,461.55	-1,406.61

报告期内，公司主营业务毛利主要来源于滤波器和双工器，逐年增长。

3、主营业务毛利率

报告期内，公司主营业务毛利率按照产品类别划分的情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
滤波器	35.23%	26.47%	3.48%
双工器	18.85%	12.94%	-16.41%
谐振器	7.05%	8.44%	-50.68%
其他	27.66%	42.06%	26.29%
主营业务毛利率	26.98%	20.63%	-3.38%

由于声表面波滤波器的设计与制造需要密切配合，目前行业内领先企业以 IDM 模式为主导，包括村田、高通（RF360）、太阳诱电、思佳讯等主要的 SAW 滤波器厂商均采用 IDM 模式。由于技术壁垒高，资金投入巨大，国内仅有少数企业采用 IDM 模式。公司是国内 IDM 厂商之一，已具备成熟的芯片设计、制造与封装测试能力，能够有效保障产品性能、提升良率和降低成本，从而获取全产业链产品附加值。

为把握射频芯片国产替代的整体趋势，公司抓住历史机遇，积极扩充产能，经过近几年的积累发展，公司逐步完成了产能产量爬坡，产量大幅增长，产能利用率不断提升。2023 年至 2025 年，公司产量分别为 13.95 亿颗、32.89 亿颗和 48.42 亿颗，产能利用率分别为 30.22%、64.07%和 83.73%，随着公司产量的增长，IDM 模式的规模效应逐步显现，显著降低了单位制造费用和单位直接人工。

同时随着原材料整体采购价格下降、产品良率提升及产品小型化，公司单位直接材料逐年下降。

2023年至2025年，公司主营业务毛利率逐年增长，主要系随着公司经营规模的扩大，规模效应逐步显现，单位成本大幅下降所致，其中，2023年毛利率为负，主要系IDM模式下，产量和良率爬坡期单位产品分摊的制造费用和人工成本较高所致。

公司主营产品主要为滤波器和双工器，报告期内，公司滤波器和双工器的销售收入占主营业务收入的比重分别为93.74%、96.76%和97.55%。报告期内，公司滤波器和双工器的毛利率变动分析如下：

（1）滤波器

报告期内，公司滤波器的单位售价、单位成本和毛利率变动情况如下：

单位：元/颗

项目	2025年度		2024年度		2023年度
	数值	变动比例	数值	变动比例	数值
单位售价	0.12	-16.07%	0.14	0.34%	0.14
单位成本	0.08	-26.07%	0.10	-23.56%	0.13
毛利率	35.23%	8.76%	26.47%	22.99%	3.48%

注：毛利率的变动比例为绝对变动

报告期内，公司滤波器的平均销售单价分别为0.14元/颗、0.14元/颗和0.12元/颗，其中，2025年单位售价下降，主要受电子元件行业发展规律及公司竞争策略影响。

报告期内，公司滤波器的单位成本分别为0.13元/颗、0.10元/颗和0.08元/颗，逐年下降，主要系（1）报告期内，公司滤波器的产量逐年大幅增加，单位制造费用和单位直接人工下降；（2）报告期内，公司主要原材料的采购价格整体呈下降趋势，单位直接材料下降；（3）报告期内，受产品小型化及产品的良率的提升，单颗滤波器所需晶片、封装材料等原材料耗用量相应减少。

报告期内，公司滤波器的毛利率分别为3.48%、26.47%和35.23%，逐年上升，主要系单位成本逐年下降所致。

（2）双工器

报告期内，公司双工器的单位售价、单位成本和毛利率变动情况如下：

单位：元/颗

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	数值	变动比例	数值	变动比例	数值
单位售价	0.23	-17.34%	0.28	-14.94%	0.33
单位成本	0.19	-22.95%	0.24	-36.39%	0.38
毛利率	18.85%	5.91%	12.94%	29.35%	-16.41%

注：毛利率的变动比例为绝对变动

报告期内，受电子元件行业发展规律及行业竞争的影响，公司双工器的单位售价逐年下降。报告期内，得益于产量增加和良率的提升、规模化效益的影响和原材料采购价格下降及产品小型化趋势，公司双工器的单位成本逐年下降。

报告期内，公司双工器的毛利率分别为-16.41%、12.94%和 18.85%，逐年上升，主要系单位成本下降抵减了单位售价下降的影响所致，其中，2023 年毛利率为负，主要系 2023 年，公司双工器的产量较小，未大规模量产，单位制造费用较高，导致单位成本高于单位售价所致。

4、与同行业可比公司毛利率的比较情况

公司主营业务定位于射频芯片行业，主营产品为声表面波射频滤波器、双工器等。射频前端主要包含功率放大器（PA）、滤波器（Filter）、射频开关/天线调谐开关（Switch/Tuner）、低噪声放大器（LNA）四类器件。A 股上市公司中，尚无主营生产滤波器的企业，公司在选取同行业可比公司时，主要选取主营业务中有射频前端相关产品的公司，同时考虑应用领域、销售模式是否相同或相似及数据是否容易获取等因素，选取了以下 7 家公司进行比较分析，具体情况如下：

公司名称	主营业务	应用领域	业务模式	销售模式
卓胜微 (300782)	射频集成电路领域的研究、开发、生产与销售，主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等射频前端分立器件及各类模组产品解决方案	移动智能终端、智能穿戴、通信基站、汽车电子、蓝牙耳机、VR/AR 设备及网通组网设备等领域	Fab-lite	经销与直销模式，2025 年经销占比 51.10%

公司名称	主营业务	应用领域	业务模式	销售模式
唯捷创芯 (688153)	射频前端芯片的研发、设计及销售，主要产品涵盖射频功率放大器模组和接收端模组等	智能手机、平板电脑、无线路由器、智能穿戴设备、车载通信系统、卫星通信终端以及 AI 智能产品等多样化的终端设备	Fabless	直销与经销并重，2025 年经销占比 48.34%
慧智微 (688512)	射频前端芯片及模组的研发、设计和销售，产品系列覆盖 2G、3G、4G、3GHz 以下的 5G 重耕频段、3GHz~6GHz 的 5G UHB 等蜂窝通信频段和 Wi-Fi 通信等，可为客户提供无线通信射频前端发射模组、接收模组等	智能手机、物联网等	Fabless	经销为主、直销为辅，2025 年经销占比 74.31%
昂瑞微 (688790)	射频前端芯片、射频 SoC 芯片及其他模拟芯片的研发、设计与销售。核心产品线主要包括面向智能移动终端的 5G/4G/3G/2G 全系列射频前端芯片产品（包括射频前端模组及功率放大器、开关、LNA 等）以及面向物联网的射频 SoC 芯片产品（包括低功耗蓝牙类及 2.4GHz 私有协议类无线通信芯片）	智能手机、手机卫星通信、汽车、物联网、无线外设、智能家居、健康医疗、智慧物流等	Fabless	经销与直销模式，2025 年经销占比 59.91%
飞骧科技 (港交所审核中)	射频前端芯片的设计、研发和销售，主要产品为 PA 及 PA 集成收发模组	移动智能设备、Wi-Fi 产品、智能家居及其他物联网、车载通信及卫星通信等	Fabless	经销为主，2024 年经销占比 95.50%
锐石创芯 (科创板审核中)	射频前端模组及射频分立器件的研发、设计、制造和销售。产品覆盖射频滤波器（含双工器、多工器、SAW Bank）、功率放大器、射频开关及低噪声放大器等全品类核心射频器件	智能手机、物联网、智能穿戴、消费电子等	Fab-lite	经销与直销模式，2025 年经销占比 66.49%
麦捷科技 (300319)	高端电子元器件及模组的研发、生产和销售，核心业务覆盖磁性元器件、射频器件、显示模组三大板块	通讯设备、消费终端、新能源、汽车电子、服务器、工业控制、安防设备等领域	未披露	直销为主、经销为辅，2025 年直销占比 84.22%
好达电子	声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售，主要产品包括声表面波滤波器、双工器、谐振器	智能终端、物联网、汽车电子、基站、低轨卫星通信等多个应用领域	IDM	直销与经销相结合，2025 年经销占比 55.90%

报告期内，公司主营业务毛利率与同行业可比公司对比情况如下：

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
卓胜微	25.64%	39.63%	46.56%
唯捷创芯	25.20%	23.77%	24.76%
慧智微	7.08%	1.90%	11.97%
昂瑞微	21.26%	20.22%	20.08%
飞骧科技	未披露	18.99%	14.06%
锐石创芯	9.57%	8.78%	13.90%
麦捷科技	16.35%	20.31%	19.25%
平均值	17.52%	19.09%	21.51%
好达电子	26.98%	20.63%	-3.38%

数据来源：同行业可比公司数据来源于公开披露文件，下同

公司采用 IDM 模式，固定资产规模较大，与主要采用 Fabless 轻资产运营模式的同行业可比公司相比，设备投入后公司处于产能产量爬坡及良率提升阶段，单位成本相对较高，形成规模效益需要一定的时间。

为把握射频芯片国产替代的整体趋势，公司抓住历史机遇，在 2020 年至 2021 年积极扩充产能，经过近几年的积累发展，公司逐步完成了产能产量爬坡和良率提升，产量大幅增长。报告期内，公司产量分别为 13.95 亿颗、32.89 亿颗和 48.42 亿颗，年均复合增长率为 86.29%。随着公司产量的增长，公司 IDM 模式的规模效应逐步显现，显著降低了单位成本。2023 年，公司的产量处于低谷，单位制造费用较高，导致单位成本高于单位售价，毛利率为负，低于行业平均值；2023 年后，随着公司产能利用率和良率的提升，产销量大幅增加，规模效应开始逐步显现，单位成本逐年下降，主营业务毛利率逐步回升，2024 年公司主营业务毛利率为 20.63%，与行业平均值相近，2025 年公司主营业务毛利率为 26.98%，与卓胜微、唯捷创芯和昂瑞微相近，略高于同行业可比公司的平均值。

（四）期间费用分析

报告期内，公司各项期间费用及占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	2,442.37	3.62%	2,499.51	4.12%	2,206.21	5.27%
管理费用	3,817.82	5.66%	3,967.26	6.54%	3,975.75	9.50%
研发费用	5,717.43	8.47%	5,931.82	9.78%	5,000.02	11.95%
财务费用	4,982.03	7.38%	5,184.84	8.55%	5,670.30	13.55%
合计	16,959.65	25.14%	17,583.43	28.99%	16,852.27	40.27%

报告期内，公司期间费用总体保持稳定，分别为 16,852.27 万元、17,583.43 万元和 16,959.65 万元，占营业收入的比例随收入规模的上升而逐年降低，分别为 40.27%、28.99%和 25.14%。

1、销售费用分析

(1) 销售费用构成分析

报告期内，公司销售费用的具体构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	1,196.81	49.00%	1,255.13	50.21%	1,159.64	52.56%
业务招待费	533.28	21.83%	463.06	18.53%	450.73	20.43%
股份支付	409.40	16.76%	431.28	17.25%	236.21	10.71%
差旅交通费	152.55	6.25%	185.65	7.43%	186.85	8.47%
办公费用	54.63	2.24%	35.88	1.44%	31.76	1.44%
折旧及摊销	58.38	2.39%	73.49	2.94%	76.36	3.46%
其他	37.33	1.53%	55.02	2.20%	64.64	2.93%
合计	2,442.37	100.00%	2,499.51	100.00%	2,206.21	100.00%

2023 年至 2025 年，公司销售费用分别为 2,206.21 万元、2,499.51 万元和 2,442.37 万元，占营业收入的比例分别为 5.27%、4.12%和 3.62%。公司销售费用主要由职工薪酬、业务招待费及股份支付构成。

报告期内，销售人员的薪酬分别为 1,159.64 万元、1,255.13 万元和 1,196.81 万元，其中，2025 年小幅下降，主要系 2025 年销售人员数量小幅减少所致。

报告期内，业务招待费分别为 450.73 万元、463.06 万元和 533.28 万元，随着公司经营规模的扩大，逐年增长。

报告期内，股份支付分别为 236.21 万元、431.28 万元和 409.40 万元，其中，2023 年金额较小，主要系 2023 年 7 月，公司新增对 17 名销售人员进行股权激励，按 4 年的服务年限进行摊销，2023 年摊销期限较短。

(2) 销售费用同行业对比分析

公司销售费用占营业收入比例与同行业可比公司对比情况如下：

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
卓胜微	1.20%	1.26%	1.06%
唯捷创芯	2.28%	1.40%	1.10%
慧智微	5.95%	7.09%	8.27%
昂瑞微	3.49%	2.86%	4.86%
飞骧科技	未披露	2.26%	3.14%
锐石创芯	2.58%	2.53%	2.72%
麦捷科技	1.19%	1.31%	1.65%
平均值	2.78%	2.67%	3.26%
好达电子	3.62%	4.12%	5.27%

报告期各期，公司销售费用率分别为 5.27%、4.12%和 3.62%，低于慧智微，高于行业平均值，主要系公司处于业务成长期，与同行业卓胜微、唯捷创芯、昂瑞微、飞骧科技和麦捷科技相比，销售规模较小，销售费用率相对较高，随着公司业务规模逐步扩大，销售费用率已与可比公司均值较为接近。

2、管理费用分析

(1) 管理费用构成分析

报告期内，公司管理费用的具体构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	1,683.35	44.09%	1,563.28	39.40%	1,515.17	38.11%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
股份支付	213.33	5.59%	809.46	20.40%	727.69	18.30%
折旧及摊销	721.66	18.90%	787.78	19.86%	696.06	17.51%
业务招待费	526.79	13.80%	352.10	8.88%	325.71	8.19%
服务费	239.44	6.27%	79.17	2.00%	396.82	9.98%
办公费用	345.31	9.04%	221.48	5.58%	186.60	4.69%
差旅交通费	21.78	0.57%	17.65	0.44%	32.50	0.82%
其他	66.15	1.73%	136.33	3.44%	95.19	2.39%
合计	3,817.82	100.00%	3,967.26	100.00%	3,975.75	100.00%

报告期内，公司管理费用金额分别为 3,975.75 万元、3,967.26 万元和 3,817.82 万元，占营业收入的比例分别为 9.50%、6.54%和 5.66%。公司管理费用主要由职工薪酬、股份支付、折旧及摊销和业务招待费组成，具体情况如下：

报告期内，公司管理人员的薪酬分别为 1,515.17 万元、1,563.28 万元和 1,683.35 万元；业务招待费用分别为 325.71 万元、352.10 万元和 526.79 万元，随公司经营规模的扩大，逐年增长。

报告期内，公司管理人员的股份支付主要为公司对管理人员实行股权激励按服务年限摊销确认的股份支付和员工退出持股平台转让给控股股东确认的股份支付。报告期内，管理人员的股份支付分别 727.69 万元、809.46 万元和 213.33 万元，其中，2025 年股份支付金额相对较低，主要系 2025 年，员工持股平台退出转让份额较少，相应确认的股份支付金额相对较低。

报告期内，折旧及摊销分别为 696.06 万元、787.78 万元和 721.66 万元，总体保持稳定。

(2) 管理费用同行业对比分析

公司管理费用占营业收入比例与同行业可比公司对比情况如下：

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
卓胜微	4.61%	4.03%	3.53%
唯捷创芯	5.97%	6.33%	4.94%
慧智微	8.42%	17.23%	16.09%

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
昂瑞微	6.31%	5.32%	17.29%
飞骧科技	未披露	4.52%	5.77%
锐石创芯	8.16%	11.43%	16.00%
麦捷科技	2.80%	3.14%	2.81%
平均值	6.05%	7.43%	9.49%
好达电子	5.66%	6.54%	9.50%

报告期内，公司管理费用率分别为 9.50%、6.54%和 5.66%，与同行业可比公司平均值相近。

3、研发费用分析

(1) 研发费用构成分析

报告期内，公司研发费用项目具体构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	3,241.54	56.70%	3,001.95	50.61%	2,610.37	52.21%
直接投入	1,501.95	26.27%	1,724.18	29.07%	1,079.54	21.59%
折旧及摊销	833.19	14.57%	925.08	15.60%	1,080.67	21.61%
股份支付	34.50	0.60%	75.33	1.27%	117.06	2.34%
其他	106.25	1.86%	205.29	3.46%	112.38	2.25%
合计	5,717.43	100.00%	5,931.82	100.00%	5,000.02	100.00%

报告期内，公司研发费用分别为 5,000.02 万元、5,931.82 万元和 5,717.43 万元，占营业收入的比例分别为 11.95%、9.78%和 8.47%。报告期内，公司研发费用主要由职工薪酬、直接投入、折旧及摊销等构成，不存在研发费用资本化情形。

报告期内，公司研发人员的薪酬分别为 2,610.37 万元、3,001.95 万元和 3,241.54 万元，逐年增长，主要系研发人员数量及平均工资增加所致。

公司直接投入主要为流片费用。报告期内，受研发项目结构及管理提升的影响，公司直接投入存在一定波动，其中，2024 年直接投入较大，主要系 2024 年，公司面向 5G 的高频大带宽声表面滤波器研发与产业化和工业声表面滤波器开发

等研发项目的直接投入较大，领用晶片等原材料相对较多。

折旧及摊销主要为研发设备的折旧和研发场所的折旧。报告期内，折旧及摊销分别为 1,080.67 万元、925.08 万元和 833.19 万元，逐年减少，主要系公司部分研发用设备折旧完毕或处置所致。

(2) 研发费用按研发项目归集情况

报告期内，公司研发项目投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目进度	研发投入金额		
			2025 年度	2024 年度	2023 年度
1	面向 5G 的高频大带宽声表面滤波器研发与产业化	已完结	1,442.26	1,702.25	1,085.09
2	工业声表滤波器开发	进行中	1,283.11	1,932.94	2,153.66
3	工业声表滤波器二代开发	进行中	725.66	-	-
4	TF-SAW 滤波器开发	进行中	653.78	519.66	437.86
5	产品小型化与频段拓展	进行中	536.51	-	-
6	二代 WLP 手机滤波器开发	进行中	241.22	704.31	114.02
7	产品高性能与高可靠性迭代	进行中	537.72	-	-
8	高频大带宽射频滤波器关键材料与器件技术	已完结	197.08	461.09	568.64
9	模组用滤波器芯片开发及射频前端模组开发	进行中	100.08	611.57	640.75
合计			5,717.43	5,931.82	5,000.02

(3) 研发费用同行业对比分析

公司研发费用占营业收入比例与同行业可比公司对比情况如下：

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
卓胜微	23.26%	22.22%	14.37%
唯捷创芯	17.94%	20.83%	15.18%
慧智微	27.77%	47.41%	58.84%
昂瑞微	15.98%	14.94%	23.38%
飞骧科技	未披露	7.50%	11.31%
锐石创芯	24.38%	32.41%	41.97%
麦捷科技	4.49%	4.78%	4.74%

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
平均值	18.97%	21.44%	24.26%
好达电子	8.47%	9.78%	11.95%

报告期内，公司研发费用占营业收入的比例高于麦捷科技，与飞骧科技相近，低于行业平均值，主要系①公司采用 IDM 模式，内部流片，工艺与设计深度协同，研发效率较高，可大幅减少重复改版流片，同时产品的核心工艺数据、良率数据内部沉淀，也降低后续流片试错成本，与主要采用 Fabless 轻资产运营模式的同行业可比公司外部流片相比，流片的直接投入的金额相对较低；②报告期内，公司营业收入增速较快。

4、财务费用分析

(1) 财务费用构成分析

报告期内，公司财务费用的具体构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息支出	4,879.28	5,675.97	4,938.29
减：利息收入	4.40	4.92	5.27
汇兑损益	26.30	-561.28	701.08
手续费支出	80.84	75.06	36.20
合计	4,982.03	5,184.84	5,670.30

报告期内，公司财务费用分别为 5,670.30 万元、5,184.84 万元和 4,982.03 万元，占营业收入的比例分别为 13.55%、8.55%和 7.38%，占比较高。报告期内，公司财务费用主要为利息支出。报告期内，公司利息支出分别为 4,938.29 万元、5,675.97 万元和 4,879.28 万元，存在一定波动，其中，2025 年利息支出下降，主要系长短期借款的利率及规模下降所致。

(2) 财务费用同行业对比分析

公司财务费用占营业收入比例与同行业可比公司对比情况如下：

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
卓胜微	1.40%	0.48%	-1.00%

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
唯捷创芯	-1.99%	-3.46%	-2.52%
慧智微	0.23%	-3.79%	-1.41%
昂瑞微	0.24%	0.43%	-0.22%
飞骧科技	未披露	1.12%	1.35%
锐石创芯	2.45%	3.91%	1.29%
麦捷科技	-0.35%	-1.38%	-0.87%
平均值	0.33%	-0.38%	-0.48%
好达电子	7.38%	8.55%	13.55%

报告期内，公司财务费用率分别为 13.55%、8.55%和 7.38%，大幅高于行业平均值，主要系①与主要采用 Fabless 轻资产运营模式的同行业可比公司相比，公司采用 IDM 模式，资本性支出巨大，受限于融资渠道单一，公司主要通过银行信贷、融资租赁等形式进行融资，长短期借款的规模较大，利息支出相应较高；②公司为非上市公司，通过直接融资方式进行融资的规模有限，唯捷创芯、慧智微、麦捷科技和卓胜微均在 2025 年前上市或再融资，完成了大额募资，账面货币资金充足，财务费用率较低或为负。

（五）其他利润表项目分析

1、税金及附加

报告期内，公司税金及附加的明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
土地使用税	14.36	14.36	14.36
房产税	62.32	62.32	62.27
印花税	46.17	33.83	25.62
城建税及教育费附加	-	-	0.58
其他	0.53	0.41	0.36
合计	123.39	110.92	103.20

报告期内，公司税金及附加分别为 103.20 万元、110.92 万元和 123.39 万元。公司税金及附加主要由土地使用税、房产税、印花税等组成。报告期内，公司土地使用税和房产税保持稳定，印花税随公司经营规模的扩大而逐年增长。

2、其他收益

报告期内，公司其他收益明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
政府补助	1,607.30	1,030.80	1,364.40
增值税加计抵减	190.30	240.48	156.76
个税手续费返还	18.73	7.93	7.71
生育津贴	6.41	52.94	5.21
合计	1,822.74	1,332.15	1,534.07

报告期内，公司其他收益分别为 1,534.07 万元、1,332.15 万元和 1,822.74 万元。公司其他收益主要为收到的政府补助，增值税加计抵减等，其中，增值税加计抵减系根据财政部、税务总局联合发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》，按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减的应纳增值税税额。报告期内，公司政府补助均计入当期非经常性损益。报告期内，公司其他收益存在一定波动，主要受政府补助变化的影响。

3、投资收益

报告期内，公司投资收益明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-501.40	-234.10	-24.58
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	392.62
合计	-501.40	-234.10	368.04

报告期各期，公司投资收益分别为 368.04 万元、-234.10 万元和-501.40 万元。公司投资收益主要为权益法核算的长期股权投资收益和处置长期股权投资产生的投资收益，其中，权益法核算的投资收益系 2023 年公司投资苏州达波新材料科技有限公司，按权益法核算的投资收益；处置的投资收益系 2023 年，公司出售子公司无锡市思福易半导体设备有限公司产生的投资收益。

4、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收票据坏账损失	-93.58	-79.77	15.35
应收款项融资坏账损失	-48.30	-	-
应收账款坏账损失	331.50	-164.71	-470.07
其他应收款坏账损失	17.98	-91.14	-40.78
合计	207.60	-335.62	-495.50

报告期内，公司信用减值损失金额分别为-495.50 万元、-335.62 万元和 207.60 万元，主要为应收账款坏账损失。2025 年，公司信用减值损失由负转正，主要系 2025 年，公司回款情况良好，应收账款余额下降，计提的坏账准备相应减少所致。

5、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
存货跌价损失	-3,374.42	-5,358.05	-9,433.49
固定资产减值损失	-205.57	-183.36	-311.28
合计	-3,579.99	-5,541.41	-9,744.78

报告期内，公司资产减值损失金额分别为-9,744.78 万元、-5,541.41 万元和 -3,579.99 万元，主要为存货跌价损失。

6、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-1.90	82.20	1,073.88
其中：固定资产	-1.90	75.46	1,073.88

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
使用权资产	-	6.75	-
合计	-1.90	82.20	1,073.88

报告期内，公司资产处置收益分别为 1,073.88 万元、82.20 万元和-1.90 万元，主要为固定资产处置收益。报告期内，为进一步优化工艺或提升产能，公司购置了部分新设备置换老设备，并对部分置换设备进行了处置，因部分老设备账面价值较低且具有一定的市场价值，产生了部分处置收益。

7、营业外收入

报告期内，公司营业外收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
政府补助	-	20.00	-
长期股权投资初始投资利得	-	-	44.10
其他	11.17	3.33	15.06
合计	11.17	23.33	59.16

报告期内，公司营业外收入分别为 59.16 万元、23.33 万元和 11.17 万元，金额较小。

8、营业外支出

报告期内，公司营业外支出构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
赔偿金、违约金	61.93	16.18	-
资产报废、毁损损失	13.50	1.24	3.58
公益性捐赠支出	13.00	3.00	68.00
税收滞纳金	0.01	10.97	136.49
罚款支出	-	7.83	41.00
预计未决诉讼损失	-	-	70.00
其他	2.00	13.03	35.00
合计	90.45	52.25	354.08

报告期内，公司营业外支出分别为 354.08 万元、52.25 万元和 90.45 万元，主要为公益性捐赠支出、税收滞纳金、赔偿金及违约金等。

（六）政府补助

报告期内，公司政府补助分别在其他收益、营业外收入和财务费用科目归集核算，其中，其他收益为与公司日常活动相关的政府补助；营业外收入为非与公司日常活动相关的政府补助；财务费用为政府贴息补助，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
其他收益	1,607.30	1,030.80	1,364.40
营业外收入	-	20.00	-
财务费用	20.00	-	256.20
合计	1,627.30	1,050.80	1,620.60

报告期内，公司政府补助金额分别为 1,620.60 万元、1,050.80 万元和 1,627.30 万元，占营业收入的比例分别为 3.87%、1.73%和 2.41%。

报告期内，公司政府补助区分与收益相关和与资产相关的明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
与收益相关	561.27	185.57	837.75
与资产相关	1,066.03	865.22	782.85
合计	1,627.30	1,050.80	1,620.60

报告期内，公司与收益相关的政府补助主要为技术研发补助、借款贴息、项目补助等，明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
2022 年度太湖湾科创带政策补助	-	-	300.50
2022 市级太湖人才创新领军人才项目资助	-	-	35.00
2023 年度太湖湾科创带政策补助	102.00	-	-
高品质因素大带宽器件设计与制备技术补助	-	67.05	-
国家进口贴息	-	-	156.20

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
职工岗位技能提升培训补贴	-	-	81.35
无锡市工业转型升级资金（第二批）扶持项目资金	-	-	90.00
面向 5G 的高频大带宽声表面波滤波器研发及产业化-省拨款-科技成果转化专项	200.00	-	-
单晶压电薄膜及高频声学滤波器	169.00	-	-
其他政府补助	90.27	118.52	174.70
合计	561.27	185.57	837.75

报告期内，公司与资产相关，计入递延收益的政府补助主要与科研项目相关，其在报告期内摊销影响损益的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
新一代移动通信终端用声表面波滤波器/双工器	164.01	164.01	164.01
高性能声表面波滤波器产业化集成与示范之专项经费	5.90	5.90	5.90
片式温度补偿声表面波滤波器（TC SAW）研发及产业化	47.16	47.16	47.16
5G 用 BAW 滤波器及射频模块 SAW 滤波器研发试制线	24.62	24.77	56.54
经开区产业政策扶持资金-技术改造（智能化）	19.60	19.60	19.61
信息技术产业投资资助（5G）江苏无锡经济开发区财政局 年扩产 3 亿只声表面波滤波器建设项目（新一代信息产业发展专项资金项目）	55.19	55.32	55.32
高技术产业企业和工业“战略性新兴产业”江苏无锡经济开发区经济发展局（智能化升级）	10.57	10.57	10.57
智能化改造和数字化转型-贷款贴息和设备补助项目	38.70	38.73	38.73
省级战略性新兴产业发展专项资金-5G 用 BAW 滤波器及射频 SAW 滤波器研发试制线项目	169.91	169.91	169.91
涉密项目 C	347.45	231.68	205.12
面向 5G 的高频大带宽声表面波滤波器研发及产业化-省成果	55.38	31.44	-
2023 年度数字经济和数字化转型发展资金 5G 移动终端温度补偿声表面波滤波器研发及产业化	35.65	35.65	-
面向 5G 的高频大带宽声表面波滤波器研发及产业化-市成果	13.07	8.05	0.64
2022 年太湖湾科创带政策兑现-培优工程-支持企业做大做强	22.43	22.43	9.35
2024 年江苏省制造强省建设专项资金（第二批）	45.82	-	-
5G 移动终端用 WLP 小型化射频滤波器研发及产业化	10.56	-	-
合计	1,066.03	865.22	782.85

（七）纳税情况

1、所得税费用

报告期内，公司所得税费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
本期所得税费用	-	-	-
递延所得税费用	-540.44	-1,856.35	-4,191.66
合计	-540.44	-1,856.35	-4,191.66

报告期各期，公司所得税费用分别为-4,191.66 万元、-1,856.35 万元和-540.44 万元。报告期内，公司所得税费用主要为递延所得税费用，主要由可抵扣亏损、资产减值准备、股权激励、政府补助等事项引起的可抵扣暂时性差异产生。

2、纳税情况

近三年，公司主要税种的缴纳情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度	
增值税	期初未交	-249.44	-61.87	-1,481.20
	本期应交	2,176.32	1,755.89	2,334.98
	本期已交	2,437.21	1,943.46	915.66
	期末未交	-510.33	-249.44	-61.87
企业所得税	期初未交	-	-	2.77
	本期应交	-	-	0.01
	本期已交	-	-	2.78
	期末未交	-	-	-

（八）尚未盈利及存在累计未弥补亏损的情况

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润分别为-21,611.87 万元、-7,975.47 万元和-335.42 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-23,085.86 万元、-7,705.28 万元和-840.65 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-45,818.52 万元。

1、原因分析

(1) 公司营业收入规模和毛利水平低于国际头部厂商

全球声表面波滤波器市场由日美企业主导，国外前五大声表面波滤波器厂商村田、高通（RF360）、太阳诱电、思佳讯和威讯等占据主要市场份额。国内滤波器市场主要依靠国外进口，国产化率低。与国际厂商相比，包括发行人在内的国内声表面波滤波器企业的业务规模和毛利水平总体上仍然较低，规模效应和议价能力有待进一步释放。

(2) 公司采用 IDM 运营模式，新产线投入较大，折旧和利息费用较大，产生规模效益需要一定时间

报告期内，公司固定资产折旧和财务费用占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
固定资产折旧费用	12,396.66	12,309.57	12,013.19
利息费用	4,879.28	5,675.97	4,938.29
合计	17,275.94	17,985.54	16,951.49
营业收入	67,465.69	60,655.03	41,851.74
固定资产折旧和利息费用占营业收入比例	25.61%	29.65%	40.50%

为把握射频芯片国产替代的整体趋势，公司在 2020 年至 2021 年积极扩张产能，但受制于融资渠道有限，公司主要通过借款等方式筹集产能扩张所需资金。公司因产能扩张使得固定资产规模、借款规模均大幅增长，从而导致短期内折旧成本、利息支出较高，且设备投入后公司处于产能产量爬坡及良率提升阶段，产能利用率较低，导致产品单位成本较高，对公司的盈利水平产生较大影响。

报告期内，随着新产线产能利用率和良率的提升，公司经营规模逐年扩大，公司息税折旧摊销前利润由负转正，分别为-8,523.74 万元、8,695.68 万元和 17,188.79 万元，盈利质量逐年上升，规模效应开始逐步显现。

（3）所处行业具有技术含量高、研发投入大、研发周期长的行业特点

公司所属行业是典型的资本密集型和技术密集型行业，具有技术壁垒高、研发周期长、研发投入大等特点。为保证市场竞争力和技术的先进性，公司必须在技术、产品研发领域持续投入大量的研发资金，以实现产品线的迭代升级与拓展。公司一直坚持自主研发，报告期内，公司研发费用分别为 5,000.02 万元、5,931.82 万元和 5,717.43 万元，占营业收入的比例分别为 11.95%、9.78%和 8.47%。

（4）存货跌价损失金额较大

为把握射频芯片国产替代的整体趋势，公司积极扩充产能。2021 年，公司新产线投产，产能快速扩张，产量相应大幅增加。2022 年，受下游市场需求下滑等因素的影响，公司产量与市场需求出现错配，导致 2022 年末库存商品的余额较大。由于上述存货在报告期内销售不及预期，库龄较长，公司相应计提了较大金额的存货跌价准备。报告期内，公司存货跌价损失分别为-9,433.49 万元、-5,358.05 万元和 -3,374.42 万元。

（5）确认了较多股份支付

报告期内，因实施股权激励及持股平台内部股权转让，公司确认了较多的股份支付，分别为 1,225.64 万元、1,559.32 万元和 892.98 万元。

2、影响分析

报告期内，公司主要通过股权融资、银行贷款的方式获得现金流，用来满足持续增加的研发投入和其他日常经营支出。截至 2025 年 12 月 31 日，公司账面货币资金余额为 10,334.28 万元，未来将根据资金需求增加授信及借款。公司尚未盈利及存在累计未弥补亏损未对公司现金流、业务拓展、人才吸引和核心团队稳定性、研发投入和生产经营可持续性产生重大不利影响。

（1）对公司现金流的影响

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 8,951.17 万元、24,579.21 万元和 33,054.07 万元，为公司带来可持续的经营性现金流入。同时，公司已通过长期借款等方式，较好地保障了公司未来的资金需求。报告期内，公

司偿债能力良好,不存在逾期未偿还、无法继续履行重大借款合同中的有关条款、无法获得研发所需资金等严重影响公司持续经营能力的情况。

(2) 对业务拓展的影响

报告期内,公司主营业务收入持续增长。公司行业地位、客户认可度不断提升,预计未来公司收入规模仍将保持增长趋势。报告期内,公司业务拓展状况良好,公司尚未盈利并存在累计未弥补亏损不会对公司业务拓展产生重大不利影响。

(3) 对人才吸引和核心团队稳定性的影响

公司核心团队是国内最早一批从事声表面波射频滤波器研发、设计、生产和销售团队之一,在射频芯片领域深耕多年,具备一流的战略运筹、市场开拓、技术研发和运营管理能力。公司核心管理团队具有丰富的声表面波射频滤波器行业经验,在客户开拓、技术研发、工厂建设、生产管理、工艺提升、质量管理等方面具有深厚的产业运营经验。同时,公司高度重视人才培养和研发团队的建设,形成了以高端引进、持续培养和文化遗产为核心的人才团队建设体系。经过多年的发展,公司已凝聚了一支拥有丰富行业经验和研发管理经验的人才队伍。截至2025年12月31日,公司共有在职员工599人,其中研发人员合计90人,占比15.03%。报告期内,公司研发、技术人员稳定,公司尚未盈利并存在累计未弥补亏损未对公司人才吸引和团队稳定产生重大不利影响。

(4) 对研发投入的影响

声表面波射频滤波器行业为技术密集型行业,持续大额研发投入是该领域内企业保持竞争力的必要手段,属于公司的战略性投入,公司每年投入大量资金进行射频滤波器相关产品、技术、工艺的迭代更新和升级。报告期内,公司研发费用分别为5,000.02万元、5,931.82万元和5,717.43万元,研发投入金额较大,为公司业务发展持续保持领先优势打下了坚实的基础,并已逐步实现将研发投入转化为经营成果。未来公司将结合技术发展趋势与市场需求,科学制订研发计划,强化研发过程管理,不断提升公司自主创新能力,促进研发成果的转化和有效利用。

（5）对生产经营可持续性的影响

报告期各期，发行人声表面波射频滤波器产销量不断上升，随着发行人 TC-SAW 产品不断得到下游客户认可，产品结构不断改善，收入规模将持续增长，盈利能力进一步释放，发行人生产经营的可持续性较强。

综上所述，最近一期末存在累计未弥补亏损不会对公司生产经营可持续性产生重大不利影响。

3、风险因素

声表面波射频滤波器行业是资本与技术密集型行业，具有技术壁垒高、研发周期长、研发投入大、资本支出大等特点，且新产线投产后会在短期内面临较高的折旧负担，而销售收入增长具有一定的滞后性，对公司的盈利水平产生一定影响。若未来宏观经济发生剧烈波动、公司未能按计划实现生产和销售规模的扩张或产品的总体市场需求大幅度下滑，公司的营业收入可能无法达到预计规模，无法充分发挥其经营的规模效应，或者市场竞争继续加剧导致公司的毛利空间被进一步压缩，盈利水平可能无法完全覆盖公司研发投入等各项支出，存在未来一定期间可能无法盈利或无法进行利润分配的风险，并有可能造成公司现金流紧张，对公司业务拓展、人才引进、团队稳定、研发投入等方面造成负面影响。

十、资产质量分析

报告期内，公司资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	54,687.87	34.68%	44,075.14	28.66%	42,655.31	26.91%
非流动资产	102,983.11	65.32%	109,702.44	71.34%	115,853.11	73.09%
资产总计	157,670.98	100.00%	153,777.59	100.00%	158,508.42	100.00%

公司采用 IDM 模式组织生产，设计与制造一体化，拥有从芯片设计、晶圆制造到封装测试的全产业链能力。IDM 模式是声表面波滤波器厂商采取的主流生产模式，目前村田、高通（RF360）、太阳诱电、思佳讯和威讯等国外领先的

声表面波滤波器生产厂商均采用 IDM 的生产模式。

报告期各期末，公司非流动资产分别为 115,853.11 万元、109,702.44 万元和 102,983.11 万元，占总资产的比重分别为 73.09%、71.34%和 65.32%。报告期内，公司非流动资产占资产总额的比例均在 65%以上，是公司资产的主要构成部分，主要系公司采用 IDM 模式，需要高投入自建晶圆、封测等产线，资本性支出大，形成的固定资产规模较大。报告期内，公司固定资产原值总体保持稳定，维持在 14-15 亿元，其中，机器设备原值在 13 亿元左右，各期固定资产折旧较大。报告期内，随着固定资产累计折旧的增加，公司非流动资产的规模逐年下降，占总资产的比例逐年降低。

报告期各期末，公司流动资产分别为 42,655.31 万元、44,075.14 万元和 54,687.87 万元，占总资产的比重分别为 26.91%、28.66%和 34.68%。公司流动资产主要由存货、应收账款和货币资金组成。报告期内，随着公司经营规模的扩大和经营活动产生的现金流量净额的增加，公司存货、货币资金等资产总体呈上升趋势，流动资产规模逐年增加，同时受非流动资产规模下降的影响，占总资产的比例逐年上升。

（一）流动资产构成及变化分析

报告期内，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	10,334.28	18.90%	1,009.57	2.29%	2,156.72	5.06%
应收票据	4,537.35	8.30%	2,679.17	6.08%	1,294.04	3.03%
应收账款	13,061.02	23.88%	19,824.01	44.98%	16,773.62	39.32%
应收款项融资	1,929.55	3.53%	778.29	1.77%	124.42	0.29%
预付款项	203.70	0.37%	296.67	0.67%	280.02	0.66%
其他应收款	741.75	1.36%	1,603.31	3.64%	974.00	2.28%
存货	23,076.85	42.20%	17,567.61	39.86%	20,990.62	49.21%
其他流动资产	803.35	1.47%	316.51	0.72%	61.87	0.15%
流动资产	54,687.87	100.00%	44,075.14	100.00%	42,655.31	100.00%

报告期各期末，公司流动资产分别为 42,655.31 万元、44,075.14 万元和 54,687.87 万元，主要由存货、应收账款及货币资金等构成。

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
库存现金	4.85	1.43	2.42
银行存款	10,047.26	995.05	2,104.30
其他货币资金	282.18	13.09	50.00
合计	10,334.28	1,009.57	2,156.72

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 2,156.72 万元、1,009.57 万元和 10,334.28 万元，占各期末流动资产的比重分别为 5.06%、2.29%和 18.90%。公司货币资金余额主要为银行存款和其他货币资金，其中，其他货币资金主要为票据保证金等。

报告期内，受经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额变化的影响，公司货币资金存在一定波动。2024 年末，公司货币资金较 2023 年末减少 1,147.15 万元，降幅为 53.19%，主要系 2024 年，公司偿还借款较多，筹资活动产生的现金流量净额为负，抵减了经营活动产生的现金流量净额增加的金额所致；2025 年末，公司货币资金较 2024 年末增加 9,324.71 万元，增幅为 923.63%，主要系 2025 年，公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致。

2、应收票据、应收款项融资

报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资的情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
一、账面余额			
应收票据	4,779.37	2,827.61	1,362.70
其中：银行承兑汇票	3,619.30	1,706.27	1,002.64
商业承兑汇票	1,160.07	1,121.34	360.06

项目	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
应收款项融资	1,977.85	778.29	124.42
其中：银行承兑汇票	1,011.85	778.29	124.42
数字化债权凭证	966.01	-	-
合计	6,757.22	3,605.90	1,487.12
二、坏账准备			
应收票据	242.02	148.43	68.66
其中：银行承兑汇票	180.97	85.31	50.13
商业承兑汇票	61.05	63.12	18.53
应收款项融资	48.30	-	-
其中：银行承兑汇票	-	-	-
数字化债权凭证	48.30	-	-
合计	290.32	148.43	68.66
三、账面价值			
应收票据	4,537.35	2,679.17	1,294.04
其中：银行承兑汇票	3,438.34	1,620.96	952.51
商业承兑汇票	1,099.02	1,058.22	341.53
应收款项融资	1,929.55	778.29	124.42
其中：银行承兑汇票	1,011.85	778.29	124.42
数字化债权凭证	917.71	-	-
合计	6,466.91	3,457.46	1,418.46

报告期内，公司收到的银行承兑汇票、商业承兑汇票在应收票据和应收款项融资科目核算，其中，信用等级较高的银行承兑汇票及数字化债权凭证在应收款项融资科目核算，剩余的银行承兑汇票和商业承兑汇票在应收票据科目核算。报告期各期末，公司应收票据的账面价值分别为 1,294.04 万元、2,679.17 万元和 4,537.35 万元，占流动资产的比重分别为 3.03%、6.08%和 8.30%；应收款项融资的账面价值分别为 124.42 万元、778.29 万元和 1,929.55 万元，占流动资产的比重分别为 0.29%、1.77%和 3.53%。

报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资账面价值之和分别为 1,418.46 万元、3,457.46 万元和 6,466.91 万元，逐年增长，主要系随公司经营规模的增长，部分客户使用承兑汇票支付货款，导致公司收到的承兑票据相应增加所致。

报告期内，公司应收票据均为按账龄组合计提坏账准备，计提的比例与应收账款计提的比例相同；应收款项融资为信用等级较高的银行承兑汇票、数字化债权凭证，其中银行承兑汇票未计提坏账准备，数字化债权凭证按账龄组合计提坏账准备，计提的比例与应收账款计提的比例相同。

报告期各期末，公司应收票据坏账准备的计提情况如下：

单位：万元

账龄	2025年12月31日		
	余额	占比	坏账准备
1年以内	4,718.40	98.72%	235.92
1至2年	60.97	1.28%	6.10
合计	4,779.37	100.00%	242.02
账龄	2024年12月31日		
	余额	占比	坏账准备
1年以内	2,686.52	95.01%	134.33
1至2年	141.09	4.99%	14.11
合计	2,827.61	100.00%	148.43
账龄	2023年12月31日		
	余额	占比	坏账准备
1年以内	1,352.21	99.23%	67.61
1至2年	10.49	0.77%	1.05
合计	1,362.70	100.00%	68.66

报告期各期末，公司应收款项融资数字化债权凭证坏账准备的计提情况如下：

单位：万元

账龄	2025年12月31日		
	余额	占比	坏账准备
1年以内	966.01	100.00%	48.30
合计	966.01	100.00%	48.30

报告期各期末，公司应收票据、应收款项融资质押情况如下表所示：

单位：万元

应收票据	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
应收票据	-	84.25	-

应收票据	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
应收款项融资	-	7.20	-
合计	-	91.45	-

3、应收账款

报告期各期末，公司应收账款余额和坏账准备情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
账面余额	13,797.28	20,891.77	17,676.67
坏账准备	736.26	1,067.76	903.05
账面价值	13,061.02	19,824.01	16,773.62

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 16,773.62 万元、19,824.01 万元和 13,061.02 万元，占流动资产的比重分别为 39.32%、44.98%和 23.88%。

(1) 应收账款余额分析

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 17,676.67 万元、20,891.77 万元和 13,797.28 万元。2024 年末，公司应收账款余额较 2023 年末增长 3,215.10 万元，增幅 18.19%，主要系 2024 年，公司营业收入同比增长 44.93%，应收账款余额相应增长所致。2025 年末，公司应收账款余额较 2024 年末减少 7,094.49 万元，降幅为 33.96%，未随营业收入的增长而相应增长，主要系 2025 年，公司加强应收账款管理及客户结构优化，客户回款情况良好所致。

(2) 坏账准备分析

报告期各期末，公司应收账款按坏账计提方法分类列示如下：

单位：万元

类别	2025年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,797.28	100.00%	736.26	5.34%
合计	13,797.28	100.00%	736.26	5.34%

类别	2024年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,891.77	100.00%	1,067.76	5.11%
合计	20,891.77	100.00%	1,067.76	5.11%
类别	2023年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,676.67	100.00%	903.05	5.11%
合计	17,676.67	100.00%	903.05	5.11%

报告期内，公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账龄分布情况如下表所示：

单位：万元

账龄	2025年12月31日		
	余额	占比	坏账准备
1年以内	13,740.74	99.59%	687.04
1至2年	6.66	0.05%	0.67
2至3年	1.90	0.01%	0.57
3年以上	47.99	0.35%	47.99
合计	13,797.28	100.00%	736.26
账龄	2024年12月31日		
	余额	占比	坏账准备
1年以内	20,806.36	99.59%	1,040.32
1至2年	32.01	0.15%	3.20
2至3年	41.67	0.20%	12.50
3年以上	11.74	0.06%	11.74
合计	20,891.77	100.00%	1,067.76
账龄	2023年12月31日		
	余额	占比	坏账准备
1年以内	17,538.07	99.22%	876.90

1至2年	124.66	0.71%	12.47
2至3年	0.37	0.00%	0.11
3年以上	13.57	0.08%	13.57
合计	17,676.67	100.00%	903.05

报告期内，公司根据应收账款账龄分布特点构建应收账款组合，并参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济情况的预测确定应收账款组合坏账准备的计提比例，符合公司的业务特点。

公司与同行业可比公司应收账款坏账准备计提比例对比情况如下：

公司名称	0-3个月	3-12个月	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
卓胜微	5.00%	5.00%	20.00%	60.00%	100.00%	100.00%	100.00%
唯捷创芯	0.00%	5.00%	10.00%	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%
慧智微	5.00%	5.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%
昂瑞微	0.00%	5.00%	10.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%
飞骧科技	2.00%	5.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%
锐石创芯	0.00%	5.00%	10.00%	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%
麦捷科技	3.00%	3.00%	10.00%	30.00%	100.00%	100.00%	100.00%
好达电子	5.00%	5.00%	10.00%	30.00%	100.00%	100.00%	100.00%

注：同行业可比公司数据来源于公开披露文件

对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，其账龄主要集中在1年以内，公司对于此类应收账款按照5%计提坏账准备，该比例与同行业可比公司平均水平相类似。

(3) 应收账款余额前五名客户情况

报告期各期末，公司应收账款余额前五名情况具体如下：

单位：万元

时间	客户	金额	占应收账款期末余额比例
2025年 12月31日	华勤技术股份有限公司	3,038.15	22.02%
	深圳市华凯科技开发有限公司	2,792.39	20.24%
	龙旗电子（惠州）有限公司	1,961.75	14.22%
	深圳市普荣实业有限公司	1,304.78	9.46%

时间	客户	金额	占应收账款期末余额比例
	A 公司	949.07	6.88%
	合计	10,046.14	72.82%
2024 年 12 月 31 日	龙旗电子（惠州）有限公司	7,019.52	33.60%
	华勤技术股份有限公司	2,461.47	11.78%
	深圳市华凯科技开发有限公司	2,007.52	9.61%
	深圳市普荣实业有限公司	1,546.03	7.40%
	B 公司	1,065.12	5.10%
	合计	14,099.66	67.49%
2023 年 12 月 31 日	深圳市普荣实业有限公司	3,319.98	18.78%
	龙旗电子（惠州）有限公司	3,192.38	18.06%
	A 公司	3,059.50	17.31%
	深圳市华凯科技开发有限公司	2,469.33	13.97%
	华勤技术股份有限公司	2,337.71	13.22%
	合计	14,378.91	81.34%

注：1、华勤技术股份有限公司指东莞华贝电子科技有限公司、上海勤允电子科技有限公司、南昌勤胜电子科技有限公司及南昌华勤电子科技有限公司；2、深圳市普荣实业有限公司指深圳市普荣实业有限公司及 HongKong Evergrow Industrial Co.,Ltd.。

报告期各期末，公司前五大应收账款余额合计分别为 14,378.91 万元、14,099.66 万元和 10,046.14 万元，分别占各期末应收账款余额的比例为 81.34%、67.49%和 72.82%。截至报告期末，应收账款前五大客户均与公司保持良好的合作关系，形成的应收账款账龄主要在 1 年以内，发生坏账的风险较低。

（4）应收账款期后回款情况

报告期各期末，公司应收账款余额期后回款情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款余额	13,797.28	20,891.77	17,676.67
期后回款金额	13,389.03	20,834.44	17,327.77
回款比例	97.04%	99.73%	98.03%

截至 2026 年 4 月末，报告期各期末，公司应收账款期后回款比例分别为 98.03%、99.73%和 97.04%，回款情况良好。

4、预付款项

报告期各期末，公司预付款项分别为 280.02 万元、296.67 万元和 203.70 万元，占公司流动资产的比重分别为 0.66%、0.67%和 0.37%，金额和占比较小，主要为预付的材料款、电费等。

5、其他应收款

报告期内，公司其他应收款的余额及坏账准备的情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
账面余额	869.80	1,749.35	1,028.90
坏账准备	128.05	146.03	54.90
账面价值	741.75	1,603.31	974.00

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 974.00 万元、1,603.31 万元和 741.75 万元，占公司流动资产的比重分别为 2.28%、3.64%和 1.36%。公司其他应收款余额主要为融资租赁押金保证金，报告期内，受融资租赁借款余额变化的影响，存在一定波动。

报告期内，公司其他应收款按账龄组合计提坏账准备的情况如下：

单位：万元

账龄	2025 年 12 月 31 日		
	余额	占比	坏账准备
1 年以内	451.33	51.89%	22.57
1 至 2 年	150.53	17.31%	15.05
2 至 3 年	253.59	29.15%	76.08
3 年以上	14.35	1.65%	14.35
合计	869.80	100.00%	128.05
账龄	2024 年 12 月 31 日		
	余额	占比	坏账准备
1 年以内	726.43	41.53%	36.32
1 至 2 年	1,003.59	57.37%	100.36
2 至 3 年	14.25	0.81%	4.28
3 年以上	5.08	0.29%	5.08

合计	1,749.35	100.00%	146.03
账龄	2023年12月31日		
	余额	占比	坏账准备
1年以内	1,009.57	98.12%	50.48
1至2年	14.25	1.39%	1.43
2至3年	2.98	0.29%	0.89
3年以上	2.10	0.20%	2.10
合计	1,028.90	100.00%	54.90

2023年末,公司其他应收款余额的账龄主要集中在1年内。2024年末和2025年末,公司1年以上的其他应收账款余额占比较大,主要系公司融资租赁借款为长期借款,对应保证金的期限相对较长。

6、存货

报告期内,公司的存货余额和跌价准备的情况如下:

单位:万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
账面余额	41,079.72	36,616.50	40,454.74
跌价准备	18,002.86	19,048.89	19,464.12
账面价值	23,076.85	17,567.61	20,990.62

报告期各期末,公司存货账面价值分别为20,990.62万元、17,567.61万元和23,076.85万元,占流动资产的比重分别为49.21%、39.86%和42.20%,是公司流动资产的重要组成部分。

(1) 存货余额分析

报告期内,公司存货余额的构成情况如下:

单位:万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	5,992.53	14.59%	5,776.20	15.77%	7,029.16	17.38%
在产品	4,966.70	12.09%	4,785.06	13.07%	4,651.53	11.50%
库存商品	29,904.68	72.80%	25,588.86	69.88%	28,454.73	70.34%

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
发出商品	215.81	0.53%	466.39	1.27%	319.33	0.79%
合计	41,079.72	100.00%	36,616.50	100.00%	40,454.74	100.00%

公司采用 IDM 生产模式，芯片制造、封装测试工序均自主完成。公司存货由原材料、在产品、库存商品和少量发出商品组成。报告期各期末，公司存货余额分别为 40,454.74 万元、36,616.50 万元和 41,079.72 万元，金额和结构总体保持稳定，具体情况如下：

公司原材料主要包括晶片、基板、光刻胶和合金线等。报告期内，公司原材料余额分别为 7,029.16 万元、5,776.20 万元和 5,992.53 万元，占存货余额的比例分别为 17.38%、15.77%和 14.59%。报告期内，公司原材料余额占存货余额的比例逐年下降，主要系（1）公司加强原材料的管理和调配，随着公司产能利用率的提高，原材料的周转效率上升；（2）公司优化供应商结构，进口海外晶片等原材料的规模下降，原材料的备货周期缩短。

报告期内，公司在产品的余额分别为 4,651.53 万元、4,785.06 万元和 4,966.70 万元，占存货余额的比例分别为 11.50%、13.07%和 12.09%，总体保持稳定，随公司经营规模的扩大，逐年小幅增长。

公司库存商品主要为已完成前道晶圆制造和后道封装测试的滤波器芯片。报告期内，公司库存商品的余额分别为 28,454.73 万元、25,588.86 万元和 29,904.68 万元，占存货余额的比例分别为 70.34%、69.88%和 72.80%，总体保持稳定。

（2）存货跌价准备情况

报告期内，公司存货跌价准备情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	5,992.53	2,140.69	3,851.83
在产品	4,966.70	466.26	4,500.43
库存商品	29,904.68	15,385.05	14,519.63

发出商品	215.81	10.86	204.95
合计	41,079.72	18,002.86	23,076.85
项目	2024年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	5,776.20	2,010.01	3,766.18
在产品	4,785.06	385.22	4,399.84
库存商品	25,588.86	16,633.15	8,955.71
发出商品	466.39	20.50	445.88
合计	36,616.50	19,048.89	17,567.61
项目	2023年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	7,029.16	1,849.75	5,179.41
在产品	4,651.53	1,497.20	3,154.32
库存商品	28,454.73	16,047.74	12,406.99
发出商品	319.33	69.43	249.90
合计	40,454.74	19,464.12	20,990.62

公司根据企业会计准则及实际情况，制订了谨慎的存货跌价计提政策。报告期各期末，存货跌价准备余额分别为 19,464.12 万元、19,048.89 万元和 18,002.86 万元，主要由原材料和库存商品的跌价准备构成。

报告期各期末，公司与同行业可比公司的存货跌价准备计提比例对比情况如下：

公司名称	2025 年末	2024 年末	2023 年末
卓胜微	17.95%	17.88%	22.14%
唯捷创芯	16.79%	10.55%	11.35%
慧智微	14.48%	19.48%	13.83%
昂瑞微	21.49%	14.52%	23.83%
飞骧科技	未披露	18.17%	22.52%
锐石创芯	22.77%	27.14%	22.71%
麦捷科技	16.48%	20.72%	19.67%
平均值	18.33%	18.35%	19.44%
好达电子	43.82%	52.02%	48.11%

公司存货跌价准备计提比例高于同行业可比公司的平均值，主要系：为把握射频芯片国产替代的整体趋势，公司抓住历史机遇扩产，2021年，公司新产线投产，产能快速扩张，产量相应大幅增加。2022年，受下游市场需求下滑等因素的影响，公司产量与市场需求出现错配，导致2022年末库存商品的余额较大。由于上述部分存货在报告期内销售不及预期，库龄较长，公司相应计提了较大金额的存货跌价准备，整体拉高了公司存货跌价准备的计提比例。

7、其他流动资产

公司其他流动资产主要为待抵扣税金及上市费用。报告期各期末，公司其他流动资产分别为61.87万元、316.51万元和803.35万元，占公司流动资产的比重分别为0.15%、0.72%和1.47%，金额和占比较小。

（二）非流动资产构成及变化分析

报告期内，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期股权投资	1,953.41	1.90%	2,454.81	2.24%	2,688.90	2.32%
其他权益工具投资	69.77	0.07%	69.77	0.06%	69.77	0.06%
固定资产	86,248.86	83.75%	92,858.44	84.65%	102,852.90	88.78%
在建工程	1,918.82	1.86%	2,338.76	2.13%	409.80	0.35%
使用权资产	95.96	0.09%	41.73	0.04%	174.15	0.15%
无形资产	686.55	0.67%	900.40	0.82%	1,130.28	0.98%
长期待摊费用	1,122.95	1.09%	856.76	0.78%	93.08	0.08%
递延所得税资产	10,722.22	10.41%	10,181.78	9.28%	8,325.44	7.19%
其他非流动资产	164.57	0.16%	-	-	108.79	0.09%
非流动资产合计	102,983.11	100.00%	109,702.44	100.00%	115,853.11	100.00%

报告期各期末，公司非流动资产分别为115,853.11万元、109,702.44万元和102,983.11万元，主要由固定资产、在建工程、递延所得税资产等构成。

1、长期股权投资、其他权益工具投资

报告期内，公司进行产品的上下游布局，分别投资了上游材料厂商苏州达波

新材科技有限公司和下游射频模组厂商上海凡麒微电子有限公司，其中，期末公司对苏州达波新材科技有限公司的持股比例为 26.48%，在长期股权投资科目核算；对上海凡麒微电子有限公司的持股比例为 8.33%，在其他权益工具投资科目核算，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
初始投资			
苏州达波新材科技有限公司	369.10	369.10	369.10
上海凡麒微电子有限公司	69.77	69.77	69.77
账面价值			
苏州达波新材科技有限公司	1,953.41	2,454.81	2,688.90
上海凡麒微电子有限公司	69.77	69.77	69.77

2、固定资产

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 102,852.90 万元、92,858.44 万元和 86,248.86 万元，占公司非流动资产的比重分别为 88.78%、84.65%和 83.75%，是公司非流动资产的主要构成部分。

(1) 固定资产构成及变动情况分析

报告期内，公司固定资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
一、原值			
房屋建筑物	7,950.66	8,031.64	8,031.64
机器设备	136,288.66	130,509.21	128,322.58
运输设备	399.77	377.73	342.85
其他设备	5,349.97	5,206.50	5,029.06
合计	149,989.07	144,125.08	141,726.14
二、累计折旧			
房屋建筑物	2,821.07	2,580.68	2,196.58
机器设备	55,685.53	44,260.47	33,153.19
运输设备	304.69	299.86	297.09

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
其他设备	3,896.70	3,298.99	2,583.10
合计	62,707.99	50,440.00	38,229.95
三、减值准备	1,032.22	826.65	643.29
四、账面价值			
房屋建筑物	5,129.60	5,450.96	5,835.07
机器设备	79,597.55	85,444.04	94,545.28
运输设备	95.08	77.87	45.77
其他设备	1,426.62	1,885.56	2,426.79
合计	86,248.86	92,858.44	102,852.90

公司固定资产由房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备构成。公司采用 IDM 模式组织生产，设备投入金额较大，并且滤波器、双工器产品对机器设备的加工精度、持续运转能力要求较高，因此公司固定资产构成以机器设备为主。报告期内，公司固定资产规模较大，原值总体保持稳定，固定资产以设备为主，折旧年限相对较短，各期折旧金额较大，随着累计折旧的增加，固定资产的账面价值逐年下降。

(2) 固定资产折旧年限

报告期内，公司固定资产折旧年限与同行业可比公司对比情况如下：

单位：年

公司名称	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备
卓胜微	20	5-10	4	3	5
唯捷创芯	20	3-5	5	3-5	5-8
慧智微	10-36	-	4	3-5	5
昂瑞微	-	5-10	4	3-5	-
飞骧科技	-	3-8	4	3-5	-
锐石创芯	10-30	3-10	4-5	-	-
麦捷科技	30、20	10	5	5	5
好达电子	20	10	5	5	5

报告期内，公司固定资产的折旧年限处于合理水平，与同行业可比公司相比不存在重大差异。

(3) 固定资产受限情况

截至 2025 年末，公司因开展生产设备售后回租和抵押取得借款使得部分固定资产所有权或使用权受到限制，该部分固定资产账面原值为 121,936.55 万元，账面价值为 76,836.41 万元。

3、在建工程

报告期内，公司在建工程的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
声表面波滤波器扩产建设项目	1,892.71	2,315.39	409.80
面向 5G 的高频大带宽声表面波滤波器研发及产业化	26.11	-	-
高频大带宽射频滤波关键材料与器件技术	-	23.36	-
合计	1,918.82	2,338.76	409.80

报告期各期末，公司在建工程分别为 409.80 万元、2,338.76 万元和 1,918.82 万元，占非流动资产的比例分别为 0.35%、2.13%和 1.86%。公司在建工程主要为需安装调试的设备。2024 年末，公司在建工程较 2023 年末增加 1,928.96 万元，主要系公司为声表面波滤波器扩产建设项目购入的部分设备，在 2024 年末尚未完成安装调试，达到可使用状态所致。

4、使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产分别为 174.15 万元、41.73 万元和 95.96 万元，占非流动资产的比例分别为 0.15%、0.04%和 0.09%，系对于长期租赁的员工宿舍、分公司办公场所等租赁建筑物的租金计算的使用权资产。

5、无形资产

报告期内，公司无形资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一、原值			
土地使用权	348.46	348.46	348.46

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
软件使用权	1,815.47	1,721.43	1,646.49
合计	2,163.93	2,069.89	1,994.94
二、累计摊销			
土地使用权	151.58	144.61	137.64
软件使用权	1,325.80	1,024.88	727.03
合计	1,477.38	1,169.49	864.67
三、减值准备	-	-	-
四、账面价值			
土地使用权	196.88	203.85	210.82
软件使用权	489.67	696.56	919.46
合计	686.55	900.40	1,130.28

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 1,130.28 万元、900.40 万元和 686.55 万元，占非流动资产的比例分别为 0.98%、0.82%和 0.67%。公司无形资产由土地使用权和软件使用权构成。报告期内，公司无形资产账面原值总体保持稳定，受累计摊销的影响，无形资产的账面价值逐年下降。

截至 2025 年末，公司因抵押取得借款使土地使用权受到限制，该部分无形资产账面原值为 348.46 万元，账面价值为 196.88 万元。

6、长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 93.08 万元、856.76 万元和 1,122.95 万元，占非流动资产的比例分别为 0.08%、0.78%和 1.09%。报告期内，公司长期待摊费用逐年增加，主要系公司对仓库及车间进行改造等支出增加所致。

7、递延所得税资产

公司按照同一主体递延所得税资产与递延所得税负债抵消后的净值在资产负债表列示，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
坏账准备	173.19	204.33	153.99
资产减值准备	2,855.26	2,981.33	3,016.11

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
租赁负债	13.33	5.01	25.32
政府补助	955.71	866.64	950.08
预计负债	-	10.50	10.50
未抵扣亏损	8,667.30	8,473.46	6,975.93
递延所得税资产和负债互抵金额	-1,942.58	-2,359.49	-2,806.49
其中：固定资产加速折旧	-1,928.18	-2,353.23	-2,780.37
使用权资产	-14.39	-6.26	-26.12
合计	10,722.22	10,181.78	8,325.44

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 8,325.44 万元、10,181.78 万元和 10,722.22 万元，占非流动资产的比例分别为 7.19%、9.28%和 10.41%，主要由未抵扣亏损、资产减值准备、政府补助等事项引起的可抵扣暂时性差异产生。

8、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 108.79 万元、0.00 万元和 164.57 万元，占非流动资产的比例分别为 0.09%、0.00%和 0.16%，主要为预付设备款。

（三）资产经营效率分析

1、资产经营效率指标

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率如下：

单位：次

指标	2025年度	2024年度	2023年度
应收账款周转率	3.89	3.15	3.21
存货周转率	1.26	1.25	0.91

报告期内，公司应收账款周转率分别为 3.21、3.15 和 3.89，存货周转率分别为 0.91、1.25 和 1.26，整体呈上升趋势。

2、公司应收账款周转率与同行业可比公司的比较

报告期内，公司与同行业可比公司应收账款周转率比较情况如下：

单位：次

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
卓胜微	6.00	7.77	9.06
唯捷创芯	5.83	4.57	9.00
慧智微	6.12	7.73	34.10
昂瑞微	18.03	23.68	23.23
飞骧科技	未披露	3.04	3.57
锐石创芯	8.74	11.18	28.31
麦捷科技	3.06	2.95	3.10
平均值	7.96	8.70	15.77
好达电子	3.89	3.15	3.21

报告期内，公司应收账款周转率总体保持稳定，与飞骧科技、麦捷科技相近，低于行业平均值。报告期内，应收账款的账龄主要集中在 1 年以内，客户账期稳定，截至 2026 年 4 月末，报告期各期末公司应收账款期后回款比例分别为 98.03%、99.73%和 97.04%，回款情况良好，不存在大额坏账损失的情况。

3、公司存货周转率与同行业可比公司的比较

报告期内，公司与同行业公司存货周转率比较情况如下：

单位：次

公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
卓胜微	0.78	1.09	1.16
唯捷创芯	2.38	2.00	2.55
慧智微	1.37	0.97	0.94
昂瑞微	1.73	2.08	2.03
飞骧科技	未披露	4.14	3.09
锐石创芯	1.61	1.58	1.98
麦捷科技	4.76	4.53	4.59
平均数	2.11	2.34	2.33
好达电子	1.26	1.25	0.91

报告期内，公司存货周转率低于行业平均值，主要系公司采用 IDM 模式组织生产，与主要采用 Fabless 轻资产运营模式的同行业可比公司的存货制造过程及周期存在较大差异。报告期内，公司存货周转率分别为 0.91、1.25 和 1.26，与

由 Fabless 模式逐步向 Fab-lite 模式转换,自建晶圆生产线的卓胜微的存货周转率相近。

十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

报告期内,公司负债的构成及变化情况如下:

单位:万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	81,069.36	57.97%	107,313.63	76.37%	87,315.91	62.89%
其中:一年内到期的非流动负债	15,826.78	11.32%	40,534.99	28.85%	31,070.18	22.38%
非流动负债	58,786.96	42.03%	33,206.87	23.63%	51,519.26	37.11%
负债合计	139,856.32	100.00%	140,520.50	100.00%	138,835.17	100.00%

报告期内,公司负债总额总体保持稳定,受一年内到期的长期借款和长期应付款在流动负债中列示的影响,流动负债和非流动负债存在一定波动。

报告期各期末,公司流动负债分别为 87,315.91 万元、107,313.63 万元和 81,069.36 万元,占负债总额的比例分别为 62.89%、76.37%和 57.97%。报告期各期末,剔除一年内到期的非流动负债的影响后,公司流动负债分别为 56,245.73 万元、66,778.64 万元和 65,242.59 万元,占负债总额的比例分别为 40.51%、47.52%和 46.65%,随公司经营规模的扩大,整体呈上升趋势。

报告期各期末,公司非流动负债分别为 51,519.26 万元、33,206.87 万元和 58,786.96 万元,占负债总额的比例分别为 37.11%、23.63%和 42.03%。报告期各期末,公司非流动负债和一年内到期的非流动负债之和分别为 82,589.44 万元、73,741.86 万元和 74,613.74 万元,占负债总额的比例分别为 59.49%、52.48%和 53.35%,其中,2024 年末较 2023 年末下降,主要系 2024 年,随着公司经营活动现金流的改善,公司偿还了部分长期借款,融资规模下降所致。

(一) 流动负债的构成及变化分析

报告期内,公司流动负债构成情况如下:

单位：万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	38,981.17	48.08%	44,394.07	41.37%	39,993.17	45.80%
应付票据	282.18	0.35%	104.54	0.10%	-	-
应付账款	19,181.62	23.66%	16,772.12	15.63%	11,265.17	12.90%
合同负债	62.52	0.08%	276.31	0.26%	2,290.25	2.62%
应付职工薪酬	2,107.00	2.60%	2,046.12	1.91%	1,806.22	2.07%
应交税费	75.95	0.09%	65.50	0.06%	66.83	0.08%
其他应付款	894.53	1.10%	635.84	0.59%	359.14	0.41%
一年内到期的非流动负债	15,826.78	19.52%	40,534.99	37.77%	31,070.18	35.58%
其他流动负债	3,657.62	4.51%	2,484.14	2.31%	464.94	0.53%
流动负债合计	81,069.36	100.00%	107,313.63	100.00%	87,315.91	100.00%

报告期各期末，公司流动负债主要由短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债等构成，具体情况如下：

1、短期借款

报告期内，公司短期借款的明细情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
信用借款	21,706.58	25,050.30	28,103.99
商业汇票贴现	2,736.83	198.34	558.55
应收账款保理	2,316.81	9,515.73	2,086.63
供应链借款	12,220.95	9,537.24	9,244.00
进口押汇	-	92.47	-
合计	38,981.17	44,394.07	39,993.17

报告期各期末，公司短期借款分别为 39,993.17 万元、44,394.07 万元和 38,981.17 万元，总体保持稳定，占流动负债的比例分别为 45.80%、41.37%和 48.08%，是公司流动负债主要组成部分。报告期内，公司信用状况良好，未发生短期借款违约的情形。

报告期内，公司主要通过银行借款、融资租赁等进行融资，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
短期借款	38,981.17	44,394.07	39,993.17
一年内到期的长期借款	7,983.03	17,336.98	19,459.78
一年内到期的长期应付款	7,764.79	23,168.04	11,493.75
长期借款	44,889.88	7,164.06	24,502.64
长期应付款	7,515.73	20,191.78	20,560.61
合计	107,134.60	112,254.94	116,009.95

报告期各期末，公司长短期借款融资规模分别为 116,009.95 万元、112,254.94 万元和 107,134.60 万元，总体保持稳定。报告期内，公司长短期借款规模逐年小幅减少，主要系随着公司经营活动现金流的改善，公司开始逐步偿还了部分借款所致。

2、应付票据

公司为提高资金使用效率，与部分供应商采用银行承兑汇票进行结算。2024 年末和 2025 年末，公司应付票据分别为 104.54 万元和 282.18 万元，占流动负债的比例分别为 0.10%和 0.35%，金额和占比较小。

3、应付账款

报告期内，公司应付账款的账龄分布情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
1年以内	18,485.60	15,982.25	9,805.09
1至2年	381.74	496.58	778.15
2至3年	41.61	118.21	676.15
3年以上	272.68	175.09	5.79
合计	19,181.62	16,772.12	11,265.17

报告期各期末，公司应付账款分别为 11,265.17 万元、16,772.12 万元和 19,181.62 万元，占流动负债的比例分别为 12.90%、15.63%和 23.66%，是公司流动负债的重要构成部分。

公司应付账款由原材料款、设备及工程款构成。报告期各期末，公司应付账

款的账龄主要集中在1年以内，1年以上的应付账款主要为尚未结算完毕的设备工程款。

报告期内，公司应付账款逐年增长，主要系报告期内，公司产量大幅增长，原材料采购规模逐年增长，分别为14,210.75万元、27,708.85万元和34,724.41万元，带动期末应付账款规模相应增长。

4、合同负债

报告期各期末，公司合同负债分别为2,290.25万元、276.31万元和62.52万元，占流动负债的比例分别为2.62%、0.26%和0.08%，占比较小。

5、应付职工薪酬

公司应付职工薪酬主要由短期薪酬构成。报告期各期末，公司应付职工薪酬金额分别为1,806.22万元、2,046.12万元和2,107.00万元，占流动负债的比例分别为2.07%、1.91%和2.60%。

6、应交税费

报告期内，公司应交税费构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
个人所得税	42.59	35.69	29.58
房产税	15.58	15.58	23.08
印花税	14.16	10.62	10.56
土地使用税	3.59	3.59	3.59
其他	0.03	0.03	0.03
合计	75.95	65.50	66.83

报告期各期末，公司应交税费分别为66.83万元、65.50万元和75.95万元，占流动负债的比例分别为0.08%、0.06%和0.09%，占比较小。

7、其他应付款

报告期内，公司其他应付款构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
代收代付款	590.00	99.95	65.40
押金保证金	120.00	130.00	145.00
报销款	104.62	178.03	136.46
诉讼赔偿款	70.00	-	-
合并外关联方拆借	-	212.91	-
其他	9.92	14.95	12.29
合计	894.53	635.84	359.14

报告期各期末，公司其他应付款分别为 359.14 万元、635.84 万元和 894.53 万元，占流动负债的比例分别为 0.41%、0.59%和 1.10%。公司的其他应付款主要由应付押金保证金、报销款和代收代付款等组成。

报告期各期末，公司其他应付款逐年增长。2024 年末，公司其他应付款较 2023 年末增加 276.70 万元，主要系 2024 年，因短期运营资金需求，公司向合并外关联方好达投资拆入资金所致。对于上述拆入资金，公司已于 2025 年 5 月末全部偿还，2025 年 6 月后，公司未发生新的资金拆入。2025 年末，公司其他应付款较 2024 年末增加 258.69 万元，主要系 2025 年 12 月，公司作为牵头单位，承担国家重点研发项目单晶压电薄膜及高频声学滤波器，收到项目整体资金，期末尚未转付清华大学、中国科学院声学研究所等其他参与单位的研发款项所致。

8、一年内到期的非流动负债

报告期内，公司一年内到期的非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
一年内到期的长期借款	7,983.03	17,336.98	19,459.78
一年内到期的长期应付款	7,764.79	23,168.04	11,493.75
一年内到期的租赁负债	78.96	29.97	116.65
合计	15,826.78	40,534.99	31,070.18

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为 31,070.18 万元、40,534.99 万元和 15,826.78 万元，占流动负债的比例分别为 35.58%、37.77%和 19.52%，是公司流动负债重要组成部分。

公司一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的长期借款和长期应付款。报告期内，公司长期借款、长期应付款的整体情况如下：

单位：万元

项目		2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
长期借款	1年内到期	7,983.03	17,336.98	19,459.78
	1年以上到期	44,889.88	7,164.06	24,502.64
	小计	52,872.91	24,501.04	43,962.42
长期应付款	1年内到期	7,764.79	23,168.04	11,493.75
	1年以上到期	7,515.73	20,191.78	20,560.61
	小计	15,280.52	43,359.82	32,054.36
合计		68,153.43	67,860.86	76,016.78

报告期内，公司长期融资借款的规模总体保持稳定，受长期融资借款不同合同具体到期时间不同的影响，公司一年内到期的非流动负债存在较大波动。

9、其他流动负债

报告期内，公司其他流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
待转销项税	5.24	34.35	133.70
已背书未到期应收票据	3,652.38	2,449.79	331.24
合计	3,657.62	2,484.14	464.94

报告期各期末，公司其他流动负债分别为 464.94 万元、2,484.14 万元和 3,657.62 万元，占流动负债的比例分别为 0.53%、2.31%和 4.51%。

公司其他流动负债主要为已背书未到期，未终止确认的应收票据。报告期内，随着公司经营规模的扩大，公司收到的承兑票据相应增加，为提高票据的使用效率，公司背书转让的应收票据逐年增加，导致期末已背书未到期应收票据相应增加。

（二）非流动负债的构成及变化分析

报告期内，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	44,889.88	76.36%	7,164.06	21.57%	24,502.64	47.56%
租赁负债	9.93	0.02%	3.41	0.01%	52.16	0.10%
长期应付款	7,515.73	12.78%	20,191.78	60.81%	20,560.61	39.91%
预计负债	-	-	70.00	0.21%	70.00	0.14%
递延收益	6,371.42	10.84%	5,777.62	17.40%	6,333.84	12.29%
非流动负债合计	58,786.96	100.00%	33,206.87	100.00%	51,519.26	100.00%

报告期各期末，公司非流动负债余额分别为 51,519.26 万元、33,206.87 万元和 58,786.96 万元，主要由长期借款、长期应付款和递延收益构成。

1、长期借款

报告期内，公司长期借款的明细情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
抵押借款	9,008.50	14,648.90	19,996.65
信用借款	14,974.96	9,852.14	23,965.77
抵押、保证借款	28,889.45	-	-
减：一年内到期的长期借款	7,983.03	17,336.98	19,459.78
合计	44,889.88	7,164.06	24,502.64

报告期各期末，公司长期借款分别为 24,502.64 万元、7,164.06 万元和 44,889.88 万元，占非流动负债的比例分别为 47.56%、21.57%和 76.36%，是公司流动负债主要组成部分。

公司一年内到期的长期借款在一年内到期的非流动负债科目列示。报告期内，公司长期借款的整体情况如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
1年内到期	7,983.03	17,336.98	19,459.78
1年以上到期	44,889.88	7,164.06	24,502.64
合计	52,872.91	24,501.04	43,962.42

2024 年末，公司长期借款整体金额较 2023 年末减少 19,461.38 万元，主要系（1）公司部分长期借款到期后，公司增加了售后租回融资款进行替换，2024 年末，公司售后租回融资款较 2023 年末增加 11,305.46 万元；（2）公司偿还了部分长期借款。

2025 年末，公司长期借款整体金额较 2024 年末增加 28,371.88 万元，主要系随着公司经营规模的扩大，经营活动现金流改善，公司银行授信额度增加，为优化借款利率，公司相应增加了借款利率较低长期借款的金额，同时减少利率较高的售后租回融资款，2025 年末，公司售后租回融资款较 2024 年末减少 28,079.31 万元。

2、租赁负债

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对于租赁期超过 1 年的经营租赁所形成的应付租金义务，在扣除一年内到期的租赁负债后于报告期各期末确认租赁负债分别为 52.16 万元、3.41 万元和 9.93 万元，金额较小。

3、长期应付款

报告期各期末，公司长期应付款分别为 20,560.61 万元、20,191.78 万元和 7,515.73 万元，占非流动负债的比例为 39.91%、60.81%和 12.78%，是公司非流动负债的重要组成部分，为公司因开展生产设备售后回租业务形成的非一年内需支付的售后回租款。

公司一年内到期的长期应付款在一年内到期的非流动负债科目列示。报告期内，公司长期应付款的整体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
1 年内到期	7,764.79	23,168.04	11,493.75
1 年以上到期	7,515.73	20,191.78	20,560.61
合计	15,280.52	43,359.82	32,054.36

报告期内，公司分别与芯鑫融资租赁有限责任公司、交银金融租赁有限责任公司、中信金融租赁有限公司等融资租赁公司签订《融资租赁合同》，开展融资租赁售后回租业务。公司采用 IDM 模式组织生产，设备规模较大，相对传统银

行的评估模式，专业的半导体或科技融资租赁公司一般会给予公司更高的融资额度。

2024 年末，公司长期应付款的整体金额较 2023 年增加 11,305.46 万元，主要系 2024 年，公司部分长期借款到期，公司增加了融资租赁借款的规模。2025 年末，公司长期应付款的整体金额较 2024 年减少 28,079.31 万元，主要系 2025 年，公司银行授信额度增加，为降低融资成本，公司增加了利率较低长期借款的金额，相应减少利率较高的售后租回融资款。

4、预计负债

报告期各期末，公司预计负债分别为 70.00 万元、70.00 万元和 0.00 万元，占非流动负债的比例为 0.14%、0.21%和 0.00%，为未决诉讼计提的预计负债。

5、递延收益

报告期内，公司递延收益的明细情况如下：

单位：万元

项目	原值	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
新一代移动通信终端用声表面波滤波器/双工器	1,392.00	182.47	346.48	510.49
高性能声表面波滤波器产业化集成与示范之专项经费	59.00	11.80	17.70	23.60
片式温度补偿声表面波滤波器（TC SAW）研发及产业化	440.00	176.68	223.83	270.99
5G 用 BAW 滤波器及射频模块 SAW 滤波器研发试制线	249.00	114.77	139.39	164.16
经开区产业政策扶持资金-技术改造（智能化）	180.00	96.80	116.41	136.01
信息技术产业投资资助（5G）江苏无锡经济开发区财政局 年扩产 3 亿只声表面波滤波器建设项目（新一代信息产业发展专项资金项目）	500.00	283.47	338.66	393.98
高技术产业企业和工业“战略性新兴产业”江苏无锡经济开发区经济发展局（智能化升级）	100.00	61.44	72.01	82.59
智能化改造和数字化转型-贷款贴息和设备补助项目	340.86	215.01	253.71	292.44
省级战略性新兴产业发展专项资金-5G 用 BAW 滤波器及射频 SAW 滤波器研发试制线项目	1,600.00	934.51	1,104.42	1,274.34
涉密项目 C	3,281.00	2,406.19	1,793.64	2,025.31

项目	原值	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
面向5G的高频大带宽声表面波滤波器研发及产业化-省成果	550.00	463.18	518.56	550.00
2023年度数字经济和数字化转型发展资金:5G移动终端温度补偿声表面波滤波器研发及产业化	319.91	248.61	284.26	319.91
面向5G的高频大带宽声表面波滤波器研发及产业化-市成果	200.00	178.24	91.31	99.36
2022年太湖湾科创带政策兑现-培优工程-支持企业做大做强	200.00	145.80	168.23	190.65
2024年江苏省制造强省建设专项资金(第二批)	309.00	263.18	309.00	-
5G移动终端用WLP小型化射频滤波器研发及产业化	309.62	299.06	-	-
高性能碳化硅声表面波滤波器器件关键技术研发-省拨款-省前沿技术专项	98.00	98.00	-	-
基于压电异质薄膜的高性能射频滤波器研发与产业化研究-无锡市人工智能与物联网产业发展资金	192.21	192.21	-	-
合计	10,320.60	6,371.42	5,777.62	6,333.84

报告期各期末,公司递延收益分别为6,333.84万元、5,777.62万元和6,371.42万元,占非流动负债的比例分别为12.29%、17.40%和10.84%,是公司非流动负债的重要组成部分,均为收到的与资产相关的政府补助,总体保持稳定。

报告期内,公司累计销售滤波器近百亿颗,是国内企业中少数能与同行业全球知名公司直接竞争的声表面波射频滤波器制造厂商。报告期内,公司递延收益主要为国家级、省级及市级与滤波器相关的研发攻关项目,在射频芯片国产化的大趋势下,公司通过持续技术突破,已成为国产替代的重要力量。

(三) 偿债能力分析

1、公司偿债能力分析

报告期内,公司主要偿债能力指标如下:

指标	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
流动比率(倍)	0.67	0.41	0.49
速动比率(倍)	0.39	0.25	0.25
资产负债率(合并)	88.70%	91.38%	87.59%

指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	17,188.79	8,695.68	-8,523.74
利息保障倍数（倍）	0.82	-0.73	-4.24

（1）流动比率和速动比率

报告期各期末，公司流动比率分别为 0.49、0.41 和 0.67，速动比率分别为 0.25、0.25 和 0.39。报告期内，公司流动比率和速动比率较低，主要系①公司采用 IDM 模式，资产主要为固定资产等非流动资产，流动资产占比较低；②受限于融资渠道单一，公司主要依赖股权融资及金融机构借款等传统方式，负债主要为长短期借款。受一年内到期的长期借款和长期应付款在流动负债中列示的影响，公司在流动负债中反映的借款规模较大。

报告期各期末，公司流动比率和速动比率整体呈上升趋势。其中，2024 年流动比率下降，主要系①2024 年末，在流动负债中列示的一年内到期的非流动负债较 2023 年末增加 9,464.81 万元；②2024 年末，随着公司经营规模的扩大，公司短期借款和应付账款同比增长，但同时随着公司经营活动现金流的改善，公司偿还了部分长期借款，货币资金同比减少，导致 2024 年末公司流动资产的增幅小于流动负债的增幅。

（2）资产负债率

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 87.59%、91.38%和 88.70%。报告期内，公司资产负债率较高，主要系公司采用 IDM 模式，为把握射频芯片国产替代的整体趋势，2020 年至 2021 年，公司积极扩张产能，但受制于融资渠道有限，公司主要通过金融机构借款等方式筹集产能扩张所需资金，长短期借款的融资规模较大，导致负债总额较大。

（3）息税折旧摊销前利润、利息保障倍数

报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 -8,523.74 万元、8,695.68 万元和 17,188.79 万元，由负转正，呈上升趋势。

报告期内，公司利息保障倍数分别为-4.24、-0.73 和 0.82，主要系报告期内，公司新产线处于产能产量爬坡和良率提升阶段，折旧、利息支出等固定支出较大，

同时受下游竞争激烈的影响，毛利率相对较低，未实现盈利所致。报告期内，随着公司经营规模的扩大，产量的提升和产品结构的优化，公司经营活动现金流逐年改善，已逐步偿还部分长短期借款。报告期内，公司按期偿还借款本息，未出现借款违约的情形。

2、公司偿债能力与同行业可比公司的比较分析

报告期内，公司主要偿债能力指标与同行业可比公司比较情况如下：

公司	指标	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
卓胜微	流动比率（倍）	2.01	1.69	3.71
	速动比率（倍）	0.93	0.84	2.02
	资产负债率（合并）	36.17%	28.33%	10.54%
唯捷创芯	流动比率（倍）	6.70	7.19	5.79
	速动比率（倍）	5.87	5.77	4.92
	资产负债率（合并）	14.93%	13.03%	16.28%
慧智微	流动比率（倍）	8.83	5.90	14.29
	速动比率（倍）	6.19	4.19	10.07
	资产负债率（合并）	15.15%	18.33%	9.24%
昂瑞微	流动比率（倍）	5.15	2.20	2.45
	速动比率（倍）	4.18	0.98	1.51
	资产负债率（合并）	21.05%	43.22%	39.33%
飞骧科技	流动比率（倍）	未披露	1.20	1.27
	速动比率（倍）	未披露	0.92	0.95
	资产负债率（合并）	未披露	72.05%	69.32%
锐石创芯	流动比率（倍）	1.26	1.12	1.85
	速动比率（倍）	0.71	0.63	1.22
	资产负债率（合并）	54.71%	90.41%	66.76%
麦捷科技	流动比率（倍）	1.62	1.65	1.92
	速动比率（倍）	1.34	1.40	1.63
	资产负债率（合并）	33.83%	32.29%	28.06%
平均值	流动比率（倍）	4.26	2.99	4.47
	速动比率（倍）	3.20	2.11	3.19
	资产负债率（合并）	29.31%	42.52%	34.22%

公司	指标	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
好达电子	流动比率（倍）	0.67	0.41	0.49
	速动比率（倍）	0.39	0.25	0.25
	资产负债率（合并）	88.70%	91.38%	87.59%

报告期内，公司流动比率、速动比率低于行业平均值，资产负债率（合并）高于行业平均值，主要系（1）公司为非上市公司，通过直接融资方式进行融资的规模有限，卓胜微、唯捷创芯、慧智微、昂瑞微和麦捷科技均系上市公司，完成了大额募资，整体流动性好于公司；（2）公司专注于声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售，采用 IDM 模式，资产负债结构与主要采用 Fabless 模式及 Fab-lite 模式的同行业可比公司存在较大差异。

（四）报告期内股利分配的具体实施情况

报告期内，公司未进行股利分配。

（五）现金流量分析

报告期内，公司现金流量基本情况如下：

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
经营活动产生的现金流量净额	33,054.07	24,579.21	8,951.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,180.64	-4,566.32	-2,692.19
筹资活动产生的现金流量净额	-24,251.65	-21,683.19	-4,534.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11.96	560.06	-558.27
现金及现金等价物净增加额	6,609.83	-1,110.25	1,166.51

1、经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量明细情况如下：

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
销售商品、提供劳务收到的现金	66,890.51	56,966.81	33,324.98
收到的税费返还	65.27	-	60.31
收到其他与经营活动有关的现金	2,866.00	666.70	2,118.67

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动现金流入小计	69,821.78	57,633.51	35,503.96
购买商品、接受劳务支付的现金	18,095.03	16,787.04	11,791.21
支付给职工以及为职工支付的现金	13,568.12	12,552.41	11,637.10
支付的各项税费	2,471.39	2,096.25	666.41
支付其他与经营活动有关的现金	2,633.17	1,618.60	2,458.07
经营活动现金流出小计	36,767.71	33,054.31	26,552.80
经营活动产生的现金流量净额	33,054.07	24,579.21	8,951.17
净利润	-335.42	-7,975.47	-21,704.63
经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额	33,389.49	32,554.68	30,655.80

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 8,951.17 万元、24,579.21 万元和 33,054.07 万元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额均高于同期净利润，与净利润的差额较大，主要系公司采用 IDM 模式组织生产，设计与制造一体化，需要高投入自建晶圆、封测等产线，资本性支出大，形成的固定资产规模较大，导致报告期内各期计提固定资产的折旧较大；同时由于产线建设资金主要来自借款，各期的财务费用相应较大。报告期内，净利润调节为经营活动产生的现金流量净额的过程如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
净利润	-335.42	-7,975.47	-21,704.63
加：资产减值损失	3,579.99	5,541.41	9,744.78
信用减值损失	-207.60	335.62	495.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,396.66	12,309.57	12,013.19
使用权资产折旧	94.61	108.15	112.39
无形资产摊销	307.89	304.82	279.37
长期待摊费用摊销	386.21	129.00	29.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	1.90	-82.20	-1,073.88
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	13.50	1.24	3.58
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-	-	-

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
财务费用（收益以“－”号填列）	4,982.09	5,147.55	5,908.73
投资损失（收益以“－”号填列）	501.40	234.10	-368.04
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）	-	-	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-540.44	-1,856.35	-4,184.06
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-	-7.60
存货的减少（增加以“－”号填列）	-8,883.66	-1,935.04	8,200.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,548.75	-8,518.86	-8,613.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	21,412.71	19,276.36	6,864.51
处置划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组（子公司和业务除外）时确认的损失（收益以“－”号填列）	-	-	-
其他	892.98	1,559.32	1,251.54
经营活动产生的现金流量净额	33,054.07	24,579.21	8,951.17

2、投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.50	337.14	2,658.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	71.39
投资活动现金流入小计	1.50	337.14	2,729.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,182.14	4,903.46	5,096.66
投资支付的现金	-	-	325.00
投资活动现金流出小计	2,182.14	4,903.46	5,421.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,180.64	-4,566.32	-2,692.19

报告期内，公司投资活动主要为公司购置生产设备支出。报告期内，公司投

资活动产生的现金流量净额分别为-2,692.19 万元、-4,566.32 万元和-2,180.64 万元。

3、筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	4,000.00	-	-
取得借款收到的现金	83,404.69	26,872.47	42,741.87
收到其他与筹资活动有关的现金	43,065.95	53,905.59	43,500.16
筹资活动现金流入小计	130,470.64	80,778.05	86,242.03
偿还债务支付的现金	60,599.25	49,231.06	56,663.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,843.39	5,556.38	5,594.27
支付其他与筹资活动有关的现金	89,279.65	47,673.81	28,518.23
筹资活动现金流出小计	154,722.29	102,461.25	90,776.22
筹资活动产生的现金流量净额	-24,251.65	-21,683.19	-4,534.19

报告期内，公司收到和支付其他与筹资活动有关的现金，主要为银行借款、售后回租融资款等。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-4,534.19 万元、-21,683.19 万元和-24,251.65 万元。

（六）流动性风险分析

报告期内，公司负债构成以流动负债为主，主要包括短期借款、应付账款、应付票据、应付职工薪酬等负债项目。报告期各期末，公司短期借款分别为 39,993.17 万元、44,394.07 万元和 38,981.17 万元，总体保持稳定，占流动负债的比例分别为 45.80%、41.37%和 48.08%，是公司流动负债主要组成部分。报告期内，公司信用状况良好，未发生短期借款违约的情形。报告期内，随着经营规模的扩大，经营活动现金流的改善，公司流动比率和速动比率整体呈上升趋势，流动性风险较低。

（七）持续经营能力情况分析

1、业务和产品定位

公司主要从事声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售，是国内极少数具备芯片设计、晶圆制造、封装测试于一体的全链条自主可控并规模化量产出货的 IDM 企业，主要产品包括滤波器、双工器、谐振器等。公司构建了以 SAW、TC-SAW 及 TF-SAW 为核心的技术平台，拥有领先的滤波器晶圆制造产线及 SMD、CSP、WLP、Bare-Die 等封装产线，形成了涵盖低频、中频、高频的完整产品体系，实现了 300MHz 到 6GHz 关键频段的全面覆盖，是国内声表面波滤波器龙头企业。

公司具备卓越的科研实力与持续创新能力，作为国家滤波器领域科技攻关的核心单位，公司曾荣获 2 次国家科技进步二等奖，并作为主要承担单位，先后牵头承担或参与实施了 7 项国家级和 5 项省级重点科研项目。历经二十余年深耕，公司已建成年产能达 60 亿颗的规模化交付体系，确立了在国内声表面波滤波器领域的领导地位，成为突破国外技术垄断、保障产业链安全的中坚力量。报告期内，公司的产品销量近 100 亿颗。

2、报告期经营策略以及未来经营计划

报告期内，为实现企业的可持续发展与市场领先地位，公司实施“深耕现有市场”与“突破瓶颈技术”双轨并行的战略路径。一方面，通过体系化的研发投入和持续的工艺优化，为智能手机、物联网、基站等客户提供高性价比的标准化产品，快速提升市场份额。另一方面，集中优势资源突破瓶颈技术，针对 5G/6G 通信、智能网联汽车、低轨卫星通信、无人机等新兴领域的需求，在不断迭代现有产品的基础上，集中优势资源加快 TC-SAW、TF-SAW 等高性能滤波器的研发与量产进程。

报告期内，公司高端技术实现规模化应用，突破了 TC-SAW 滤波器核心技术，成功解决了温度补偿薄膜沉积工艺、多层结构声波耦合机制等技术难题，通过建立国内首条 TC-SAW 专用产线，公司已实现数十款 TC-SAW 滤波器与双工器的规模化量产，产品性能指标达到国际主流厂商水平。得益于技术突破与产能

保障，公司 TC-SAW 系列产品已广泛应用于智能手机、物联网等领域的知名品牌客户，带动该类产品销售收入实现跨越式增长，收入占比逐年提高，成为公司业绩增长的核心动力。公司充分发挥 IDM 模式的经营优势，通过建立研发与制造协同创新机制，实现了“工艺驱动设计”与“设计兼容制造”的双向赋能，规模化交付与全链条自主构成了公司核心产能优势，为公司快速响应市场需求、保障稳定交付提供了坚实保障；同时公司是国内少数具有 POI 材料制备能力的滤波器厂商，为未来公司产品迭代升级打下坚实基础。

未来公司将持续加大研发投入，重点突破新一代滤波器核心技术，加强人才队伍建设与培养，同时将深化与国内外顶尖科研机构战略合作，通过所建立长期、稳定的合作关系，共同开展前沿技术研究；重点布局新一代 POI 材料、新型声波器件结构等基础研究领域，推动技术创新与产业应用的深度融合。未来经营计划参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”之“二、公司战略规划与未来发展目标”。

2023 年至 2025 年，公司主营业务收入分别为 41,640.32 万元、60,411.28 万元和 67,141.27 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 8,951.17 万元、24,579.21 万元和 33,054.07 万元，逐年增长；息税折旧摊销前利润分别为-8,523.74 万元、8,695.68 万元和 17,188.79 万元，由负转正，呈上升趋势。报告期内，公司不存在债务违约、无法继续履行重大合同、无法获得研发所需资金等严重影响公司持续经营能力的情形，同时随着公司经营活动现金流的改善，公司开始逐步偿还部分长短期借款，长短期借款的规模逐年小幅减少，具备持续造血功能，能实现自我维持和发展。未来，公司将持续加强技术创新、开拓优质客户、扩大经营规模，不断增强公司的持续经营能力。

关于公司持续经营过程中存在的重要风险，请投资者充分关注本招股说明书“第三节 风险因素”。

十二、重大资本性支出与资产业务重组事项

（一）资本性支出情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为

5,096.66 万元、4,903.46 万元和 2,182.14 万元，主要为生产设备、研发设备等购置支出。上述资本性支出均与公司主营业务相关。公司未来可预见的重大资本性支出主要为：1、建设本次募集资金拟投资项目的支出，具体情况请参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”；2、截止 2025 年末，公司已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关重大财务支出为 9,364.70 万元。除此之外，公司近期无其他可预见的重大资本性支出情况。

（二）资产业务重组事项

报告期内，公司不存在重大资产业务重组情况。

十三、期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

截至本招股说明书签署日，公司无其他需要披露的重大期后事项。

（二）或有事项

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已贴现或背书且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资余额中期末终止确认金额为 12,363.40 万元。除此之外，截至本招股说明书签署日，公司无其他需要披露的重大或有事项。

（三）其他重要事项

截至本招股说明书签署日，公司无需要披露的其他重要事项。

十四、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营情况

公司财务报告审计基准日为 2025 年 12 月 31 日。自财务报告审计基准日至本招股说明书签署日，公司的主要经营状况、经营模式、主要产品的生产与销售，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大不利变化。

十五、盈利预测信息

公司未编制盈利预测报告。

十六、未来实现盈利的前瞻性信息

未来实现盈利的前瞻性信息并非盈利预测。本公司前瞻性信息是建立在推测性假设数据基础上的预测，具有重大不确定性，投资者应谨慎使用。

（一）未来实现盈利依据的假设条件

- 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律法规、经济政策无重大改变；
- 2、国家宏观经济继续平稳运行；
- 3、公司所处行业与市场环境不会发生重大变化；
- 4、本次公司股票发行上市成功，募集资金顺利到位；
- 5、募集资金投资项目能够顺利实施，并取得预期收益；
- 6、公司无重大经营决策失误和足以严重影响公司正常运转的重大人事变动；
- 7、不会发生对公司正常经营造成重大不利影响的突发性事件或其他不可抗力因素。

（二）为实现盈利公司拟采取的措施

1、持续加强竞争优势及技术积累

公司主要从事声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售，是国内极少数具备芯片设计、晶圆制造、封装测试于一体的全链条自主可控并规模化量产出货的 IDM 企业，主要产品包括滤波器、双工器、谐振器等。公司构建了以 SAW、TC-SAW 及 TF-SAW 为核心的技术平台，拥有领先的滤波器晶圆制造产线及 SMD、CSP、WLP、Bare-Die 等封装产线，形成了涵盖低频、中频、高频的完整产品体系，实现了 300MHz 到 6GHz 关键频段的全面覆盖，是国内声表面波滤波器龙头企业。

经过多年的沉淀和积累，公司已形成并将持续强化自身鲜明的竞争优势，包括：（1）基础研究和开发能力并重，构建了从理论研究到工程实现的全链条创新体系，实现了对“卡脖子”技术的突破；（2）公司采用 IDM 模式，实现设计、制造一体化，具备开发周期短、交付及时、产品可靠性高等综合性优势；（3）

SAW 滤波器产品系列持续迭代，满足小型化、集成化的市场需求；（4）公司率先在国内突破 TC-SAW 关键技术，实现量产出货；（5）公司是国内少数具有 POI 材料制备能力的滤波器厂商，为未来公司产品迭代升级打下坚实基础；（6）公司产品系列覆盖频段全、品类多、应用广，满足客户多样化需求，具有较强的竞争优势；（7）公司制造技术持续创新，拥有先进的智能化制造平台；（8）晶圆级封装（WLP）技术自主突破，率先进入高端射频前端模组供应链。上述竞争优势为公司在未来的竞争中开拓市场，逐步提升业绩并最终扭亏为盈提供了内生动力。

2、产业规模与技术先进性两轮驱动，提升市场份额

公司实施“深耕现有市场”与“突破瓶颈技术”双轨并行的战略路径。一方面，通过体系化的研发投入和持续的工艺优化，为智能手机、物联网、基站等客户提供高性价比的标准化产品，提升产能利用率和良率，增加产量，快速提升市场份额。另一方面，集中优势资源突破瓶颈技术，针对 5G/6G 通信、智能网联汽车、低轨卫星通信、无人机等新兴领域的需求，在不断迭代现有产品的基础上，集中优势资源加快 TC-SAW、TF-SAW 等高性能滤波器的研发与量产进程。

3、提升产线稼动率，降低产品成本

公司作为国内少数采用 IDM 模式并实现全链条自主可控的声表面波滤波器企业，形成了年产超 60 亿颗的规模化交付能力。报告期内，随着公司产能利用率和良率的提升，公司产销量快速增长，单位成本逐年下降。未来随着公司产品持续放量、叠加产品直通率与良率的持续提升，规模效应与工艺优化将继续驱动单位成本下降。

4、不断优化产品结构，满足客户多样化需求

公司作为国内少数采用 IDM 模式并实现全链条自主可控的声表面波滤波器企业，已构建了覆盖 SAW、TC-SAW 及 TF-SAW 的全技术平台。报告期内，公司持续对 SAW 产品进行设计迭代与性能优化，通过精细化管理和技术创新不断提升产品良率、降低制造成本；同时，依托设计和工艺创新，持续缩小芯片尺寸，有效满足客户对器件小型化的持续需求；公司突破了 TC-SAW 滤波器核心技术，

成功解决了温度补偿薄膜沉积工艺、多层结构声波耦合机制等技术难题，通过建立国内首条 TC-SAW 专用产线，公司已实现数十款 TC-SAW 滤波器与双工器的规模化量产，产品性能指标达到国际主流厂商水平。得益于技术突破与产能保障，公司 TC-SAW 系列产品已广泛应用于智能手机、物联网等领域的知名品牌客户，带动该类产品销售收入实现跨越式增长，收入占比逐年提高，成为公司业绩增长的核心动力。同时，公司建立了 POI 材料的制备与生产能力，开发了独具竞争力的 TF-SAW 产品。未来公司将进一步提高 TC-SAW 和 TF-SAW 产品占比，以满足客户多样化需求，提升市场份额。

5、优化供应链体系，实现持续成本优化

报告期内，随着公司销售规模的增长，带动采购规模快速增长。随着晶片、基板等原材料的采购规模不断扩大，公司对于供应链的议价能力逐步增强，规模效应初步显现，采购成本呈下降趋势。随着公司业务规模的不断扩大，规模效应持续释放，将为进一步提升盈利能力提供有力支撑。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金运用概况

(一) 募集资金投资项目

经公司第二届董事会第二十次会议及 2025 年第七次临时股东会批准，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，投资项目及投入金额具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	年产 6 亿颗 TC-SAW 及 4 亿颗 TF-SAW 滤波器生产线扩建项目	51,893.41	51,893.41
2	研发中心建设项目	43,355.95	43,355.95
3	智能制造能力提升项目	8,326.06	8,326.06
4	补充流动资金	80,000.00	80,000.00
合计		183,575.42	183,575.42

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额及项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

若实际募集资金净额超过上述项目拟投入金额的，超过部分将根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定的要求进行管理和使用。

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。

(二) 募集资金使用管理制度

公司 2025 年 11 月 24 日第七次临时股东会审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监督进行了规定。公司将严格按照有关规定存放及使用本次募集资金，公司募集资金将存放于专户集中管理，做到专款专用。公司将以上述制度为基础，对募集资金进行规范化的管理和使用，切实维护资金安全、防范相关风险、提高使用效益。

本次发行募集资金到位前，发行人将根据实际经营需要以自筹资金对上述项目进行前期投入。募集资金到位后，将按照监管部门的相关规定及《募集资金管理制度》的要求予以置换。

（三）募集资金投资项目的确定依据

本次募集资金投资项目以公司已有的声表面波滤波器设计制造一体化技术平台以及声表面波滤波器行业的技术发展趋势为依据确定，能够与公司的主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力、发展目标等情况相匹配，具体如下：

1、与公司主营业务及生产经营规模相匹配

公司是集声表面波射频芯片设计、制造、封装测试于一体的 IDM 企业，主营业务覆盖 SAW、TC-SAW、TF-SAW 三大技术平台，产品广泛应用于智能终端、物联网、汽车电子、基站及低轨卫星通信等领域。报告期内，公司营业收入分别为 41,851.74 万元、60,655.03 万元和 67,465.69 万元，年均复合增长率为 26.97%，生产经营规模呈现快速增长态势。公司现有滤波器年产能超过 60 亿颗，TC-SAW 滤波器出货量位居国内前列。本次募集资金投资项目中的“年产 6 亿颗 TC-SAW 及 4 亿颗 TF-SAW 滤波器生产线扩建项目”系对公司现有高性能滤波器产能的直接扩充，与公司主营业务的发展方向及当前产能情况高度契合；“研发中心建设项目”和“智能制造能力提升项目”则服务于公司技术迭代与效率提升，与主营业务协同发展。因此，本次募集资金投资项目与公司主营业务及生产经营规模相匹配。

2、与公司财务状况相匹配

公司采用 IDM 模式，固定资产投资较大，报告期末资产负债率相对较高，营运资金随业务规模扩张而持续增加。本次募集资金投资项目中的“补充流动资金”有助于优化公司资本结构，降低资产负债率，增强偿债能力和抗风险能力。同时，TC-SAW 及 TF-SAW 扩产项目投产后预计将进一步提升公司盈利水平。公司资产质量良好，经营性现金流量正常，能够为募投项目的实施提供基础保障。募集资金到位后，将进一步优化财务结构，提高公司整体盈利能力和抵御风险能

力。因此，本次募集资金投资项目与公司的财务状况相匹配。

3、与公司技术水平相匹配

目前，本次募集资金投资项目相关的核心技术均已成熟并实现产业化应用。公司已掌握 TC-SAW 滤波器的规模化量产技术（温漂系数降至 $-20\sim 0\text{ppm}/^\circ\text{C}$ ，Q 值提升 1.5~2 倍），并自主突破了 POI 材料制备关键技术（薄膜厚度不均匀性控制在 4% 以下，表面粗糙度优于 0.2nm），为 TF-SAW 滤波器的大规模量产奠定了材料与工艺基础。公司拥有自主开发的系列仿真软件，涵盖脉冲响应模型、耦合模理论、FEM/BEM、有限元级联、电磁场与热传导等多种理论模型，可支持全系列产品的精确仿真。报告期内，公司累计研发投入 16,649.26 万元，占累计营业收入比例为 9.80%；截至报告期末，累计获得授权专利 61 项（其中发明专利 40 项），两次荣获国家科学技术进步二等奖。公司建立了高效的研发体系，组建了 90 人的研发团队，能够为募投项目的顺利实施提供充分的技术保障。因此，本次募集资金投资项目与公司的技术水平相匹配。

4、与公司管理能力相匹配

公司拥有长期稳定的经营管理团队，核心管理人员刘平、王为标、陆增天等均具有数十年声表面波滤波器行业的研发、生产及运营经验，对行业发展趋势具有深刻理解。公司已建立完善的 IDM 全链条管理体系，覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试及材料制备各环节。近年来通过智能制造升级，关键工艺控制能力和全过程质量追溯能力持续提升，产品良率处于国内领先水平。公司已按照上市公司要求建立了规范的治理结构和内控制度，本次募集资金投资项目所涉及的扩产、研发、智能制造等事宜均在现有管理框架下具备成熟的实施经验。丰富的行业经验和高效的管理团队能够确保募投项目顺利推进。因此，本次募集资金投资项目与公司的管理能力相匹配。

5、与公司发展目标相匹配

公司确立了“产业规模与技术先进性双轮驱动”的战略发展目标，愿景是成为全场景射频滤波器解决方案的领先者。公司将持续深耕声表面波射频芯片领域，依托 IDM 模式优势，加快 TC-SAW、TF-SAW 等高性能滤波器的研发与量产进

程。本次募集资金投资项目中的 TC-SAW 及 TF-SAW 扩产项目直接推动高性能产品进一步规模化，研发中心建设项目布局下一代压电材料、模组封装以及高性能滤波器等技术，智能制造提升项目强化生产效能，补充流动资金保障战略实施。上述投资方向均围绕公司提升规模与技术先进性，引领声表面波滤波器国产替代的战略目标，能够与公司的发展目标相匹配。

综上，本次募集资金投资项目与公司的主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力及发展目标相适应，具有充分的必要性和可行性。

（四）募集资金投资项目与公司现有业务及核心技术之间的关系

本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有主营业务及核心技术体系，其中“年产 6 亿颗 TC-SAW 及 4 亿颗 TF-SAW 滤波器生产线扩建项目”依托公司已掌握的 TC-SAW 量产能力和 POI 材料自主制备技术，实现高性能滤波器产能的规模化扩张，是核心技术的规模化延伸；“研发中心建设项目”在公司现有研发体系和多款自主仿真软件基础上，聚焦下一代压电材料、模组封装及高性能滤波器等前瞻技术，为技术迭代提供储备；“智能制造能力提升项目”对公司现有 IDM 产线进行智能化升级，进一步提高良率、降低成本、缩短交付周期，强化制造优势；“补充流动资金”则为上述项目的实施及业务扩张提供运营资金保障，并有助于优化公司财务结构，降低资产负债率，保障负债情况健康，增强抗风险能力。四个项目相互协同，均服务于公司高性能滤波器国产替代及成为全场景射频滤波器解决方案的领先者的战略目标，不存在与现有业务或核心技术无关的情形。

（五）募集资金对发行人主营业务的贡献、未来经营战略的影响

本次募集资金投资项目将有力推动发行人主营业务的提质增效。一方面，通过 TC-SAW 和 TF-SAW 滤波器扩产，公司将快速提升高性能产品的产能规模，优化产品结构，提高高附加值产品收入占比，增强在国产替代进程中的供货能力；另一方面，研发中心与智能制造项目将夯实公司的技术基础和生产效率，加快下一代压电材料、模组封装、高性能滤波器等前瞻技术的产业化进程，同时通过智能化升级进一步提高良率、降低成本、缩短交付周期。补充流动资金则为上述项目的实施及日常运营提供稳健的资金保障，降低财务风险。

从未来经营战略看，募投项目的落地是实现公司“产业规模与技术先进性双轮驱动”战略的关键一步。公司将以高性能滤波器规模化量产为抓手，加快从 SAW 产品向 TC-SAW、TF-SAW 等高性能产品矩阵的切换，巩固在智能终端、物联网等核心市场的份额，并积极拓展 5G/6G 通信、汽车电子、低轨卫星通信、无人机等新兴应用领域。同时，通过深化 IDM 模式下的材料、设计、制造、封装全链条协同，公司逐步从分立器件供应商向成为全场景射频滤波器解决方案的领先者转型，为跻身全球射频滤波器领域领先企业奠定坚实基础。

（六）募集资金重点投向科技创新领域的具体安排

公司的募集资金主要投向为 TF-SAW（4 亿颗）及 TC-SAW（6 亿颗）扩产项目、研发中心建设项目、智能制造能力提升项目。为积极响应《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》中聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，采取超常规措施，全链条推动集成电路等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破，紧抓全球 5G 深化普及与万物互联时代的历史性机遇，本公司本次募集资金将精准、高效地投向科技创新领域的核心环节。具体安排为：一方面，大规模扩产具备高性能与高稳定性的 TF-SAW 与 TC-SAW 滤波器，扩产年产能合计达 10 亿颗，旨在快速填补国内高性能声表面波滤波器市场的供给缺口，突破海外技术壁垒，实现关键元器件的国产化替代与自主可控；另一方面，同步投入资源用于前沿技术研发中心的建设，旨在构建一个集基础材料研究、先进工艺开发与产品测试验证于一体的高水平创新平台，为公司中长期的技术迭代与产品创新注入持续动力。这一系列举措，是公司夯实核心技术竞争力、向产业链价值链高端攀升的必然选择，更是服务于国家科技自强战略、赋能数字经济高质量发展的关键一步。

（七）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响

本次募集资金投资项目的实施不会导致公司新增同业竞争，也不会对公司的独立性产生不利影响。

二、公司战略规划与未来发展目标

（一）公司战略规划与未来发展目标

在 5G/6G 通信、智能汽车与万物互联浪潮的推动下，声表面波滤波器已成为智能终端、通信基站及车载电子设备等应用领域不可或缺的核心元件。面对全球市场机遇与国产化替代的迫切需求，公司立志加速突破技术壁垒，实现从追赶者到引领者的跨越，成为全场景射频滤波器解决方案的领先者。为此，公司发展重点聚焦于实现产业规模与技术先进性的同步突破，同时布局未来产业生态。

1、产业规模与技术先进性双轮驱动，稳固市场领先地位

为实现企业的可持续发展与市场领先地位，我们将实施“深耕现有市场”与“突破瓶颈技术”双轨并行的战略路径。一方面，通过体系化的研发投入和持续的工艺优化，为智能终端、物联网、基站等客户提供高性价比的标准化产品，快速提升市场份额。另一方面，集中优势资源突破瓶颈技术，针对 5G/6G 通信、智能网联汽车、低轨卫星通信、无人机等新兴领域的需求，在不断迭代现有产品的基础上，集中优势资源加快 TC-SAW、TF-SAW 等高性能滤波器的研发与量产进程。

在战略执行层面，公司通过建立柔性化、智能化的生产能力，将市场应用从智能终端、基站等领域，横向拓展至物联网、汽车电子、低轨卫星通信等新兴领域，实现全方位的市场布局，构建具有强大市场竞争力的完整产品矩阵。这一战略布局将确保我们在保持现有市场优势的同时，在新兴领域建立先发优势，为企业的长期发展奠定坚实基础。

2、构建产业生态，引领下一代技术发展

公司还将致力于构建开放协同的产业创新生态系统。通过整合产业链上下游资源，建立从材料、设计、制造到封测的全链条协同创新体系，重点布局面向未来通信技术、低轨卫星通信、智能网联汽车等前沿领域的系统级解决方案，推动滤波器技术与射频前端的深度融合创新。同时积极参与行业标准制定，构建自主知识产权体系，培育产业创新生态。最终实现从技术追随者到标准制定者、从产品供应商到系统方案提供者的战略转型，成为全场景射频滤波器解决方案的领先

者，在全球射频滤波器产业格局中占据重要位置。

(二) 报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

1、核心技术实现规模化应用，产品结构与市场地位显著提升

公司持续加大研发投入，重点突破 TC-SAW 滤波器核心技术，成功解决了温度补偿薄膜沉积工艺、多层结构声波耦合机制等技术难题，使产品温度特性得到显著改善，温度漂移系数由-80~-40 ppm/°C优化至-20~0 ppm/°C。通过建立国内首条 TC-SAW 专用产线，公司已实现数十款 TC-SAW 滤波器与双工器的规模化量产，产品性能指标达到国际主流厂商水平。得益于技术突破与产能保障，公司 TC-SAW 系列产品已广泛应用于智能终端、物联网等领域的知名品牌客户，带动该类产品销售收入实现跨越式增长，收入占比逐年提高，成为公司业绩增长的核心动力，标志着公司在滤波器先进技术及领域实现了从技术突破到产业化成功的重要跨越。

2、IDM 模式与智能制造协同增效，保障高质量交付与成本竞争力

报告期内，公司充分发挥 IDM 模式的经营优势，通过建立研发与制造协同创新机制，实现了“工艺驱动设计”与“设计兼容制造”的双向赋能。公司持续推进智能制造平台建设，引入智能化制造控制系统，实现对关键工艺参数的实时监控和全过程质量追溯。同时通过持续优化生产工艺路线，精简制造流程，公司在滤波器制造的核心工序上取得显著进步，线条精度、膜厚均匀性等关键工艺能力持续提升。这些举措使公司在保持年产达到 60 亿颗滤波器产能的基础上，产品良率和一致性达到国内领先水平，有效控制了单位制造成本，为公司快速响应市场需求、保障稳定交付提供了坚实保障。

3、核心材料制备能力取得突破，构筑面向未来的技术壁垒

为布局下一代滤波器技术，公司前瞻性地开展 POI 衬底材料的自主研发，成功攻克了钽酸锂、铌酸锂等高性能压电薄膜的键合、减薄、抛光与均匀性控制等核心工艺难题。目前公司已实现多款高品质 POI 晶圆的自主制备，薄膜厚度不均匀性控制在 4%以内，表面粗糙度优于 0.2nm，达到国际先进水平。基于自研 POI 材料平台，公司开发出独具特色的横向模式自然抑制技术，有效规避了国外专利

限制，为开发高性能 TF-SAW 滤波器奠定了坚实基础。此项突破使公司形成了从材料制备到器件设计的完整技术闭环，强化了公司的核心技术壁垒。

（三）未来规划采取的措施

1、技术研发与创新突破

公司将持续加大研发投入，重点突破新一代滤波器核心技术。在现有技术基础上，我们将持续优化 TC-SAW 工艺并扩宽 TC-SAW 器件应用，加快推进 TF-SAW 滤波器的量产进程，着力攻克高频、大宽带、高功率滤波器的关键工艺难题。同时，积极布局基于新型压电材料的下一代器件技术，重点开发面向 6G 通信、低轨卫星通信等前沿领域的高性能滤波器产品。通过建立完善的研发创新体系，我们将持续推进产品迭代升级，确保在声表面波滤波器领域的技术领先地位。

2、人才队伍建设与培养

人才是公司发展的核心动力。公司将实施全方位的人才发展战略，在全球范围内引进滤波器领域的高层次技术人才和产业化专家。通过建立系统化的人才培养机制，我们将重点加强材料科学、系统架构、模组封装等方向的人才储备。同时，公司将优化创新激励机制，推行多元化激励方式，充分调动研发人员的创新积极性，打造一支具有国际视野和创新精神的技术团队。

3、产学研合作与生态构建

公司将深化与国内顶尖科研机构的战略合作，通过建立长期、稳定的合作关系，共同开展前沿技术研究。公司将重点布局新一代 POI 材料、新型声波器件结构等基础研究领域，推动技术创新与产业应用的深度融合。同时，公司将积极参与行业标准制定，推动自主技术方案成为行业标准；同时与产业链上下游企业建立紧密合作，共同构建健康可持续发展的产业生态。

第八节 公司治理与独立性

一、发行人内部控制情况

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2025年修订）《上市公司治理准则》（2025年修订）等相关规定的要求，逐步建立健全了股东会、董事会、独立董事、董事会秘书等制度，制定并完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《关联交易制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》等公司治理的相关制度，形成了规范的公司治理结构。此外，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化、高效化。

（一）公司管理层对内部控制的自我评估意见

公司结合自身经营特点，制定了一系列内部控制制度，内部控制制度设计合理、执行有效，从而保证了公司经营管理的正常进行。公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价，认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计并出具了无保留意见的《内部控制审计报告》（中汇会审[2026]10586号），报告的结论性意见为：发行人于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（三）公司报告期内财务内控不规范的情况

1、银行转贷

（1）银行转贷的基本情况

报告期内，外部或内部单位为公司提供转贷的情况如下：

期间	涉及走账通道的单位	走账通道的单位与公司关系	转贷金额（万元）
2024 年	瑞驿通	公司子公司	7,934.00
	盐城振弘	供应商	7,895.00
	东盛	供应商	600.00
	合计		16,429.00
2025 年	瑞驿通	公司子公司	13,748.00
	盐城振弘	供应商	2,000.00
	东盛	供应商	750.00
	合计		16,498.00

报告期内，因公司向银行申请贷款存在资金使用周期与银行一次性支付贷款时间不匹配、贷款要求与企业实际经营情况脱节等原因，公司存在外部或内部单位为公司提供贷款走账通道的情况。外部单位收到公司转贷资金，一般短期内便转回公司，双方未约定结算利息。收回转贷资金后，公司主要用于支付供应商款项。

（2）是否违反相关法律法规及后果、后续可能影响的承担机制

根据《贷款通则》《流动资金贷款管理暂行办法》相关规定，借款人应按借款合同规定用途使用贷款。发行人通过转贷或转贴现的形式取得银行贷款或贴现款的行为不符合其与银行签订的相关贷款合同约定以及《贷款通则》《流动资金贷款管理暂行办法》相关规定，但相关资金用途为补充发行人正常的资金需求，获取的银行贷款均用于发行人的主营业务，未用于证券投资、股权投资、房地产投入或国家禁止生产、经营的领域和用途，并且发行人已按照贷款合同的约定按时还本付息，从未发生逾期还款或其他任何违约事项，无骗取贷款的主观恶意，亦未损害银行的利益。在上述资金周转过程中，不存在相互输送利益或者损害各方利益的情形，未产生任何纠纷或潜在纠纷。

公司不存在骗取银行贷款的情形，公司转贷行为未侵犯其辖区内相关金融机构权益，未危害其辖区内金融安全与金融稳定。国家金融监督管理总局无锡监管分局已出具证明，确认 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，发行人未被国家金融监督管理总局无锡监管分局实施过行政处罚。

发行人转贷涉及银行已针对该事项出具文件，证明公司转贷事项相关借款合同

同均已履行完毕，不存在贷款逾期偿还等违约情形。

发行人控股股东及实际控制人已就上述转贷事项出具承诺，承诺若发行人因转贷行为受到主管政府部门的行政处罚或被要求承担其他责任，发行人控股股东及实际控制人将无条件全额承担应由发行人补缴或支付的全部罚款或赔偿款项，以及因上述事项而产生的应由发行人支付的所有相关费用。综上，发行人上述转贷的行为虽不符合《贷款通则》《流动资金贷款管理暂行办法》的相关规定，但发行人使用相关资金不存在重大违法违规情形，不存在潜在纠纷或承担相关法律责任的风险，上述情形不会对发行人本次发行并上市构成实质性法律障碍。

（3）整改措施、相关内控建立及运行情况等

发行人已按照《公司法》《贷款通则》《流动资金贷款管理暂行办法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及部门规章的要求，完善了关于银行贷款资金的使用管理，并积极按照相关内控制度要求严格履行内部控制流程。2025年12月后，发行人未再发生新的转贷行为；2025年12月后与转贷相关的贷款现已偿还完毕。

2、资金拆借

（1）资金拆借的基本情况

报告期内，公司资金拆借的明细情况如下：

资金拆出方	与公司关系	拆入资金（万元）			资金流向
		2025年	2024年	2023年	
好达投资	公司股东	-	595.00	-	银行、供应商等

2024年，因短期运营资金需求，公司向好达投资拆入595.00万元，用于偿还银行借款、购买原材料等。对于拆入资金，公司已于2025年5月全部偿还，2025年6月后，公司未发生新的资金拆入。

（2）是否违反相关法律法规及后果、后续可能影响的承担机制

发行人的资金拆借行为，违反了《贷款通则》有关规定，但是根据《中华人民共和国民法典》、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的

规定》相关规定，前述资金拆借不存在影响合同效力的情形，约定的利率符合相关规定。

发行人控股股东、实际控制人已出具承诺，若发行人因资金拆借行为受到主管政府部门的行政处罚或被要求承担其他责任，发行人控股股东、实际控制人将无条件全额承担应由发行人补缴或支付的全部罚款或赔偿款项，以及因上述事项而产生的应由发行人支付的所有相关费用。

鉴于资金拆借的效力在事实上受到司法实践保护，同时，发行人控股股东及实际控制人就上述资金拆借事项出具兜底承诺，上述资金拆借事项对本次发行不构成法律障碍。

(3) 整改措施、相关内控建立及运行情况等

针对与关联方或第三方的资金拆借，公司主要采取了以下整改措施：

①对于拆入资金，公司已于 2025 年 5 月全部偿还；2025 年 6 月后，公司未发生新的资金拆入；

②针对报告期内的关联资金拆借事项，发行人已召开股东会、董事会进行了确认，关联股东及关联董事均已回避表决，独立董事亦发表独立意见，履行了相应审议程序；

③组织发行人董事、高级管理人员及财务人员等深入学习《中华人民共和国民法典》、《贷款通则》、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规，提高资金管理安全性和使用规范性的意识；

④充分发挥审计委员会、内部审计部门的作用，通过开展自查自纠活动，规范资金的使用和管理。

发行人制定了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《财务管理制度》等制度，对发行人与关联方之间的资金拆借行为进行控制，同时为避免、减少和规范与发行人之间的关联交易，发行人控股股东、实际控制人出具了关于规范和减少关联交易的承诺。自上

述资金拆借清理完毕后，发行人按照上述规则或制度执行，未再发生公司与关联方或第三方之间进行资金拆借等非经营性资金占用的情形。

3、第三方回款

(1) 基本情况

报告期内，公司存在部分销售回款由第三方代客户支付的情形，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025年	2024年	2023年
第三方回款金额	3.80	2.09	11.77
营业收入	67,465.69	60,655.03	41,851.74
第三方回款占营业收入的比例	0.01%	0.00%	0.03%

报告期内，公司部分客户因①外汇管制、外汇出境手续繁琐等原因，由境外客户指定方付款或委托代理商等付款；②基于结算便利、资金临时性周转等因素考虑，部分客户货款由该客户委托法定代表人等代为支付，存在第三方回款的情况。

(2) 是否违反相关法律法规及后果、后续可能影响的承担机制

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的相关规定，公司与客户交易价款的支付方式系交易双方自主约定，法律法规未对交易价款的支付主体和支付方式作出限制性规定，公司客户出于便利性等原因，由第三方向公司直接支付交易价款，不存在违反《中华人民共和国民法典》等法律法规规定的情形。境外第三方回款方面，公司境外第三方回款基于真实的销售行为，报告期内不存在因境外第三方回款而受到国家外汇主管部门行政处罚的情形。综上，发行人第三方回款的形成原因系客户自身需求所致，存在商业合理性，未受到相关的行政处罚，不存在重大违法违规情形。

(3) 整改措施、相关内控建立及运行情况等

公司已通过完善与收款相关的内部控制制度，对第三方回款进行规范管理，同时公司严格执行相关内控制度，对第三方回款进行跟踪管理，财务内控制度健

全并有效执行。

4、现金交易

(1) 现金交易

报告期内，公司现金回款情况如下：

单位：万元

项目	2025年	2024年	2023年
现金回款的金额	7.01	2.01	2.06
营业收入	67,465.69	60,655.03	41,851.74
现金回款占营业收入的比例	0.01%	0.00%	0.00%

报告期各期，公司的现金回款的金额分别为 2.06 万元、2.01 万元和 7.01 万元，金额较小，主要为废品销售收入。

(2) 是否违反相关法律法规及后果、后续可能影响的承担机制

公司报告期内的现金交易均基于正常商品销售，具备商业合理性，不属于主观恶意行为、不存在相关争议或纠纷事项，不存在违反相关法律法规的情形。

发行人控股股东及实际控制人已就上述现金收支出具承诺，承诺若发行人因现金收支不规范行为受到主管政府部门的行政处罚或被要求承担其他责任，发行人控股股东及实际控制人将无条件全额承担应由发行人补缴或支付的全部罚款或赔偿款项，以及因上述事项而产生的应由发行人支付的所有相关费用。

(3) 整改措施、相关内控建立及运行情况等

报告期内，公司通过完善《财务管理制度》中关于货币资金管理的相关制度，明确现金使用范围、岗位职责、现金管理等，进一步规范现金交易，并减少现金交易行为。报告期内，公司现金交易金额较小，现金交易的相关制度得到了有效执行。

(四) 财务内控不规范行为对内部控制有效性的影响

发行人针对报告期内的财务内控不规范情形，已通过完善制度、组织培训、加强内控等方式进行积极纠正并整改，相关财务内控不规范行为均已整改完毕。

经过整改，发行人已建立健全相关内控制度并持续有效运行。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计并出具了无保留意见的《内部控制审计报告》（中汇会审[2026]10586号），报告的结论性意见为：发行人于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告期内发行人存在的上述财务内控不规范情形不属于主观故意或者恶意行为，不构成重大违法违规；上述财务内控不规范情形已经整改完毕，发行人已建立健全并有效实施配套内控制度，相关事项不会对发行人财务内控有效性产生重大不利影响。

二、公司报告期内违法违规行及受到处罚情况

（一）报告期内存在的重大违法违规行为

报告期内，公司严格按照法律法规的规定开展经营活动，不存在涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法违规行为以及受到主管部门行政处罚且情节严重的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或其他严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情况。

（二）报告期内受到的处罚情况

报告期内，公司受到的处罚情况如下：

1、安全生产处罚

2024年2月2日，无锡市应急管理局向发行人出具了《行政处罚决定书（单位）》（苏锡）应急罚[2023]174号，认定发行人存在以下两项安全生产违规行为：

- a. 发行人未与承包单位签订专门的安全生产管理协议、未对承包单位的工作统一协调、管理；
- b. 发行人未在20KV变电所内15组配电柜未张贴警示标志。

就上述a项行为，无锡市应急管理局认为发行人违反了《江苏省安全生产条

例》第三十条第一款的规定，并依据《江苏省安全生产条例》第七十四条及参照《江苏省安全生产行政处罚自由裁量适用细则》第二档的处罚标准，给予发行人罚款 32,000 元的处罚。

就上述 b 项行为，无锡市应急管理局认为发行人违反了《江苏省安全生产条例》第三十条第一款的规定，并依据《安全生产法》第九十九条及参照《江苏省安全生产行政处罚自由裁量适用细则》第三档的处罚标准，给予发行人罚款 46,250 元的处罚。

上述两项违规行为，发行人合计受到 75,250 元的罚款处罚，未受到没收违法所得、责令停产停业等情节严重情况导致的重大行政处罚，未被《行政处罚决定书（单位）》（苏锡）应急罚[2023]174 号认定为重大行政处罚，且未有导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。发行人已按时足额缴纳了罚款，相关违法行为已完成整改。根据无锡市公共信用信息中心出具的《无锡市社会法人专项信用报告（有无违法违规记录证明 2025 版）》，发行人在报告期内，不存在重大行政处罚。

综上，发行人上述安全生产违法行为不属于重大违法行为，不会对发行人本次发行上市构成法律障碍。

2、海关处罚

2023 年 4 月 19 日，中华人民共和国无锡海关出具《行政处罚决定书》（锡关缉违字[2023]0005 号），认定 2020 年 3 月 6 日至 2020 年 7 月 6 日期间，发行人以一般贸易方式申报进口全自动分选机共计 13 台，申报税号为 8479899990，进口关税税率为 0。经海关核查，上述设备用途为对含有芯片的半导体元器件测试、分选、编带，根据《进出口税则》中“8422400010 半导体检测分选编带机”的具体列名和总署 J2011-0005 号归类决定，实际税号应为 8422400010，进口关税税率为 5%。经无锡海关计核，涉案货物完税价格 14,368,096 元人民币，应纳税款 2,679,649.91 元人民币，发行人漏缴税款 811,797.43 元人民币，并因此科处行政处罚，共计罚款人民币 41 万元。

根据《海关法》《海关行政处罚实施条例》的相关规定，发行人上述行政处

罚事项属于“进出口货物应当申报的项目申报不实”的情形，系一般违反海关监管规定的行为，不构成重大违法违规。

另根据《海关行政处罚实施条例》第十五条之规定：“进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的，分别依照下列规定予以处罚，有违法所得的，没收违法所得：……（四）影响国家税款征收的，处漏缴税款30%以上2倍以下罚款……”。发行人上述漏缴税款行为根据其情节严重程度，应当被处以30%以上2倍以下罚款，发行人实际罚款金额为漏缴税款的约50%，在30%以上2倍以下罚款的罚款范围中，属于偏低罚款金额。

中华人民共和国南京海关出具《企业信用状况证明》，确认报告期内发行人未有涉及海关进出口领域的重大违法犯罪记录。

综上，发行人上述海关处罚不属于重大违法行为，不会对发行人本次发行上市构成法律障碍。

报告期内，除上述事项外，公司不存在其他受到行政处罚的情形。上述违法行为不属于重大违法违规行为，对公司经营活动不会造成重大不利影响。

三、发行人资金占用和对外担保情况

报告期内，公司与关联方之间的资金往来详情参见本节之“六、关联方、关联关系和关联交易”之“（二）报告期内的关联交易”之“2、偶发性关联交易”之“（2）关联方资金往来”。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

四、公司直接面向市场独立持续经营的能力

公司设立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与公司股东完全分开，具有独立完整的资产和业务及面向市场自主开发经营的能力，具备独立的供应、生产和销售系统。具体情况如下：

（一）资产完整

公司是由好达有限整体变更而来，依法承继了原有限公司的所有资产及业务。整体变更后，股份公司依法办理了相关资产的产权变更登记手续，具有开展生产经营所必备的独立、完整的资产。报告期内，公司资产权属清晰、完整，不存在对实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况。

（二）人员独立

公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，并根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况建立了独立、完整的财务核算体系，制定了符合上市公司要求的、规范的内部控制制度，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

（四）机构独立

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，拥有独立的经营和办公场所，各机构、部门在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，与实际控制人控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东干预公司机构设置和运行的情况。

（五）业务独立

公司主要从事声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售。公司拥有从事上述业务完整、独立的采购、研发、生产、销售体系，不存在对股东和其他关联方的依赖，具备独立面向市场、独立承担责任和风险的能力。公司的业务独立于实际控制人及其控制的其他企业，与实际控制人及其控制的其他企业不存在同业

竞争，不存在显失公平的关联交易。

（六）主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员变动情况

公司主营业务为声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售，最近 2 年内未发生变化。最近 2 年内，公司董事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大不利变化。控股股东和受实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，公司实际控制人为刘平，最近 2 年未发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

（七）影响持续经营的重大事项

截至报告期末，公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大资产权属纠纷，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

综上所述，公司在资产、人员、财务、机构和业务方面与股东及其关联方相互独立，拥有独立完整的业务体系，具有面向市场的独立经营能力。

五、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况

（一）公司与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争

本次发行前，公司控股股东好达投资除直接和间接持有好达电子股权外，不存在通过投资关系、其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体，与公司之间不存在同业竞争。

本次发行前，公司实际控制人刘平不存在通过投资关系、其他安排控制或重大影响持有任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体，与公司之间不存在同业竞争。

报告期内，公司实际控制人刘平除持有公司股份外，还控制好达投资和共进同达、共进同达二号、共进同达三号等 4 家企业。好达投资基本情况介绍参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、持有公司 5%以上股份的股东及

实际控制人的基本情况”之“（一）公司控股股东、实际控制人基本情况”。共进同达、共进同达二号、共进同达三号基本情况介绍参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、本次申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排”之“（一）股权激励情况”。

上述企业或经营主体与公司之间不存在实际从事相同、相似业务的情况，不存在同业竞争。

（二）避免新增同业竞争的承诺

控股股东好达投资、实际控制人刘平出具了《关于避免新增同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、本人/本机构除直接或间接持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。

2、本人/本机构今后也不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的企业。

3、如公司认定本人/本机构通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本人/本机构将及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本人/本机构应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。

4、本人/本机构保证不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。

上述承诺自即日起具有法律效力，对本人/本机构具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，本人/本机构愿意承担法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本人/本机构不再对公司有重大影响为止。”

六、关联方、关联关系和关联交易

（一）关联方与关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规关于关联方和关联关系的有关规定，截至本招股说明书签署日，发行人的主要关联方及关联关系列示如下：

1、直接或者间接控制发行人的自然人、法人或其他组织

（1）控股股东、实际控制人

公司控股股东为好达投资、实际控制人为刘平，其基本情况参见“第四节 发行人基本情况”之“七、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况”之“（一）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

（2）控股股东、实际控制人控制的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织

好达投资不存在控制其他企业的情形，刘平控制的其他企业均为发行人的员工持股平台，其基本情况参见“第四节 发行人基本情况”之“七、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况”之“（一）公司控股股东、实际控制人基本情况”之“5、控股股东和实际控制人控制的其他企业”。

2、直接或者间接持有发行人 5%以上股份的自然人

除实际控制人刘平外，其他直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人如下：

序号	名称	关联关系
1	刘博	直接持有发行人 11.2368%的股份，担任公司董事、总经理
2	黄辉	直接持有公司 5.4688%的股份
3	刘思羽	通过持有好达投资股份间接持有公司 5%以上股份；公司实际控制人刘平之女儿

3、发行人董事、历史监事、高级管理人员

公司董事、历史监事、高级管理人员的具体情况参见本招股说明书“第四节

发行人基本情况”之“十一、董事、历史监事、高级管理人员与核心技术人员”。其中历史监事系公司报告期内曾存在的关联方。截至本招股说明书签署日，公司已取消监事会，不设监事。

4、上述第（一）至（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成员

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律法规及规范性文件规定，公司实际控制人、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人、公司的董事、历史监事或高级管理人员关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母为公司的关联方。

5、直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人

除公司控股股东外，直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人如下：

序号	名称	关联关系
1	共进同达	直接持有公司 7.0072%的股份
2	小米基金	直接持有公司 5.2533%的股份
3	摩勤智能	摩勤智能直接持有公司 3.8039%的股份，宽联投资直接持有公司 3.8039%的股份，宽联投资与摩勤智能受上海奥勤信息科技有限公司同一控制
4	宽联投资	

6、直接或间接控制发行人的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人

公司控股股东为好达投资，刘平担任好达投资执行董事兼总经理，刘思羽担任好达投资监事，华建芬为好达投资财务负责人。

7、上述第（一）至（六）项所列关联法人或关联自然人直接或者间接控制，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员、共同控制或施加重大影响的法人或其他组织，但发行人及其控股子公司除外

序号	名称	关联关系
1	射阳外国语学校	董事长刘平持有 28.75%的股权
2	江苏翔鹤园农业发展有限公司	公司董事长配偶华建芬持有 100%的股权

序号	名称	关联关系
3	深圳市春宇无线科技有限公司	董事、总经理刘博持有 25.00%的股权
4	达波新材	首席技术官、副总经理、职工代表董事王为标担任董事的企业
5	合泰盟方电子（深圳）股份有限公司	董事晏胜担任董事的企业
6	嘉兴景焱智能装备技术有限公司	董事倪谅担任董事的企业
7	宁波卢米蓝新材料有限公司	董事倪谅担任董事的企业
8	科大智能（合肥）科技有限公司	董事倪谅担任董事的企业
9	新港海岸（北京）科技有限公司	董事姚海锋担任董事的企业
10	裕太微电子股份有限公司	董事姚海锋担任董事的企业
11	英创新材料（绍兴）有限公司	董事姚海锋担任董事的企业
12	杰华特微电子股份有限公司	董事姚海锋担任董事的企业；原董事方伟曾担任董事的企业
13	上海为众永光会计师事务所（普通合伙）	董事涂武根持有 50%的股权
14	上海图瑞精密电子有限公司	董事涂武根持有 31.25%的股权
15	无锡瀛达商务咨询有限公司	董事程德兵持有 90%的股权
16	无锡市修明量宇科技有限公司	董事程德兵持有 20.00%的股权
17	江苏顾垣得医疗科技有限公司	董事程德兵持有 20.00%的股权
18	口袋瀛恒（无锡）科技产业发展有限公司	董事程德兵持有 20.00%的股权
19	江苏瀛恒律师事务所	董事程德兵担任法定代表人的企业
20	泉州蔓星鸿石股权投资合伙企业（有限合伙）	财务负责人黄宇峰持有 39.61%的股权
21	东莞华誉精密技术有限公司	摩勤智能控制的企业
22	南昌春勤精密技术有限公司	摩勤智能控制的企业
23	广东省西勤精密模具有限公司	摩勤智能控制的企业
24	西安创趣信息技术有限公司	摩勤智能控制的企业
25	广东省勤享科技有限公司	摩勤智能控制的企业
26	东莞市西品精密模具有限公司	摩勤智能控制的企业
27	东莞市华誉光电科技有限公司	摩勤智能控制的企业
28	上海螺趣科技有限公司	摩勤智能控制的企业
29	南昌昌勤精密技术有限公司	摩勤智能控制的企业
30	东莞欣宏贯金属科技有限公司	摩勤智能控制的企业
31	深圳昊勤机器人科技有限公司	摩勤智能控制的企业
32	惠州豪成科技有限公司	摩勤智能控制的企业
33	广东昊勤机器人科技有限公司	摩勤智能控制的企业

序号	名称	关联关系
34	广州昊勤机器人科技有限公司	摩勤智能控制的企业
35	惠州豪成技术有限公司	摩勤智能控制的企业

如未特别说明，除上表所列关联方外，第（一）至（六）项所列关联法人或关联自然人直接或者间接控制的，或者由第（一）至（六）项所列关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员、共同控制或施加重大影响的法人或其他组织亦为公司关联方。

8、间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人

间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织如下：

序号	名称	关联关系
1	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司	小米基金的执行事务合伙人，小米基金为直接持有公司 5%以上股份的股东
2	上海奥勤信息科技有限公司	通过持有摩勤智能和宽联投资股份间接持有公司 5%以上的股份

如未特别说明，能够间接控制公司 5%以上表决权的法人或其他组织及其一致行动人亦为公司关联方。

9、发行人子公司及参股公司

截至本招股说明书签署日，公司拥有 1 家子公司，2 家参股公司，其基本情况参见“第四节 发行人基本情况”之“六、公司控股子公司、参股子公司基本情况”。

序号	名称	关联关系
1	瑞驿通	发行人全资子公司
2	达波新材	发行人持有 26.4766%的股权
3	达波科技（上海）有限公司	达波新材的全资子公司
4	凡麒微	发行人持有 8.3249%的股权
5	苏州凡麒微电子有限公司	凡麒微的全资子公司

10、其他关联方

根据实质重于形式原则认定的其他与发行人有特殊关系，可能导致发行人利益对其倾斜的自然人、法人或其他组织，包括但不限于：

序号	名称	备注
1	小米通讯技术有限公司	与小米基金存在关系 ^注
2	北京小米电子产品有限公司	
3	小米商业保理（天津）有限责任公司	
4	天星（天津）商业保理有限公司	
5	华勤技术股份有限公司	上海奥勤信息科技有限公司控股子公司
6	南昌华勤电子科技有限公司	华勤技术股份有限公司子公司
7	东莞华贝电子科技有限公司	华勤技术股份有限公司控股子公司
8	南昌勤胜电子科技有限公司	华勤技术股份有限公司子公司
9	上海勤允电子科技有限公司	华勤技术股份有限公司子公司

注：小米通讯技术有限公司、北京小米电子产品有限公司、小米商业保理（天津）有限责任公司、天星（天津）商业保理有限公司为雷军控制的企业。小米基金执行事务合伙人为湖北小米长江产业投资基金管理有限公司，根据公开资料查询，湖北小米长江产业投资基金管理有限公司受雷军间接控制。

11、公司曾存在的关联方及关联方变化情况

截至本招股书签署日，与公司曾经具有关联关系的其他关联自然人和关联法人的情况主要如下：

序号	名称	曾经存在的关联关系	备注
1	何仕英	董事或高级管理人员	已于 2023 年 6 月辞任
2	吴浩东		已于 2023 年 6 月辞任
3	姜羿山		已于 2023 年 8 月辞任
4	盛建宏		已于 2024 年 1 月辞任
5	张建兴		已于 2025 年 7 月辞任
6	方伟		已于 2025 年 11 月辞任
7	袁建平	公司监事	已于 2023 年 6 月辞任
8	思福易	控股子公司	发行人在报告期内持有 51% 的股权，于 2023 年 7 月全部退出
9	济南晶正电子科技有限公司	原董事方伟担任董事	方伟、何仕英、姜羿山、盛建宏已辞任
10	锐石创芯（重庆）科技股份有限公司	原董事方伟担任董事；原董事何仕英曾担任董事	
11	瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司	原董事方伟担任董事	
12	山东天岳先进科技股份有限公司	原董事方伟曾担任董事	
13	重庆物奇微电子股份有限公司	原董事方伟担任董事；原董事盛建宏曾担任董事	

序号	名称	曾经存在的关联关系	备注
14	深迪半导体（绍兴）有限公司	原董事方伟曾担任董事； 原董事姜羿山曾担任董事	
15	辽宁中蓝电子科技有限公司	原董事方伟曾担任董事； 原董事姜羿山曾担任董事； 原董事盛建宏曾担任董事	
16	武汉昱升光电股份有限公司	原董事方伟曾担任董事	
17	南京中江新材料科技有限公司	原董事方伟曾担任董事	
18	上海安其威微电子科技有限公司	原董事方伟担任董事	
19	北京中科海钠科技有限责任公司	原董事方伟担任董事	
20	宁波赛墨科技有限公司	原董事方伟担任董事	
21	南通山口精工股份有限公司	原董事方伟曾担任董事； 原董事盛建宏曾担任董事	
22	上扬软件（上海）有限公司	原董事方伟曾担任董事	
23	上海本诺电子材料有限公司	原董事方伟担任董事	
24	南京芯视界微电子科技有限公司	原董事方伟担任董事； 原董事盛建宏曾担任董事	
25	北京清程极智科技有限公司	原董事方伟曾担任董事	
26	中电科技德清华莹电子有限公司	原董事方伟曾担任董事	
27	新港海岸（北京）科技有限公司	原董事方伟曾担任董事	
28	北京面壁智能科技有限责任公司	原董事方伟曾担任董事	
29	苏州东微半导体股份有限公司	原董事方伟曾担任董事	
30	广东富信热电器件科技有限公司	原董事方伟曾担任董事	
31	北京云道智能科技股份有限公司	原董事方伟曾担任董事	
32	湖南浩威特科技发展有限公司	原董事方伟曾担任董事	
33	成都睿宝电子科技有限公司	原董事方伟曾担任董事	
34	苏州凡赛特材料科技有限公司	原董事何仕英担任董事	
35	上海傅里叶半导体股份有限公司	原董事何仕英曾担任董事	
36	南昌英力精密制造有限公司	原董事何仕英曾担任董事	
37	光弘科技（投资）有限公司	原董事何仕英担任董事	
38	正弘电子有限公司	原董事何仕英担任董事	
39	常州富烯科技股份有限公司	原董事姜羿山曾担任董	

序号	名称	曾经存在的关联关系	备注
		事	
40	阜阳欣奕华新材料科技股份有限公司	原董事盛建宏曾担任董事	
41	北京昂瑞微电子技术股份有限公司	原董事盛建宏曾担任董事	
42	东莞羽笙科技有限公司	原董事盛建宏曾担任董事	
43	吉林求是光谱数据科技有限公司	原董事盛建宏曾担任董事	
44	哈勃投资	直接持有公司 5.2533% 的股份	哈勃投资持股比例变更为 4.9934%
45	华为投资控股有限公司	通过持有哈勃投资间接持有公司 5% 以上股份	
46	A 公司及其关联方	与报告期内持股 5% 以上的股东存在关联关系, 根据实质重于形式原则认定的其他与发行人有特殊关系, 可能导致发行人利益对其倾斜的自然人、法人或其他组织	-
47			
48			
49			
50			

除上表所列示之外, 在交易发生之日前 12 个月内, 或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内, 存在的上述过往关联法人曾直接或者间接控制的法人或其他组织亦为公司的过往关联方; 在交易发生之日前 12 个月内, 或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内, 存在的上述过往关联自然人及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织亦为公司的过往关联方。

(二) 报告期内的关联交易

报告期内, 公司关联交易汇总情况如下:

单位: 万元

关联交易性质	2025 年	2024 年	2023 年
经常性关联交易			
销售商品	11,376.54	10,966.10	10,457.07
采购商品	143.02	63.04	117.09
关键管理人员薪酬 (含股份支付)	830.51	1,278.46	1,066.76
关联租赁-公司出租	97.32	108.00	180.13

关联交易性质	2025年	2024年	2023年
偶发性关联交易			
关联担保	具体情况参见本节之“六、关联方、关联关系和关联交易”之“（二）报告期内的关联交易”之“2、偶发性关联交易”之“（1）关联担保”		
关联方资金往来	具体情况参见本节之“六、关联方、关联关系和关联交易”之“（二）报告期内的关联交易”之“2、偶发性关联交易”之“（2）关联方资金往来”		
应收账款保理和债权凭证贴现形成的贴息	具体情况参见本节之“六、关联方、关联关系和关联交易”之“（二）报告期内的关联交易”之“2、偶发性关联交易”之“（3）债权凭证转让、应收账款保理”		

1、经常性关联交易

（1）关联销售

报告期内，公司关联销售情况如下：

单位：万元

关联方	销售内容	2025年		2024年		2023年	
		金额	营业收入占比	金额	营业收入占比	金额	营业收入占比
华勤	滤波器、双工器	8,299.73	12.30%	6,265.49	10.33%	4,626.87	11.06%
A公司及其关联方	滤波器、双工器	1,774.31	2.63%	3,938.05	6.49%	5,784.25	13.82%
小米	滤波器、双工器	1,276.69	1.89%	553.15	0.91%	30.24	0.07%
晶正电子	受托验证服务	14.00	0.02%	-	-	-	-
凡麒微	滤波器、双工器	11.81	0.02%	209.41	0.35%	15.71	0.04%
合计		11,376.54	16.86%	10,966.10	18.08%	10,457.07	24.99%

注：1、华勤包括南昌华勤电子科技有限公司、东莞华贝电子科技有限公司、上海勤允电子科技有限公司、南昌勤胜电子科技有限公司；2、小米包括小米通讯技术有限公司、北京小米电子产品有限公司；3、晶正电子为济南晶正电子科技有限公司。

报告期内，公司向关联方销售金额合计分别为 10,457.07 万元、10,966.10 万元和 11,376.54 万元，占营业收入的比重分别为 24.99%、18.08%和 16.86%。

公司关联销售对方主要为华勤、A 公司和小米。华勤系全球消费电子 ODM 领域领先的厂商；小米系国际知名手机终端品牌。公司主营产品为声表面波滤波器、双工器，主要应用场景包括手机，公司向上述关联方销售滤波器、双工器具

备合理性及必要性。

上述关联交易定价系根据具体产品在关联方客户处面临的竞争情况，同时考虑客户行业地位、业务合作规模、未来合作预期等因素与关联方客户协商确定，价格公允。

(2) 关联采购

报告期内，公司关联采购情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2025年	2024年	2023年
济南晶正电子科技有限公司	晶片	59.36	62.57	45.40
中电科技德清华莹电子有限公司	晶片	51.06	-	5.60
苏州凡麒微电子有限公司	模组	14.75	-	-
上海凡麒微电子有限公司	晶圆颗粒、模组	12.71	-	61.70
达波科技（上海）有限公司	晶片	5.13	-	-
无锡市思福易半导体设备有限公司	配件、服务费	-	0.47	4.39
合计		143.02	63.04	117.09

报告期内，公司向关联方采购的产品主要为晶片，按市场价格采购，采购金额较小。

(3) 关联租赁

报告期内，公司作为出租方出租给关联方资产的情况如下：

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	2025年	2024年度	2023年度
上海凡麒微电子有限公司	设备	97.32	108.00	173.08
无锡市思福易半导体设备有限公司	房屋	-	-	7.05

公司租赁给凡麒微的设备主要是机器设备和电子设备，其用于开展经营，按账面价值定价；租给思福易的房屋用于办公，租赁价格参照市场价格协商确定，不存在显失公允的情形。

(4) 关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2025年	2024年	2023年
关键管理人员薪酬	830.51	1,278.46	1,066.76
其中：工资薪金总额	830.51	866.02	648.38
股份支付总额	-	412.44	418.38

2、偶发性关联交易**(1) 关联担保**

报告期内，公司存在接受实际控制人刘平向公司提供担保的情况，具体如下：

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘平	881.34	2023/11/29	2024/2/6	是
刘平	1,200.00	2023/12/20	2024/4/19	是
刘平	867.69	2024/2/4	2024/6/19	是
刘平	800.00	2024/3/29	2024/7/19	是
刘平	643.00	2024/6/7	2024/9/19	是
刘平	463.00	2024/7/10	2024/10/18	是
刘平	787.80	2024/7/19	2024/10/18	是
刘平	518.50	2024/8/7	2024/11/19	是
刘平	445.80	2024/8/23	2024/11/19	是
刘平	784.50	2024/9/20	2024/12/19	是
刘平	805.70	2024/10/24	2025/1/17	是
刘平	653.50	2024/11/22	2025/2/19	是
刘平	1,179.90	2025/1/6	2025/4/19	是
刘平	415.00	2025/2/11	2025/5/19	是
刘平	511.00	2025/3/12	2025/6/19	是
刘平	369.00	2025/3/27	2025/6/19	是
刘平	641.00	2025/4/18	2025/7/19	是
刘平	800.00	2025/5/22	2025/8/19	是
刘平	602.20	2025/6/18	2025/9/19	是
刘平	1,315.00	2025/6/30	2025/10/15	是

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘平	1,184.00	2025/8/1	2025/10/15	是
刘平	903.00	2025/8/27	2025/11/19	是
刘平	855.00	2025/9/22	2025/12/19	是
刘平	519.00	2025/10/21	2025/12/30	是
刘平	930.00	2024/9/18	2024/10/8	是
刘平	1,180.00	2024/9/18	2024/10/31	是
刘平	2,500.00	2024/10/31	2025/10/10	是
刘平	925.00	2025/4/25	2025/10/10	是
刘平	1,000.00	2025/10/13	2025/12/30	是
刘平	1,600.00	2025/10/13	2026/10/12	否
刘平	4,978.21	2025/10/27	2027/10/26	否
刘平	23,884.56	2025/3/31	2033/3/31	否
刘平	145.00	2025/3/31	2025/5/21	是
刘平	342.44	2025/3/31	2025/11/21	是
刘平	5,000.00	2023/7/19	2025/4/18	是
刘平	5,000.00	2023/9/20	2025/6/17	是
刘平	3,000.00	2023/5/17	2023/9/22	是
刘平	5,000.00	2023/6/7	2024/3/25	是
刘平	2,000.00	2023/6/19	2025/5/19	是
刘平	10,000.00	2024/1/15	2025/7/11	是
刘平	3,000.00	2024/7/30	2025/10/30	是
刘平	1,250.00	2024/7/9	2025/10/9	是
刘平	1,750.00	2024/7/9	2027/7/8	否

(2) 关联方资金往来

报告期内，公司与关联方之间存在非经营性资金往来行为，具体情况如下：

单位：万元

非经营性 资金往来	年度	往来对方	期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额
	2025年	好达投资	205.00	-	205.00	-
	2024年	好达投资	-	595.00	390.00	205.00

应付关联方利息	年度	往来对方	期初利息 余额	本期借款 利息	本期归还 利息	期末利息 余额
	2025年	好达投资	7.91	2.78	10.69	-
	2024年	好达投资	-	7.91	-	7.91

(3) 债权凭证转让、应收账款保理

① 债权凭证转让融资

2023 年度，公司因偿还银行贷款、支付供应商货款等短期资金需要，将收到的龙旗电子（惠州）有限公司合计 1,654.70 万元未到期电子债权凭证通过小米供应链金融平台进行贴现，发行人收到小米商业保理（天津）有限责任公司支付款项 1,629.33 万元，该贴现业务的贴现利息为 25.37 万元。

2024 年度，公司因偿还银行贷款、支付供应商货款等短期资金需要，将收到的龙旗电子（惠州）有限公司合计 2,906.87 万元未到期电子债权凭证通过小米供应链金融平台进行贴现，发行人收到小米商业保理（天津）有限责任公司支付款项 2,873.47 万元，该贴现业务的贴现利息为 33.40 万元，公司将收到的龙旗电子（惠州）有限公司合计 1,484.01 万元未到期电子债权凭证通过天星供应链金融平台进行贴现，发行人收到天星（天津）商业保理有限公司支付款项 1,463.13 万元，该贴现业务的贴现利息为 20.88 万元。

2025 年度，公司因偿还银行贷款、支付供应商货款等短期资金需要，将收到的龙旗电子（惠州）有限公司合计 719.62 万元未到期电子债权凭证通过天星供应链金融平台进行贴现，发行人收到天星（天津）商业保理有限公司支付款项 717.80 万元，该贴现业务的贴现利息为 1.82 万元。

2025 年度，公司因偿还银行贷款、支付供应商货款等短期资金需要，将收到的小米通讯技术有限公司合计 683.74 万元未到期电子债权凭证通过天星供应链金融平台进行贴现，发行人收到小米商业保理（天津）有限责任公司支付款项 676.53 万元，该贴现业务的贴现利息为 7.21 万元。

② 应收账款转让融资

2024 年度，公司因偿还银行贷款、支付供应商货款等短期资金需要，将应收龙旗电子（惠州）有限公司合计 9,174.22 万元未到信用期货款质押于天星供应

链金融平台进行融资，发行人收到天星（天津）商业保理有限公司支付融资金额 7,216.38 万元，该融资业务的融资利息为 196.47 万元，报告期内已全部偿还，截至 2024 年末剩余融资本息合计额度为 1,761.37 万元。

2025 年度，公司因偿还银行贷款、支付供应商货款等短期资金需要，将应收龙旗电子（惠州）有限公司合计 3,008.07 万元未到信用期货款新增质押于天星供应链金融平台进行融资，连同 2024 年末剩余 1,761.37 万元融资额度，合计融资本息额度为 4,769.44 万元，发行人收到天星（天津）商业保理有限公司支付融资金额 3,911.34 万元，该融资业务的融资利息为 105.93 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，本金及利息报告期内已全部偿还。

2025 年度，公司因偿还银行贷款、支付供应商货款等短期资金需要，将小米通讯技术有限公司共计 1,479.01 万元未到信用期货款质押于天星供应链金融平台进行融资，公司收到天星（天津）商业保理有限公司支付融资金额 720.00 万元，该业务的融资利息为 4.69 万元。

3、关联方应收应付情况

(1) 关联应收款项情况

单位：万元

项目名称	关联方名称	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南昌勤胜电子科技有限公司	2,972.62	148.63	-	-	-	-
	A 公司及其关联方	950.25	47.51	1,023.07	51.15	3,059.50	152.98
	小米通讯技术有限公司	374.95	18.75	280.93	14.05	-	-
	东莞华贝电子科技有限公司	63.46	3.17	2,459.39	122.97	2,333.27	116.66
	南昌华勤电子科技有限公司	2.08	0.59	2.08	0.20	4.44	0.22
	北京小米电子产品有限公司	-	-	1.45	0.07	1.85	0.09
应收票据	东莞华贝电子科技有限公司	766.97	38.35	-	-	295.84	14.79
预付款项	无锡市思福易半导体设备有限公司	-	-	-	-	45.44	-

(2) 关联应付款项情况

单位：万元

项目名称	关联方名称	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
应付账款	济南晶正电子科技有限公司	5.16	47.05	26.68
	上海凡麒微电子有限公司	30.69	-	-
	中电科技德清华莹电子有限公司	27.53	-	-
	达波科技（上海）有限公司	2.40	-	-
其他应付款	上海凡麒微电子有限公司	5.61	5.61	5.61
	无锡市好达投资有限公司	-	212.91	-
	达波科技（上海）有限公司	42.00	-	-
	苏州达波新材科技有限公司	28.00	-	-
合同负债	小米通讯技术有限公司	-	-	449.99

(三) 公司报告期关联交易的执行情况

公司在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》中已经明确规定了关联交易的决策权限、程序、关联交易的信息披露等事项，建立了相对完善的决策机制和监督体系。

公司已召开董事会和股东会对 2023 年至 2025 年的关联交易事项予以确认。独立董事对关联交易履行审议程序的合法性及交易价格的公允性发表了意见。独立董事认为：公司 2023 年至 2025 年关联交易符合公司实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观、公允，关联交易公平、合理，有利于公司的业务发展，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。

(四) 公司关于规范关联交易和减少关联交易的措施

公司依照《公司法》等法律、法规建立了规范、健全的法人治理结构，公司制定的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等规章制度，对关联交易决策权力和程序作出了详细的规定，有利于公司规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正。此外，公司建立健全了规范的独立董事制度；董事会成员中有 3 位独立董事，有利于公司董事会的独立

性和公司治理机制的完善。公司的独立董事将在规范和减少关联交易方面发挥重要作用，积极保护公司和中小投资者的利益。

实际控制人刘平先生出具承诺，将采取措施以确保关联交易公允和减少关联交易，保证发行人的利益不受侵犯：

“本人将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，遵循公平合理的商业原则，处理与公司之间的关联交易，保证不会发生显失公平的关联交易或通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。

本人均将严格遵守和按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司章程的有关规定行使股东权利，在公司股东会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，本人履行回避表决的义务。

本人承诺不以任何方式违法违规占用公司的资金、资产。

如本人违反本承诺，导致公司受到损害的，本人将无条件对公司受到的全部损失承担连带责任。

本人将促使本人控制（直接或间接）的其他企业按照与本人同样的标准遵守以上承诺事项。”

第九节 投资者保护

一、本次发行完成前滚存利润的分配安排

根据公司 2025 年第七次临时股东会决议：公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享，累计未弥补亏损由发行后的新老股东按照发行后的持股比例相应承担。

二、发行后的股利分配政策

公司召开 2025 年第七次临时股东会审议通过《公司章程（草案）》，公司上市后的利润分配政策主要内容如下：

“第一百六十一条 公司利润分配政策如下：

（一）公司利润分配原则

公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对全体股东的合理投资回报并兼顾公司的持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的方式分配股利，现金分红优先于其他分红方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（三）现金分红条件和比例

满足以下条件的，公司应该进行现金分配：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配的利润为正值；

(3) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(4) 公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）（重大资金现金支出是指：①公司未来 12 个月内拟实施对外投资、收购资产、购买设备、购买土地或其它交易的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；或②公司未来 12 个月内拟实施对外投资、收购资产、购买设备、购买土地或其它交易的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；下同）。

(5) 未出现公司股东会审议通过确认的不适宜分配利润的其他特殊情况。

在满足上述现金分红条件时，公司每年应当以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

公司制定分配方案时，应以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第 3 项的规定处理。

在满足现金分红条件的情况下，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东会审议决定。公司董事会可以根据公司

的盈利状况及资金需求提议进行中期利润分配。

（四）公司发放股票股利的具体条件

根据公司可持续发展的实际情况，董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司采取股票方式分配股利的条件为：（1）公司经营情况良好；（2）因公司具有成长性、股本规模和经营规模不相适应、有重大投资计划或重大现金支出等真实合理因素，以股票方式分配股利有利于公司和股东整体利益；（3）不违反公司的现金分红政策。

（五）公司利润分配方案的审议程序

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数董事表决通过，并提交股东会审议。

审计委员会应对董事会拟定的利润分配方案进行审议，并经审计委员会全体委员过半数表决通过。

董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

股东会审议利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过；公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，公司当年利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表决权的

三分之二以上通过。

公司应切实保障中小股东参与股东大会的权利，在公司股东大会对利润分配方案进行审议前，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（六）公司利润分配政策的变更

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，行业监管政策，自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化确实需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

（七）公司利润分配政策的实施

1、公司应当严格按照证券监管部门的有关规定，在年度报告中披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：（1）是否符合章程的规定或者股东会决议的要求；（2）分红标准和比例是否明确和清晰；（3）相关的决策程序和机制是否完备；（4）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。公司对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

2、公司当年盈利但董事会未作出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，董事会会议的审议和表决情况。

公司总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东会股权登记日之前，在公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的，应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会，就相关事项与媒体、股东特别是持有公司股份的机构投资者、中小

股东进行沟通和交流、及时答复媒体和股东关心的问题。

3、公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因。

（八）股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

三、发行前后股利分配政策的差异情况

本次发行前后股利分配政策的差异在于进一步完善了发行人发行上市后的利润分配政策。发行后的股利分配政策更重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，进一步明确了公司股利分配的审议程序、利润分配方案的调整等约定，加强了对投资者利益的保护。

四、存在累计未弥补亏损情况的投资者保护措施

截至 2025 年 12 月末，公司累计未弥补亏损为-458,185,185.91 元，预计首次公开发行股票并上市后，发行人账面累计未弥补亏损将持续存在，导致一定时期内无法向股东进行现金分红。发行人已在本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“1、持续亏损和存在累计未弥补亏损的风险”中，披露了持续亏损和存在累计未弥补亏损的风险。发行人已制定了明确的战略规划，并针对保障持续经营能力、提高盈利水平制定了清晰的经营策略，未来，发行人将会把握市场发展机遇，以规范运作、科学管理提升盈利能力，并在达到分红条件后，回报全体股东。

此外，发行人的主要股东和董事、高级管理人员及核心技术人员亦做出了关于减持股票所做的承诺，参见本招股说明书“附件二、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、高级管理人员及其他核心技术人员以及保荐人、证券服务机构作出的重要承诺及其履行情况和约束措施”。

第十节 其他重要事项

一、重大合同

(一) 销售合同

公司及其子公司与销售客户一般签订框架性的销售合同，合同中就双方合作关系、履行期限等作出约定，而就产品规格、数量、货款金额、支付方式等具体内容则通过订单的形式予以确定。因此公司对单个客户销售金额超过 1,000 万元的年度所涉及的框架合同。

报告期各期，发行人及其控股子公司与客户签订的重大销售合同情况如下：

序号	销售主体	客户名称	合同标的	签订日期	履行期限	合同履行情况
1	好达电子	深圳市华凯科技开发有限公司	以订单为准	2022 年 12 月 7 日	自 2023 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，甲方保留提前终止合约的权利，如甲方欲提前终止本合同，经三个月前以书面通知乙方后即可生效。	履行完毕
2	好达电子	深圳市华凯科技开发有限公司	以订单为准	2024 年 12 月 23 日	自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，甲方保留提前终止合约的权利，如甲方欲提前终止本合同，经三个月前以书面通知乙方后即可生效。	履行完毕
3	好达电子	深圳市普荣实业有限公司	以订单为准	2022 年 12 月 13 日	自 2023 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，甲方保留提前终止合约的权利，如甲方欲提前终止本合同，经三个月前以书面通知乙方后即可生效。	履行完毕
4	好达电子	深圳市普荣实业有限公司	以订单为准	2024 年 12 月 18 日	自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，甲方保留提前终止合约的权利，如甲方欲提前终止本合同，经三个月前以书面通知乙方后即可生效。	履行完毕
5	好达电子	华勤技术股份有限公司（东莞华贝电子科技有限公司、南昌华勤电子科技有限公司、华勤通讯香港有限公司、上海勤允电子科技有限公司、南昌勤胜电子科技有限公司、上海勤芸电子	以订单为准	2022 年 1 月 11 日	本协议自生效之日（2022 年 1 月）起【三（3）】年内（2025 年 1 月）有效。若协议双方均未在本协议终止前【九十（90）】日发出终止本协议的书面通知，则该协议自动延续【一（1）】年，自动延续到期后依照前述规定处理，循环次数不限。从本协议生效之日起，本协议应取代双方曾经签订或可能签订过的《原材料采购框架协议》。本协议更改及修正须采	正在履行

序号	销售主体	客户名称	合同标的	签订日期	履行期限	合同履行情况
		科技有限公司以加入协议方式加入本协议)			用书面形式经双方授权代表签字并盖章。	
6	好达电子	龙旗电子(惠州)有限公司	以订单为准	2020年4月22日	本协议有效期自双方加盖公章(或合同专用章)之日起生效,至本协议买卖双方的权利和义务履行完毕之日止。	履行完毕
7	好达电子	龙旗电子(惠州)有限公司	以订单为准	2024年3月20日	本协议有效期自双方盖章之日起生效,至本协议买卖双方的权利和义务履行完毕之日止。	正在履行
8	好达电子	深圳市南盟电子有限公司	以订单为准	2022年12月9日	自2023年1月1日起至2023年12月31日止,甲方保留提前终止合约的权利,如甲方欲提前终止本合同,经三个月前以书面通知乙方后即可生效。	履行完毕
9	好达电子	深圳市南盟电子有限公司	以订单为准	2023年12月15日	自2024年1月1日起至2024年12月31日止,甲方保留提前终止合约的权利,如甲方欲提前终止本合同,经三个月前以书面通知乙方后即可生效。	履行完毕
10	好达电子	深圳市南盟电子有限公司	以订单为准	2024年12月18日	自2025年1月1日起至2025年12月31日止,甲方保留提前终止合约的权利,如甲方欲提前终止本合同,经三个月前以书面通知乙方后即可生效。	履行完毕
11	好达电子	A公司	以订单为准	2020年3月10日	本MPA自生效之日起【三(3)】年内有效。若协议双方均未在本MPA终止前【六十(60)】日(2022年11月20日)发出终止本MPA的书面通知,则该MPA及正在执行的SOW、PO自动延续【一(1)】年,自动延续的次数不限。	履行完毕
12	好达电子	A公司	以订单为准	2024年2月6日	本协议自生效日期(2024年2月6日)起生效,有效期五(5)年(2029年2月5日)。除非任何一方在本协议有效期或任何续约有效期到期前九十(90)日向另一方发出终止协议的书面通知,则本协议有效期自动延续五(5)年,延续次数不限。	正在履行
13	好达电子	上海蕊逸电子科技有限公司	以订单为准	2022年12月7日	自2023年1月1日起至2023年12月31日止,甲方保留提前终止合约的权利,如甲方欲提前终止本合同,经三个月前以书面通知乙方后即可生效。	履行完毕
14	好达电子	上海蕊逸电子科技有限公司	以订单为准	2023年12月15日	自2024年1月1日起至2024年12月31日止,甲方保留提前终止合约的权利,如甲方欲提前终止本合同,经三个月前以书面通知乙方后即可生效。	履行完毕

序号	销售主体	客户名称	合同标的	签订日期	履行期限	合同履行情况
					可生效。	
15	好达电子	上海蕊逸电子科技有限公司	以订单为准	2024年12月18日	自2025年1月1日起至2025年12月31日止,甲方保留提前终止合约的权利,如甲方欲提前终止本合同,经三个月前以书面通知乙方后即可生效。	履行完毕
16	好达电子	上海实呈电子科技有限公司	以订单为准	2023年12月15日	自2024年1月1日起至2024年12月31日止,甲方保留提前终止合约的权利,如甲方欲提前终止本合同,经三个月前以书面通知乙方后即可生效。	履行完毕
17	好达电子	上海实呈电子科技有限公司	以订单为准	2024年12月18日	自2025年1月1日起至2025年12月31日止,甲方保留提前终止合约的权利,如甲方欲提前终止本合同,经三个月前以书面通知乙方后即可生效。	履行完毕
18	好达电子	深圳锐趣电子科技有限公司	以订单为准	2022年12月7日	自2023年1月1日起至2024年12月31日止,甲方保留提前终止合约的权利,如甲方欲提前终止本合同,经三个月前以书面通知乙方后即可生效。	履行完毕
19	好达电子	深圳锐趣电子科技有限公司	以订单为准	2024年12月20日	自2025年1月1日起至2025年12月31日止,甲方保留提前终止合约的权利,如甲方欲提前终止本合同,经三个月前以书面通知乙方后即可生效。	履行完毕
20	好达电子	小米通讯技术有限公司(珠海小米通讯技术有限公司、Xiaomi H.K. Limited 通过加入方式加入本协议)	以订单为准	2024年10月28日	本合同应由双方加盖公章或合同专用章后于本合同封面所载之生效日日期开始生效,除非根据本合同约定提前终止,有效期【一(1)】年。如果双方均未在有效期届满前六十(60)日书面通知对方终止合同的视为同意续期,本合同将自动延续【一(1)】年,自动延续次数无限制。	正在履行
21	好达电子	香港天诚发展有限公司	以订单为准	2024年12月26日	自2025年1月1日起至2025年12月31日止,甲方保留提前终止合约的权利,如甲方欲提前终止本合同,经三个月前以书面通知乙方后即可生效。	履行完毕
22	好达电子	重庆欧珀集采科技有限公司	以订单为准	2023年6月28日	本协议由双方加盖公章或合同专用章之后,于签署之日起生效,自双方终止合作且各方义务均履行完毕时止。	正在履行
23	好达电子	深圳市中兴康讯电子有限公司	以订单为准	2021年8月26日	本协议双方签订后长久有效,当一方提出终止或变更时,须提前30天书面通知对方并应经对方同意。	正在履行

序号	销售主体	客户名称	合同标的	签订日期	履行期限	合同履行情况
24	好达电子	B 公司	以订单为准	2022 年 1 月 1 日	有效期为 3 年, 并于到期后自动续期 3 个月。若协议任何一方想在有效期内解除协议, 须提前 3 个月以书面的形式通知另一方, 协议自书面通知到达对方之日起解除。	履行完毕
25	好达电子	深圳市星辰嘉科技有限公司	以订单为准	2022 年 12 月 8 日	自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止, 甲方保留提前终止合约的权利, 如甲方欲提前终止本合约, 经三个月前以书面通知乙方后即可生效。	履行完毕

(二) 采购合同

1、原材料采购合同

公司及子公司与供应商一般签订框架性的采购合同, 合同中就双方合作关系、履行期限作出约定, 而就产品规格、数量、货款金额、支付方式等具体内容则通过订单的形式予以确定。因此公司对单个供应商采购金额超过 1,000 万元的年度所涉及的框架合同为重大原材料采购合同。

报告期各期, 发行人及其控股子公司与供应商签订的重大原材料采购合同情况如下:

序号	采购主体	供应商名称	合同标的	签订日期	履行期限	合同履行情况
1	瑞驿通	天通凯巨科技有限公司	以订单为准	2025 年 6 月 1 日	本协议自签订之日起生效, 有效期 1 年。期限届满之日, 如双方之间还有尚未履行完毕的生效订单, 则本协议的有效期自动延续至前述订单履行完毕之日止。	履行完毕
2	好达电子	苏州阿尔泰克电子科技有限公司	以订单为准	2024 年 1 月 1 日	本协议自双方盖章之日起生效, 有效期 1 年。除非任何一方在协议有效期届满前至少三十天书面通知另一方其不续签的意愿, 否则本协议将自动续期一年。	履行完毕
3	好达电子	盐城晶弘电子材料有限公司	以订单为准	2024 年 11 月 1 日	本协议自双方盖章之日起生效, 有效期 1 年。除非任何一方在协议有效期届满前至少三十天书面通知另一方其不续签的意愿, 否则本协议将自动续期一年。	正在履行

序号	采购主体	供应商名称	合同标的	签订日期	履行期限	合同履行情况
4	好达电子	安捷利美维电子（厦门）有限责任公司	以订单为准	2024年1月1日	本协议自双方盖章之日起生效，有效期1年。除非任何一方在协议有效期届满前至少三十（30）天书面通知另一方其不续签的意愿，否则本协议将自动续期一年（1年）。	履行完毕
5	好达电子	广州美维电子有限公司	以订单为准	2022年1月1日	本协议自双方盖章之日起生效，有效期1年。除非任何一方在协议有效期届满前至少三十（30）天书面通知另一方其不续签的意愿，否则本协议将自动续期一年（1年）。	履行完毕
6	好达电子	天通控股股份有限公司	以订单为准	2023年1月1日	本协议自签订之日起生效，有效期1年。期限届满之日，如双方之间还有尚未履行完毕的生效订单，则本协议的有效期自动延续至前述订单履行完毕之日止。	履行完毕
7	好达电子	天通控股股份有限公司	以订单为准	2024年1月1日	本协议自签订之日起生效，有效期1年。期限届满之日，如双方之间还有尚未履行完毕的生效订单，则本协议的有效期自动延续至前述订单履行完毕之日止。	履行完毕
8	好达电子	盐城市振弘电子材料厂	以订单为准	2024年1月4日	本协议自双方盖章之日起生效，有效期1年。除非任何一方在协议有效期届满前至少三十（30）天书面通知另一方其不续签的意愿，否则本协议将自动续期一年（1年）。	履行完毕
9	好达电子	厦门佳达微集成电路有限公司	以订单为准	2024年1月1日	本协议自双方盖章之日起生效，有效期1年。除非任何一方在协议有效期届满前至少三十（30）天书面通知另一方其不续签的意愿，否则本协议将自动续期一年（1年）。	履行完毕
10	好达电子	四川泰美克科技有限公司	以订单为准	2025年4月3日	本协议自双方盖章之日起生效，有效期1年。除非任何一方在协议有效期届满前至少三十（30）天书面通知另一方其不续签的意愿，否则本协议将自动续期一年（1年）。	正在履行

序号	采购主体	供应商名称	合同标的	签订日期	履行期限	合同履行情况
11	好达电子	宁波康强电子股份有限公司	以订单为准	2024年1月1日	本协议自双方盖章之日起生效，有效期1年。除非任何一方在协议有效期届满前至少三十（30）天书面通知另一方其不续签的意愿，否则本协议将自动续期一年（1年）。	履行完毕

2、设备采购合同

报告期内，公司及其子公司已履行和正在履行的金额在1,000.00万元以上的设备采购合同情况如下：

序号	采购主体	供应商名称	采购内容	合同金额	合同日期	合同履行情况
1	好达电子	Evatec AG	磁控溅射设备	295.00 万美元	2023年12月22日	履行完毕
2	好达电子	苏州阿尔泰克电子科技有限公司	全自动划片机	1,300.00 万元	2025年12月12日	正在履行
3	好达电子	苏州阿尔泰克电子科技有限公司	投影式光刻机	1,450.00 万元	2025年12月12日	履行完毕
4	好达电子	Evatec AG	磁控溅射设备	295.00 万美元	2025年12月24日	正在履行

（三）授信合同

报告期内，发行人及其控股子公司已履行和正在履行的合同金额在3,000.00万元以上的重大银行授信合同情况如下：

序号	授信申请人	授信银行	授信金额	有效期	合同履行情况
1	好达电子	招商银行股份有限公司无锡分行	10,000.00 万元	2022年9月20日至2023年9月19日	履行完毕
2	好达电子	招商银行股份有限公司无锡分行	13,000.00 万元	2023年1月4日至2025年1月3日	履行完毕
3	好达电子	中国银行股份有限公司无锡滨湖支行	15,000.00 万元	2023年3月21日至2023年11月1日	履行完毕
4	好达电子	中国光大银行股份有限公司无锡分行	15,000.00 万元	2022年3月28日至2025年3月27日	履行完毕
5	好达电子	中国民生银行股份有限公司无锡分行	8,000.00 万元	2023年2月28日至2024年2月27日	履行完毕
6	好达电子	中国银行股份有限公司无锡滨湖支行	3,867.00 万元	2024年2月28日至2025年11月5日	履行完毕
7	好达电子	中国银行股份有限公司无锡滨湖支行	3,867.00 万元	2024年11月8日至2025年11月3日	履行完毕
8	好达电子	中国光大银行股份有限公司无锡分行	15,000.00 万元	2025年6月17日至2028年6月16日	正在履行

序号	授信申请人	授信银行	授信金额	有效期	合同履行情况
9	好达电子	中国民生银行股份有限公司无锡分行	6,000.00 万元	2025 年 5 月 27 日至 2026 年 5 月 26 日	正在履行
10	好达电子	中国银行股份有限公司无锡滨湖支行	3,000.00 万元	2025 年 11 月 17 日至 2026 年 11 月 5 日	正在履行

(四) 借款合同

报告期内，发行人及其控股子公司已履行和正在履行的合同金额在 3,000.00 万元以上的重大借款合同如下：

序号	贷款主体	借款方	借款金额	借款期间	合同履行情况
1	好达电子	南京银行股份有限公司无锡分行	7,000.00 万元	2022 年 4 月 19 日至 2023 年 4 月 18 日	履行完毕
2	好达电子	中国农业银行股份有限公司无锡滨湖分行	3,000.00 万元	2022 年 9 月 30 日至 2023 年 9 月 29 日	履行完毕
3	好达电子	中国农业银行股份有限公司无锡滨湖分行	4,000.00 万元	2022 年 4 月 27 日至 2023 年 4 月 26 日	履行完毕
4	好达电子	兴业银行股份有限公司无锡分行	5,000.00 万元	2022 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 20 日	履行完毕
5	好达电子	兴业银行股份有限公司无锡分行	3,000.00 万元	2022 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 10 日	履行完毕
6	好达电子	中国银行股份有限公司无锡滨湖支行	3,000.00 万元	2022 年 1 月 10 日至 2023 年 1 月 9 日	履行完毕
7	好达电子	中国银行股份有限公司无锡滨湖支行	4,000.00 万元	2022 年 2 月 7 日至 2023 年 2 月 6 日	履行完毕
8	好达电子	交通银行股份有限公司无锡分行	3,000.00 万元	2023 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 28 日	履行完毕
9	好达电子	中国民生银行股份有限公司无锡分行	7,000.00 万元	2023 年 2 月 28 日至 2025 年 2 月 26 日	履行完毕
10	好达电子	招商银行股份有限公司无锡分行	3,000.00 万元	2023 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 14 日	履行完毕
11	好达电子	中国光大银行股份有限公司无锡分行	3,000.00 万元	2024 年 9 月 26 日至 2025 年 6 月 24 日	履行完毕
12	好达电子	交通银行股份有限公司无锡分行	3,000.00 万元	2024 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 17 日	履行完毕
13	好达电子	中国光大银行股份有限公司无锡支行	4,000.00 万元	2022 年 9 月 7 日至 2024 年 9 月 6 日	履行完毕
14	好达电子	中国光大银行股份有限公司无锡支行	3,000.00 万元	2022 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 11 日	履行完毕
15	好达电子	中国农业银行股份有限公司无锡滨湖分行	3,000.00 万元	2024 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 26 日	履行完毕
16	好达电子	兴业银行股份有限公司无锡分行	4,000.00 万元	2024 年 2 月 22 日至 2025 年 2 月 17 日	履行完毕
17	好达电子	中国光大银行股份有限公司无锡支行	4,000.00 万元	2022 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 25 日	履行完毕

序号	贷款主体	借款方	借款金额	借款期间	合同履行情况
18	好达电子	中国光大银行股份有限公司无锡支行	3,000.00 万元	2025 年 6 月 17 日至 2027 年 6 月 16 日	正在履行
19	好达电子	中国光大银行股份有限公司无锡支行	3,000.00 万元	2025 年 6 月 24 日至 2027 年 6 月 23 日	正在履行
20	好达电子	中国光大银行股份有限公司无锡支行	3,200.00 万元	2025 年 6 月 27 日至 2027 年 6 月 26 日	正在履行
21	好达电子	兴业银行股份有限公司无锡分行	3,500.00 万元	2025 年 6 月 20 日至 2026 年 6 月 19 日	正在履行
22	好达电子	中国银行股份有限公司无锡滨湖支行	25,000.00 万元	借款期限 60 个月，自 实际提款日起算；若 为分期提款，则自第 一个实际提款日起算	正在履行
23	好达电子	交通银行股份有限公司无锡分行	3,000.00 万元	2025 年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 17 日	正在履行

（五）融资租赁合同

报告期内，公司及其子公司已履行和正在履行的合同金额在 3,000.00 万元以上的重大融资租赁情况如下：

序号	承租人	出租人	融资金额	租赁期间	合同履行情况
1	好达电子	交银金融租赁有 限责任公司	3,000.00 万元	2023 年 8 月 31 日 起 36 个月	履行完毕
2	好达电子	交银金融租赁有 限责任公司	7,000.00 万元	2023 年 9 月 19 日 起 36 个月	履行完毕
3	好达电子	无锡金控融资租 赁有限公司	3,000.00 万元	2023 年 5 月 10 日 起 36 个月	履行完毕
4	好达电子	无锡金控融资租 赁有限公司	5,000.00 万元	2023 年 6 月 15 日 起 36 个月	履行完毕
5	好达电子	芯鑫融资租赁有 限责任公司	5,000.00 万元	2023 年 3 月 20 日 起 36 个月	正在履行
6	好达电子	芯鑫融资租赁有 限责任公司	5,000.00 万元	2023 年 4 月 14 日 起 36 个月	履行完毕
7	好达电子	芯鑫融资租赁有 限责任公司	5,000.00 万元	2023 年 7 月 19 日 起 36 个月	履行完毕
8	好达电子	芯鑫融资租赁有 限责任公司	5,000.00 万元	2023 年 9 月 20 日 起 36 个月	履行完毕
9	好达电子	苏州禾裕融资租 赁有限公司	4,000.00 万元	2024 年 3 月 25 日 起 24 个月	履行完毕
10	好达电子	芯鑫融资租赁有 限责任公司	3,000.00 万元	2024 年 7 月 9 日 起 36 个月	正在履行
11	好达电子	芯鑫融资租赁有 限责任公司	3,000.00 万元	2024 年 7 月 30 日 起 36 个月	履行完毕
12	好达电子	浙江浙银金融租 赁有限责任公司	4,000.00 万元	2024 年 4 月 20 日 起 24 个月	履行完毕
13	好达电子	中关村科技租赁	4,500.00 万元	2024 年 12 月 18 日	履行完毕

		有限公司		起 24 个月	
14	好达电子	中信金融租赁有限公司	10,000.00 万元	2024 年 1 月 15 日起 36 个月	履行完毕
15	好达电子	交银金融租赁有限责任公司	4,000.00 万元	2025 年 5 月 15 日起 36 个月	正在履行
16	好达电子	芯鑫融资租赁有限责任公司	4,950.00 万元	2025 年 6 月 24 日起 36 个月	正在履行
17	好达电子	芯鑫融资租赁有限责任公司	4,000.00 万元	2025 年 12 月 24 日起 24 个月	正在履行
18	好达电子	交银金融租赁有限责任公司	3,700.00 万元	2025 年 12 月 31 日起 36 个月	正在履行

(六) 重大关联担保合同

报告期内，公司及其子公司已履行和正在履行的合同金额在 3,000.00 万元以上的重大关联担保合同情况如下：

序号	担保方	被担保方	债权人/受益人	担保金额	保证期间	合同履行情况
1	刘平	好达电子	无锡金控商业保理有限公司	3,000.00 万元	债务履行期限届满之日起三年	履行完毕
2	刘平	好达电子	无锡金控商业保理有限公司	5,000.00 万元	债务履行期限届满之日起三年	履行完毕
3	刘平	好达电子	无锡金控融资租赁有限公司	3,000.00 万元	本合同项下的保证期间为自主合同项下的债务履行期限届满之日后满【三】年时止。承租人在主合同项下的债务履行期限如有变更,则保证期间为变更后的债务履行期限届满之日后满【三】年时止	履行完毕
4	刘平	好达电子	无锡金控融资租赁有限公司	5,000.00 万元	本合同项下的保证期间为自主合同项下的债务履行期限届满之日后满【三】年时止。承租人在主合同项下的债务履行期限如有变更,则保证期间为变更后的债务履行期限届满之日后满【三】年时止	履行完毕
5	刘平	好达电子	无锡太湖新城商业保理有限公司	4,500.00 万元	保证人的保证期间为主合同项下的各笔债务履行期限届满之日起三年	正在履行
6	刘平	好达电子	芯鑫融资租赁有限责任公司	5,000.00 万元	自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	履行完毕
7	刘平	好达电子	芯鑫融资租赁有限责任公司	5,000.00 万元	自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届	履行完毕

					满之日起两年	
8	刘平	好达电子	芯鑫融资租赁有限责任公司	3,000.00 万元	自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	履行完毕
9	刘平	好达电子	芯鑫融资租赁有限责任公司	3,000.00 万元	自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	正在履行
10	刘平	好达电子	兴业银行股份有限公司无锡分行	17,206.00 万元	债务履行期限届满之日起三年	正在履行
11	刘平	好达电子	中信金融租赁有限公司	10,000.00 万元	自本合同生效之日起至主合同项下中信金最后一期被担保债务履行期限届满之日起三年	履行完毕
12	刘平	好达电子	中国银行股份有限公司无锡滨湖支行	25,000.00 万元	本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年	正在履行

二、公司对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保情况。

三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项

报告期内，公司作为一方当事人并可能对公司产生一定影响的诉讼或仲裁事项如下：

1、村田“表面声波装置及其制造方法”（专利号：200410075163.2）发明专利相关诉讼争议

国家知识产权局于 2022 年 12 月作出第 59827 号《无效宣告请求审查决定书》，宣告涉案村田专利全部无效。公司关于侵害发明专利权纠纷民事诉讼、发明专利权无效行政诉讼均获得胜诉。

2、村田“表面声波滤波器和通信设备”（专利号：200410005583.3）发明专利相关诉讼争议

国家知识产权局于 2024 年 1 月作出第 566790 号《无效宣告请求审查决定书》，宣布涉案村田专利权全部无效。公司关于侵害发明专利权纠纷民事诉讼胜诉、发明专利无效行政诉讼一审程序获得胜诉，发明专利无效行政诉讼二审程序已经开庭，但尚未判决。

3、村田“分波装置”（专利号：ZL201280047249.7）发明专利相关诉讼争议

2023年8月，上海知识产权法院判决被告公司、上海实呈电子科技有限公司立即停止对原告村田所享有的“分波装置”（专利号 ZL201280047249.7）发明专利权的侵害，公司赔偿村田经济损失及合理费用合计70万元，并驳回村田的其他诉讼请求。2023年9月，公司向最高人民法院提出上诉，2025年12月，最高人民法院作出判决驳回上诉，维持原判。

2022年12月，国家知识产权局作出第59803号《无效宣告请求审查决定书》，宣布涉案专利维持专利权有效。2023年3月，发行人以国家知识产权局为被告，以村田为第三人，向北京知识产权法院提起发明专利权无效行政诉讼。2024年6月，北京知识产权法院作出判决驳回公司的诉讼请求。2024年7月，公司不服上述一审行政判决，向最高人民法院提出上诉，2025年12月，最高人民法院作出判决驳回上诉，维持原判。

涉诉专利技术非公司核心技术，案件不利诉讼结果不会对公司核心技术造成重大不利影响，发行人报告期内不涉及该涉诉产品的销售，因此不利诉讼结果对发行人的生产经营影响较小。

除上述情况外，发行人不存在报告期内发生或虽在报告期外发生但仍对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁的相关情况；发行人不存在涉及主要产品、核心商标、专利、技术等方面的诉讼或仲裁可能对发行人生产经营造成重大影响的情形，或者诉讼、仲裁有可能导致发行人实际控制人变更，或者其他可能导致发行人不符合发行条件的情形。

四、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人不存在作为一方当事人的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。


截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

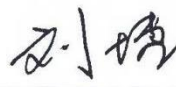
第十一节 声明

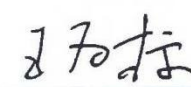
一、董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

发行人全体董事签字：


刘平


刘博


王为标

倪谅

姚海锋

晏胜

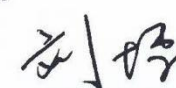
汤立国

涂武根

程德兵

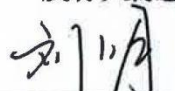
发行人全体审计委员会成员签字：

涂武根



刘博

程德兵

发行人除董事、审计委员会成员外的高级管理人员：


刘明


王骏


丁艳


黄宇峰


陆增天


无锡市好达电子股份有限公司
2026年5月29日



一、董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

发行人全体董事签字：

刘平	刘博	王为标
		
倪凉	姚海锋	晏胜
汤立国	涂武根	程德兵

发行人全体审计委员会成员签字：

涂武根	刘博	程德兵
-----	----	-----

发行人除董事、审计委员会成员外的高级管理人员：


刘明	王骏	丁艳
黄宇峰	陆增天	



一、董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

发行人全体董事签字：

_____	_____	_____
刘平	刘博	王为标
_____		_____
倪谅	姚海锋	晏胜
_____	_____	_____
汤立国	涂武根	程德兵

发行人全体审计委员会成员签字：

_____	_____	_____
涂武根	刘博	程德兵

发行人除董事、审计委员会成员外的高级管理人员：

_____	_____	_____
刘明	王骏	丁艳
_____	_____	
黄宇峰	陆增天	

无锡市好达电子股份有限公司


2026年5月29日



一、董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

发行人全体董事签字：

_____ 刘平	_____ 刘博	_____ 王为标 
_____ 倪谅	_____ 姚海锋	_____ 晏胜
_____ 汤立国	_____ 涂武根	_____ 程德兵

发行人全体审计委员会成员签字：

_____ 涂武根	_____ 刘博	_____ 程德兵
--------------	-------------	--------------

发行人除董事、审计委员会成员外的高级管理人员：

_____ 刘明	_____ 王骏	_____ 丁艳
_____ 黄宇峰	_____ 陆增天	

无锡市好达电子股份有限公司

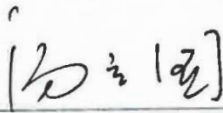
2026年5月29日



一、董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

发行人全体董事签字：

_____ 刘平	_____ 刘博	_____ 王为标
_____ 倪谅	_____ 姚海锋	_____ 晏胜
_____  汤立国	_____ 涂武根	_____ 程德兵

发行人全体审计委员会成员签字：

_____ 涂武根	_____ 刘博	_____ 程德兵
--------------	-------------	--------------

发行人除董事、审计委员会成员外的高级管理人员：

_____ 刘明	_____ 王骏	_____ 丁艳
_____ 黄宇峰	_____ 陆增天	



一、董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

发行人全体董事签字：

_____ 刘平	_____ 刘博	_____ 王为标
_____ 倪谅	_____ 姚海锋	_____ 晏胜
_____ 汤立国	_____ 涂武根	_____ 程德兵

发行人全体审计委员会成员签字：

_____ 涂武根	_____ 刘博	_____ 程德兵
--------------	-------------	--------------

发行人除董事、审计委员会成员外的高级管理人员：

_____ 刘明	_____ 王骏	_____ 丁艳
_____ 黄宇峰	_____ 陆增天	

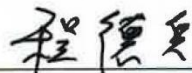
无锡市好达电子股份有限公司
2026年5月29日
3202000013177



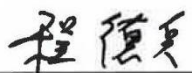
一、董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

发行人全体董事签字：

_____ 刘平	_____ 刘博	_____ 王为标
_____ 倪谅	_____ 姚海锋	_____ 晏胜
_____ 汤立国	_____ 涂武根	_____  程德兵

发行人全体审计委员会成员签字：

_____ 涂武根	_____ 刘博	_____  程德兵
--------------	-------------	---

发行人除董事、审计委员会成员外的高级管理人员：

_____ 刘明	_____ 王骏	_____ 丁艳
_____ 黄宇峰	_____ 陆增天	

无锡市好达电子股份有限公司

2026年5月29日



二、控股股东、实际控制人声明

本公司（或本人）承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：无锡市好达投资有限公司

法定代表人签名：

刘平

实际控制人签名：

刘平

无锡市好达电子股份有限公司

2026年5月27日

三、保荐人（主承销商）声明

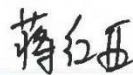
本公司已对招股说明书进行核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：



周栋

保荐代表人签名：



蒋红亚



李凯

法定代表人签名：



徐春



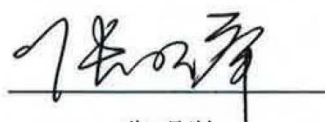
国联民生证券承销保荐有限公司

2026年5月29日

四、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明

本人已认真阅读无锡市好达电子股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理签字：



张明举

董事长签字：



徐春

国联民生证券承销保荐有限公司

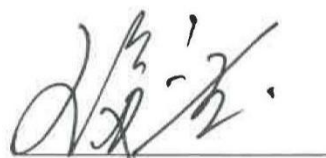
2026年 5 月 29 日



五、联席主承销商声明

本公司已对招股说明书进行核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

法定代表人：



王苏望



六、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读无锡市好达电子股份有限公司招股说明书, 确认无锡市好达电子股份有限公司招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在无锡市好达电子股份有限公司招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议, 确认无锡市好达电子股份有限公司招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。



负责人: _____

王 丽

承办律师: _____

张振宇

承办律师: _____

张 磊

2026年5月29日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读无锡市好达电子股份有限公司的招股说明书,确认招股说明书与本所出具的《审计报告》(中汇会审[2026]10585号)、《内部控制审计报告》(中汇会审[2026]10586号)及经本所鉴证的非经常性损益明细表(以下统称“报告及说明”)无矛盾之处。本所及签字注册会计师对无锡市好达电子股份有限公司在招股说明书中引用的上述报告及说明的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



会计师事务所负责人:



签字注册会计师:


中国注册会计师
周贵人
110603530092

签字注册会计师:


中国注册会计师
刘跃飞
320100082113

2026年5月29日

八、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书, 确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议, 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师: _____
谢刚凯 (已离职)



资产评估机构负责人: _____
徐峰

A handwritten signature in black ink, appearing to be "徐峰".

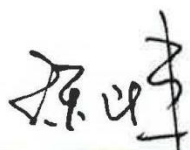


签字资产评估师的离职声明

本机构就首次公开发行股票并在科创板上市出具的资产评估报告之签字资产评估师谢刚凯因个人原因已从本机构离职。

特此声明。

资产评估机构负责人：



徐峰



验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读无锡市好达电子股份有限公司的招股说明书,确认招股说明书与本所出具的《验资报告》(中汇会验[2025]9084号)无矛盾之处。本所及签字注册会计师对无锡市好达电子股份有限公司在招股说明书中引用的上述报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



会计师事务所负责人:


高峰

签字注册会计师:


中国注册会计师
荆跃飞
320100482113

签字注册会计师:


中国注册会计师
王惠康
330000140383

2026年5月29日

第十二节 附件

一、备查文件

- (一) 发行保荐书；
- (二) 上市保荐书；
- (三) 法律意见书；
- (四) 财务报告及审计报告；
- (五) 公司章程（草案）；
- (六) 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；
- (七) 发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、高级管理人员及其他核心技术人员以及保荐人、证券服务机构作出的重要承诺及其履行情况和约束措施；
- (八) 股东会、董事会、历史监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况；
- (九) 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；
- (十) 募集资金投资项目具体情况；
- (十一) 内部控制审计报告；
- (十二) 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- (十三) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、查询时间及地点

投资者可以在公司和保荐机构处查阅本招股说明书的附件，相关文件并会在上海证券交易所指定披露网站（www.sse.com.cn）上披露。

（一）发行人：无锡市好达电子股份有限公司

地址：无锡市滨湖经济技术开发区高运路 115 号

电话：0510-85629111

时间：周一至周五，9:00-17:00

（二）保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司

地址：上海市浦明路 8 号

电话：021-80508866

时间：周一至周五，9:00-17:00

附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 股东投票机制建立情况

（一）股东投票机制的建立情况

1、累积投票制

公司已建立累积投票选举董事的机制。公司股东会在选举或者更换两名及以上董事时，根据《公司章程（草案）》的规定，可以实行累积投票制。累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

2、中小投资者单独计票机制

公司已建立中小投资者单独计票机制。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

3、网络投票制

股东会将设置会场，以现场会议形式召开，还可以同时采用电子通信方式召开。公司还将提供网络或其他通讯方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

4、征集投票权

公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。

（二）投资者关系的主要安排情况

为切实提高公司的规范运作水平，充分保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，公司制定了相关制度和措施以保护投资者的合法利益。

1、内部信息披露制度和流程的建立健全情况

为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程（草案）》等有关规定，2025年11月9日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《无锡市好达电子股份有限公司信息披露管理制度》，该制度明确了信息披露的基本原则和一般规定、内容及披露标准、责任划分等，该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。

2、投资者沟通渠道的建立情况

为进一步规范和加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司了解和认识，强化公司与投资者之间的良性互动关系，提升公司形象，完善公司治理结构，形成良好的回报投资者的企业文化，切实保护投资者的利益，2025年11月9日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《投资者关系管理制度》。

公司由董事会秘书担任投资者关系管理的直接负责人；董秘办是公司负责投资者关系管理的常设机构，由董事会秘书领导，作为公司信息汇集和对外披露的部门，负责投资者关系管理的具体工作。

3、未来开展投资者关系管理的规划

为完善公司治理结构，规范投资者关系管理工作，加强与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的内容方式、投资者关系管理责任人及其职责、投资者关系管理职能部门及其职责等作出了明确的规定。

（三）发行后的股利分配政策

发行后的股利分配政策参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、发行后的股利分配政策”。

附件二：发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、高级管理人员及其他核心技术人员以及保荐人、证券服务机构作出的重要承诺及其履行情况和约束措施

（一）关于自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺

1、公司控股股东好达投资承诺：

（1）自公司首次公开发行股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

（2）所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本机构直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。

（3）如公司上市时未盈利，在公司实现盈利前，本机构自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持首次公开发行股票前所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的首次公开发行股票前所持有的股份不超过公司股份总数的 2%；同时承诺遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》关于减持股份的相关规定。公司实现盈利后，本机构方可自当年年度报告披露后次日起减持首次公开发行股票前所持有的公司股份，但该等减持应当遵守本承诺函的其他规定。

（4）公司上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本机构届时所持股份锁定期限 6 个月；公司上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本机构届时所持股份锁定期限 6 个月；公司上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本机构届时所持股份锁定期限 6 个月。前述“届时所持

股份”分别指本机构在公司上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年公司年报披露时仍持有的股份。

(5) 如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对上述股份锁定及减持有新的规定，则本承诺函中承诺的与新规定不一致的内容自动终止，且本机构承诺按照最新的监管规定和要求履行锁定及减持的义务。

2、公司实际控制人、核心技术人员、董事长刘平承诺：

(1) 自公司首次公开发行股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

(2) 所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。

(3) 如公司上市时未盈利，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持首次公开发行股票前所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的首次公开发行股票前所持有的股份不超过公司股份总数的 2%；同时承诺遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》关于减持股份的相关规定。公司实现盈利后，本人方可自当年年度报告披露后次日起减持首次公开发行股票前所持有的公司股份，但该等减持应当遵守本承诺函的其他规定。

(4) 公司上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；公司上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；公司上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。前述“届时所持股份”

分别指本人在公司上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年公司年报披露时仍持有的股份。

(5) 除前述锁定期外，在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，本人将继续遵守下列限制性规定：

①每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的 25%；

②离职后半年内不得转让本人所持公司股份；

③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及交易所的业务规则对董事、高级管理人员股份转让的其他规定。

(6) 自本人所持的本次公开发行前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的本次公开发行前所持发行人股份不超过本次公开发行前本人所持发行人股份总数的 25%（该减持比例可以累计使用）。

(7) 如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对上述股份锁定及减持有新的规定，则本承诺函中承诺的与新规定不一致的内容自动终止，且本人承诺按照最新的监管规定和要求履行锁定及减持的义务。

3、公司实际控制人刘平控制的企业共进同达、共进同达二号、共进同达三号承诺：

(1) 自公司首次公开发行股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

(2) 如公司上市时未盈利，在公司实现盈利前，本机构自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持首次公开发行股票前所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的首次公开发行股票前所持有的股份不超过公司股份总数的 2%；同时承诺遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减

持股份》关于减持股份的相关规定。公司实现盈利后，本机构方可自当年年度报告披露后次日起减持首次公开发行股票前所持有的公司股份，但该等减持应当遵守本承诺函的其他规定。

(3) 公司上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本机构届时所持股份锁定期限 6 个月；公司上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本机构届时所持股份锁定期限 6 个月；公司上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本机构届时所持股份锁定期限 6 个月。前述“届时所持股份”分别指本机构在公司上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年公司年报披露时仍持有的股份。

(4) 如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对上述股份锁定及减持有新的规定，则本承诺函中承诺的与新规定不一致的内容自动终止，且本机构承诺按照最新的监管规定和要求履行锁定及减持的义务。

4、实际控制人刘平之女刘思羽承诺：

(1) 自公司首次公开发行股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

(2) 所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。

(3) 如公司上市时未盈利，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持首次公开发行股票前所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的首次公开发行股票前所持有的股份不超过公司股份总数的 2%；同时承诺遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持

股份》关于减持股份的相关规定。公司实现盈利后，本人方可自当年年度报告披露后次日起减持首次公开发行股票前所持有的公司股份，但该等减持应当遵守本承诺函的其他规定。

(4) 公司上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；公司上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；公司上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。前述“届时所持股份”分别指本人在公司上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年公司年报披露时仍持有的股份。

(5) 如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对上述股份锁定及减持有新的规定，则本承诺函中承诺的与新规定不一致的内容自动终止，且本人承诺按照最新的监管规定和要求履行锁定及减持的义务。

5、实际控制人刘平之弟、高级管理人员刘明承诺：

(1) 自公司首次公开发行股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

(2) 所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。

(3) 如公司上市时未盈利，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持首次公开发行股票前所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的首次公开发行股票前所持有的股份不超过公司股份总数的 2%；同时承诺遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持

股份》关于减持股份的相关规定。公司实现盈利后，本人方可自当年年度报告披露后次日起减持首次公开发行股票前所持有的公司股份，但该等减持应当遵守本承诺函的其他规定。

(4) 公司上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；公司上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；公司上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。前述“届时所持股份”分别指本人在公司上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年公司年报披露时仍持有的股份。

(5) 除前述锁定期外，在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，本人将继续遵守下列限制性规定：

①每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的 25%；

②离职后半年内不得转让本人所持公司股份；

③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及交易所的业务规则对董事、高级管理人员股份转让的其他规定。

(6) 如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对上述股份锁定及减持有新的规定，则本承诺函中承诺的与新规定不一致的内容自动终止，且本人承诺按照最新的监管规定和要求履行锁定及减持的义务。

6、持有公司股份的董事、高级管理人员刘博、高级管理人员王骏、丁艳、黄宇峰承诺：

(1) 自公司首次公开发行股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

(2) 所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。

(3) 公司上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不得减持首次公开发行股票前已发行股份；在前述期间内离职的，应当继续遵守本承诺。公司实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持首次公开发行股票前已发行股份，但本人亦同时遵循其他限售安排和自愿锁定承诺及相关法律法规的规定。

(4) 除前述锁定期外，在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，本人将继续遵守下列限制性规定：

①每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的 25%；

②离职后半年内不得转让本人所持公司股份；

③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及交易所的业务规则对董事、高级管理人员股份转让的其他规定。

(5) 如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对上述股份锁定及减持有新的规定，则本承诺函中承诺的与新规定不一致的内容自动终止，且本人承诺按照最新的监管规定和要求履行锁定及减持的义务。

7、持有公司股份的职工代表董事、高级管理人员、核心技术人员王为标、高级管理人员、核心技术人员陆增天承诺：

(1) 自公司首次公开发行股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

(2) 所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。

(3) 公司上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不得减持首次公开发行股票前已发行股份；在前述期间内离职的，应当继续遵守本承诺。公司实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持首次公开发行股票前已发行股份，但本人亦同时遵循其他限售安排和自愿锁定承诺及相关法律法规的规定。

(4) 除前述锁定期外，在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，本人将继续遵守下列限制性规定：

①每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的 25%；

②离职后半年内不得转让本人所持公司股份；

③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及交易所的业务规则对董事、高级管理人员股份转让的其他规定。

(5) 自本人所持的本次公开发行前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的本次公开发行前所持发行人股份不超过本次公开发行前本人所持发行人股份总数的 25%（该减持比例可以累计使用）。

(6) 如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对上述股份锁定及减持有新的规定，则本承诺函中承诺的与新规定不一致的内容自动终止，且本人承诺按照最新的监管规定和要求履行锁定及减持的义务。

8、公司股东王竞宇、苏民投君信、国投创业、枣庄拓海、嘉兴君强、聚隆景润、聚源铸芯、金浦创拓、嘉兴君俞、宁波清容、金程新高、毓立投资、温州毅巽、海南丰晟、橙盛天际、追远财富、黄辉、小米基金、哈勃投资、杨义平、摩勤智能、宽联投资、王建文、茆林凤、中和春生、廖震、俱成秋实、杭州楚巽、嘉兴科巽、严雯、林永波、民生投资、无锡市集成电路基金承诺：

自公司股票上市之日起 12 个月内，本人/本机构不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本机构直接或间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。

（二）关于相关股东持股意向及减持意向的承诺

1、公司控股股东好达投资就持股意向及减持意向承诺：

（1）本机构将严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司招股说明书中记载的和本机构出具的承诺文件中载明的各项锁定期要求，在锁定期内本机构不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。

（2）锁定期届满后的两年内，在不违反相关法律、法规、规范性文件之规定以及本机构作出的其他公开承诺前提下，本机构存在适当减持公司股份的可能。

（3）在锁定期届满后，本机构拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

（4）本机构减持直接或者间接所持有的公司股票的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本机构在公司首次公开发行股票前直接或者间接所持有的公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。若因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述股份价格按照证券交易所的有关规定作相应调整。

（5）锁定期届满后，本机构减持直接或者间接所持发行人股份时，将按照证券监督管理机构及证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务并配合发行人的信息披露工作，提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人在减持前 3 个交易日对相关减持计划予以公告，通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式首次减持的，在减持前 15 个交易日前对相关减

持计划予以公告。

(6) 在本机构持有发行人股份期间，若股份减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本机构将依据相关法律法规的要求适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

(7) 本机构将严格遵守上述承诺，如本机构违反上述承诺进行减持的，本机构减持公司股票所得全部收益归公司所有。如本机构未将违规减持所得收益上缴公司，则公司有权将应付本机构现金分红中与违规减持所得收益相等的金额收归公司所有。

2、公开发行前持有公司 5%以上股份的股东共进同达、黄辉、刘博就持股意向及减持意向承诺：

(1) 本人/本机构将严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司招股说明书中记载的和本人/本机构出具的承诺文件中载明的各项锁定期要求，在锁定期内本人/本机构不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。

(2) 锁定期届满后的两年内，在不违反相关法律、法规、规范性文件之规定以及本人/本机构作出的其他公开承诺前提下，本人/本机构存在适当减持公司股份的可能。

(3) 在锁定期届满后，本人/本机构拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

(4) 本人/本机构减持直接或者间接所持有的公司股票的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人/本机构在公司首次公开发行股票前直接或者间接所持有的公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。若因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述股份价格按照证券交易所的有关规定作相应调整。

(5) 锁定期届满后，本人/本机构减持直接或者间接所持发行人股份时，将

按照证券监督管理机构及证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务并配合发行人的信息披露工作，提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人在减持前3个交易日对相关减持计划予以公告，通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式首次减持的，在减持前15个交易日对相关减持计划予以公告。

(6) 在本人/本机构持有发行人股份期间，若股份减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人将依据相关法律法规的要求适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

(7) 本人/本机构将严格遵守上述承诺，如本人/本机构违反上述承诺进行减持的，本人/本机构减持公司股票所得全部收益归公司所有。如本人/本机构未将违规减持所得收益上缴公司，则公司有权将应付本人/本机构现金分红中与违规减持所得收益相等的金额收归公司所有。

3、公开发行前持有公司5%以上股份的股东小米基金、摩勤智能及宽联投资就持股意向及减持意向承诺：

如本机构所持有的公司股份在限售期届满后两年内减持的，本机构减持应符合相关法律、法规、规章的规定。本机构减持所持有公司股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。

(三) 关于稳定股价及股份回购的承诺

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司制定了《无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》，具体如下：

“一、启动稳定股价措施的条件

公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值（以下简称“启动条件”），则公司应按下述规则启动稳定股价措施。

二、稳定股价的具体措施

（一）公司回购

1、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司股份回购规则》及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

2、公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。

3、公司股东会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东会中投赞成票。

4、公司为稳定股价进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：

（1）公司回购股份的价格不高于上一会计年度经审计的每股净资产；

（2）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额；

（3）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 500 万元；

（4）公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。

5、公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）超过公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。

（二）实际控制人、控股股东增持

1、下列任一条件发生时，公司实际控制人、控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

（1）公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日除权后的公

公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值；

（2）公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。

2、公司实际控制人、控股股东为稳定公司股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：

（1）增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；

（2）单次增持总金额不应少于人民币 500 万元；

（3）单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。

（三）董事、高级管理人员增持

1、下列任一条件发生时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

（1）控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；

（2）控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。

2、在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）为稳定公司股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：

（1）增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；

（2）单次用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取薪酬总和的 30%，但不超过该董事、高级管理人员上年度的在公司领取薪酬总和。

在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）对该等增持义务的履行承担

连带责任。

3、在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东增持及在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持工作。

4、公司如有新聘任董事、高级管理人员，公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。

三、稳定股价措施的启动程序

（一）公司回购

1、公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个工作日内做出回购股份的决议。

2、公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。

3、公司回购应在公司股东会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。

4、公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

（二）实际控制人、控股股东及董事、高级管理人员增持

1、公司董事会应在上述实际控制人、控股股东及在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个工作日内做出增持公告。

2、实际控制人、控股股东及在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。

四、稳定股价的进一步承诺

在启动条件首次被触发后，公司控股股东及持有公司股份的董事和高级管理人员的股份锁定期自动延长 6 个月。

本预案需经公司股东会审议通过，公司完成首次公开发行 A 股股票并在科创板上市之日起生效，有效期三年。”

公司承诺：在公司上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司将按照《无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》回购公司股份。公司未履行股价稳定措施的，将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。

公司控股股东好达投资、实际控制人、董事长刘平承诺：将根据公司股东会批准的《无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会与股东会上，对回购股份的相关决议投赞成票；将根据公司股东会批准的《无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。公司控股股东、实际控制人未履行股价稳定措施的，将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处领取薪酬及股东分红，同时持有的公司股份不得转让，直至按承诺采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

公司全体董事承诺：将根据公司股东会批准的《无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会与股东会上，对回购股份的相关决议投赞成票；将根据公司股东会批准的《无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行本人职责范围内的各项义务（如未在公司领取薪酬且未在公司担任其他职务的董事，无需承担预案中所述增持公司股票的相关义务）。公司董事未履行股价稳定措施的，将根据

法律法规及监管机构的要求，在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处领取薪酬（适用于本人在公司领取薪酬的情形）及股东分红（适用于本人持有公司股份的情形），同时持有的公司股份不得转让（适用于本人持有公司股份的情形），直至按承诺采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

公司全体高级管理人员承诺：将根据公司股东会批准的《无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。公司高级管理人员未履行股价稳定措施的，将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处领取薪酬及股东分红，同时持有的公司股份不得转让，直至按承诺采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

（四）关于欺诈发行上市的股份购回的承诺

1、公司承诺如下：

（1）保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。

2、公司控股股东好达投资及实际控制人刘平关于欺诈发行股份购回承诺事项如下：

（1）本人/本机构保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人/本机构将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

根据公司 2025 年第七次临时股东会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》，公司拟通过加强市场开拓，降低公司运营成本，积极实施募投项目，完善利润分配制度等方式，提高公司盈利能力，以填补被摊薄即期回报，具体措施如下：

1、加强市场开拓，提高公司持续盈利能力

公司主要从事声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售，凭借着持续的研发投入和优良的产品质量，公司产品已具有较大的市场影响力。公司将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力，进一步提升公司产品品牌影响力及主营产品市场占有率。同时，公司将继续加大研发投入和技术储备，加强自身核心技术的开发和积累，提高公司竞争能力和持续盈利能力。

2、提高发行人日常运营效率，降低发行人运营成本

公司经过多年的经营积累，已经形成了较为有效的管理体系以保证日常高效运营，但随着募集资金投资项目实施，公司的业务规模将不断扩大，公司经营活动、组织架构以及管理体系均将趋于复杂，管理难度相应增加。因此，培养优秀人才、建立完善的绩效考核体系是提升公司经营业绩的必要选择。

公司将坚持“以人为本”的理念，充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性；明确各岗位的职责权限、任职条件和工作要求；通过公开招聘、竞争上岗等多种方式选聘优秀人才，切实做到因事设岗、以岗选人。

公司将不断完善目标管理和绩效考核体系，设置科学的业绩考核指标，对各级管理人员和全体员工进行合理的考核与评价。公司通过晋升规划、补充规划、培训开发规划、职业规划等人力资源计划确保员工队伍持续优化，实现人力资源管理的良性循环。

3、积极实施募投项目，争取实现项目预期收益

本次募集资金用于募集资金投资项目，该等募集资金投资项目均紧紧围绕公司主营业务，募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，有利于扩大公司整体

规模并扩大市场份额，进一步提高公司竞争力和可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。

本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资项目落地并实现预期效益。同时，公司将根据相关法律法规和公司有关募集资金使用管理的相关规定，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

4、完善利润分配制度

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司制定了《无锡市好达电子股份有限公司上市后三年分红回报规划》《公司章程（草案）》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和股票股利分配条件等，公司已建立了较为完善的利润分配制度，公司将予以严格执行并不断优化。

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：

（1）本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）本人不参与公司的职务消费行为；

（3）本人不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）本人承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

公司控股股东好达投资、实际控制人刘平根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

（六）关于依法承担赔偿责任的承诺

1、公司承诺：

若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

公司未履行上述承诺的，将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。

2、公司控股股东好达投资承诺：

若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司控股股东未履行上述承诺的，将在股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，公司有权扣减应向本机构支付的分红代本机构履行上述承诺，同时持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。

3、公司实际控制人刘平承诺：

若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司实际控制人未履行上述承诺的，将在股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。

4、公司全体董事、高级管理人员承诺：

若公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将根据法律法规及监管机构的要求承担相应的法律责任。

（七）主要股东关于不谋求控制权的承诺

1、公开发行前持有公司 5%以上股份的股东刘博、黄辉承诺：

本人认可并尊重刘平先生对发行人的实际控制人地位，本人自取得发行人股权之日起从未以任何直接或间接方式谋求对发行人的控制权，本人在发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，将不以任何方式谋求公司的控股股东或实际控制人地位、不以控制为目的而直接或间接增持公司的股份，亦不会做出损害公司控制权和股权结构稳定性的任何其他行为。

上述谋求或争夺发行人控制权的行为包括但不限于：（1）与本人的一致行动人（如有）通过直接或间接方式合计持有发行人 50%以上的股份；（2）发行人股票上市后，与本人的一致行动人（如有）通过直接或间接方式合计实际支配发行人表决权超过 30%；（3）由本人及一致行动人（如有）直接提名或通过向发行人董事会提名委员会推荐的方式间接提名发行人董事会半数以上的董事或超过半数非独立董事；（4）法律、法规、其他规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所等监管部门认定的取得公司控制权的其他情形。

2、公开发行前持有公司 5%以上股份的股东小米基金、摩勤智能及宽联投资承诺：

本机构认可并尊重刘平先生对发行人的实际控制人地位，本机构自取得发行人股权之日起从未以任何直接或间接方式谋求对发行人的控制权，本机构在发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，将不以任何方式谋求公司的控股股东或实际控制人地位、不以控制为目的而直接或间接增持公司的股份。

（八）关于未履行承诺事项时采取的约束措施

1、公司承诺：

公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

（1）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受

如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①在股东会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

②对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。

③给投资者造成损失的，本公司将按中国证监会、上交所或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿责任。

(2) 如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①在股东会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。

2、公司控股股东好达投资承诺：

本机构将严格履行就公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

(1) 如本机构非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①在股东会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

②不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

③暂不领取公司分配利润中归属于本机构的部分；

④如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；

⑤如因本机构未履行相关承诺事项，给公司或者投资者造成损失的，本机构将依法赔偿公司或投资者损失。

(2) 如本机构因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①在股东会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上及时、充分说明未履行承诺的具体原因；

②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

3、公司实际控制人刘平承诺：

本人将严格履行就公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

(1) 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①在股东会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

②不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；

③暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；

④如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；

⑤如因本人未履行相关承诺事项，给公司或者投资者造成损失的，本人将依

法赔偿公司或投资者损失。

(2) 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项, 需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

①在股东会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上及时、充分说明未履行承诺的具体原因;

②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。

4、持有公司 5%以上股份的股东刘博、共进同达、黄辉承诺:

本人/本机构将严格履行就公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督。

(1) 如本人/本机构非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项, 需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

①不转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;

②暂不领取公司分配利润中归属于本人/本机构的部分;

③如因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益后将所获收益支付给公司指定账户;

④如因本人/本机构未履行相关承诺事项, 给公司或者投资者造成损失的, 本人/本机构将依法赔偿公司或投资者损失。

(2) 如本人/本机构因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项, 需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

①在股东会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上及时、充分说明未履

行承诺的具体原因；

②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

5、持有公司5%以上股份的股东小米基金、摩勤智能及宽联投资承诺：

本机构将严格履行就公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

(1) 如本机构非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①在股东会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上及时、充分说明未履行承诺的具体原因；

②如因本机构未履行相关承诺事项，给公司或者投资者造成损失的，本机构将依法赔偿公司或投资者损失。

(2) 如本机构因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①在股东会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上及时、充分说明未履行承诺的具体原因；

②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

6、公司全体董事、高级管理人员承诺：

本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

(1) 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①不得转让公司股份（如有）。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。

②暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分。（如有）

③主动申请调减或停发薪酬或津贴。（如有）

④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益后将所获收益支付给公司指定账户。

⑤本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，将根据法律法规及监管机构的要求赔偿投资者损失。

（2）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并履行。

（九）证券服务机构作出的承诺

1、保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司承诺

保荐机构已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形；若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。

2、发行人律师北京德恒律师事务所承诺

若本所为发行人本次发行并上市制作的律师工作报告、法律意见书等申报文件的内容被证明存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，且本所因此应承担赔偿责任的，本所将依法承担赔偿责任，但有证据证明本所无过错的除外。

3、审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）承诺

本所承诺，因本所为发行人首次公开发行股票并在科创板上市制作、出具的

文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，但是能够证明本所没有过错的除外。

（十）发行人股东信息披露专项承诺

发行人承诺：

1、公司股东持有的发行人股份权属清晰，不存在股份代持等情况，不存在权属纠纷或潜在纠纷；

2、公司股东均具备持有公司股份的主体资格，不存在法律法规和中国证监会规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形；

3、截至本承诺签署之日，本次发行的保荐机构（主承销商）国联民生承销保荐、联席主承销商国投证券股份有限公司关联方存在直接或间接持有本公司股份的情形，该等情形系相关投资主体依据市场化原则作出的投资决策，不属于法律法规禁止持股的情形或利益冲突情形。除前述已披露情形外，本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司股份的情形；

4、公司股东不存在以公司股权进行不当利益输送的情形；

5、公司及公司股东已及时向本次发行上市的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行上市的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行上市的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。

附件三：股东会、董事会、历史监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

（一）公司股东会制度的建立健全及运行情况

公司在《公司章程（草案）》中明确规定了股东的权利和义务、股东会的权力和决策程序，并制定了《无锡市好达电子股份有限公司股东会议事规则》。对股东会的职权、召开方式、表决方式等作出了明确规定。股东会分为年度股东会

和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。《股东会议事规则》分别从股东会职权、会议的召集与通知、会议提案、股东资格认定、会议签到、会议议事程序、会议表决、会议决议及公告、会议决议的执行、会议记录等方面详细规定了股东行使权力的方式以及股东会作为公司最高权力机构的基本职能。

公司设立股份公司以来，股东依法履行了《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定赋予的权利和义务，不存在违反《公司法》及其他相关规定行使职权的情形。

(二) 公司董事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《无锡市好达电子股份有限公司董事会议事规则》，对董事会的职权、召开方式、表决方式等作出了明确规定。公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，职工代表董事1名；董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事由股东会选举或更换，任期3年。

自股份公司设立以来，公司董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

(三) 公司监事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《无锡市好达电子股份有限公司监事会议事规则》，公司监事会由3名监事组成，监事会设主席1名，职工代表监事1名。2025年11月11日，根据新《公司法》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，公司召开2025年第六次临时股东大会，审议通过取消设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权并同步修改公司治理制度。

自股份公司设立以来，公司监事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

（四）公司独立董事制度的建立健全及运行情况

公司制定了《无锡市好达电子股份有限公司独立董事工作制度》，对独立董事的任职资格、独立董事的独立性、独立董事的提名、选举和更换、独立董事的职权、独立董事的权责范围等做出相应规定。公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。

公司独立董事制度自建立伊始，保持规范、有序运行，保障了董事会决策的科学性，维护了广大中小股东的利益，发挥了应有的作用。独立董事制度将对公司重大事项和关联交易事项的决策，对公司法人治理结构的完善起到积极的作用，独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德将在董事会制定公司发展战略、发展计划和生产经营决策等方面发挥良好的作用，将有力地保障公司经营决策的科学性和公正性。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事会秘书对董事会负责，为公司与公司股票上市的证券交易所之间的指定联系人。

公司制定了《无锡市好达电子股份有限公司董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任职资格、董事会秘书的职责、董事会秘书的工作程序、董事会秘书的法律责任等作出了规定。公司董事会秘书制度自建立伊始，始终保持规范、有序运行，保障了董事会各项工作的顺利开展，发挥了应有的作用。

（六）公司治理存在的缺陷及改进情况

公司自设立以来，建立了符合《公司法》《证券法》及其他法律法规要求的公司治理结构。一方面，股东会、董事会和历史监事会之间建立了相互协调和相互制衡机制，独立董事和《独立董事工作制度》能够有效增强董事会决策的公正性和科学性。另一方面，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，健全了董事会的审计评价、监督制度和薪酬管理制度等，充分发挥各专门委员会的作用。

2025 年 11 月 11 日，根据新《公司法》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，公司召开 2025 年第六次临时股东大会，审议通

过取消设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权并同步修改公司治理制度。

综上，公司建立健全了由公司股东会、董事会、历史监事会和高级管理人员组成的符合发行上市要求的公司治理结构，为公司高效发展提供了制度保障，不存在重大缺陷。

附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司董事会按照股东会的相关决议，设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责。公司各专门委员会的人员构成情况如下：

委员会名称	成员
战略委员会	刘平（召集人）、王为标、汤立国
提名委员会	汤立国（召集人）、程德兵、刘平
薪酬与考核委员会	程德兵（召集人）、涂武根、王为标
审计委员会	涂武根（召集人）、程德兵、刘博

各专门委员会自设立以来，按照《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定开展工作，充分地履行了其职责。

附件五：募集资金投资项目具体情况

（一）年产 6 亿颗 TC-SAW 及 4 亿颗 TF-SAW 滤波器生产线扩建项目

1、项目概况

本项目旨在通过公司多年在声表面波滤波器产品上积累的丰富经验，对 TC-SAW 和 TF-SAW 滤波器进行扩产，通过引进国外先进制造生产设备，扩建滤波器生产线，改善现有工艺技术并扩大现有产能，实现 TC-SAW 和 TF-SAW 滤波器的大规模量产。本项目的实施将进一步提高公司生产线的集成化和自动化，提高公司成本优势和配置效率，提高生产的周转速度，从而提高产品质量，优化产品结构，进一步提升公司知名度和市场占有率。

本项目考虑到生产线规划建设、设备选型与订购、人员招聘与培训及投产前各项准备工作与试投产等实际需要，计划建设周期为 18 个月。项目建设完成后，将形成年产 TC-SAW 滤波器 6 亿颗、TF-SAW 滤波器 4 亿颗的制造能力，项目达产后年均销售收入为 49,820.02 万元。

2、项目可行性分析

(1) 行业前景广阔，市场基础良好

在移动终端市场，随着通讯技术的不断升级，智能手机的通信制式已经从 2G 发展至 5G，实现了更丰富的手机功能，满足了互联网时代消费者随时随地的上网需求。全球 5G 手机出货量经历爆发式增长。2020 年，全球 5G 手机出货量仅为 2.48 亿件，2025 年，5G 手机出货量达到 8.55 亿件，市占率逐步提高。随着 5G 手机的性能升级，单部手机滤波器的用量从 4G 手机的 20~40 颗增加至 5G 手机的 40~80 颗，单部手机滤波器的用量和价值量在大幅提升。因此，滤波器行业的市场规模将显著提升。

在物联网领域，万物互联的深入推进使得无线连接节点数量激增，从智能表计、工业机器人到家用服务机器人，每个接入节点均需配备无线通信模组，为声表面波滤波器创造了持续且规模化的配套需求。在汽车电子领域，汽车智能化趋势加速，车联网、智能辅助驾驶、车载导航与 T-BOX 等功能日益普及，单车通信频段数量大幅增加，直接拉动了车规级滤波器用量。同时，声表面波滤波器在低轨卫星通信和无人机等新兴领域的应用，将为声表面波滤波器开辟全新的增量赛道。

在声表面波滤波器领域，目前海外厂商仍然掌控着全球高性能滤波器的量产技术和市场份额，对我国滤波器产业形成了潜在的垄断威胁。在此形势下，公司自主研发的 TC-SAW 及 TF-SAW 产品能够完成进口高性能滤波器的国产化替代，相比海外厂商，能为国内客户提供更稳定的、更安全的、性价比更高的高性能滤波器产品。

(2) 深耕行业多年，IDM 模式经验丰富

公司从事滤波器行业已经有 20 多年的历史，行业经验丰富，核心骨干团队

稳定，未发生过重大变化。公司高管成员多毕业于国内一流院校，研发人员多获得博士学位或硕士学位。优秀的专业背景和丰富的行业经验使得高管团队对滤波器行业的未来发展具有深刻的了解和判断，具备战略性眼光。经过多年发展，公司的管理团队积累了丰富的声表面波滤波器的管理和生产经验，使得生产效率和良品率显著提升，在产品研发、品质管控、成本管理等方面均处于国内领先地位，为本项目的实施提供了管理保证。

同时，公司是目前国内少有的能够完全掌握 IDM 经营模式的厂商之一，能够率先向市场提供技术更先进、性能更稳定、性价比更高的滤波器产品，获得先发优势，保证了公司在国内滤波器领域的领先地位，为本项目的顺利实施提供了基础。

(3) 产品技术领先，研发团队稳定

作为国家高新技术企业，公司长期重视研发投入，近三年研发费用率保持在8%以上，累计拥有专利61项（其中发明专利40项）。针对SAW滤波器无商用软件的行业痛点，公司自主开发了覆盖全产品线的分析与设计软件，仿真精度与速度达国际先进水平。凭借持续的研发积累，公司成为国内少数实现TC-SAW大规模量产并率先突破高性能滤波器国产化的企业，同时TF-SAW产品批量量产。公司荣获2次国家科技进步二等奖，多项省、部级奖项。面对海外垄断导致国内专业人才稀缺的困境，公司自成立之初即坚持自主培养，逐步建立起一支技术精湛、忠诚度高的核心团队，为公司持续引领技术前沿、顺利实施募投项目提供了坚实保障。

(4) 客户资源优质，利于产能消化

公司依托强大的技术研发、先进的制造设备、精细的管理能力，在向市场推出新一代滤波器的同时，不断完善产品管控体系，提升产品质量和可靠性。目前，公司SAW、TC-SAW产品的产量和销量在国内处于领先地位，产品的各项性能指标处于国内先进水平，与国际一流水平接近。公司产品高性能、高可靠性、高性价比的特点得到了智能终端、物联网、汽车电子、基站以及低轨卫星通信等领域头部客户的认可。通过多年经营，公司积累了优质的客户群，为本项目提供了产能消化的保障。公司自主研发的TF-SAW高性能滤波器的目标客户与现有客

户群一致，既有的客户资源有利于新产品的产能消化，同时能够降低新客户的开发成本。因此，公司多年积累的客户资源能够帮助消化新增产能，为公司带来新的利润增长点，并为本项目的产能扩产提供了坚实的客户保障。

3、项目必要性分析

(1) 突破高性能滤波器技术，打破国外厂商垄断

目前，全球滤波器市场仍被美日等发达国家垄断。在声表面波滤波器领域，美日头部厂商市占率较高。在高性能滤波器领域，被市场公认的新一代滤波器技术：TC-SAW 和 TF-SAW 的产品技术，目前同样被美日厂商垄断。随着通讯设备的不断升级，我国对高性能滤波器的需求不断提升，但是由于国产化率低主要依赖海外进口，因此高性能滤波器的国产化代替已经迫在眉睫。

在此形势下，公司于 2018 年开始布局 TC-SAW 和 TF-SAW 等高性能滤波器的技术研发，并且已经成功实现技术突破。2018 年公司首次完成 TC-SAW 的样品制造，2020 年实现大批量量产，率先实现国内 TC-SAW 滤波器量产出货，出货量位居国内前列。针对适用频段更高、性能更好的高性能滤波器，公司通过自主研发实现了 TF-SAW 滤波器批量量产，能够逐步在智能手机市场实现高性能国产滤波器替代，弥补了我国高性能滤波器产业在全球市场的空白。

(2) 提高产能产量，满足市场需求

公司自主研发的 TC-SAW、TF-SAW 产品面临着智能终端、物联网、汽车电子、低轨卫星通信等领域广阔的市场前景，但由于公司目前产能有限，无法满足市场对高性能滤波器的持续新增需求。与此同时，在供应链自主可控的大背景下，我国企业比以往更需要性价比高、安全性高、供货稳定的国产化滤波器产品。因此，公司需要通过本项目的实施募集资金，用来购置进口设备、扩充生产人员、扩产产能产量，满足新增的市场需求。

(3) 升级产品结构，提升公司持续盈利能力

在目前的全球滤波器市场中，尚无一款产品能够高效率适配所有频段，各厂商普遍针对特定频段设计最具性价比的滤波器方案，通过多技术路线互补实现各频段收发的最优解决方案。公司 TC-SAW 产品主要适配中低频段，具备更高 Q

值和更优信号质量，大规模量产后将逐步替代 SAW 产品成为中低频段首选；TF-SAW 产品在高频领域表现更佳，兼具成本优势，有望成为未来高性能多工器的核心方案。因此，公司亟需通过本次募投项目实现 TC-SAW 及 TF-SAW 的大规模量产，抢占国内高性能滤波器市场，完善全频段产品布局，在快速迭代的通信器件市场中构建持续盈利能力。

4、项目投资概算

本项目预计总投资额 51,893.41 万元，资金拟全部由本次发行募集筹措，具体构成如下：

序号	项目	金额（万元）	比例
1	设备采购及安装	37,369.50	72.01%
2	预备费	2,242.17	4.32%
3	铺底流动资金	12,281.74	23.67%
合计		51,893.41	100.00%

5、项目实施周期及进度

本项目建设周期为 1.5 年，项目实施进度安排如下：

序号	项目阶段	T+1				T+2			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	设备购置及安装	■	■	■	■				
2	设备调试					■	■		
3	人员招聘及培训				■	■	■		
4	开始释放产能							■	■

6、项目选址

本项目选址于公司目前生产经营所处的无锡市经济技术开发区高运路 115 号厂区，不涉及新增募投用地。

7、项目备案情况

2024 年 11 月 19 日，本项目已经在江苏无锡经济开发区数据局备案，备案项目代码：2402-320272-89-05-806091。

8、项目环保情况

本项目建设产生的废气、固体废弃物、废水等污染物较少，不会对环境造成较大的影响。公司将严格按照《中华人民共和国环境保护法》等有关法律的规定，根据公司生产的实际情况，建设与主体工程相匹配的环境保护设施。目前已完成环评批复。

（二）研发中心建设项目

1、项目概况

研发和创新能力是企业核心竞争力的体现，也是公司未来持续增长的核心推动力。本项目拟在公司现有研发中心的基础上，加大研发投入，添置所需的研发设备、检测设备，引进高端技术人才，对行业内前瞻性课题提前开展有计划、有步骤的研究和开发，以进一步提高公司的研发能力和自主创新能力，为公司技术创新提供软硬件支持和实验保障。研发中心建设项目将在充分发挥公司现有研发能力的基础上，进一步加大公司研发投入，提高研发能力和整体竞争力。通过本项目的建设，公司将持续储备潜力产品，实现可持续发展，实现科技成果转化，进一步巩固公司在行业内的技术领先水平。

2、项目可行性分析

（1）公司拥有知识结构全且经验丰富的研发团队

公司一贯注重团体协作与内部人才培养的人才发展模式，形成了内部储备和外部协作相结合、注重经验积累、形成规范化文件记录的技术研发体系。公司通过不断加大研发费用的投入力度，改善研发设备及研发环境、引进专业技术人才、促进外部技术交流等方式使公司技术一直保持行业领先地位。公司核心技术人员刘平、王为标和陆增天均具有多年行业从业经验，三人累计多次承担重大科研项目并多次获得国家级奖项，是公司研发团队的核心力量。

目前公司的研发人员来自多个专业领域，涉及声学、通信工程、电子工程、软件工程、材料工程、电化学工程、精密制造等学科，均具备较为丰富的理论及实践经验。截至报告期末，公司研发人员 90 人，占员工总数的比重为 15.03%。公司知识结构全面、研发经验丰富和梯队结构合理的研发团队能够为本项目实施

提供充足的人才保障。

(2) 公司持续研发投入积累了较强的技术基础

①研发资金方面

公司一直将研发能力的提升作为自身发展的重要战略，多年来一直注重研发投入，通过改善技术设备和科研条件，引进高级技术人才，使得公司技术实力一直保持行业的领先地位。近年来公司不断加大对研发的投入力度，研发费用用于支持技术研发和核心技术的引进，研发资金投入处于国内领先水平。报告期内，公司研发投入整体保持较高水平，研发费用分别为 5,000.02 万元、5,931.82 万元、5,717.43 万元，研发投入占比分别为 11.95%、9.78%及 8.47%。

②产学研方面

公司坚持产学研相结合，与清华大学、南京大学、东南大学、江南大学和中国科学院声学研究所等科研院所合作课题研究。公司作为主要承担单位，先后牵头承担或参与实施了 7 项国家级和 5 项省级重点科研项目。公司具备卓越的科研实力与持续创新能力，作为国家滤波器领域科技攻关的核心单位，公司荣获 2 次国家科技进步二等奖等荣誉奖项。

公司长期致力于滤波器基础理论与基础工艺研究，支撑公司的可持续发展。公司产品创新能力强，具备高效高精度的设计技术优势和综合工艺技术优势，及产学研紧密结合的协作研发机制。公司能够有效满足前瞻性产品开发、生产工艺革新等技术需求，技术创新和产品创新成效显著。同时公司已经形成了应对客户需求变化的快速反应机制，可以快速适应市场变化，完成新产品的研发。

③核心技术积累方面

公司经过二十余年在 SAW 滤波器领域的精耕细作，深入研究，目前已积累了多项核心技术，包括：（1）声表面波射频芯片精确仿真技术；（2）声表面波滤波器前道技术；（3）高功率滤波器制造技术；（4）TC-SAW 滤波器制造技术；（5）声表面波射频芯片 CSP、WLP 封装技术、（6）POI 材料制备技术。公司研发技术全部已实现成果转化并量产，在国内 SAW 滤波器厂商中处于龙头地位。

公司领先的技术研发实力和持续的研发投入能够为公司产品质量和技术水平的提升提供强有力的保障。公司的研发优势为公司建立了良好品牌形象，为公司未来业务的进一步扩张奠定了良好的基础。

(3) 公司建立了完善的研发管理模式及激励制度

公司研发机构主要为研发部和工程技术部，其中研发部主要负责策划并实施新产品设计和开发活动；工程技术部负责设计试制转入试生产的评审和试生产阶段工艺控制和技术改进。上述团队各司其职、分工协作，保障了公司研发工作的高效推进。同时，公司建立了完善的激励机制，持续优化创新投入体系与考核政策，鼓励研发团队积极申报科研项目与专利。公司营造宽松自由的技术氛围，支持科研探索，并通过常态化培训帮助员工持续提升专业能力，形成了良好的学习型研发氛围，为募投项目实施提供了有力的制度保障。

3、项目必要性分析

(1) 完善公司研发环境，引进先进设备增强自主研发能力

随着无线通信技术的快速发展，市场对滤波器性能及迭代速度的要求日益提高，高性能滤波器技术成为行业焦点。公司的研发中心建设项目包括新一代 TC-SAW、POI 材料、XBAR 滤波器、模组封装工艺、8 英寸晶圆高性能 SAW 滤波器先进工艺等基础研究，以提高公司的研发实力和核心竞争力。近年来，公司虽在新材料、新工艺及电路优化设计等方面取得系列研发成果，但现有研发与检测设备及人员配置已难以满足持续拓展的研发需求，研发环境亦对高端人才引进和先进设备导入形成制约。本项目拟依托公司已有研发成果与项目实施经验，引进国内外先进研发及检测设备，优化研发环境。项目实施后，将有助于公司巩固技术优势，增强自主研发与成果转化能力，保障公司在行业技术加速迭代的背景下占据主动地位。

(2) 顺应行业技术发展趋势，持续技术创新巩固公司行业地位

为顺应行业技术发展趋势、持续巩固公司行业地位，本项目将围绕以下方向展开：一是针对 5G 通信对高频段、多频段及高可靠性的新需求，公司将持续推进高性能滤波器、Sub-6G 及毫米波滤波器等技术研发，巩固在滤波器市场的竞

争优势；二是面向物联网及汽车电子等新兴应用场景，公司将进一步开发低成本、高性能、低插损的新一代滤波器，丰富技术储备，支撑业务持续扩张；三是加强新一代 TC-SAW、POI 材料、XBAR 滤波器等基础性、前瞻性技术研究，夯实理论工艺基础。同时，本项目将引进国内外先进研发与检测设备，优化研发环境，全面提升公司研发创新能力，助力公司保持技术领先地位。

(3) 突破技术瓶颈，加快国产化替代进程打破国外垄断

声表面波滤波器行业属于技术密集型制造业，设计开发与制造工艺难度高。我国起步较晚，目前仍与国际厂商存在较大差距。目前全球声表面波滤波器市场主要被村田、高通（RF360）、太阳诱电、思佳讯和威讯等主导。尽管国内企业已经取得长足进步，但是部分高性能滤波器技术仍掌握在日美企业手中。在声表面波滤波器供应链自主可控以及国内企业实力持续增强的背景下，国产化替代已成为极为迫切的任务。本项目的实施，将助力公司突破技术瓶颈，打破国外厂商在该领域的持续垄断，把握国产化替代的历史机遇，进一步强化公司的技术及研发优势，提升市场份额。

(4) POI 材料成为 TF-SAW 滤波器关键原材料

TF-SAW 滤波器凭借出色的高频性能，在 5G/6G 通信应用中扮演关键角色，其核心材料的质量与性能直接决定滤波器的品质。在对滤波器的插损、带外抑制等指标要求更高的领域，优质的 POI 材料可有效提升滤波器的插损、带外抑制等关键指标，保障信号传输的稳定性与高效性。随着高性能 TF-SAW 滤波器需求爆发式增长，开展 POI 材料研发、优化制备工艺，是满足通信技术升级对核心材料需求的必然选择。

(5) 模组封装工艺成为技术演进趋势之一

当前，全球 5G 通信网络已进入规模商用与技术深化并行的发展阶段，同时 6G 通信技术的前瞻性研究亦在加速推进。伴随通信频段持续向毫米波、太赫兹等高阶频段迁移，通信设备对滤波器的性能指标提出了更高维度的要求，涵盖高频特性优化、微型化封装设计、多频段协同处理能力等多个技术维度。滤波器受限于自身物理特性与工艺瓶颈，在复杂通信系统的综合性能适配方面逐渐显露出

局限性。例如，在移动终端设备领域，智能手机轻薄化设计趋势与全频段通信功能需求的双重驱动下，亟需突破传统器件的体积限制与性能瓶颈。通过多组件异构集成与协同设计，可实现器件性能优化与体积密度提升的双重目标。

(6) 8 英寸晶圆产线替代 6 英寸成为必然趋势

随着 5G/6G 通信技术的快速发展，声表面波滤波器正加速向高性能、小型化、高频化演进，对滤波器的带外抑制、插损、谐波性能提出了更高要求。现有 6 英寸晶圆产线因设备精度与工艺局限，已难以满足下一代高性能滤波器对分辨率、精度与良率的要求。本项目升级至 8 英寸晶圆产线，能够凭借更先进的光刻、蚀刻与薄膜沉积设备，提高膜厚均匀性、线宽均匀性等，有效解决高频信号处理中的性能瓶颈。

同时，6 英寸产线在产能与成本方面已难以适应市场需求爆发式增长。8 英寸晶圆单批次加工芯片数量理论可达 6 英寸的 1.78 倍，规模化效应可显著降低单位成本。产线升级将有助于降低滤波器生产成本，并为公司滤波器集成化发展奠定基础，助力抢占高性能射频器件市场先机。

4、项目投资概算

本项目预计总投资额 43,355.95 万元，资金拟全部由本次发行募集筹措，具体构成如下：

序号	项目	金额（万元）	占比
1	设备购置费	36,365.00	83.88%
2	预备费	1,090.95	2.52%
3	研发费用	5,900.00	13.61%
合计		43,355.95	100.00%

5、项目实施周期及进度

本项目建设周期为 24 个月，项目实施进度安排如下：

序号	项目阶段	T+1				T+2				T+3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	设备购置与安装												

序号	项目阶段	T+1				T+2				T+3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
2	人员招募												
3	人员培训												
4	研发课题实施												

6、项目选址

本项目选址于公司目前生产经营所处的无锡市经济技术开发区高运路 115 号厂区，不涉及新增募投用地。

7、项目备案情况

2025 年 11 月 7 日，本项目已经在江苏无锡经济开发区数据局备案，备案项目代码：2020-320272-39-03-674608。。

8、项目环保情况

本项目建设产生的废气、固体废弃物、废水等污染物较少，不会对环境造成较大的影响。公司将严格按照《中华人民共和国环境保护法》等有关法律的规定，根据公司生产的实际情况，建设与主体工程相匹配的环境保护设施。

目前正在办理环评批复。

（三）智能制造能力提升项目

1、项目概况

为紧跟市场需求变化与行业技术革新步伐，公司亟需对现有生产线进行改造升级，全方位提升生产效能与产品质量。本项目聚焦生产线的智能化改造，致力于深度优化生产流程，重新布局车间空间，完善各环节衔接，削减不必要的生产步骤，提高整体生产效率。

通过生产线改造升级项目，公司有望缩短产品交付周期，快速响应市场订单波动，稳定保障产品供应。同时，能够显著提升产品品质，以更精良、可靠的产品满足客户严苛要求，进一步巩固公司在行业内的市场地位，为公司持续、稳健发展注入强劲动力，开创更广阔的发展前景。

2、项目可行性分析

(1) 国家多领域政策赋能行业成长

近年来，国家相关部门陆续发布多项产业政策，从技术攻关、设备升级、市场需求、产业协同等多维度构建了支持声表面波滤波器行业发展的政策体系。在技术攻关层面，政策鼓励突破智能控制、智能传感等关键技术，为滤波器的高频化、集成化发展提供技术指引。在设备升级层面，政策明确支持电子信息制造业更新智能化生产检测设备，推动 5G、人工智能等技术在生产环节深度应用，加快行业数字化转型进程。在市场需求层面，通过完善高质量供给体系、优化消费环境，进一步扩大智能手机、物联网设备等下游产品需求，间接拉动滤波器市场持续扩容。上述政策从多维度共同发力，推动声表面波滤波器行业向高端化、智能化、绿色化方向加速迈进，为行业技术升级与市场增长营造了良好的政策环境。

(2) 下游产业加速崛起，智能化升级正逢良机

随着智能终端、物联网、汽车电子、基站及低轨卫星通信等新兴领域的快速发展，声表面波滤波器正迎来前所未有的市场增量空间，为本次生产基地制造能力的智能化优化升级提供了坚实的可行性基础。通过智能化车间升级，引进自动化精密设备，企业可生产满足终端微型化需求的产品，有效抓住声表面波滤波器需求增长的契机，实现产能与市场需求的精确匹配，充分释放技术改造后的生产效益。借助行业的增长东风，将新增产能迅速转化为市场份额与经济效益，进一步验证了技术改造在市场需求层面的可行性，确保企业在供应链中占据更有利的地位，实现可持续发展。

(3) 自动化与智能化赋能项目实施

当前，自动化与智能化技术已趋于成熟，成为驱动制造业向高效智能转型的核心引擎，为企业生产线智能化改造提供了坚实的可行性支撑。以高精度智能加工设备、工业机器人、智能物流 AGV、数字孪生系统为代表的的关键装备，通过视觉识别、实时传感与闭环控制；可实现微米级的精准操作与动态误差修正，有效解决传统产线良品率不稳的问题；并能同时适配规模化生产与柔性制造需求。

技术成熟带来的显著优势，更体现在改造门槛的降低与落地风险的可控。标

准化接口与模块化架构使不同设备可快速集成，显著缩短改造周期、降低前期投入；丰富的行业应用案例与完善的第三方技术服务，为企业灵活选择“分步升级”等方案提供了可靠保障。上述成熟技术与配套服务共同构建了智能化改造的可行路径，使公司能够以较低成本、稳健节奏推进改造项目，实现生产效率提升、运营成本优化、产品竞争力增强的核心目标。

(4) 专业生产团队与质量管控体系支撑项目升级

公司拥有一支覆盖声学、通信工程、电子工程、软件工程、材料工程等多学科的生产管理团队，具备丰富的理论及实践经验，熟悉从原料采购到成品交付的全流程作业，为本次智能化升级项目的顺利开展奠定了坚实基础。同时，公司已建立完善的声表面波滤波器生产质量管控体系，从设备参数校准、核心工艺监督到成品检测均有明确的行业标准和操作规范。在设备端，公司生产团队对线宽精度、沉积厚度等关键参数实施实时校准与定期核验，有效控制次品率，确保项目升级后能够承接更高标准订单，巩固市场竞争力。

3、项目必要性分析

(1) 提升生产效率增强市场竞争力

通过实施自动化、智能化生产线升级，企业能够借助先进的控制系统和智能设备，实现生产过程的精准规划与高效执行。从原材料的精准配送，到生产工艺参数的自动优化调整，再到产品的自动化检测与包装，整个生产流程将更加紧凑和流畅，从而大幅缩短产品的生产周期。这使企业在面对下游客户的紧急补单或季节性产能高峰时，可快速调整生产计划、高效组织生产，确保订单按时交付，从而在激烈的市场竞争中形成差异化优势。高效的生产模式不仅有助于扩大市场份额，还能增强现有客户粘性、吸引潜在客户，树立快速响应与稳定交付的市场口碑，提升企业整体地位，为拓展新业务、实现可持续发展提供有力支撑。

(2) 降低人力成本与运营风险

公司核心工艺依赖熟练工人，但新人的培训周期较长，期间可能因技能不达标而影响产品质量，导致生产和运营成本增加。引入自动化、智能化设备可有效改善这一现状，通过系统主导的全流程生产，减少人工干预，降低人为失误率，

提升良品率；标准化的智能流程降低了对个体技能的依赖，即使人员变动也能快速恢复生产，保障长期稳定。企业依托智能化产线，可规避市场波动与人力不稳定带来的生产中断风险，增强抗风险能力，在市场竞争中维持稳健经营，为实现长期稳定发展提供有力保障。

（3）优化生产管理与质量控制

滤波器生产制程复杂且对精度要求很高，良率直接决定企业成本控制与市场竞争力。传统人工模式下，晶圆光刻、蚀刻、封装等关键工序依赖人工记录或离线抽检，数据采集滞后、误差率高，难以实现全流程覆盖，往往到批量缺陷出现后才追溯根源，造成原材料浪费且难以精准定位问题。智能化升级后，生产线实现从“经验驱动”向“数据驱动”转变，光刻功率、蚀刻深度、薄膜厚度等核心参数通过高精度传感器实时采集，借助大数据与 AI 算法，管理层可实时掌控各工序良率与设备状态，实现全链路透明化管理。通过对这些数据的深度挖掘和分析，智能系统能快速适配不同型号滤波器的工艺参数，提前预警设备异常、及时发现工艺偏差，避免生产中断或批量次品，助力企业打造透明、敏捷、智能的车间管理模式，提升质量稳定性与市场响应速度，赢得客户信任，为长期发展奠定坚实基础。

4、项目投资概算

本项目预计总投资额 8,326.06 万元，资金拟全部由本次发行募集筹措，具体构成如下：

序号	项目	金额（万元）	占比
1	工程费用	7,953.60	95.53%
2	预备费用	372.46	4.47%
合计		8,326.06	100.00%

5、项目实施周期及进度

本项目建设周期为 24 个月，项目实施进度安排如下：

序号	项目阶段	T+1				T+2			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	前期准备工作/初步设计								
2	设备购置、安装和调试								
3	全部竣工并组织验收								

6、项目选址

本项目选址于公司目前生产经营所处的无锡市经济技术开发区高运路 115 号厂区，不涉及新增募投用地。

7、项目备案情况

2025 年 11 月 18 日，本项目已经在江苏无锡经济开发区数据局备案，备案项目代码：2511-320272-89-04-439500。

（四）补充流动资金

公司本次公开发行拟使用募集资金 8.00 亿元用于补充公司主营业务发展所需要的流动资金，其中包括偿还部分银行贷款。伴随业务规模持续扩大，公司营运资金需求相应增加。本次拟将部分募集资金用于补充营运资金并偿还银行贷款，以降低公司资产负债率、优化资本结构，有效满足公司持续研发投入及业务扩张的增长需求，为公司持续经营及长远发展提供资金保障。

公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定对补充流动资金进行管理，根据公司业务发展的需要，合理安排资金投放，保障募集资金的使用安全、高效，努力保障和提高股东收益。